创业板投资风险提示

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

苏州猎奇智能设备股份有限公司

Suzhou Lieqi Intelligent Equipment Co., Ltd.

（昆山市玉山镇新塘路 826 号 12 栋、13 栋）

SZLQ

首次公开发行股票并在创业板上市

招股意向书

保荐人（主承销商）

国泰海通证券股份有限公司

GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

重要声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明

一、发行人发行上市目的

公司主要从事光通信、半导体、汽车自动化等领域智能生产装备的研发、生产和销售，是国内光模块智能制造装备的主要供应商之一，公司产品已覆盖光模块封装测试的核心环节，包括贴片、耦合、老化测试等关键工序。公司在技术水平、产品指标、客户覆盖等方面均保持较高水平，公司生产的贴片设备、耦合设备可配套 800G/1.6T 光模块的生产需求，在国内外高速光模块、算力基础设施相关细分市场均具有较强的市场竞争力，位于行业内的第一梯队。

通过本次发行上市，发行人将紧抓 AI 算力爆发、5G/6G 通信升级及光模块封装测试设备国产替代的双重战略机遇，依托持续的技术创新，深化高速光模块封装测试设备、半导体封装测试设备等核心产品的研发应用，为国内外领先的光模块及器件厂商提供高性能、定制化封装测试综合解决方案，促进实现我国光电子信息产业链在中高端光模块封装测试设备方面的国产化水平提升。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

发行人已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东会、董事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度，保障发行人内部高效可靠运行，有效提升了公司治理水平。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

发行人本次融资系综合考虑国家产业政策、行业发展情况、未来发展战略、市场竞争状况、下游市场需求等因素后确定，符合国家产业政策与发行人未来发展战略要求。本次募集资金投资项目建成后，能够提高生产经营规模与生产效率，提升公司研发实力，优化生产工艺，提升产品品质与性能，扩充公司产品矩阵和应用领域，进一步提升公司现有产品的创新性，适应公司业务的快速发展需求和下游行业的技术迭代，从而增强公司的持续盈利能力和整体竞争力。

发行人本次募集资金投资项目与现有业务关系密切，是对发行人现有业务的扩展和深化。高端智能装备制造建设项目可扩大公司现有产能，提升产品质量，以满足光通信、半导体和汽车产业等下游市场对智能生产装备持续增长的需求；研发中心建设项目进一步提升公司的研发能力，有利于促进公司产品的持续优化、升级，拓展产品应用领域，提升公司在市场中的竞争力。补充流动资金项目有利于保证发行人日常生产经营活动的顺利开展，满足业务增长与未来经营战略布局所带来的流动资金需求。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

报告期内，发行人营业收入分别为 28,918.30 万元、54,292.61 万元、69,779.24 万元和 58,144.73 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 8,160.46 万元、18,078.25 万元、18,235.60 万元和 14,868.26 万元。受益于下游数据中心建设以及人工智能（AI）、5G 通信等新兴技术的广泛应用，对高速率、高带宽光模块的需求日益增加，全球高速率光模块封测设备市场呈现跨越式增长。

发行人专注于光通信、半导体、汽车自动化等领域智能生产装备的研发、生产和销售，是国内光模块智能制造装备的主要供应商之一，细分领域市场占有率国内领先，具有研发与技术优势、产品质量控制优势、品牌优势，具有良好的持续经营能力。

在 AI 技术发展带动的算力与高速网络通信需求增长的背景下，发行人坚持以市场需求和技术创新为导向，未来将在巩固光模块封装测试设备优势基础上，将产品应用逐步扩展半导体、汽车等领域，致力于成为世界领先的高端智能装备制造商，为股东及社会创造更大的价值。

董事长：罗超

罗 超

苏州猎奇智能设备股份有限公司

2026 年 11 月 18 日

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次发行股份 1,375.00 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	2026 年 11 月 26 日
拟上市的交易所和板块	深圳证券交易所创业板
发行后总股本	5,500.00 万股
保荐人（主承销商）	国泰海通证券股份有限公司
招股意向书签署日期	2026 年 11 月 18 日

目 录

重要声明 1

致投资者的声明 2

一、发行人发行上市目的 2

二、发行人现代企业制度的建立健全情况 2

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 2

四、发行人持续经营能力及未来发展规划 3

本次发行概况 4

目 录 5

第一节 释义 10

一、一般释义 10

二、专业释义 13

第二节 概览 18

一、重大事项提示 18

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 23

三、本次发行概况 24

四、发行人的主营业务经营情况 30

五、发行人符合成长型创新创业企业的情况 34

六、发行人主要财务数据及财务指标 38

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 38

八、发行人选择的具体上市标准 40

九、发行人公司治理特殊安排 40

十、募集资金运用与未来发展规划 40

十一、其他对发行人有重大影响的事项 41

第三节 风险因素 42

一、与发行人相关的风险 42

二、与行业相关的风险 45

三、其他风险 45

第四节 发行人基本情况 47

一、发行人基本情况.....47
二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.....47
三、发行人股权结构.....66
四、发行人控股子公司、参股公司及分公司.....67
五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.....68
六、发行人特别表决权股份或类似安排情况.....72
七、发行人协议控制架构情况.....72
八、控股股东和实际控制人报告期内违法违规情况.....72
九、发行人股本情况.....72
十、董事、高级管理人员及其他核心人员情况.....78
十一、董事、高级管理人员及其他核心人员签订的重要协议和作出的重要承诺及履行情况.....84
十二、董事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况.....84
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况..85
十四、董事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.....87
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.....88
十六、公司持股计划及股权激励的情况.....89
十七、员工及社会保障情况.....93
第五节 业务与技术 96
一、发行人的主营业务、主要产品和服务情况.....96
二、发行人所处行业基本情况.....114
三、行业竞争情况及发行人行业地位.....144
四、发行人销售情况和主要客户.....161
五、发行人采购情况和主要供应商.....167
六、发行人的主要固定资产和无形资产.....170
七、发行人主要产品或服务的核心技术.....175
八、发行人环境保护以及安全生产情况.....183
九、发行人境外经营和境外资产情况.....184

第六节 财务会计信息与管理层分析 186
一、发行人财务报表 186
二、会计师事务所审计意见类型 191
三、关键审计事项 191
四、分部信息 193
五、财务报表的编制基础及合并报表范围 193
六、报告期内采用的重要会计政策及会计估计 194
七、非经常性损益 227
八、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策 229
九、主要财务指标 231
十、经营成果分析 233
十一、资产质量分析 254
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 273
十三、重大资产业务重组或股权收购合并事项 286
十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项 286
十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 287
第七节 募集资金运用与未来发展规划 288
一、募集资金运用概况 288
二、募集资金投资项目的确定依据 290
三、本次募集资金投资项目实施的可行性及与主要业务、核心技术之间的关系 291
四、募集资金投资项目具体情况 294
五、未来发展规划 294
第八节 公司治理与独立性 298
一、报告期内公司治理情况 298
二、内部控制评估意见及审计意见 298
三、发行人报告期内违法违规行为的情况 299
四、报告期资金占用和对外担保情况 299
五、独立性 300

六、同业竞争.....301
七、关联方与关联关系.....302
八、关联交易.....306
九、其他参照关联交易披露的交易.....313
第九节 投资者保护.....315
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.....315
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及本次发行后的股利分配政策.....315
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排、累计未弥补亏损的情况.....320
第十节 其他重要事项.....321
一、重大合同.....321
二、对外担保情况.....326
三、重大诉讼与仲裁事项.....326
第十一节 声明.....329
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明.....329
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....332
三、保荐人（主承销商）声明.....334
保荐人（主承销商）董事长、总经理声明.....335
四、发行人律师声明.....336
五、会计师事务所声明.....337
六、资产评估机构声明.....338
七、验资机构声明.....339
八、验资复核机构声明.....340
第十二节 附件.....341
一、备查文件.....341
二、文件查阅地址和时间.....341
附件一：重要承诺.....342
附件二：发行人主要无形资产详细情况.....379
附件三：募集资金投资项目具体情况介绍.....386

附件四：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.....390
附件五：股东会、董事会、监事会（审计委员会）、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.....391
附件六：申报前十二个月新增股东的基本情况.....393
附件七：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.....401
附件八：子公司、参股公司简要情况.....402

第一节 释义

在本招股意向书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义：

一、一般释义

发行人、公司、猎奇智能	指	苏州猎奇智能设备股份有限公司
猎奇有限	指	苏州猎奇智能设备有限公司，发行人的前身
西安正奇	指	西安正奇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
昆山奔博	指	昆山奔博投资管理合伙企业（有限合伙）
南京俱成	指	南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业（有限合伙）
广发乾和	指	广发乾和投资有限公司
苏州辰丰、安吉辰丰	指	苏州辰丰领航企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：安吉辰丰企业管理合伙企业（有限合伙）
安吉秋实	指	苏州秋实满盈企业管理有限责任公司，曾用名：安吉秋实企业管理有限责任公司
安吉励欣	指	苏州励欣华章企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名：安吉励欣企业管理合伙企业（有限合伙）
昆高新创投	指	昆山高新创业投资有限公司
昆山美满	指	昆山美满管理咨询合伙企业（有限合伙）
毅达众创	指	江苏高投毅达众创创业投资合伙企业（有限合伙）
新余极目	指	新余极目睿远投资咨询中心（有限合伙）
昆山合鸣	指	昆山合鸣管理咨询合伙企业（有限合伙）
昆山中觅	指	昆山中觅企业管理中心（有限合伙）
金海通	指	天津金海通半导体设备股份有限公司
金浦慕和	指	上海金浦慕和私募投资基金合伙企业（有限合伙）
飞泰智能	指	武汉飞泰智能设备有限公司
昆山奔越	指	昆山奔越企业管理合伙企业（有限合伙）
士兰微	指	杭州士兰微电子股份有限公司
士兰控股	指	士兰控股（浙江）有限公司
盛宇华天	指	江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）
全德学镂科芯	指	南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）
鸿溢盛朗	指	宁波鸿溢盛朗创业投资合伙企业（有限合伙）
鸿溢盛越	指	宁波鸿溢盛越创业投资合伙企业（有限合伙）
玉澄德菉	指	昆山市玉澄德菉股权投资基金合伙企业（有限合伙）
鹏城愿景	指	深圳鹏城愿景创业投资合伙企业（有限合伙）

成都励石	指	成都励石创业投资合伙企业（有限合伙）
上海励聚	指	上海励聚创业投资合伙企业（有限合伙）
国泰君安母基金	指	上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）
凯欧光电	指	昆山凯欧光电科技有限公司
峻博软件	指	苏州峻博软件有限公司
云琦精密	指	武汉云琦精密制造有限公司，曾用名：苏州云琦精密组件有限公司
瑞森联	指	武汉瑞森联科技有限公司
新加坡芯泰	指	XINTAI SEMICONDUCTOR EQUIPMENT PTE.LTD.、芯泰半导体设备有限公司
泰国飞泰	指	FEITAI SEMICONDUCTOR EQUIPMENT CO.,LTD.、飞泰半导体设备有限公司
迈时光电、伽蓝致远	指	苏州迈时光电股份有限公司，曾用名：苏州伽蓝致远电子科技股份有限公司
珠海迈时	指	珠海迈时光电有限公司，曾用名：珠海迈时光电科技有限公司
苏州迈时	指	苏州迈时光电科技有限公司
众恒光电	指	铜陵迈时光电有限公司，曾用名：铜陵众恒光电有限公司
陕西正合	指	陕西迈时光电有限公司，曾用名：陕西正合芯科光电技术有限公司
昆山博阅诚	指	昆山市博阅诚管理咨询合伙企业（有限合伙）
中际旭创	指	中际旭创股份有限公司及其子公司
光迅科技	指	武汉光迅科技股份有限公司
源杰科技	指	陕西源杰半导体科技股份有限公司
华为技术	指	华为技术有限公司及其子公司
东山精密	指	苏州东山精密制造股份有限公司及其子公司
索尔思	指	Source Photonics Holdings （Cayman） Limited 及其子公司、索尔思光电控股（开曼）有限公司
菲亚姆	指	武汉菲亚姆电气有限公司
东风汽车	指	东风汽车有限公司
剑桥科技	指	上海剑桥科技股份有限公司
钧恒科技	指	武汉钧恒科技有限公司
先导科技	指	先导科技集团有限公司及其子公司
索恩格	指	SEG Automotive Germany GmbH、索恩格汽车德国有限公司
苏世博	指	苏世博（南京）减振系统有限公司，德国 SUSPA 集团在华全资子公司
三花智控	指	浙江三花智能控制股份有限公司
牧野汽车	指	牧野汽车装备（武汉）有限公司，牧野集团子公司
FiconTEC	指	FiconTEC Service GmbH、斐控泰克服务有限公司

BESI	指	BE Semiconductor Industries N.V.、佰瑟半导体工业有限公司
ASMPT	指	ASM Pacific Technology Ltd.、ASM 太平洋科技有限公司
先进香港	指	先进香港控股有限公司，ASMPT 的全资子公司
MRSI	指	MRSI Systems、迈克罗尼科集团子公司
Four-Technos	指	FOUR TECHNOS Co., Ltd.（株式会社フォーテクノス）
Finetech	指	Finetech GmbH & Co. KG、芬泰有限公司
致茂电子	指	致茂电子股份有限公司
微见智能	指	微见智能封装技术（深圳）有限公司
镭神技术	指	镭神技术（深圳）有限公司
联讯仪器	指	苏州联讯仪器股份有限公司
英伟达	指	NVIDIA Corporation、英伟达公司
谷歌	指	Google Inc.、谷歌公司
奥普瑞	指	昆山奥普瑞模具机械有限公司
瑞鑫力	指	昆山瑞鑫力精密机械有限公司
星微科技	指	无锡星微科技有限公司
恩茂欣	指	恩茂欣机械设备（上海）有限公司
南央国际	指	南央国际贸易（上海）有限公司
津微光电	指	上海津微光电科技有限公司及北京津微光电技术有限公司
上海骏煦	指	上海骏煦自动化技术有限公司
建祥机电	指	昆山建祥机电有限公司
上海冉涵	指	上海冉涵自动化科技有限公司
微软	指	Microsoft Corporation、微软公司
亚马逊	指	Amazon.com Inc.、亚马逊公司
字节跳动	指	抖音有限公司，曾用名：字节跳动有限公司
阿里巴巴	指	阿里巴巴集团控股有限公司
腾讯	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司
Meta	指	Meta Platforms, Inc.，该公司原名 Facebook
LightCounting	指	LightCounting Market Research，一家专注于光电通讯、无线网络、5G 基建等领域的知名市场研究机构
弗若斯特沙利文	指	一家全球知名的企业增长咨询公司，为企业提供投融资及其他专业咨询服务，包括尽调、估值、战略和管理咨询、财务顾问等
IDC	指	国际数据公司，是国际数据集团旗下全资子公司，是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
YOLE	指	是一家总部位于法国里昂的研究机构，该机构专注于半导体、光电和电子行业的市场调研和技术分析，提供关于这些

		领域的深入报告和预测
Counterpoint	指	Counterpoint Research，一家全球知名的市场研究机构，专注于科技行业的数据分析和趋势预测
光纤在线	指	光纤在线成立于 2001 年 5 月，系服务于中国光纤通信行业的专业垂直门户网站和咨询机构，是最早的光纤通信中文资讯网站之一
IMT-2020（5G）推进组	指	由工信部、发改委、科技部联合推动成立，是聚合移动通信领域产学研用力量、推动第五代移动通信技术研究、开展国际交流与合作的基础工作平台
招股意向书、本招股意向书	指	《苏州猎奇智能设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》
保荐人、保荐机构、主承销商、国泰海通	指	国泰海通证券股份有限公司
发行人律师	指	江苏世纪同仁律师事务所
发行人会计师、审计机构、容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、专业释义

光通信	指	即光纤通信，是以光波为传输媒质的通信方式，具备高速、大容量、低损耗、抗干扰能力强的优势，已成为现代通信领域的重要技术之一
半导体	指	常温下导电性能介于导体（Conductor）与绝缘体（Insulator）之间的材料，按照制造技术可分为集成电路（IC）、分立器件、光电子和传感器，可广泛应用于下游通信、计算机、消费电子、网络技术、汽车及航空航天等产业
分立器件	指	单一封装的半导体组件，具备电子特性功能，常见的分立式半导体器件有二极管、三极管、光电器件等
传感器	指	一种能感受规定的被测量件并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成
光模块	指	光芯片加工封装为光发射组件（TOSA）及光接收组件（ROSA），再将光收发组件、电芯片、结构件等进一步集成，形成具备光电信号转换的模块
光电子器件	指	Optical device，利用电光/光电效应制成的各种功能器件，包括光有源组件、光无源组件等最终实现光电转化功能的器件总称，是构成光模块的主要元器件
功率器件	指	用于处理高电压、大电流，实现电能转换、控制和放大的电子器

		件。它们能够承受和处理更高的功率，在电子系统中起到调节和分配电能的关键作用
COC	指	Chip on Carrier 缩写，光模块行业中指置于载体上的光芯片
COB	指	Chip on Board 缩写，板上芯片封装，一种光器件的封装工艺
COS	指	Chip on Submount，一种将半导体激光器芯片直接安装到基板上的封装形式，这种封装方式不仅可以将芯片固定在基板上，还能提供良好的热管理和电气性能，同时减小整体尺寸，提高集成度
TO	指	Transistor Outline，同轴封装，是光芯片封装的一种方式
BOX	指	是一种将光电器件（如激光器、探测器等）完全密封在金属外壳内的封装技术，通过填充惰性气体（如氮气或氩气）隔绝外部环境干扰，同时优化热管理性能
有源	指	需要外加能源驱动工作
无源	指	不需要外加能源驱动工作
速率	指	描述数据传输系统的重要技术指标之一，是指通信线上传输信息的速度，在单位时间内（通常为一秒）传输的比特数
T、Tb/s	指	太字节每秒，信号传输速率单位
硅光	指	Silicon Photonics，是一种以激光器芯片作光源，基于硅基半导体材料和微电子工艺平台集成各类光子芯片实现集成光子芯片的技术
光纤	指	一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成
光芯片	指	应用于光通信的半导体，是完成光电信号转换的核心器件，分为激光器芯片（LD Chip）和探测器芯片（PD Chip），分别完成电光转换和光电转换，是光模块最核心的功能芯片
EML	指	一种光模块技术方案，基于磷化铟（InP）等 III-V 族化合物半导体材料，通过将光芯片、电芯片、无源光学器件等进行精密组装与光学耦合对准，形成光模块
CPO	指	一种在芯片封装级别上集成光学组件的技术，旨在将光学通信组件（如光模块）与电子芯片（如应用特定集成电路、ASIC）放置在同一个封装内，以实现高速光通信和高性能电子处理的紧密集成，从而提升数据中心内光通信效率和降低能耗
LPO	指	一种光模块封装技术，其核心在于摒弃传统光模块中的 DSP（数字信号处理）芯片，采用线性模拟技术直接驱动光电器件，从而实现信号传输的简化与能效优化
DSP	指	一种专用于数字信号处理的可编程芯片。它通过对数字信号进行快速计算和转换，实现对声音、图像、视频、通信信号等多种信号的处理
PCB	指	印制电路板，一种重要的电子部件，是电子元器件的支撑体。包括 PCB 裸板和带有集成电路芯片及阻容等元件的 PCB 成品（PCBA）
CMOS	指	互补金属氧化物半导体（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor）技术，它是制造大规模集成电路芯片的一种技术或用这种技术制造出来的芯片
数据中心	指	通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的系统
5G	指	第五代移动通信技术
物联网	指	通过射频识别（RFID）、传感器等信息传感设备，遵循约定协议（如通信标准），将任何物体与互联网或专用网络连接，利用信息

		传播媒介（如无线通信）实现数据交换，最终完成智能化的识别、定位、跟踪或远程控制等功能
云计算	指	Cloud Computing，是分布式计算的一种，是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
人工智能	指	是计算机科学的一个分支，旨在通过算法、数据和计算能力模拟或扩展人类智能的核心能力（如学习、推理、感知、决策）
大数据	指	超出传统软件处理能力的海量、高增长率和多样化的信息资产，需借助分布式系统、机器学习等技术实现价值挖掘
接入网	指	业务节点与终端用户之间的所有线路设备、传输设备以及传输媒质组成的网络，负责用户接入，通常有固网接入和无线接入方式，即“最后一公里”
无线网	指	利用无线电波技术来连接各个网络设备的计算机网络,可以分为无线广域网（基于移动通信基础设施的电信数据网络，即 3G/4G/5G）、无线局域网（负责在短距离范围之内无线通信接入功能的网络，即 WIFI）、无线城域网和无线个人局域网等
骨干网	指	连接多个区域或地区的高速网络，一般作用范围从几十到几千公里
算力中心	指	又称高性能计算中心或数据中心，是集中部署大量高性能计算机和相关设备，提供强大计算能力的基础设施。这些设施通常包括高性能服务器、存储设备、网络设备等，通过高度集成和优化，形成强大的计算和存储能力，支持各种复杂的数据处理和计算任务
集成电路、IC、芯片	指	Integrated Circuit 的简称，是指经过特种电路设计，采用一定的半导体加工工艺，把晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块硅、锗等半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的一种微型电子电路
射频	指	即 Radio Frequency，可辐射到空间的电磁频率，频率范围在 300KHz~300GHz 之间，包括蓝牙、WiFi、2.4G 无线传输技术、FM（调频）等技术。目前射频技术被广泛运用于无线通信领域，如蓝牙类产品、WiFi 类产品等
封装	指	将芯片转配为最终产品的过程，即把晶圆上的半导体集成电路用导线及各种连接方式加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所使用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆
Bondhead	指	是贴片设备中直接跟芯片接触完成芯片拾取和贴装的功能部件。Bondhead 是贴装设备的“心脏”，具备芯片贴装过程中压力、位置等工艺参数的测量与管控
贴片	指	在光模块封测过程中，将激光器驱动芯片、跨阻放大器芯片、激光器芯片、探测器芯片等各类芯片通过特定的粘合剂（共晶焊料/导电胶/紫外胶）将各类芯片精确地固定在 PCB 上
引线键合	指	一种使用细金属线，利用热、压力、超声波能量为使金属引线与基板焊盘紧密焊合的技术，将芯片上的电极与基板或封装外壳上的电极连接起来，形成稳定的电气通路，确保光信号和电信号能够在芯片与外部电路之间有效传输
共晶贴片	指	利用两种或多种金属在特定温度下形成共晶合金的特性，通过熔融共晶材料将芯片与基板连接
固晶贴片	指	利用导电银胶在芯片底部和基板上进行粘接，银胶主要由环氧树脂、银粉和少量添加剂组成，其中环氧树脂和添加剂起粘结作用，而银粉则起导电导热作用

UV 固化	指	通过紫外线照射使特殊配方树脂中的光敏剂产生化学反应，从而引发聚合反应，使涂料在数秒内由液态转化为固态
耦合	指	通过多自由度调节模组与检测组件搭建回路，通过调整光学器件的位置来达到预定值的方法
Gel-PAK 上料	指	使用高交联合专利聚合材料 Gel 的芯片包装盒，通过本身表面的张力来固定器件，具备防静电、粘结力强、可追溯、适用于自动化设备、保护性能好的特点
蓝膜上料	指	在光模块生产过程中，使用蓝膜作为载体将芯片等元器件固定并传输到贴片机上进行贴片操作的一种方法。蓝膜是一种特殊的薄膜材料，通常用于保护和固定芯片，确保在传输和贴片过程中不会损坏芯片
倒装芯片（Flip Chip）	指	是一种无引脚结构，通过在芯片上的凸点直接将元器件朝下互连到基板、载体或者电路板上。这种技术通过熔融的锡铅球与陶瓷基板结合，实现了高可靠性的电气和机械连接
晶圆级封装（WLP）	指	一种先进的封装技术，其核心是在晶圆上直接进行封装测试，然后再将晶圆切割成单个芯片
硅通孔（TSV）	指	一种让 3D IC 封装遵循摩尔定律（Moore's Law）的互连技术，TSV 可堆叠多片芯片
液冷封装	指	将光模块完全浸没在绝缘冷却液中，通过液体直接接触发热部件（如激光器、芯片），利用液体的高比热容和对流特性快速带走热量，从而实现高效散热的一种技术
激光辅助键合	指	Laser-assisted Bonding，简称 LAB，是一种利用高强度激光束照射金属表面，使其熔化从而实现电气连接的技术。通过激光束的高精度和聚焦能力，对特定区域进行选择性加热和键合，增强键合精度和稳定性，属于先进封装技术的一种
倒装热压	指	使用倒装焊机对硬凸点如 Au 凸点、Ni/Au 凸点、Cu 凸点等进行焊接，该工艺通过在一定的压力和温度下，对芯片的凸点施加超声波能量，使凸点与基板焊盘产生结合力，从而实现芯片与基板的互连，属于先进封装技术的一种
老化测试	指	是评估光模块在长时间使用过程中性能稳定性的一种方法，通常在高温、高湿的环境下进行，模拟实际光模块的工作状态
运动控制	指	运动控制是通过对运动部件的控制，改变运动部件的转矩、速度、位移等变量，使得运动部件按照人们的期望运行
机器视觉	指	通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，获取被摄目标的形态信息，根据像素分布、亮度、颜色等信息，转变成数字化信号
机械设计	指	将力学原理和工程技术应用于创造和改进机械系统的过程，旨在通过自动化技术实现高效、高精度的设计与制造
柔性生产	指	以市场需求为导向，通过技术、流程和管理优化，使制造系统具备快速响应内外环境变化的能力
光栅尺	指	一种基于光栅光学原理进行精密测量的反馈装置，主要用于测量直线或角位移
气浮导轨	指	一种利用气体作为润滑剂的滑动导轨，主要通过压缩空气在动子和定子间形成气膜，利用气体动静压效应实现无摩擦和无振动的平滑移动。气浮导轨具有运动精度高、清洁无污染、使用寿命长等特点
直线电机	指	一种将电能直接转换成直线运动机械能的装置，无需任何中间转换机构。它可以将传统旋转电机沿径向剖开并展成平面，从而形成一种新颖的电机类型
龙门	指	一种具有门式框架结构的机械设备。这种设备通常由一个横梁和两个立柱构成，形成一个类似门框的结构。龙门结构的设备在工业生

		产中有着广泛的应用，主要用于支撑和移动重物，提高工作效率和加工精度
激光准直仪	指	一种利用激光束作为定向基准线的高精度工程测量仪器，用于标定直线、检测几何参数（如直线度和平行度）的设备
激光干涉仪	指	利用激光的干涉原理进行高精度测量的光学仪器。其工作原理基于两束或多束相干激光在空间叠加时产生的干涉条纹，通过分析条纹变化量（如相位移动、条纹间距）来推算被测目标的位移、角度、速度等物理量
刚性	指	其抵抗变形和维持精度的能力，直接决定加工稳定性与精度
温飘	指	指机械或电子系统因温度变化引起的参数或尺寸变化现象，对龙门结构而言，表现为横梁、立柱等部件因热胀冷缩产生的几何形变
电脉冲	指	电压或电流在极短时间内发生的突变（通常为微秒至毫秒级），形成短暂的非连续信号波形，其本质是能量在瞬态的集中释放
PID 控制	指	一种通过比例（P）、积分（I）、微分（D）三个环节的线性组合来调节系统输出的闭环控制算法。其目标是通过实时计算设定值与实际值之间的误差，动态调整控制量以最小化误差，实现精确、稳定的过程控制
亚像素	指	超越物理像素网格限制的分辨率精度，通过算法从相邻像素的灰度/色彩信息中提取出比单个物理像素更精细的位置或形状数据，实现超分辨率测量
SOP	指	即标准作业程序，指将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用于指导和规范日常的工作

注：本招股意向书中数字一般保留两位小数，部分表格合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。

第二节 概览

本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。

一、重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下事项。

（一）特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书“第三节 风险因素”的全部内容并重点关注下列风险：

1、经营业绩波动或下滑的风险

报告期内，公司营业收入分别为 28,918.30 万元、54,292.61 万元、69,779.24 万元和 58,144.73 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 8,160.46 万元、18,078.25 万元、18,235.60 万元和 14,868.26 万元。影响公司未来经营业绩的因素较多，包括宏观经济状况环境、产业政策、市场竞争程度、原材料价格波动等诸多内外部不可控因素。若未来出现公司产品销售价格下降、原材料价格上涨、市场竞争加剧等不利变化等因素，将会对公司收入、盈利水平产生不利影响，导致公司出现经营业绩波动或下滑的风险。

2、单一客户重大依赖风险

报告期内，本公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比重分别为 93.17%、82.83%、79.40%和 87.92%，客户集中度较高，其中对中际旭创的销售收入占比分别为 62.19%、58.85%、53.42%和 64.81%，公司对中际旭创存在重大依赖。

目前，下游光模块厂商市场集中度较高。据 LightCounting、弗若斯特沙利文统计，2025 年中际旭创光模块全球市场份额排名第一，其中 800G 及以上光模块市场份额超过 40%，市场领先地位显著。同时，中国前十光模块供应商在全球市场的占有率超过 55%，公司客户集中度较高与下游光模块行业竞争格局

较为集中的发展现状相一致。

报告期内，公司与主要客户合作关系稳定，客户结构逐渐多元化。但受下游光模块行业竞争格局等行业特点影响，公司短期内客户集中度较高的结构性特征及对中际旭创存在重大依赖的情形仍将持续，如未来发行人客户多元化拓展进度不及预期，可能面临客户集中度较高、收入来源相对集中的结构性风险。若未来公司与主要客户的合作关系发生变化，采购数量或产品价格下降、销售毛利率降低，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

此外，受下游光模块厂商客户产能建设节奏及周期、在手订单阶段性结构分布特征等因素影响，短期内发行人对中际旭创的销售收入占比可能存在进一步上升趋势。若后续中际旭创产能扩张节奏放缓，或发行人与中际旭创的合作关系发生变化，可能对公司经营业绩产生不利影响。

3、光模块行业周期波动导致下游客户资本性支出减少的风险

公司所处光模块封装测试设备行业，其发展与下游全球通信市场技术迭代、数据中心建设周期及宏观经济环境密切相关。光模块作为光通信网络的核心器件，其市场需求直接受 AI 算力需求爆发、数据中心向超高速率（800G/1.6T）升级、5G/6G 商用进程等因素驱动。从产业演进规律出发，光模块行业受数据中心扩容与运营配套能源供应、资本开支边际效益递减等客观因素制约，长期来看行业增速预计从爆发增长阶段逐渐过渡至平稳增长阶段。

若全球或中国宏观经济增速显著放缓，或光模块行业技术迭代周期延长，或资本开支边际效益递减，可能导致下游客户资本性支出计划延缓或缩减。公司下游客户的扩产计划与光模块行业景气度相关性较高，若行业景气度下滑或出现周期性波动，可能导致光模块厂商对光模块封测设备的采购需求呈阶段性放缓，或推迟设备导入验证节奏，可能导致公司订单获取、收入确认节奏放缓，业绩出现阶段性波动，可能对公司经营业绩产生不利影响。

4、未决诉讼风险

2025 年 5 月，MRSI 以公司销售的产品侵犯了 MRSI 的 ZL201680048482.5 号发明专利为由，将公司诉至深圳市中级人民法院，诉请法院：（1）判令公司立即停止侵犯原告第 ZL201680048482.5 号发明专利权的行为，包括并不限于停

止制造、使用、销售、许诺销售侵害第 ZL201680048482.5 号发明专利权的产品的行为；（2）判令公司赔偿因其侵权行为给 MRSI 造成的经济损失及 MRSI 为制止侵权行为所支付的合理支出人民币共计 2,000 万元；（3）判令公司承担本案的全部诉讼费用。

2026 年 6 月 30 日，深圳市中级人民法院出具民事判决书，一审判决驳回原告 MRSI 的全部诉讼请求。

2026 年 10 月 15 日，发行人收到《中华人民共和国最高人民法院上诉案件应诉通知书》（（2026）最高法知民终 692 号），中华人民共和国最高人民法院已受理 MRSI 的上诉申请。其中 MRSI 的上诉请求主要包括：（1）判令依法撤销一审判决,并改判被上诉人构成对上诉人涉案专利的侵权，判令被上诉人立即停止所有侵犯上诉人第 ZL201680048482.5 号发明专利权的行为;（2）判令被上诉人赔偿因其侵权行为给上诉人造成的经济损失及上诉人为制止侵权行为所支付的合理支出人民币共计 2,000 万元，并承担本案一审、二审诉讼费用。

截至本招股意向书签署日，该案件尚在审理中，案件最终结果存在不确定性风险。

5、毛利率下滑的风险

2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-6 月，公司综合毛利率分别为 48.81%、50.33%、42.96%及 40.28%，各期之间存在一定波动。2025 年，公司综合毛利率同比下滑 7.37 个百分点，主要系老化测试设备和自动化设备及整线解决方案毛利率阶段性下降、收入占比提升所致。2026 年 1-6 月，公司综合毛利率相较 2025 年下降 2.68 个百分点，下降原因包括贴片设备、耦合设备毛利率下滑因素。其中：（1）贴片设备毛利率为 53.16%，相较 2025 年下降 7.34 个百分点，一方面系受共晶机与固晶机结构性因素影响，共晶机毛利率通常高于固晶机，而当期验收的共晶机收入占贴片设备比重由报告期内平均 66.97%下降至 38.32%，另一方面固晶机中本期确认收入的项目中包含部分毛利率相对较低的无源器件贴装机型（工艺要求低、非主要应用领域），导致贴片设备整体毛利率有所下降；（2）耦合设备毛利率为 47.15%，相较 2025 年下降 6.84 个百分点，主要系本期确认收入的项目中包含部分早期为开拓新客户签订的报价相对

较低的订单所致。

公司毛利率存在持续下滑的可能性：一方面，模块老化测试设备、自动化设备与整线解决方案部分业务毛利率可能仍相对低于贴片设备、耦合设备业务，若其收入占比进一步提升将影响公司整体毛利率水平；另一方面，随着行业竞争加剧，境外龙头厂商加大中国市场投入、国内同行技术追赶速度加快，以及下游客户自身面临市场压力导致的成本管控提升，贴片设备、耦合设备业务亦可能面临一定价格竞争压力，导致毛利率出现下降，从而对公司的盈利能力带来不利影响。

6、存货余额较高及跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 26,147.80 万元、31,073.94 万元、82,668.31 万元和 198,866.51 万元，随公司生产和销售规模的扩大呈现快速增长态势。未来，随着公司业务规模的持续扩大，预计存货规模可能进一步有所增加。

公司采用以销定产、适当备货的生产模式，主要以客户需求为导向组织生产，但由于从原材料采购、生产调试至客户验收需要经历一定周期，若客户因项目进度调整、资金安排变化或终端需求波动等原因推迟提货、延期验收甚至取消订单，公司将面临存货滞压及跌价的风险。同时，若未来市场环境出现重大不利变化，或由于产品更新迭代滞后、技术路线切换导致客户需求转移，已储备的原材料及在成品出现积压、滞销，公司将面临产生跌价损失的风险，进而影响经营业绩和财务状况。

7、未能紧跟光模块技术迭代升级的风险

公司专注于光通信、半导体及汽车自动化等领域智能生产装备的研发、生产和销售，所处行业下游应用领域及细分市场具有技术密集、迭代速度快的特点。随着光通信技术向 1.6T/3.2T 超高速率、硅光集成、NPO、CPO 等方向加速演进，光模块封装工艺对设备的精度、效率及工艺兼容性提出了更高要求。现阶段 3.2T 及以上超高速率、NPO、CPO 等新型技术路线尚处于多元并行探索阶段、商业化落地节奏存在一定不确定性。

发行人现已开展前瞻性技术研发，若公司无法持续投入研发以保持技术领

先性，或未能准确预判行业技术趋势，或未能及时跟进各类差异化技术路径的迭代进度，或在技术迭代、样机验证、工艺适配、产品落地、客户导入等关键环节进度不及预期，可能导致公司产品竞争力下降、研发资源错配、客户合作稳定性受损，从而对公司经营业绩和市场地位产生不利影响。

8、市场竞争加剧的风险

公司所处的光模块封装测试设备行业，长期以来由 BESI、ASMPT、MRSI 等海外厂商主导，其凭借技术先发优势、成熟的产品矩阵及深厚的客户资源，在高端设备市场（如 800G/1.6T 光模块耦合机、高精度共晶贴片设备）形成较高壁垒。相比国际巨头，公司的综合竞争力仍存在一定差距。

同时，随着下游光模块市场扩容，部分国内光模块封测设备厂商也在加速自身产品、技术的迭代。近年来部分国内厂商通过在精密运动控制、视觉定位算法等方面的技术突破，正加速向高精度领域渗透。

此外，光模块市场高速发展带动上游封测设备需求持续旺盛，叠加国产替代进程不断深化，光模块封测设备成为部分半导体封测设备厂商和自动化设备厂商拓展业务的新方向。

因此，公司面临国际巨头及部分国内厂商、部分半导体封测设备厂商和自动化设备厂商的多重竞争。同时，耦合设备与光模块产品设计和工艺高度相关，部分下游客户基于开展光模块产品技术研发、优化工艺等考虑，自行生产部分耦合设备。若公司未能在产品创新、技术研发等方面保持持续投入，维护自身核心技术的先进性，以及持续提升产品质量、交货速度、服务响应速度等，可能存在被竞争替代的风险，导致公司的行业地位、市场份额及经营业绩受到不利影响。

9、国际贸易摩擦风险

当前全球国际贸易格局趋于复杂，国际贸易摩擦有所增加，关税政策调整频发，如未来相关贸易政策发生不利变化，导致进口关税增加、出口管制或物流受阻，一方面可能对发行人零部件采购成本与供应稳定性造成一定影响，另一方面国际贸易政策可能影响下游光模块企业海外订单需求，发行人下游主要光模块厂商客户境外收入占比普遍较高，如其海外出货规模收缩，相关资本开

支计划或将收紧，进而减少对发行人光模块封测设备的采购需求或推迟验收节奏，可能对公司经营发展产生不利影响。

此外，如贸易壁垒升级到光模块封测设备层面，也可能进一步影响发行人向境外光模块厂商的设备销售业务。截至 2026 年 6 月末，发行人在手订单中对应境外光模块厂商的订单金额约为 5.53 亿元，如部分订单受到上述政策冲击，可能对公司经营发展产生不利影响。

（二）本次发行相关主体作出的重要承诺

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人已作出关于业绩下滑情形的相关承诺，主要内容如下：发行人上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月。

本公司提示投资者认真阅读本公司、控股股东、实际控制人、主要股东、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施，相关内容详见本招股意向书“第十二节 附件”之“附件一：重要承诺”。

（三）关于发行前滚存利润的分配安排及上市后股利分配政策

经发行人 2025 年第一次临时股东会决议通过，公司本次发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有。公司提示投资者认真阅读公司发行上市后的利润分配政策、现金分红比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，具体内容详见本招股意向书“第九节 投资者保护”相关内容。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况			
中文名称	苏州猎奇智能设备股份有限公司	有限公司成立日期	2015 年 11 月 23 日

英文名称	Suzhou Lieqi Intelligent Equipment Co., Ltd.	股份公司成立日期	2024 年 10 月 28 日
注册资本	4,125 万元人民币	法定代表人	罗超
注册地址	昆山市玉山镇新塘路 826 号 12 栋、13 栋	主要生产经营地址	昆山市玉山镇新塘路 826 号 12 栋、13 栋
控股股东	昆山奔博	实际控制人	罗超
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	-
（二）本次发行的有关中介机构			
保荐人	国泰海通证券股份有限公司	主承销商	国泰海通证券股份有限公司
发行人律师	江苏世纪同仁律师事务所	其他承销机构	-
审计机构	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司
验资机构	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	验资复核机构	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		截至本招股意向书签署日，国泰海通全资子公司国泰君安创新投资有限公司存在通过直接或间接方式持有国泰君安母基金份额的情形，而国泰君安母基金持有发行人股东全德学镂科芯 8.5332%份额，国泰海通因此间接持有发行人 0.0541%股份。此外，国泰海通实际控制人上海国际集团有限公司通过直接持有国泰君安母基金份额，间接持有发行人 0.0203%股份。上海国际集团有限公司与国泰海通合计持有发行人股份不超过 0.1%。 除上述情形外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利益关系。	
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	收款银行	中国建设银行上海市分行营业部

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	1.00 元		
发行股数	1,375 万股	占发行后总股本比例	25%
其中：发行新股数量	1,375 万股	占发行后总股本比例	25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	5,500 万股		
每股发行价格	【】元/股		

发行市盈率	【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2025 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	21.27 元/股（按照 2026 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）	发行前每股收益	4.15 元/股（按 2025 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股净资产	【】元/股（按照 2026 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）	发行后每股收益	【】元/股（按 2025 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	采取向参与战略配售的投资者定向配售、网下向询价对象配售发行与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户并开通创业板交易权限的自然人、法人、证券投资基金及符合中国法律规定的其他投资者，但法律、法规和规范性文件及深圳证券交易所业务规则等禁止参与者除外		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	高端智能装备制造建设项目		
	研发中心建设项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	本次发行费用（不含增值税）明细为： 1、保荐及承销费用： （1）保荐费用：300 万元； （2）承销费用：承销费用=实际募集资金总额*6.5%，且承销费用不低于 5,200.00 万元。 保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额确定，根据项目进度分节点支付； 2、审计及验资费用：1,600 万元； 审计及验资费用参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素确定，根据项目进度分阶段支付； 3、律师费用：1,050 万元； 律师费用参考市场律师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素确定，根据项目进度分阶段支付； 4、用于本次发行的信息披露费用：470.57 万元； 5、发行手续费及其他费用：93.17 万元。		

	注：以上发行费用均不含增值税，各项费用根据发行结果可能会有调整；合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费。
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即 137.50 万股，且认购金额不超过 13,800 万元。最终战略配售数量将在确定发行价格后确定。资产管理计划获配股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	不涉及
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登初步询价公告日期	2026 年 11 月 18 日
初步询价日期	2026 年 11 月 23 日
刊登发行公告日期	2026 年 11 月 25 日
申购日期	2026 年 11 月 26 日
缴款日期	2026 年 11 月 30 日
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快申请在深交所创业板挂牌上市

（三）本次发行的战略配售情况

1、本次战略配售的总体安排

（1）本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投（如有）、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司国泰海通证裕投资有限公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

（2）本次发行的初始战略配售发行数量为 412.50 万股，占本次发行数量的 30.00%。其中，保荐人相关子公司跟投（如有）的初始战略配售数量预计为

68.75 万股，占本次发行数量的 5.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即 137.50 万股，且认购金额不超过 13,800 万元；其他参与战略配售的投资者认购金额不超过 32,500 万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。

2、保荐人相关子公司跟投（如有）

（1）跟投主体

如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2026 年修订）》（深证上〔2026〕552 号）（以下简称“《业务实施细则》”）等相关规定参与本次发行的战略配售。保荐人跟投主体为国泰海通依法设立的另类投资子公司国泰海通证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）。

（2）跟投数量

根据《业务实施细则》，如发生下述情形，本次保荐人相关子公司证裕投资将按照相关规定参与本次发行的战略配售，具体比例和金额将在 2026 年 11 月 24 日（T-2 日）确定发行价格后，根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定：

①发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；

②发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；

③发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；

④发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。

（3）配售条件

如发生上述跟投情况，证裕投资将与发行人签署战略配售协议，不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行，不参加本次发行初步询价，并承诺接受发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格。

3、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划

（1）投资主体

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰海通君享创业板猎奇智能 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享 1 号资管计划”）。

（2）参与规模和具体情况

具体名称：国泰海通君享创业板猎奇智能 1 号战略配售集合资产管理计划

设立时间：2026 年 8 月 17 日

备案时间：2026 年 8 月 24 日

产品编码：SEH108

募集资金规模：13,800 万元

认购资金规模上限：13,800 万元

管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司

集合计划托管人：招商银行股份有限公司苏州分行

实际支配主体：上海国泰海通证券资产管理有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非君享 1 号资管计划的支配主体。

实际参与人姓名、职务、入职时间、拟认购金额及比例：

单位：万元

序号	姓名	入职时间	任职单位	职位	类别	实缴金额	份额占比
1	罗超	2015/11/23	猎奇智能	董事长、总经理	高级管理人员	4,560	33.04%

序号	姓名	入职时间	任职单位	职位	类别	实缴金额	份额占比
2	葛宏涛	2016/3/31	猎奇智能	研发总监兼研发一部负责人	核心员工	1,540	11.16%
3	徐凯	2015/11/23	猎奇智能	董事、副总经理	高级管理人员	1,515	10.98%
4	陈文杰	2019/3/11	猎奇智能	副总经理	高级管理人员	1,460	10.58%
5	刘正	2023/11/1	猎奇智能	副总经理、董事会秘书兼财务负责人	高级管理人员	1,325	9.60%
6	宋玉华	2015/11/23	猎奇智能	副总经理	高级管理人员	575	4.17%
7	胡志南	2019/5/27	猎奇智能	运营总监	核心员工	330	2.39%
8	高贤	2017/4/5	猎奇智能	供应链总监	核心员工	305	2.21%
9	张学良	2019/4/8	猎奇智能	研发一部经理	核心员工	242	1.75%
10	谢强	2022/2/1	飞泰智能	飞泰智能常务经理	核心员工	238	1.72%
11	程显	2015/11/23	猎奇智能	董事、销售经理	核心员工	238	1.72%
12	刘鸿铭	2015/12/1	猎奇智能	研发二部技术总监	核心员工	230	1.67%
13	韦亮	2019/8/26	猎奇智能	研发一部副经理	核心员工	207	1.50%
14	杜杆	2021/3/1	飞泰智能	飞泰智能常务经理	核心员工	200	1.45%
15	罗传标	2018/3/1	飞泰智能	飞泰智能厂务负责人	核心员工	200	1.45%
16	李文明	2016/3/1	猎奇智能	研发二部负责人	核心员工	165	1.20%
17	江挺	2017/2/15	猎奇智能	生产管理部经理	核心员工	120	0.87%
18	熊静	2019/3/30	猎奇智能	生产管理部负责人	核心员工	120	0.87%
19	何崇文	2024/9/1	瑞森联	瑞森联研发负责人	核心员工	115	0.83%
20	李珂	2018/6/19	猎奇智能	研发一部软件研发经理	核心员工	115	0.83%
合计						**13,800**	**100%**

注 1：君享 1 号资管计划所募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款。
注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
注3：最终获配金额和获配股数待T-2日确定发行价格后确认。
注4：飞泰智能、瑞森联均为发行人全资子公司。

（3）配售条件

君享 1 号资管计划已与发行人签署战略配售协议，不参与本次公开发行股

票网上发行与网下发行，并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

4、其他参与战略配售的投资者

本次发行中，其他参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，列示如下：

序号	认购主体	战投类型	限售期
1	中际旭创（上海）投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	12 个月
2	苏州东山产业投资有限公司		
3	汇绿生态科技集团股份有限公司		
4	陕西源杰半导体科技股份有限公司		
5	江苏永鼎股份有限公司		
6	上海剑桥科技股份有限公司		

四、发行人的主营业务经营情况

（一）发行人主要业务及产品

发行人主要从事光通信、半导体、汽车自动化等领域智能生产装备的研发、生产和销售，是国内领先的高端智能装备制造商。经过多年的发展和积累，发行人产品已覆盖光模块封装测试流程的主要核心环节，包括贴片、耦合、老化测试等，并最终应用于数通市场及电信市场。上述封装测试环节为保障光模块传输效率和可靠性的关键环节之一。同时，发行人充分利用在光通信领域积累的自动化装备经验和技术，积极布局半导体、汽车自动化智能装备领域，增强公司综合竞争实力。

自设立以来，公司始终致力于推动高端光模块封装测试设备的国产替代，实现对国际厂商的技术追赶甚至赶超，向下游光模块厂商、器件厂商提供性能优越、高可靠性的封装测试设备，从源头提升我国光通信产业的核心竞争力。公司凭借过硬的产品质量、技术创新能力和高效优质的配套服务能力，成为国内光模块智能制造装备的主要供应商之一。公司产品得到了国内主流市场的高度认可，公司设备已广泛应用于中际旭创（300308）、索尔思、光迅科技（002281）、源杰科技（688498）、剑桥科技（603083）、客户三、客户四等

光通信行业龙头客户和知名企业，并与 2025 年光模块全球前十厂商（前十厂商排名来源于 LightCounting）中九家企业保持良好合作。

此外，公司稳步开拓半导体、汽车自动化等领域客户，公司产品已应用于客户五、先导科技、士兰微（600460）等半导体领域客户，以及索恩格、苏世博、三花智控（002050）等全球领先的汽车零部件供应商。

报告期内，公司按产品类型分类的主营业务收入结构如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
贴片设备	8,229.93	14.16%	24,370.66	34.93%	23,718.09	43.71%	9,008.98	31.22%
耦合设备	26,679.79	45.90%	16,250.69	23.29%	15,102.99	27.84%	9,076.06	31.45%
老化测试设备	13,277.12	22.84%	7,514.76	10.77%	3,999.73	7.37%	4,865.21	16.86%
自动化设备及整线解决方案	3,155.29	5.43%	13,564.67	19.44%	6,746.98	12.43%	3,352.59	11.62%
配件及其他	6,779.32	11.66%	8,061.57	11.56%	4,690.93	8.65%	2,557.12	8.86%
合计	**58,121.44**	**100.00%**	**69,762.36**	**100.00%**	**54,258.73**	**100.00%**	**28,859.97**	**100.00%**

（二）发行人主要原材料及重要供应商

公司从事高端智能装备生产制造，下游客户需求多样，采购的原材料种类繁多、规格型号复杂。公司采购的原材料主要分为机械类、电气类、气动/液动类、加工件及其他。其中机械类主要包括电机、滑台等，电气类主要包括驱动器、控制卡等，气动/液动类主要包括气缸、液压缸等，加工件及其他主要包括龙门、机架等定制件及耗材、钣金件等辅料。报告期内，公司主要供应商包括星微科技、奥普瑞、南央国际、津微光电、上海骏熙、供应商二等。

（三）主要生产模式

公司主要从事光通信、半导体、汽车自动化等领域智能生产装备的研发、生产和销售。不同客户订单在适用场景、技术要求等方面存在个性化差异，因此公司主要采用以销定产的生产管理模式，根据客户需求情况进行生产调度、管理和控制，同时对部分热门标准机型进行适度比例的备货生产。

生产流程方面，销售部接到客户订单后，运营中心协调组织生产部、设计部门、采购部、销售部等组建项目组，进行项目启动会，并根据合同约定的相

关技术指标，确定项目生产主计划。项目组统筹公司各部门，对人员、设备等进行评估和分工，协调设计总体方案。设计部门负责产品方案设计和设备软件编写，生产部门负责装配、电气接线及测试工作。设备完成内部测试后，组织相关人员进行发货。设备运抵客户指定地点后，公司相关人员进行设备安装及现场调试，以满足客户设备验收要求。

（四）销售方式及主要客户

公司采取直销的销售模式，报告期内存在少量代理和贸易商销售收入。直销模式下，由公司与客户进行前期接触、技术洽谈，双方达成意向后，公司直接与客户签订合同、发货给客户。公司项目订单的获得主要通过开发存量客户新需求、存量客户推荐、市场推广、参加行业展会等方式获得。

公司建立了完善的销售网络体系，配备了一批高素质的销售人员和市场拓展人员，营销管理部下设市场拓展部和销售部两个部门，其中市场拓展部主要负责市场推介材料的制作与推广，销售部主要负责已有客户的维护和新客户的获取工作。针对需求集中的大客户建立专人负责机制，与客户保持良好的合作关系，能够快速响应客户需求。报告期内，公司主要客户包括中际旭创、光迅科技、索尔思、客户五、源杰科技、索恩格等。

出于保证产品良率、控制生产成本的考虑，光模块厂商对生产设备具有严格的要求。发行人主要客户均为行业内知名企业，对设备供应商的筛选标准较高。发行人与主要客户均已形成了多年的合作历史，合作关系稳定。

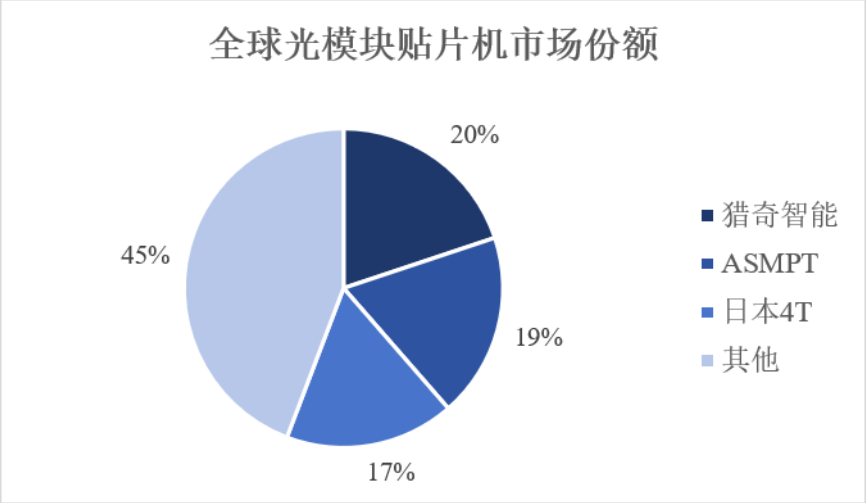
（五）行业竞争情况及发行人竞争地位

公司主要从事光通信、半导体、汽车自动化等领域智能生产装备的研发、生产和销售，是国内光模块智能制造装备的主要供应商之一，在技术水平、产品指标、客户覆盖等方面均保持较高水平，位于行业内的第一梯队，成功打破了欧美设备厂商在该领域的长期垄断，实现了国产设备的替代。公司系国家级专精特新“重点小巨人”、国家级专精特新“小巨人”、江苏省专精特新中小企业，公司自动耦合机、共晶贴片设备被江苏省工业和信息化厅评为首台（套）重大装备。

经过多年的发展和积累，公司产品已覆盖光模块封装测试流程的主要核心

环节，产品包含中高精度共晶和固晶贴片设备、耦合设备和老化测试设备等，支持最高 1.6T 速率光模块的封装需求。同时，公司根据行业发展趋势，基于未来硅光技术、CPO 等市场需求，积极研发和储备激光辅助键合、倒装热压等先进封装相关工艺，解决未来硅光芯片倒装及 PD 阵列倒装焊接等高端光模块的封装需求。

公司已成为光模块封装设备市场的重要竞争者。根据弗若斯特沙利文数据，2025 年公司光模块贴片设备市场份额为 20%（按设备数量口径统计），排名全球第一，已成为行业龙头企业。头部三家企业占据 56%的市场份额，未来随着国产化替代的推进，海外厂商市场份额将有望逐年降低。



数据来源：弗若斯特沙利文

根据弗若斯特沙利文报告，2025 年在光模块耦合设备领域猎奇智能以 23%的市场份额排名第二。（以上市场份额按设备数量口径统计）



数据来源：弗若斯特沙利文

综上，公司是国内领先的光模块封装测试设备厂商，在光模块设备细分市场占有率处于国内领先水平。

五、发行人符合成长型创新创业企业的情况

（一）发行人符合创业板定位相关指标要求

公司符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第四条第（二）套标准，具体情况如下：

创业板定位相关指标	指标情况	是否符合
最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元	最近三年累计研发费用金额为 12,788.88 万元	是
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%	2025 年，公司营业收入为 69,779.24 万元，大于 3 亿元，不适用营业收入复合增长率要求	不适用

（二）发行人符合创业板定位的具体说明

公司主要从事自动化智能设备的研发、生产和销售，产品主要应用于光通信、半导体、汽车自动化等行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C35 专用设备制造业”中的半导体器件专用设备制造（行业代码：C3562）。公司主营业务不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定的行业，亦不属于产能过剩行业、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的淘汰类行业，以

及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业。

1、公司创新、创造、创意特征

（1）聚焦光模块封装测试领域，坚持自主创新，保障核心技术自主可控

公司自成立以来，深耕光模块封装设备领域，坚持以产业发展方向和客户需求为导向，高度重视自主创新和技术研发，持续投入大量资金和人力，确保关键核心技术自主可控。截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有发明专利共 55 项，并以技术诀窍（Know-How）和商业机密的形式保有众多工艺及专有技术。

依托多年在运动控制、光学视觉、控制软件及设备机械结构等领域的深耕积累和自主创新，目前公司已具备光模块封装全流程设备的开发能力，并在贴片设备、耦合设备和老化测试设备等方面已经实现了国产替代。其中共晶贴片设备的设备精度达到±1μm，产品精度达到±3μm，技术水平与国际龙头齐平。耦合设备、固晶贴片设备精度及效率指标处于国内领先水平，相关产品得到国内主流市场的高度认可，公司设备已广泛应用于中际旭创、光迅科技、索尔思、源杰科技等光模块、光芯片龙头厂商。

公司创始团队具有十余年自动化和光通信行业从业经验，公司目前已建立了一支研发人员超过 100 人的技术团队，专业领域涵盖机械控制、软件设计、光学视觉等多个领域，具备根据市场需求和行业发展趋势，进行快速产品迭代升级的研发能力。

（2）强化技术创新能力，丰富公司产品领域，储备行业前沿技术

半导体行业可以划分为集成电路、分立器件、光电器件和传感器四大类。其中光模块中使用的光电芯片归属于光电子器件这一分类。而半导体其他领域的封装测试工艺流程与光模块领域较为接近，都需要进行芯片贴装、键合、测试等环节。因此，光模块领域的封装测试设备在底层原理、技术方面存在一定的共通性，底层技术如运动控制、视觉技术、机械设计等方面具有较强的延展性。公司依托于在光模块封装测试设备领域的技术积累，逐步向半导体行业其他领域拓展。目前公司推出的固晶和共晶设备，可适用于半导体微波射频领域，并实现向客户五等射频行业知名客户批量供货，公司研发的 SiC 预烧结设备已通过士兰微验证。

此外，公司研发团队针对硅光方案之后的先进封装发展方向，储备了大量的技术和设计工艺，目前公司已针对 TCB、LAB、Reflow 等先进封装工艺设计出新的设备方案，并通过模块优化和下游客户调研不断调整设备工艺。公司集中公司研发技术资源积极攻关重大难点，其中 TCB 设备已在客户处送样试验。公司坚持以技术创新为核心，不断提升产品性能和产品覆盖领域，以满足不断变化的市场发展趋势和下游客户需求。

2、公司促进新技术、新产业、新业态、新模式与传统产业深度融合情况

（1）紧跟光通信技术迭代趋势，深化产业融合创新

公司所处的光通信行业正经历技术革新与市场需求爆发的双重驱动，光模块作为核心传输器件，其封装技术迭代速度加快，对光模块封装测试设备的精度、效率及工艺适配性提出更高要求。近年来，随着 AI 算力需求激增、数据中心向 800G/1.6T 超高速率演进，以及硅光集成、CPO 等新兴技术的兴起，光模块行业呈现三大显著变化：

①速率与集成度升级：高速率光模块（800G/1.6T）对芯片贴装精度要求提升至±3 微米级，需同步优化耦合、测试等全流程工艺；②工艺革新加速：硅光芯片倒装焊、激光辅助键合（LAB）等先进封装技术逐渐普及，传统封装设备亟需向高精度、多工艺兼容方向升级；③国产设备替代率持续提升：在政策支持与市场需求双重驱动下，国产光模块封测设备正快速突破“卡脖子”环节。一方面，国内厂商通过自主创新填补高端设备空白。另一方面，产业链协同效应显现，中国企业在光模块领域的优势带动生产设备国产化率不断提升。

针对上述行业变革，公司依托自主研发的通用软件平台与核心技术优势，积极推进产品迭代与产业融合。一方面，公司基于 CPO、硅光等新技术需求，依托于 H3 贴装平台和实时对准贴装平台，开展前瞻性研发，包括激光辅助键合（LAB）、倒装热压等先进封装相关工艺，解决未来硅光芯片倒装及 PD 阵列倒装焊接的需求。同时，公司积极对现有设备功能进行升级，研发适配硅光模块的全自动耦合测试系统。

另一方面，公司通过跨领域技术复用，将光通信领域积累的高精度运动控制、压力控制、视觉引导等技术应用于半导体光电器件封装，进行 IC 高速固晶

机、多功能高速贴片设备、倒装贴片设备、热压超声焊设备等新设备的研发。

公司通过持续的技术研发与产品迭代，不仅满足光模块行业对高性能封装测试设备的迫切需求，更以技术融合创新推动光通信、半导体等领域的协同发展，为制造业向高端化、智能化转型提供核心装备支撑。

（2）自主研发通用软件平台，赋能产业融合升级

公司自主研发的通用软件平台紧密围绕光模块贴片设备核心需求，以“标准化架构+模块化应用”为设计理念，通过分层架构实现技术能力与贴片工艺场景的深度协同，成为推动光模块制造产业智能化升级的关键引擎。平台聚焦光模块贴片核心环节，涵盖高精度运动控制、微米级视觉定位、贴片工艺智能编排、参数与配方管理、生产数据统计分析、用户管理六大核心模块，构建起覆盖光模块贴片设备全生命周期的数字化解决方案。

在技术架构层面，平台采用分布式系统设计，针对光模块贴片设备对精度（±1 微米级）与效率的严苛要求，集成 20+标准化功能模块与开放式脚本接口，实现设备功能的“即插即用”快速开发。通过预设的标准化工艺流程模板，显著降低开发复杂度与开发周期。根据不同元件特性设置的参数，自动适配贴片压力、速度等工艺参数，确保贴装良率稳定。同时，平台内置的智能算法库融合传统视觉与深度学习模型，将视觉功能进一步扩展至缺陷检测、目标提取、分类、OCR 等方面。

在应用场景层面，平台兼具标准化开发与深度定制双重能力：一方面，通过预设的光模块贴片功能流程与界面模板，保障基础贴片业务的高效执行；另一方面，基于客户对特殊封装工艺、定制化界面交互的需求，支持可视化编程与二次开发，实现不同速率（100G-1.6T）、不同封装形式（COB/COC）光模块贴片设备的个性化配置。目前，该平台已成功应用于公司 DB3000、LQ-VADB30 系列固晶贴片机等核心产品，助力中际旭创、索尔思、光迅科技等客户实现光模块贴片工序的自动化调试、生产数据实时监控及工艺参数智能优化，推动光模块制造向智能化、柔性化转型。

该平台的研发与应用，不仅实现了光模块贴片设备技术的自主可控，更通过数据驱动的决策模式，推动光通信制造流程再造与产业协同创新，切实促进

新技术与光模块制造产业的深度融合，为我国光通信产业高质量发展提供技术支撑。

六、发行人主要财务数据及财务指标

项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额（万元）	306,102.55	163,771.15	100,291.90	66,419.67
归属于母公司所有者权益（万元）	87,734.35	72,386.22	56,630.28	25,782.61
资产负债率（母公司）	72.06%	57.63%	41.20%	56.88%
资产负债率（合并）	71.36%	55.81%	43.57%	61.20%
营业收入（万元）	58,144.73	69,779.24	54,292.61	28,918.30
净利润（万元）	14,831.17	18,155.76	18,056.52	8,150.30
归属于母公司所有者的净利润（万元）	14,868.26	18,235.60	18,078.25	8,160.46
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	14,322.59	17,138.68	17,426.02	9,019.78
基本每股收益（元）	3.6044	4.4014	5.1652	不适用
稀释每股收益（元）	3.6044	4.4014	5.1652	不适用
加权平均净资产收益率	18.57%	28.79%	53.60%	42.16%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,238.48	2,923.00	14,178.06	14,871.16
现金分红（万元）	-	3,500.00	1,500.00	1,200.00
研发投入占营业收入的比例	5.89%	8.35%	8.28%	8.52%

注：上述财务指标的计算方法详见本招股意向书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、主要财务指标”的注释。公司于 2024 年整体变更为股份公司，因此 2023 年不适用基本每股收益、稀释每股收益。

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

财务报告审计截止日至本招股意向书签署日期间，公司经营模式、主要原材料采购、技术研发、生产及销售等业务、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

（一）公司 2026 年 1-9 月业绩情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年 1-9 月财务数据进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚阅字[2026]215Z0012 号）。2026 年 1-9 月，

公司经审阅的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动比例
资产总计	432,763.94	163,771.15	164.25%
负债合计	321,980.60	91,406.70	252.25%
所有者权益	110,783.35	72,364.44	53.09%
项目	**2026 年 1-9 月**	**2025 年 1-9 月**	**变动比例**
营业收入	119,345.53	39,150.00	204.84%
营业利润	43,733.55	9,794.60	346.51%
利润总额	43,704.86	9,784.65	346.67%
净利润	37,520.55	8,637.87	334.37%
归属于母公司所有者的净利润	37,579.61	8,697.18	332.09%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	36,757.99	8,161.93	350.36%
经营活动产生的现金流量净额	16,525.81	-9,149.04	280.63%

受益于下游光模块行业扩产需求旺盛，公司销售收入、净利润同比增加。2026 年 1-9 月，公司实现营业收入 119,345.53 万元，较上年同期增长 204.84%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 36,757.99 万元，较上年同期增长 350.36%，公司经营活动产生的现金流量净额为 16,525.81 万元，较上年同期增长 280.63%。综上，发行人 2026 年 1-9 月整体经营保持良好发展态势。

2026 年 1-9 月，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额为 821.63 万元，主要系计入当期的政府补助 561.03 万元。

（二）公司 2026 年全年业绩预计情况

基于公司实际经营情况，结合公司历史经营数据，并考虑公司预计期间的订单执行、市场需求情况，公司对 2026 年全年的经营业绩情况预计如下：

单位：万元

项目	2026 年	2025 年	变动比例
营业收入	180,005.12~198,953.03	69,779.24	157.96%~185.12%
归属于母公司所有者的净利润	59,277.36~65,517.08	18,235.60	225.06%~259.28%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	58,234.64~64,364.61	17,138.68	239.78%~275.55%

公司预计 2026 年营业收入较上年同期增长 157.96%~185.12%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期增长 239.78%~275.55%。导致公司预计营业收入和净利润增长原因系在光模块需求持续放量的背景下，光模块厂商纷纷加速产能扩张，对设备的需求不断提升所致。

上述 2026 年预计经营业绩数据为初步测算结果，预计数不代表公司最终可实现的营业收入、扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润，亦不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

八、发行人选择的具体上市标准

发行人本次发行上市申请适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）项规定的上市标准：最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元。

发行人 2024 年度和 2025 年度归属于发行人母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 17,426.02 万元和 17,138.68 万元，符合相关上市标准。

九、发行人公司治理特殊安排

截至本招股意向书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排。

十、募集资金运用与未来发展规划

本次募集资金投资项目已经发行人第一届董事会第五次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过，由董事会根据项目的轻重缓急情况安排实施。发行人本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额
1	高端智能装备制造建设项目	58,240.78	58,240.78
2	研发中心建设项目	25,100.61	25,100.61
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		**91,341.39**	**91,341.39**

在本次发行上市募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。若募集资金金额小于上述项目拟投资金额，不足部分由公司自有或自筹资金进行投资，以保证项目的顺利实施；若本次发行实际募集资金超过上述项目投资需求，超过部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

关于本次募集资金项目与公司未来发展规划具体情况详见本招股意向书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股意向书签署日，不存在其他对发行人有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股意向书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险主要根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。公司的主要风险因素如下：

一、与发行人相关的风险

（一）技术风险

1、未能紧跟光模块技术迭代升级的风险

详见本招股意向书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“7、未能紧跟光模块技术迭代升级的风险”。

2、技术泄密风险

核心技术是公司构建竞争壁垒与持续创新的根基。公司通过多年技术攻坚，已自主掌握运动控制、视觉定位、耦合算法等领域多项关键核心技术，这些技术造就了公司在光模块封装测试设备领域的领先地位，是支撑产品性能的核心要素。公司高度重视对核心技术的保护，通过申请专利、签署保密协议等多种措施防止核心技术泄密，但不能排除未来核心技术外泄或被盗用的可能。若上述情况发生，将加剧市场竞争，削弱公司的技术优势，对公司生产经营产生不利影响。

3、高端技术人才流失的风险

智能装备制造行业作为技术密集型领域，具有跨学科、设计复杂、软硬件深度融合等特点，其创新发展需兼顾机械控制、运动控制、耦合算法、材料选型等多维度技术突破，对行业人才在理论知识、产业经验、技术集成创新等方面的综合能力要求极高。高端专业人才队伍作为公司维持持续创新能力与发展动力的核心支撑，其稳定性对技术迭代与业务拓展至关重要。

随着公司业务规模扩张及研发投入持续增加，对技术人才的需求始终保持高位。公司在持续强化内部培养体系的同时，通过推行股权激励等长效激励政策，构建吸引与稳定优秀人才的制度保障。

若未来出现技术人才大量流失，尤其是核心技术人才流失，而公司未能及时补充符合要求的技术力量，将直接削弱在人才储备与技术创新领域的竞争优势，对生产经营产生不利影响。

（二）经营风险

1、经营业绩波动或下滑的风险

详见本招股意向书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“1、经营业绩波动或下滑的风险”。

2、单一客户重大依赖风险

详见本招股意向书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“2、单一客户重大依赖风险”。

3、产品质量风险

公司产品主要应用于光模块、半导体等行业的封装测试环节，而封装测试设备本身是光通信、半导体产业的关键环节之一。其质量，尤其是测试设备的精度与稳定性等指标，直接关系到产品的核心竞争力。

下游客户对设备质量标准要求严苛，若公司未能有效把控产品质量，不仅可能需承担相应赔偿责任，还会对经营业绩、财务状况产生不利影响；同时，产品质量问题还可能损害公司品牌形象，进而影响客户合作关系的稳定性。

4、国际贸易摩擦风险

详见本招股意向书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“9、国际贸易摩擦风险”。

（三）财务风险

1、应收账款及合同资产出现坏账损失的风险

报告期各期末，公司应收账款及合同资产账面价值合计分别为 11,065.72 万元、12,783.35 万元、20,588.89 万元和 29,717.82 万元，分别占资产总额的 16.66%、12.75%、12.57%和 9.71%。未来随着公司经营规模的进一步扩大，公司的应收账款及合同资产规模也将进一步增加，若客户经营出现困难或由于其

他原因导致无法按期支付款项，则公司将面临应收账款及合同资产的坏账损失风险，对公司经营业绩及资产质量产生不利影响。

2、税收优惠政策变动的风险

猎奇智能分别于 2021 年 11 月 30 日、2024 年 12 月 16 日获得编号为 GR202132008643、GR202432012264 的高新技术企业证书，享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。飞泰智能分别于 2020 年 12 月 1 日、2023 年 11 月 14 日获得编号为 GR202042000940、GR202342003390 的高新技术企业证书，享受减按 15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。如果公司未来无法通过高新技术企业资格重新认定，或国家相关税收政策发生变化，则可能导致税收优惠减少或取消，进而对公司经营业绩产生影响。

3、毛利率下滑的风险

详见本招股意向书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“5、毛利率下滑的风险”。

4、存货余额较高及跌价风险

详见本招股意向书“第二节 概览”之“ 一、重大事项提示”之“ （一）特别风险提示”之“6、存货余额较高及跌价风险”。

（四）内控风险

1、经营规模快速扩张带来的管理风险

报告期内，公司保持了良好的发展势头，资产、业务规模逐年增长。随着公司经营规模的持续扩大、组织结构的日益复杂，公司的经营管理能力和内部控制体系将面临着更高的要求和挑战。若公司不能及时适应资产、业务规模快速扩张和资本市场的要求，适时优化管理体系并提高自身经营能力，公司的盈利能力和发展前景将面临一定经营管理风险。

2、实际控制人不当控制风险

发行人目前已经按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定建立了公司治理结构，但公司实际控制人仍可凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策、利润分

配等进行控制。如未来实际控制人利用其对公司的控制权对公司实施不当控制，可能对公司及其他股东的利益造成不利影响。

（五）未决诉讼风险

详见本招股意向书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“4、未决诉讼风险”。

二、与行业相关的风险

（一）光模块行业周期波动导致下游客户资本性支出减少的风险

详见本招股意向书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“3、光模块行业周期波动导致下游客户资本性支出减少的风险”。

（二）市场竞争加剧的风险

详见本招股意向书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“8、市场竞争加剧的风险”。

三、其他风险

（一）募集资金投资项目实施风险

本次发行的募集资金投资项目基于现有的业务情况、行业发展趋势、国家经济环境、产业政策和未来技术发展方向制定，项目包括高端智能装备制造建设项目和研发中心建设项目。本次募集资金投资项目虽然经过了可性论证和市场研究，但该等论证和研究均系基于当前市场环境、技术能力和发展趋势等因素作出的。在项目实际实施的过程中，可能会面临整体经济形势、行业市场环境、技术革新等不确定因素，以及在研发过程中未能实现关键技术的突破，或研发的产品性能无法达到预期，将会对公司募集资金投资项目的实施带来不利影响。

如募投项目建成后产能释放不及预期，或市场需求不利变化导致新增产能无法充分消化，公司将面临一定的资产折旧摊销增加，预计新增折旧摊销金额为 5,512.10 万元，占发行人 2025 年营业收入和净利润比例分别为 7.90%和 30.36%，可能对公司生产经营业绩产生一定不利影响。

（二）本次发行摊薄即期回报的风险

本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。但由于募集资金使用产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期回报存在被摊薄的风险，特提请投资者注意投资风险。

（三）发行失败风险

公司计划首次公开发行股票并在创业板上市，在取得相关批复后将根据创业板发行规则进行发行。本次发行的发行结果会受到证券市场整体情况、投资者价值判断、市场供需等多方面因素的影响。本次发行过程中，如前述因素出现不利变动，可能出现有效报价或认购不足等情况，进而导致公司本次公开发行失败。

（四）不可抗力风险

重大地质灾害、气象灾害、战争等不可抗力事件的发生可能严重影响公司的正常生产经营，或者使公司财产造成重大损失，给公司经营业绩带来一定影响。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称	苏州猎奇智能设备股份有限公司
英文名称	Suzhou Lieqi Intelligent Equipment Co., Ltd.
注册资本	4,125.00 万元人民币
法定代表人	罗超
有限公司成立日期	2015 年 11 月 23 日
股份公司成立日期	2024 年 10 月 28 日
注册地址	昆山市玉山镇新塘路 826 号 12 栋、13 栋
主要生产经营地址	昆山市玉山镇新塘路 826 号 12 栋、13 栋
邮政编码	215300
电话号码	0512-57022580-622
电子信箱	ir@suzhoulieqi.com
互联网网址	suzhoulieqi.com
负责信息披露和投资者关系的部门	证券部
信息披露负责人及联系电话	刘正，0512-57022580-622

二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况

（一）有限公司的设立情况

2015 年 11 月 10 日，罗超、徐凯、西安正奇、刘鸿铭和宋玉华签署了《苏州猎奇智能设备有限公司章程》，约定共同出资 500.00 万元设立猎奇有限，其中罗超认缴出资 155.00 万元，徐凯认缴出资 145.00 万元，西安正奇认缴出资 100.00 万元，刘鸿铭认缴出资 60.00 万元、宋玉华认缴出资 40.00 万元，出资方式均为货币。

2015 年 11 月 23 日，猎奇有限领取了昆山市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320583MA1MBH7J5A）。

猎奇有限设立时的股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	罗超	155.00	31.00

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
2	徐凯	145.00	29.00
3	西安正奇	100.00	20.00
4	刘鸿铭	60.00	12.00
5	宋玉华	40.00	8.00
合计		**500.00**	**100.00**

（二）股份公司的设立情况

猎奇智能系由猎奇有限整体变更设立的股份有限公司。

2024 年 10 月 15 日，猎奇智能召开成立大会，审议并通过了猎奇有限整体变更设立为股份公司的相关议案，有限公司以股改基准日 2024 年 2 月 29 日经审计净资产 25,273.99 万元按 1:0.1385 比例折合为股份公司股本 3,500.00 万股，其余 21,773.99 万元计入公司资本公积。各股东按原持股比例分割经审计后的上述净资产并以此抵作股款投入拟设立的股份公司。

2024 年 8 月 26 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2024]215Z0205 号《审计报告》，确认截至 2024 年 2 月 29 日，有限公司经审计后净资产为 25,273.99 万元。

2024 年 8 月 27 日，厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具了嘉学评估评报字[2024]8310045 号《资产评估报告》，确认截至 2024 年 2 月 29 日，有限公司净资产评估价值为 41,989.16 万元。

2024 年 10 月 15 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2024] 215Z0036 号《验资报告》，确认截至 2024 年 10 月 15 日，股份公司已收到全体股东以各自拥有的有限公司股权对应净资产折合的股本 3,500.00 万元，净资产超过股本部分计入资本公积。

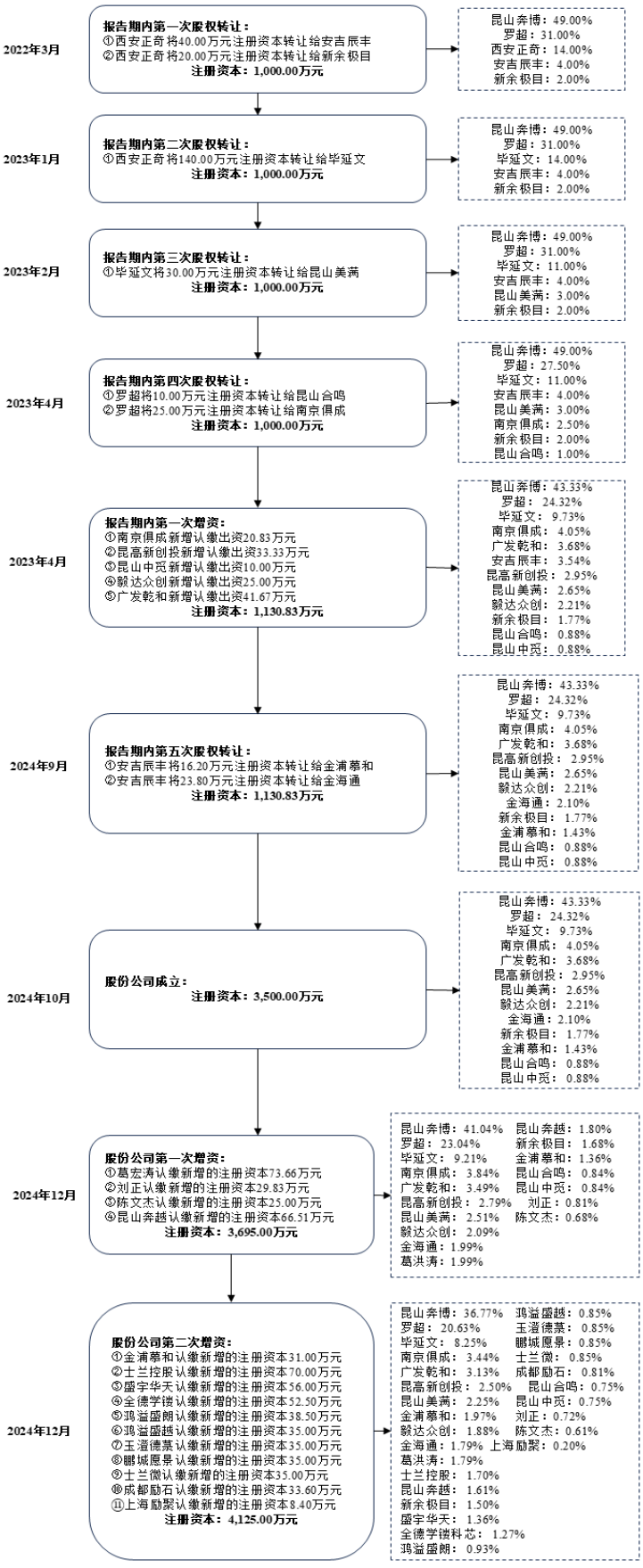
2024 年 10 月 28 日，苏州市数据局向发行人核发《营业执照》（统一社会信用代码：91320583MA1MBH7J5A），法定代表人为罗超，注册资本为 3,500.00 万元，公司类型为股份有限公司（未上市）。

本次股份改制完成后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	昆山奔博	1,516.58	43.33
2	罗超	851.14	24.32
3	毕延文	340.46	9.73
4	南京俱成	141.86	4.05
5	广发乾和	128.96	3.68
6	昆高新创投	103.17	2.95
7	昆山美满	92.85	2.65
8	毅达众创	77.38	2.21
9	金海通	73.66	2.10
10	新余极目	61.90	1.77
11	金浦慕和	50.14	1.43
12	昆山中觅	30.95	0.88
13	昆山合鸣	30.95	0.88
合计		**3,500.00**	**100.00**

（三）报告期内的股本和股东变化情况

报告期内，公司股本和股东变化情况示意图如下：


2022年3月
报告期内第一次股权转让：
①西安正奇将40.00万元注册资本转让给安吉辰丰
②西安正奇将20.00万元注册资本转让给新余极目
注册资本：1,000.00万元
昆山奔博：49.00%
罗超：31.00%
西安正奇：14.00%
安吉辰丰：4.00%
新余极目：2.00%
2023年1月
报告期内第二次股权转让：
①西安正奇将140.00万元注册资本转让给毕延文
注册资本：1,000.00万元
昆山奔博：49.00%
罗超：31.00%
毕延文：14.00%
安吉辰丰：4.00%
新余极目：2.00%
2023年2月
报告期内第三次股权转让：
①毕延文将30.00万元注册资本转让给昆山美满
注册资本：1,000.00万元
昆山奔博：49.00%
罗超：31.00%
毕延文：11.00%
安吉辰丰：4.00%
昆山美满：3.00%
新余极目：2.00%
2023年4月
报告期内第四次股权转让：
①罗超将10.00万元注册资本转让给昆山合鸣
②罗超将25.00万元注册资本转让给南京俱成
注册资本：1,000.00万元
昆山奔博：49.00%
罗超：27.50%
毕延文：11.00%
安吉辰丰：4.00%
昆山美满：3.00%
南京俱成：2.50%
新余极目：2.00%
昆山合鸣：1.00%
2023年4月
报告期内第一次增资：
①南京俱成新增认缴出资20.83万元
②昆高新创投新增认缴出资33.33万元
③昆山中贡新增认缴出资10.00万元
④毅达众创新增认缴出资25.00万元
⑤广发乾和新增认缴出资41.67万元
注册资本：1,130.83万元
昆山奔博：43.33%
罗超：24.32%
毕延文：9.73%
南京俱成：4.05%
广发乾和：3.68%
安吉辰丰：3.54%
昆高新创投：2.95%
昆山美满：2.65%
毅达众创：2.21%
新余极目：1.77%
昆山合鸣：0.88%
昆山中贡：0.88%
2024年9月
报告期内第五次股权转让：
①安吉辰丰将16.20万元注册资本转让给金浦慕和
②安吉辰丰将23.80万元注册资本转让给金海通
注册资本：1,130.83万元
昆山奔博：43.33%
罗超：24.32%
毕延文：9.73%
南京俱成：4.05%
广发乾和：3.68%
昆高新创投：2.95%
昆山美满：2.65%
毅达众创：2.21%
金海通：2.10%
新余极目：1.77%
金浦慕和：1.43%
昆山合鸣：0.88%
昆山中贡：0.88%
2024年10月
股份公司成立：
注册资本：3,500.00万元
昆山奔博：43.33%
罗超：24.32%
毕延文：9.73%
南京俱成：4.05%
广发乾和：3.68%
昆高新创投：2.95%
昆山美满：2.65%
毅达众创：2.21%
金海通：2.10%
新余极目：1.77%
金浦慕和：1.43%
昆山合鸣：0.88%
昆山中贡：0.88%
2024年12月
股份公司第一次增资：
①葛宏涛认缴新增的注册资本73.66万元
②刘正认缴新增的注册资本29.83万元
③陈文杰认缴新增的注册资本25.00万元
④昆山奔越认缴新增的注册资本66.51万元
注册资本：3,695.00万元
昆山奔博：41.04%
罗超：23.04%
毕延文：9.21%
南京俱成：3.84%
广发乾和：3.49%
昆高新创投：2.79%
昆山美满：2.51%
毅达众创：2.09%
金海通：1.99%
葛洪涛：1.99%
昆山奔越：1.80%
新余极目：1.68%
金浦慕和：1.36%
昆山合鸣：0.84%
昆山中贡：0.84%
刘正：0.81%
陈文杰：0.68%
2024年12月
股份公司第二次增资：
①金浦慕和认缴新增的注册资本31.00万元
②士兰控股认缴新增的注册资本70.00万元
③盛宇华天认缴新增的注册资本56.00万元
④全德学镭认缴新增的注册资本52.50万元
⑤鸿溢盛朗认缴新增的注册资本38.50万元
⑥鸿溢盛越认缴新增的注册资本35.00万元
⑦玉澄德蒽认缴新增的注册资本35.00万元
⑧鹏城愿景认缴新增的注册资本35.00万元
⑨士兰微认缴新增的注册资本35.00万元
⑩成都励石认缴新增的注册资本33.60万元
⑪上海励聚认缴新增的注册资本8.40万元
注册资本：4,125.00万元
昆山奔博：36.77%
罗超：20.63%
毕延文：8.25%
南京俱成：3.44%
广发乾和：3.13%
昆高新创投：2.50%
昆山美满：2.25%
金浦慕和：1.97%
毅达众创：1.88%
金海通：1.79%
葛洪涛：1.79%
士兰控股：1.70%
昆山奔越：1.61%
新余极目：1.50%
盛宇华天：1.36%
全德学镭科芯：1.27%
鸿溢盛朗：0.93%
鸿溢盛越：0.85%
玉澄德蒽：0.85%
鹏城愿景：0.85%
士兰微：0.85%
成都励石：0.81%
昆山合鸣：0.75%
昆山中贡：0.75%
刘正：0.72%
陈文杰：0.61%
上海励聚：0.20%

1、报告期期初，猎奇有限的股权结构

报告期初，猎奇有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	昆山奔博	490.00	49.00
2	罗超	310.00	31.00
3	西安正奇	200.00	20.00
合计		**1,000.00**	**100.00**

2、2022 年 3 月，猎奇有限报告期内第一次股权转让

2022 年 2 月 18 日，安吉辰丰与西安正奇、罗超、昆山奔博签署股权转让协议，约定西安正奇将其持有的公司 4.00%股权（对应出资额 40.00 万元）作价 800.00 万元转让给安吉辰丰。2022 年 2 月 18 日，新余极目与西安正奇、公司签署股权转让协议，约定西安正奇将其持有的公司 2.00%股权（对应出资额 20.00 万元）作价 400.00 万元转让给新余极目。

2022 年 2 月 18 日，猎奇有限召开股东会，同意公司原股东西安正奇将其所持公司 40.00 万元出资额转让给新股东安吉辰丰；同意公司原股东西安正奇将其所持公司 20.00 万元出资额转让给新股东新余极目；其他股东同意放弃行使优先购买权；同意并通过公司新章程。

2022 年 3 月 4 日，猎奇有限办理了本次股权转让的工商变更登记，本次股权转让完成后，公司股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	昆山奔博	490.00	49.00
2	罗超	310.00	31.00
3	西安正奇	140.00	14.00
4	安吉辰丰	40.00	4.00
5	新余极目	20.00	2.00
合计		**1,000.00**	**100.00**

3、2023 年 1 月，猎奇有限报告期内第二次股权转让

2022 年 12 月 29 日，西安正奇与毕延文签署股权转让协议，约定西安正奇将其所持有的公司 14.00%股权（对应出资额 140.00 万元）作价 1,925.33 万元转

让给毕延文。

2022 年 12 月 29 日，猎奇有限召开股东会，同意公司原股东西安正奇将其所持公司 140.00 万元出资额转让给新股东毕延文；其他股东同意放弃行使优先购买权；同意并通过公司新章程。

2023 年 1 月 5 日，猎奇有限办理了本次股权转让的工商变更登记，本次股权转让完成后，公司股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	昆山奔博	490.00	49.00
2	罗超	310.00	31.00
3	毕延文	140.00	14.00
4	安吉辰丰	40.00	4.00
5	新余极目	20.00	2.00
合计		**1,000.00**	**100.00**

4、2023 年 2 月，猎奇有限报告期内第三次股权转让

2023 年 1 月 16 日，毕延文与昆山美满签署股权转让协议，约定毕延文将其所持有的公司 3.00%股权（对应出资额 30.00 万元）作价 600.00 万元转让给昆山美满。

2023 年 1 月 16 日，猎奇有限召开股东会，同意股东毕延文将其所持公司 30.00 万元出资额转让给新股东昆山美满；其他股东同意放弃行使优先购买权；同意并通过公司新章程。

2023 年 2 月 13 日，猎奇有限办理了本次股权转让的工商变更登记，本次股权转让完成后，公司股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	昆山奔博	490.00	49.00
2	罗超	310.00	31.00
3	毕延文	110.00	11.00
4	安吉辰丰	40.00	4.00
5	昆山美满	30.00	3.00
6	新余极目	20.00	2.00

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
合计		**1,000.00**	**100.00**

5、2023 年 4 月，猎奇有限报告期内第四次股权转让

2023 年 3 月 28 日，罗超与昆山合鸣签署股权转让协议，约定罗超将其持有的公司 1.00%股权（对应出资额 10.00 万元）作价 500.00 万元转让给昆山合鸣；罗超与南京俱成签署股权转让协议，约定罗超将其持有的公司 2.50%股权（对应出资额 25.00 万元）作价 1,250.00 万元转让给南京俱成。

2023 年 3 月 28 日，猎奇有限召开股东会，同意股东罗超将其所持公司 10.00 万元出资额转让给昆山合鸣；同意股东罗超将其所持公司 25.00 万元出资额转让给南京俱成；其他股东同意放弃行使优先购买权；同意并通过公司新章程。

2023 年 4 月 17 日，猎奇有限办理了本次股权转让的工商变更登记，本次股权转让完成后，公司股东及其出资情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	昆山奔博	490.00	49.00
2	罗超	275.00	27.50
3	毕延文	110.00	11.00
4	安吉辰丰	40.00	4.00
5	昆山美满	30.00	3.00
6	南京俱成	25.00	2.50
7	新余极目	20.00	2.00
8	昆山合鸣	10.00	1.00
合计		**1,000.00**	**100.00**

6、2023 年 4 月，猎奇有限报告期内第一次增资

2023 年 3 月 9 日，南京俱成、昆高新创投、昆山中觅、毅达众创、广发乾和与罗超、昆山奔博、昆山美满、毕延文、安吉辰丰、新余极目、昆山合鸣签署投资协议，约定南京俱成增资 1,250.00 万元，其中 20.83 万元计入注册资本，占注册资本的 1.84%，剩余的 1,229.17 万元计入资本公积；昆高新创投增资 2,000.00 万元，其中 33.33 万元计入注册资本，占注册资本的 2.95%，剩余的

1,966.67 万元计入资本公积；昆山中觅增资 600.00 万元，其中 10.00 万元计入注册资本，占注册资本的 0.88%，剩余的 590.00 万元计入资本公积；毅达众创增资 1,500.00 万元，其中 25.00 万元计入注册资本，占注册资本的 2.21%，剩余的 1,475.00 万元计入资本公积；广发乾和增资 2,500.00 万元，其中 41.67 万元计入注册资本，占注册资本的 3.68%，剩余的 2,458.33 万元计入资本公积。

2023 年 4 月 3 日，猎奇有限召开股东会，同意增加公司注册资本 130.83 万元，以货币方式出资，其中南京俱成认缴出资 20.83 万元；昆高新创投认缴出资 33.33 万元；昆山中觅认缴出资 10.00 万元；毅达众创认缴出资 25.00 万元；广发乾和认缴出资 41.67 万元；变更后公司的注册资本为 1,130.83 万元；同意并通过公司新章程；批准相关投资协议的全部条款、条件和拟议事项，批准公司签署和交付投资协议、并按照投资协议的约定履行公司在其项下需尽的各项义务。

2023 年 4 月 26 日，猎奇有限办理了本次增资的工商变更登记，本次增资完成后，公司股东及其出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	昆山奔博	490.00	43.33
2	罗超	275.00	24.32
3	毕延文	110.00	9.73
4	南京俱成	45.83	4.05
5	广发乾和	41.67	3.68
6	安吉辰丰	40.00	3.54
7	昆高新创投	33.33	2.95
8	昆山美满	30.00	2.65
9	毅达众创	25.00	2.21
10	新余极目	20.00	1.77
11	昆山合鸣	10.00	0.88
12	昆山中觅	10.00	0.88
合计		**1,130.83**	**100.00**

7、2024 年 9 月，猎奇有限报告期内第五次股权转让

2024 年 8 月 23 日，安吉辰丰与金浦慕和签署股权转让协议，约定安吉辰

丰将其所持有的公司 1.43%股权（对应出资额 16.20 万元）作价 1,360.96 万元转让给金浦慕和；安吉辰丰与金海通签署股权转让协议，约定安吉辰丰将其所持有的公司 2.10%股权（对应出资额 23.80 万元）作价 1,999.44 万元转让给金海通。

2024 年 8 月 23 日，猎奇有限召开股东会，同意原股东安吉辰丰将其所持公司 16.20 万元出资额转让给新股东金浦慕和；同意原股东安吉辰丰将其所持公司 23.80 万元出资额转让给新股东金海通；其他股东同意放弃行使优先购买权；同意并通过公司新章程。

2024 年 9 月 29 日，猎奇有限办理了本次股权转让的工商变更登记，本次股权转让完成后，公司股东及其出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	昆山奔博	490.00	43.33
2	罗超	275.00	24.32
3	毕延文	110.00	9.73
4	南京俱成	45.83	4.05
5	广发乾和	41.67	3.68
6	昆高新创投	33.33	2.95
7	昆山美满	30.00	2.65
8	毅达众创	25.00	2.21
9	金海通	23.80	2.10
10	新余极目	20.00	1.77
11	金浦慕和	16.20	1.43
12	昆山合鸣	10.00	0.88
13	昆山中觅	10.00	0.88
合计		**1,130.83**	**100.00**

8、2024 年 10 月，整体变更为股份公司

2024 年 10 月，猎奇有限整体变更设立股份公司，具体情况见本节“二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况”之“（二）股份公司的设立情况”。

9、2024 年 12 月，股份公司第一次增资

2024 年 11 月 18 日，猎奇智能召开 2024 年第二次临时股东会作出决议，

同意公司通过增资实施股权激励，同意增加公司注册资本 195.00 万元。其中：激励对象葛宏涛以货币出资 631.27 万元认缴新增的注册资本 73.66 万元，激励对象刘正以货币出资 255.64 万元认缴新增的注册资本 29.83 万元，激励对象陈文杰以货币出资 214.25 万元认缴新增的注册资本 25.00 万元，持股平台昆山奔越以货币出资 569.99 万元认缴新增的注册资本 66.51 万元。

2024 年 12 月 5 日，猎奇智能办理了本次增资的工商变更登记，本次增资完成后，猎奇智能的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	昆山奔博	1,516.58	41.04
2	罗超	851.14	23.04
3	毕延文	340.46	9.21
4	南京俱成	141.86	3.84
5	广发乾和	128.96	3.49
6	昆高新创投	103.17	2.79
7	昆山美满	92.85	2.51
8	毅达众创	77.38	2.09
9	金海通	73.66	1.99
10	葛宏涛	73.66	1.99
11	昆山奔越	66.51	1.80
12	新余极目	61.90	1.68
13	金浦慕和	50.14	1.36
14	昆山中觅	30.95	0.84
15	昆山合鸣	30.95	0.84
16	刘正	29.83	0.81
17	陈文杰	25.00	0.68
合计		**3,695.00**	**100.00**

10、2024 年 12 月，股份公司第二次增资

2024 年 12 月 9 日，猎奇智能召开 2024 年第三次临时股东会作出决议，同意公司注册资本由 3,695.00 万元增加至 4,125.00 万元，新增注册资本 430.00 万元。其中：金浦慕和以货币出资 885.71 万元认缴新增的注册资本 31.00 万元、士兰控股以货币出资 2,000.00 万元认缴新增的注册资本 70.00 万元、盛宇华天

以货币出资 1,600.00 万元认缴新增的注册资本 56.00 万元、全德学镂科芯以货币出资 1,500.00 万元认缴新增的注册资本 52.50 万元、鸿溢盛朗以货币出资 1,100.00 万元认缴新增的注册资本 38.50 万元、鸿溢盛越以货币出资 1,000.00 万元认缴新增的注册资本 35.00 万元、玉澄德菉以货币出资 1,000.00 万元认缴新增的注册资本 35.00 万元、鹏城愿景以货币出资 1,000.00 万元认缴新增的注册资本 35.00 万元、士兰微以货币出资 1,000.00 万元认缴新增的注册资本 35.00 万元、成都励石以货币出资 960.00 万元认缴新增的注册资本 33.60 万元、上海励聚以货币出资 240.00 万元认缴新增的注册资本 8.40 万元。

2024 年 12 月 16 日，金浦慕和、金海通、士兰控股、盛宇华天、全德学镂科芯、鸿溢盛朗、鸿溢盛越、玉澄德菉、鹏城愿景、士兰微、成都励石、上海励聚与罗超、昆山奔博及公司签署投资协议，约定金浦慕和认购股份总价 885.71 万元，其中 31.00 万元计入公司的注册资本，剩余 854.71 万元计入公司的资本公积；士兰控股认购股份总价 2,000.00 万元，其中 70.00 万元计入公司的注册资本，剩余 1,930.00 万元计入公司的资本公积；盛宇华天认购股份总价 1,600.00 万元，其中 56.00 万元计入公司的注册资本，剩余 1,544.00 万元计入公司的资本公积；全德学镂科芯认购股份总价 1,500.00 万元，其中 52.50 万元计入公司的注册资本，剩余 1,447.50 万元计入公司的资本公积；鸿溢盛朗认购股份总价 1,100.00 万元，其中 38.50 万元计入公司的注册资本，剩余 1,061.50 万元计入公司的资本公积；鸿溢盛越认购股份总价 1,000.00 万元，其中 35.00 万元计入公司的注册资本，剩余 965.00 万元计入公司的资本公积；玉澄德菉认购股份总价 1,000.00 万元，其中 35.00 万元计入公司的注册资本，剩余 965.00 万元计入公司的资本公积；鹏城愿景认购股份总价 1,000.00 万元，其中 35.00 万元计入公司的注册资本，剩余 965.00 万元计入公司的资本公积；士兰微认购股份总价 1,000.00 万元，其中 35.00 万元计入公司的注册资本，剩余 965.00 万元计入公司的资本公积；成都励石认购股份总价 960.00 万元，其中 33.60 万元计入公司的注册资本，剩余 926.40 万元计入公司的资本公积；上海励聚认购股份总价 240.00 万元，其中 8.40 万元计入公司的注册资本，剩余 231.60 万元计入公司的资本公积。

2024 年 12 月 31 日，猎奇智能办理了本次增资的工商变更登记，本次增资

完成后，猎奇智能的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	昆山奔博	1,516.58	36.77
2	罗超	851.14	20.63
3	毕延文	340.46	8.25
4	南京俱成	141.86	3.44
5	广发乾和	128.96	3.13
6	昆高新创投	103.17	2.50
7	昆山美满	92.85	2.25
8	金浦慕和	81.14	1.97
9	毅达众创	77.38	1.88
10	金海通	73.66	1.79
11	葛宏涛	73.66	1.79
12	士兰控股	70.00	1.70
13	昆山奔越	66.51	1.61
14	新余极目	61.90	1.50
15	盛宇华天	56.00	1.36
16	全德学镂科芯	52.50	1.27
17	鸿溢盛朗	38.50	0.93
18	鸿溢盛越	35.00	0.85
19	玉澄德菉	35.00	0.85
20	鹏城愿景	35.00	0.85
21	士兰微	35.00	0.85
22	成都励石	33.60	0.81
23	昆山中觅	30.95	0.75
24	昆山合鸣	30.95	0.75
25	刘正	29.83	0.72
26	陈文杰	25.00	0.61
27	上海励聚	8.40	0.20
合计		**4,125.00**	**100.00**

（四）发行人报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

（五）发行人于其他证券市场上市/挂牌情况

公司自设立以来不存在于其他证券市场上市/挂牌的情况。

（六）发行人与相关股东之间签署的投资者特殊权利条款及解除的情况

公司历次增资扩股及股权转让过程中，曾与外部投资者约定了特殊权利。该等特殊权利条款的约定及解除情况如下：

1、2022 年 2 月，发行人、罗超、昆山奔博与安吉辰丰约定的特殊权利条款及解除情况

（1）特殊权利条款约定情况

2022 年 2 月，发行人、罗超、昆山奔博与西安正奇、安吉辰丰签署了股权转让协议，约定了安吉辰丰享有优先认购/购买权、反稀释权、共同出售权、最惠待遇等特殊权利，主要内容如下：

特殊权利	主要内容
优先认购/购买权	在签署本协议后、符合本协议其他约定的条件下，如标的公司向任何第三方有偿增发股份/股权，则受让方始终享有在同等条件下优先认购与受让方持有标的公司股权比例等比例的增发股份/股权的权利。在签署本协议后、符合本协议其他约定的条件下，如出让方或原股东向公司原有股东以外第三方转让标的公司股权/股份的，应事先获得受让方同意，且受让方在同等条件下享有对拟转让股权/股份的优先购买权。
反稀释权	在签署本协议后、符合本协议其他约定的条件下，如标的公司向任何第三方无偿增发股份或将已有股份分拆，则受让方有权无偿获得按照与受让方持有标的公司股权比例相等的增发股份/分拆股份，以维持受让方持股比例不变。如标的公司以低于第 1.1 条估值增发股份/股权的，则受让方有权按照届时更低的估值无偿获得补偿股份/股权，以维持投资估值的一致性。
共同出售权	受让方有权选择在公司实际控制人出售其持有的全部或部分标的公司股权时，以实际控制人届时与第三方协定的价格和其他条件一并出售部分或全部持有的标的公司股权。
最惠待遇权	不论是否已经向受让方披露，受让方应自动享有标的公司、出让方和原股东之间，或与其他新股东之间签订的任何有关股东特别权利条款的约定或类似安排，包括但不限于购买股权、参与公司治理、收益分配、公司清算、获得商业机会、优先清算权。不论何种情形下，受让方作为标的公司股东享有的权利不得低于其他任何股东。

（2）特殊权利条款解除情况

2024 年 9 月，安吉辰丰将其持有的公司全部股份分别转让给金浦慕和、金海通，上述特殊权利条款全部解除。

2、2023 年 4 月，有限公司报告期内第一次增资约定的特殊权利条款及解除情况

（1）特殊权利条款约定情况

2023 年 3 月，发行人、罗超、昆山奔博、昆山美满、毕延文、安吉辰丰、新余极目、昆山合鸣与南京俱成、昆高新创投、昆山中觅、毅达众创、广发乾和签署了投资协议，约定了除罗超、昆山奔博外的其他股东享有优先认购权、优先购买权、随售权、反稀释权、清算优先权、同等待遇权、股权回售权、董事会观察员、知情权、检查监督权、公司核心人员的股份转让限制、股东会对公司重大事项表决权时对投资方的保护性机制等特殊权利，主要内容如下：

特殊权利	主要内容
优先认购权	本轮增资完成后，如标的公司对除原股东及本轮投资方之外的第三方增发股权，则在同等条件下，投资方股东享有优先于该第三方的认购权，按本协议约定执行的股权激励计划除外。
优先购买权	本轮增资完成后，如标的公司股东对除原股东及本轮投资方之外的第三方转让股权，则在同等条件下，投资方股东享有优先于该第三方的购买权，实际控制人或控股股东向员工持股平台或员工转让股份实施股权激励计划的除外。
随售权	本轮增资完成后，如实际控制人或昆山奔博对除原股东及本轮投资方之外的第三方转让股权，则投资方有权但无义务以相同的条件优先于拟转让股权的股东出售所持部分或全部公司股权，若实际控制人或控股股东向员工持股平台或员工转让股份实施股份激励计划的除外。
反稀释权	本投资协议签署之后，当公司再次增资时，再次投资的股权作价不得低于本轮投资价格，其他设定条件不得优于投资方在本协议项下的投资。如再次投资的股权作价低于各投资方初次获得公司股权时的单位价格，则该投资方有权以该次投资或其他方式股权融资的价格（以下简称“新低价格”）及条款为准作股权调整，以使得该投资方持有的经调整后公司股权的对应价格为新低价格。
清算优先权	若标的公司发生清算、清盘或解散时，若投资方不存在本协议约定的违约情形，投资方有权优先于标的公司实际控制人及控股股东按届时投资方持有公司股权比例进行资产分配。如由于法律规定导致各股东获得清算财产的顺序相同，实际控制人及控股股东同意在其因清算而获得的全部额度的范围内以无偿赠与方式尽力实现投资方获得投资本金及投资期间资金成本（按年利率 8%计算，单利）的退出，如无法满足上述金额的，投资方应按照届时持股比例对可分配财产进行分配。
同等待遇权	若公司在未来融资或既有融资中存在比本次投资交易更加优惠的条款，则投资方自动享受更优惠条款并将更优惠条款适用于投资方股权。
部分投资方的股权回售权	如遇有以下情形，本轮投资方及安吉辰丰、新余极目有权要求标的公司回购投资方届时持有的部分或全部股份或股权：（1）标的公司在 2026 年 12 月 31 日前未能完成境内证券市场首次公开发售（IPO）申报（不含北交所及新三板）；（如申报后主动撤回、不予受理、申请被终止审核或被否决、未通过审核等情形均视为未能按期完成申报）；（2）标的公司实际控制人丧失对标的公司的控制权；（3）标的公司提供的信

特殊权利	主要内容
	息资料存在披露严重不实，对投资方利益造成重大损失；（4）连续 2 年以上不召开年度股东（大）会及董事会，拒绝向股东提供财务报表；（5）其他股东提出回购要求。
董事会观察员	在本轮投资交割及之后，安吉辰丰有权指派一名董事会观察员，列席董事会会议，获得董事会成员有权获得的标的公司信息，并在董事会议或执行董事决定时对相关议题发表意见和建议，但不享有投票权。

（2）特殊权利条款解除情况

2024 年 2 月，发行人、罗超、昆山奔博、昆山美满、毕延文、安吉辰丰、新余极目、昆山合鸣与南京俱成、昆高新创投、昆山中觅、毅达众创、广发乾和签署了《终止协议》；2025 年 9 月，发行人、罗超、昆山奔博、昆山美满、毕延文、新余极目、昆山合鸣与南京俱成、昆高新创投、昆山中觅、毅达众创、广发乾和签署了《终止协议（二）》，约定上述特殊性权利条款自始无效且不得恢复。因此，上述特殊权利条款全部解除。

3、2024 年 9 月，猎奇有限报告期内第五次股权转让约定的特殊权利条款及解除情况

（1）特殊权利条款约定情况

2024 年 8 月，安吉辰丰与金海通签署股权转让协议，约定安吉辰丰以人民币 1,999.44 万元转让在公司的占注册资本 2.10%的股权（计 23.80 万元注册资本）给金海通。

2024 年 8 月，公司与金海通签署战略合作协议，约定：双方在技术、渠道、投资方面进行合作。在本战略合作协议生效后，如公司后续发生增资或股权变更等事项，金海通对公司在同等条件下享有优先收购权；如公司其他股东拥有比金海通更优惠的权利，则金海通应自动享有其他投资人在该等融资中取得和享有的相关条款和条件。

（2）特殊权利条款解除情况

2025 年 9 月，公司与金海通签署战略合作协议之补充协议，约定上述特殊性权利条款自始无效且不得恢复。因此，上述特殊权利条款全部解除。

4、2024 年 12 月，股份公司第二次增资约定的特殊权利条款及解除情况

（1）特殊权利条款约定情况

2024 年 12 月 16 日，金浦慕和、金海通、士兰控股、盛宇华天、全德学镂科芯、鸿溢盛朗、鸿溢盛越、玉澄德荃、鹏城愿景、士兰微、成都励石、上海励聚与罗超、昆山奔博及公司签署了投资协议，协议约定了优先认购权、优先购买权、优先出售权、转让限制、反稀释权、清算优先权、同等待遇权、股权回售权等股东特殊权利，主要内容如下：

特殊权利	主要内容
优先认购权	本轮投资完成后，如标的公司对除原股东及本轮投资方之外的第三方增发股份或发行任何股权类权益，则在同等条件下，本轮投资方享有优先于该第三方的认购权，按本协议约定执行的股权激励计划除外或本投资协议约定的其他例外情形除外。
优先购买权	本轮投资完成后，如标的公司股东对除原股东及本轮投资方之外的第三方转让股权，则在同等条件下，本轮投资方享有优先于该第三方的购买权，实际控制人或控股股东向员工持股平台或员工转让股份实施股权激励计划的除外。
优先出售权	本轮投资完成后，如实际控制人或控股股东对除原股东及本轮投资方之外的第三方转让股份，则本轮投资方有权但无义务以相同的条件优先于拟转让股份的股东出售所持部分或全部公司股份，若实际控制人或控股股东向员工持股平台或员工转让股份实施股份激励计划的除外或本投资协议约定的其他例外情形除外。
反稀释权	本投资协议签署之后，当公司再次增资或发行任何股权类权益时新增注册资本的新认购价格不得低于本轮投资价格,其他设定条件不得优于本轮投资方在本投资协议项下的投资。如再次融资的股份或发行任何股权类权益作价低于本轮投资方初次获得公司股份时的单位价格，则本轮投资方有权以该次投资或其他方式股份融资的价格（以下简称“新低价格”）及条款为准作股份调整以使得本轮投资方持有的经调整后公司股份的对应价格为新低价格。
清算优先权	若标的公司发生清算、清盘或解散时，若本轮投资方不存在本投资协议约定的违约情形，本轮投资方有权优先于标的公司实际控制人及控股股东按届时本轮投资方持有公司股份比例进行资产分配。投资方除了获得前述优先分配款外，还应享有按届时持股比例分配剩余财产。如由于法律规定导致各股东获得清算财产的顺序相同，实际控制人及控股股东同意在其因清算而获得的全部额度的范围内以无偿赠与方式尽力实现本轮投资方获得投资本金及投资期间资金成本（按年利率 8%计算，单利）的退出，如无法满足上述金额的，本轮投资方应按照届时持股比例对可分配财产进行分配。未免歧义，本轮投资方在持股期间已经获得的分红，应当予以扣除（如有）。
同等待遇权	若公司在未来融资或既有融资中存在比本轮投资更加优惠的条款，则本轮投资方自动享受更优惠条款并将更优惠条款适用于本轮投资方股份。
股权回售权	如遇有以下情形，本轮投资方有权要求标的公司和/或实际控制人回购本轮投资方届时持有的部分或全部股份：（1）公司未能在 2026 年 12 月 31 日前向证券交易所（包括中国上海证券交易所、深圳证券交易所）提

特殊权利	主要内容
	交上市申请或者并购重组申请并获得受理的（为避免疑义，提交上市申请日以证券交易所上市申请材料受理日为准，并购重组申请日以相关上市公司审议并购重组事项的董事会决议公告日为准）；（2）标的公司实际控制人丧失对标的公司的控制权，包括但不限于 i）实际控制人在董事会控制的席位低于一半；ii）实际控制人或其控制的主体丧失标的公司第一大股东地位；（3）标的公司提供的信息资料存在披露严重不实，对本轮投资方利益造成重大损失；（4）拒绝向股东提供财务报表，或连续 2 年以上不召开年度股东会及董事会；（5）其他股东提出回购要求。

除上述特殊性权利条款外，该投资协议还约定了投资方享有的知情权、检查监督权、实际控制人及员工持股平台的股份转让限制、股东会对公司重大事项表决时对投资方的保护性机制。

（2）特殊性权利条款解除情况

2025 年 9 月及 11 月，金浦慕和、金海通、士兰控股、盛宇华天、全德学镂科芯、鸿溢盛朗、鸿溢盛越、玉澄德菉、鹏城愿景、士兰微、成都励石、上海励聚分别与罗超、昆山奔博及公司签署了终止协议，约定上述特殊性权利条款自始无效且不得恢复。因此，上述特殊权利条款全部解除。

综上，发行人上述涉及的特殊权利条款均已在申报受理前解除并确认自始无效，发行人与相关主体签署的终止条款合法有效，不存在特定情况下将自动恢复执行的安排，不存在其他替代性利益安排。

（七）发行人历史沿革中委托持股的演变过程及还原情况

发行人历次股本演变过程中，直接股东层面不存在股权代持关系，间接股东层面曾存在股权代持关系。截至本招股意向书签署日，该等代持已解除。

1、历史股东西安正奇间接投资人的股权代持及解除过程

（1）股权代持形成的背景

2015 年 8 月，毕延文准备设立有限合伙企业进行科技领域投资。有限合伙企业设立至少需两名合伙人，毕延文考虑到井伟具备相关背景，经与井伟商议，借用井伟名义作为该合伙企业的另一名合伙人，出资设立西安正奇。

2015 年 8 月，毕延文、井伟出资设立西安正奇，相关情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资（万元）	出资比例（%）
1	毕延文	普通合伙人	100.00	20.00
2	井伟	有限合伙人	400.00	80.00
合计			**500.00**	**100.00**

上述安排中存在代持行为，具体情况为：井伟持有的西安正奇合伙份额系为毕延文代持。

2015 年 11 月，西安正奇与罗超、徐凯、刘鸿铭、宋玉华共同出资设立了猎奇有限，其中西安正奇认缴 100.00 万元注册资本（占总注册资本的 20.00%）。

（2）股权代持的演变及解除过程

2015 年 12 月，猎奇有限注册资本从 500.00 万元增加至 1,000.00 万元，其中西安正奇同比例增加认缴 100.00 万元。本次注册资本增加后，西安正奇持有猎奇有限 200.00 万元注册资本（占总注册资本的 20.00%）。2021 年 2 月，毕延文为规范持股，和井伟协商解除代持，井伟将持有的西安正奇合伙份额转让给毕延文及其配偶李侠。本次合伙份额转让完成后，上述代持关系解除并清理。

2、历史股东安吉辰丰间接投资人的股权代持及解除过程

（1）股权代持的形成

2022 年 2 月 18 日，安吉辰丰与西安正奇、罗超、昆山奔博签署股权转让协议，约定西安正奇将其持有的公司 4.00%股权（对应出资额 40.00 万元）转让给安吉辰丰。

安吉辰丰的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资（万元）	出资比例（%）	穿透后股东
1	安吉秋实	普通合伙人	1.00	0.03	王华、曾晨
2	安吉励欣	有限合伙人	2,999.00	99.97	王华、曾晨
合计			**3,000.00**	**100.00**	-

上述股权转让中存在代持行为。考虑到实际持有人日常公务繁忙，客观上无法及时亲自办理工商设立手续，遂委托王华、曾晨代为设立投资平台安吉辰丰，用于对外投资。实际持有人已分别与王华、曾晨签订代持协议，王华、曾晨自愿无偿接受相关委托并同意按相关条款约定受托代为行使该代持份额所涉

相关合伙人权利、遵守相关义务。

（2）股权代持的演变及解除

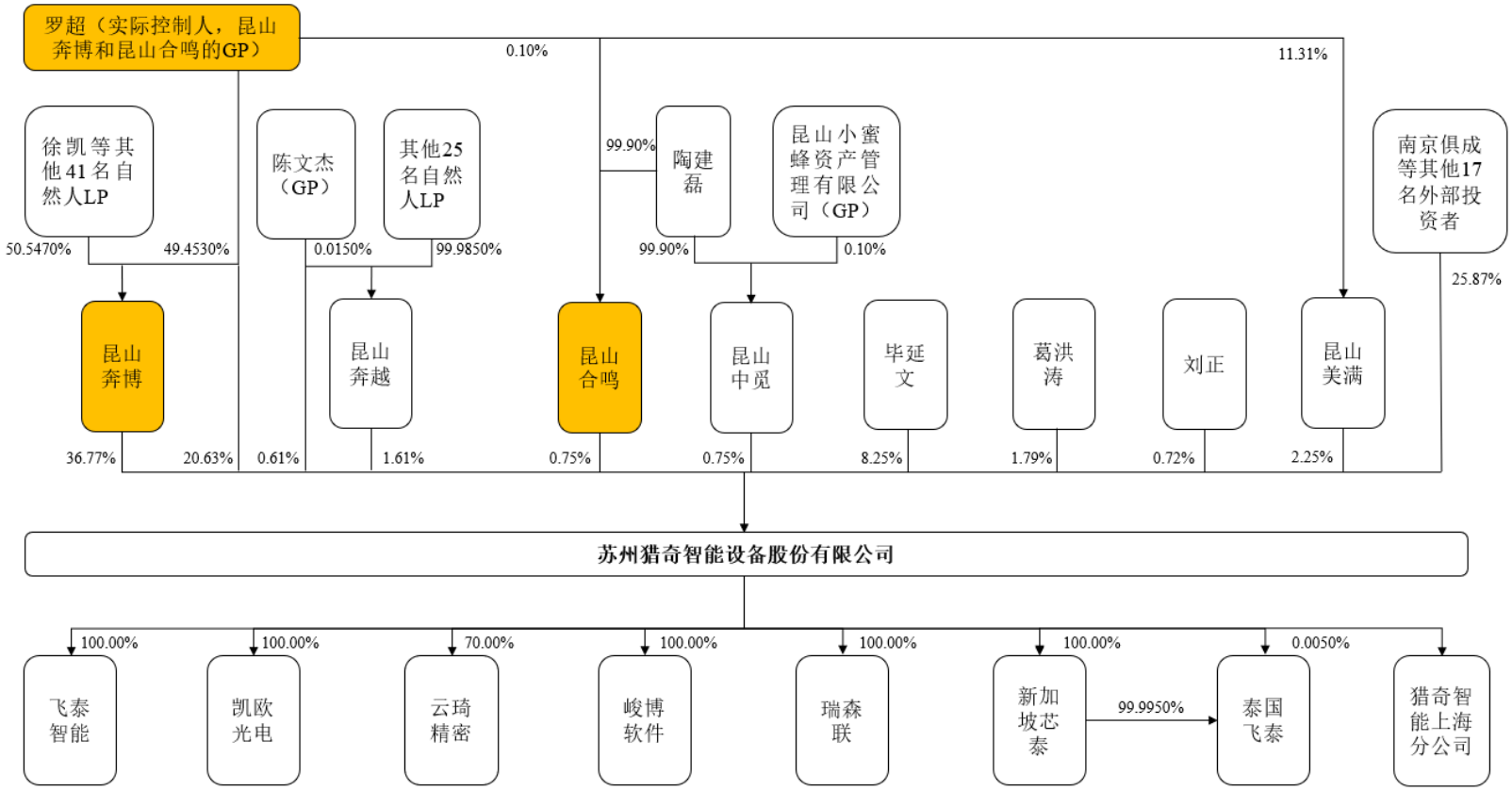
安吉辰丰入股公司后的股权演变情况，详见本节“二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况”之“（三）报告期内的股本和股东变化情况”。

2024 年 8 月，安吉辰丰与金浦慕和签署股权转让协议，约定安吉辰丰将其所持有的公司 1.43%股权（对应出资额 16.20 万元）转让给金浦慕和；安吉辰丰与金海通签署股权转让协议，约定安吉辰丰将其所持有的公司 2.10%股权（对应出资额 23.80 万元）转让给金海通。公司召开股东会并决议通过上述股权转让事宜。金浦慕和、金海通已按照协议的约定支付了全部转让价款。本次股权转让完成后，上述代持关系解除并清理。

综上所述，发行人历史上存在的上述股权代持情况已解除，相关方不存在任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷，不存在委托持股、利益输送或者其他利益安排；上述股权代持关系及其解除过程不会对发行人现有的股权结构稳定性造成影响，对发行人本次发行不会造成障碍。

三、发行人股权结构

截至本招股意向书签署日，公司的股权结构图如下：



四、发行人控股子公司、参股公司及分公司

截至本招股意向书签署日，公司拥有 4 家境内全资子公司、1 家境内控股子公司、2 家境外全资子公司，1 家分公司，无参股公司。具体情况如下：

（一）重要子公司

公司将最近一期经审计营业收入、净利润、总资产、净资产中任一指标占最近一期经审计合并报表相应财务指标 10%以上，且经营业务、未来发展战略、持有资质或证照对公司具有重要影响的子公司视为重要子公司。依据上述标准，公司综合认定飞泰智能为重要子公司。

1、基本情况

截至本招股意向书签署日，飞泰智能基本情况如下：

企业名称	武汉飞泰智能设备有限公司
统一社会信用代码	91420114MA4KXQKF3L
注册地/主要生产经营地	武汉市蔡甸区大集街竹林四路 79 号
法定代表人	罗超
成立日期	2018 年 2 月 6 日
注册资本	1,000.00 万元
实收资本	1,000.00 万元
股权结构	猎奇智能持股 100%
主营业务/业务定位	光模块封装测试设备、自动化设备及整线解决方案

2、简要财务数据

飞泰智能最近一年一期的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月/2026 年 6 月 30 日	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产	34,665.99	29,268.02
净资产	9,479.40	7,766.82
营业收入	8,912.38	17,555.02
净利润	1,632.25	3,708.40

注：上述财务数据经容诚会计师审计。

（二）其他子公司及参股公司、分公司情况

截至报告期末，公司其他子公司及参股公司、分公司的基本情况如下：

序号	公司名称	股权结构	发行人认缴出资总额	入股时间	主营业务/业务定位
1	凯欧光电	猎奇智能持股 100%	1,000.00 万元	2023 年 12 月	机加工业务
2	峻博软件	猎奇智能持股 100%	500.00 万元	2020 年 10 月	设备软件开发
3	瑞森联	猎奇智能持股 100%	1,000.00 万元	2024 年 3 月	激光设备的研发、生产和销售
4	云琦精密	猎奇智能持股 70%，李慧持股 15%，边小社持股 10%，马雪毅持股 5%	1,000.00 万元	2021 年 10 月	陶瓷劈刀技术的研发、生产及销售
5	新加坡芯泰	猎奇智能持股 100%	2.00 万新加坡元	2023 年 8 月	海外研发和销售中心
6	泰国飞泰	新加坡芯泰持股 99.9950%，猎奇智能持股 0.0050%	3,150.00 万泰铢	2023 年 8 月	海外生产加工、售后服务基地
7	猎奇智能上海分公司	-	-	2024 年 5 月	无实际经营

五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东和实际控制人基本情况

1、控股股东

截至本招股意向书签署日，昆山奔博直接持有公司 1,516.58 万股股权，占公司总股本的 36.77%，为公司控股股东。

昆山奔博系公司员工持股平台，截至本招股意向书签署日，昆山奔博涉及激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员等。罗超担任普通合伙人、执行事务合伙人。

截至 2026 年 6 月 30 日，昆山奔博的基本情况如下：

企业名称	昆山奔博投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320583MA1MAX5991
机构类型	有限合伙企业
注册地/主要生产经营地	昆山市花桥镇金捷路 1 号 7 号房 A036（集群登记）
执行事务合伙人	罗超

成立日期	2015 年 11 月 6 日
注册资本	490.00 万元人民币
实收资本	490.00 万元人民币
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务为股权投资管理，系发行人员工持股平台

截至 2026 年 6 月 30 日，昆山奔博出资人构成和出资比例如下：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	罗超	242.32	49.45%	普通合伙人
2	徐凯	87.44	17.84%	有限合伙人
3	宋玉华	45.06	9.20%	有限合伙人
4	刘鸿铭	43.32	8.84%	有限合伙人
5	葛宏涛	11.00	2.24%	有限合伙人
6	杜杆	7.26	1.48%	有限合伙人
7	徐飞	6.79	1.39%	有限合伙人
8	李文明	4.95	1.01%	有限合伙人
9	陈文杰	4.76	0.97%	有限合伙人
10	张学良	3.01	0.61%	有限合伙人
11	李珂	3.01	0.61%	有限合伙人
12	颜喜勇	2.83	0.58%	有限合伙人
13	程显	2.50	0.51%	有限合伙人
14	史文浩	2.26	0.46%	有限合伙人
15	谢强	2.00	0.41%	有限合伙人
16	韦亮	1.70	0.35%	有限合伙人
17	熊加金	1.57	0.32%	有限合伙人
18	吕延安	1.50	0.31%	有限合伙人
19	周相一	1.13	0.23%	有限合伙人
20	胡志南	1.13	0.23%	有限合伙人
21	彭德应	1.00	0.20%	有限合伙人
22	王振义	1.00	0.20%	有限合伙人
23	孟和法	1.00	0.20%	有限合伙人
24	余闯	1.00	0.20%	有限合伙人
25	柏誉	1.00	0.20%	有限合伙人
26	陈亮	0.57	0.12%	有限合伙人

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
27	陈庆东	0.57	0.12%	有限合伙人
28	贺锐	0.57	0.12%	有限合伙人
29	蒋洪亚	0.57	0.12%	有限合伙人
30	丁香萍	0.57	0.12%	有限合伙人
31	雷雨	0.57	0.12%	有限合伙人
32	李原钦	0.57	0.12%	有限合伙人
33	张维	0.57	0.12%	有限合伙人
34	熊晖	0.57	0.12%	有限合伙人
35	熊静	0.57	0.12%	有限合伙人
36	高宇	0.57	0.12%	有限合伙人
37	倪杰	0.57	0.12%	有限合伙人
38	陈世先	0.57	0.12%	有限合伙人
39	刘乃辉	0.57	0.12%	有限合伙人
40	李方方	0.57	0.12%	有限合伙人
41	于长君	0.50	0.10%	有限合伙人
42	彭小芳	0.50	0.10%	有限合伙人
合计		**490.00**	**100.00%**	

2、实际控制人

截至本招股意向书签署日，罗超直接持有猎奇智能 20.63%的股权，通过昆山奔博间接控制猎奇智能 36.77%的表决权，通过昆山合鸣间接控制猎奇智能 0.75%的表决权，合计控制发行人 58.15%的表决权。同时，罗超担任公司董事长和总经理，能够对发行人的日常经营和重大决策产生重大影响，系发行人的实际控制人。

罗超先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号为 4201141981********。2001 年 2 月至 2005 年 10 月，任鸿准精密模具（昆山）有限公司自动化部机械设计工程师；2005 年 10 月至 2006 年 3 月，筹划创业；2006 年 3 月至今，任昆山市玉山镇弘诚翔模具厂经营者；2012 年 4 月至今，任凯欧光电执行董事、总经理；2015 年 11 月至 2024 年 8 月，任猎奇有限执行董事、总经理；2024 年 8 月至 2024 年 10 月，任猎奇有限执行公司事务的董事、总经理；2024 年 10 月至今，任猎奇智能董事长、执行公司事务的董

事、总经理。

（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本招股意向书签署日，公司控股股东及实际控制人持有的公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况

截至本招股意向书签署日，除昆山奔博及罗超外，其他持有公司 5%以上股份或表决权的主要股东具体情况如下：

1、毕延文

截至本招股意向书签署日，毕延文先生直接持有公司 8.25%股权。

毕延文先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，身份证号为 5101081977********。2000 年 7 月至 2001 年 1 月，任深圳市 TCL 通信技术有限公司研发部工程师；2001 年 1 月至 2001 年 10 月，任华为技术有限公司研发部工程师；2001 年 10 月至 2002 年 8 月，备考全国硕士研究生统一招生考试；2002 年 8 月至 2005 年 3 月，于西安电子科技大学攻读硕士学位；2005 年 4 月至 2006 年 7 月，任英飞凌科技（西安）有限公司研发部工程师；2006 年 7 月至 2009 年 4 月，任奇梦达科技（西安）有限公司研发部工程师；2009 年 4 月至 2011 年 3 月，系自行创业；2011 年 4 月至 2015 年 11 月，任西安禾隽电子科技有限公司执行董事；2015 年 11 月至今，任伽蓝致远董事长；2017 年 7 月至今，任伽蓝致远总经理；2015 年 11 月至 2024 年 10 月，任猎奇有限监事；2024 年 10 月至今，任猎奇智能董事。

2、徐凯

截至本招股意向书签署日，徐凯通过昆山奔博间接持有公司 6.56%股权。

徐凯先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，身份证号为 4201141982********。2001 年 6 月至 2012 年 6 月，任鸿准精密模具（昆山）有限公司自动化部职员；2012 年 6 月至 2015 年 10 月，任凯欧光电设备开发部主管；2015 年 11 月至 2024 年 10 月；任猎奇有限销售副总经理；

2024 年 10 月至今，任猎奇智能董事、副总经理。

六、发行人特别表决权股份或类似安排情况

截至本招股意向书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

七、发行人协议控制架构情况

截至本招股意向书签署日，公司不存在协议控制架构情况。

八、控股股东和实际控制人报告期内违法违规情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

九、发行人股本情况

（一）本次发行前总股本、本次发行及公开发售的股份，以及本次发行及公开发售的股份占发行后总股本的比例

公司本次发行前总股本为 4,125.00 万股。公司本次拟公开发行股票 1,375.00 万股，全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形。公司发行后总股本为 5,500.00 万股，发行完成后公开发行股份数占发行后总股本的比例为 25.00%。发行前后公司的股本结构变化情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	昆山奔博	1,516.58	36.77%	1,516.58	27.57%
2	罗超	851.14	20.63%	851.14	15.48%
3	毕延文	340.46	8.25%	340.46	6.19%
4	南京俱成	141.86	3.44%	141.86	2.58%
5	广发乾和	128.96	3.13%	128.96	2.34%
6	昆高新创投	103.17	2.50%	103.17	1.88%
7	昆山美满	92.85	2.25%	92.85	1.69%
8	金浦慕和	81.14	1.97%	81.14	1.48%

序号	股东名称	发行前股本结构		发行后股本结构	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
9	毅达众创	77.38	1.88%	77.38	1.41%
10	金海通	73.66	1.79%	73.66	1.34%
11	葛宏涛	73.66	1.79%	73.66	1.34%
12	士兰控股	70.00	1.70%	70.00	1.27%
13	昆山奔越	66.51	1.61%	66.51	1.21%
14	新余极目	61.90	1.50%	61.90	1.13%
15	盛宇华天	56.00	1.36%	56.00	1.02%
16	全德学镂科芯	52.50	1.27%	52.50	0.95%
17	鸿溢盛朗	38.50	0.93%	38.50	0.70%
18	鸿溢盛越	35.00	0.85%	35.00	0.64%
19	玉澄德菉	35.00	0.85%	35.00	0.64%
20	鹏城愿景	35.00	0.85%	35.00	0.64%
21	士兰微	35.00	0.85%	35.00	0.64%
22	成都励石	33.60	0.81%	33.60	0.61%
23	昆山中觅	30.95	0.75%	30.95	0.56%
24	昆山合鸣	30.95	0.75%	30.95	0.56%
25	刘正	29.83	0.72%	29.83	0.54%
26	陈文杰	25.00	0.61%	25.00	0.45%
27	上海励聚	8.40	0.20%	8.40	0.15%
28	社会公众股东	-	-	1,375.00	25.00%
合计		**4,125.00**	**100.00%**	**5,500.00**	**100.00%**

（二）本次发行前的前十名股东

截至本招股意向书签署日，公司股本总数为 4,125.00 万股，其中前十名股东情况如下表所示：

单位：万股

序号	股东名称/姓名	持股数量	持股比例（%）
1	昆山奔博	1,516.58	36.77
2	罗超	851.14	20.63
3	毕延文	340.46	8.25
4	南京俱成	141.86	3.44
5	广发乾和	128.96	3.13

序号	股东名称/姓名	持股数量	持股比例（%）
6	昆高新创投	103.17	2.50
7	昆山美满	92.85	2.25
8	金浦慕和	81.14	1.97
9	毅达众创	77.38	1.88
10	金海通	73.66	1.79
合计		**3,407.20**	**82.60**

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股意向书签署日，公司股本总数为 4,125.00 万股，其中前十名自然人股东及在发行人处担任的职务情况如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例	担任职务
1	罗超	851.14	20.63%	董事长、总经理
2	毕延文	340.46	8.25%	董事
3	葛宏涛	73.66	1.79%	研发总监兼研发一部负责人
4	刘正	29.83	0.72%	副总经理、财务负责人、董事会秘书
5	陈文杰	25.00	0.61%	副总经理
合计		**1,320.09**	**32.00%**	-

（四）国有股东或外资股东持股情况

1、国有股东持股情况

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第 36 号）、《关于进一步明确非上市股份有限公司国有股权管理有关事项的通知》（国资厅产权〔2018〕760 号）的相关规定，昆高新创投在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“SS”（State-owned Shareholder，国有股东）标识。

2025 年 4 月 28 日，江苏省国资委出具《江苏省国资委关于苏州猎奇智能设备股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复》（苏国资复[2025]22 号），猎奇智能股份如在境内发行股票并上市，昆高新创投在中国证券登记结算有限责任公司登记的证券账户标注 SS。公司已取得有关主管部门对国有股份的设置批复文件。

昆高新创投直接持有公司股份数量及持股比例情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	昆高新创投（SS）	103.17	2.50%
合计		**103.17**	**2.50%**

2、外资股东持股情况

截至本招股意向书签署日，公司不存在外资股份。

（五）申报前十二个月发行人新增股东情况

1、申报前十二个月新增股东的入股原因、入股价格及定价依据

申报前十二个月，公司新增 11 名股东，均非战略投资者，入股原因主要系看好行业及公司发展，具体取得股份的方式、时间、持股数量及取得股权价格的情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	取得方式	持股比例		取得时间	出资价格（元/股）	定价依据
			投资金额	对应注册资本			
1	金浦慕和	增资	885.71	31.00	2024 年 12 月	28.57	基于公司当时的经营发展状况，并考虑到公司未来的发展前景，经各方协商一致后，按照 10 亿元估值定价
2	士兰控股		2,000.00	70.00			
3	盛宇华天		1,600.00	56.00			
4	全德学镂科芯		1,500.00	52.50			
5	鸿溢盛朗		1,100.00	38.50			
6	鸿溢盛越		1,000.00	35.00			
7	玉澄德菉		1,000.00	35.00			
8	鹏城愿景		1,000.00	35.00			
9	士兰微		1,000.00	35.00			
10	成都励石		960.00	33.60			
11	上海励聚		240.00	8.40			

2、申报前十二个月新增股东的基本情况

关于申报前十二个月新增股东的基本情况，详见本招股意向书“第十二节 附件”之“附件六：申报前十二个月新增股东的基本情况”。

3、申报前十二个月新增股东与发行人其他股东、董事、监事（审计委员会委员）、高级管理人员是否存在关联关系

申报前十二个月新增股东与公司其他股东的关联关系详见本节“九、发行人股本情况”之“（六）本次发行前各股东之间的关联关系、一致行动关系及持股比例”。

申报前十二个月新增股东与公司董事、监事（审计委员会委员）、高级管理人员不存在关联关系。

4、申报前十二个月新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系，新增股东是否存在股份代持情形

截至本招股意向书签署日，国泰海通全资子公司国泰君安创新投资有限公司存在通过直接或间接方式持有国泰君安母基金份额的情形，而国泰君安母基金持有发行人股东全德学镂科芯 8.5332%份额，国泰海通因此间接持有发行人0.0541%股份。此外，国泰海通实际控制人上海国际集团有限公司通过直接持有国泰君安母基金份额，间接持有发行人 0.0203%股份。上海国际集团有限公司与国泰海通合计持有发行人股份不超过 0.1%。

除上述情形外，申报前十二个月新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在其他关联关系，亦不存在股份代持的情形。

（六）本次发行前各股东之间的关联关系、一致行动关系及持股比例

本次发行前公司各股东之间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自的持股比例如下：

序号	股东名称	持股比例	股东间关联关系
1	昆山奔博	36.77%	罗超系昆山奔博的执行事务合伙人及第一大合伙人，罗超系昆山合鸣的执行事务合伙人
	罗超	20.63%	
	昆山合鸣	0.75%	
2	昆山奔越	1.61%	陈文杰系昆山奔越的执行事务合伙人
	陈文杰	0.61%	
3	昆山合鸣	0.75%	陶建磊分别持有昆山合鸣、昆山中觅 99.90%合伙份额
	昆山中觅	0.75%	

序号	股东名称	持股比例	股东间关联关系
4	士兰控股	1.70%	1、士兰控股由杭州士兰控股有限公司 100%持股，杭州士兰控股有限公司持有士兰微 30.88%股权，为其第一大股东； 2、鹏城愿景的私募投资基金管理人浙江银杏谷投资有限公司的董事兼总经理陈向明，同时担任士兰控股的总经理
	士兰微	0.85%	
	鹏城愿景	0.85%	
5	鸿溢盛朗	0.93%	双方执行事务合伙人、私募投资基金管理人均为上海襄聚私募基金管理有限公司
	鸿溢盛越	0.85%	
6	成都励石	0.81%	成都励石的执行事务合伙人为成都励赞企业管理合伙企业（有限合伙），上海励聚的执行事务合伙人为上海励烁企业管理合伙企业（有限合伙），成都励赞企业管理合伙企业（有限合伙）与上海励烁企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、私募投资基金管理人均为北京励石投资管理有限公司
	上海励聚	0.20%	
7	金浦慕和	1.97%	金浦慕和与截至 2026 年 6 月 30 日的金海通前十大股东之一上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）拥有共同的执行事务合伙人上海金浦新朋投资管理有限公司
	金海通	1.79%	

注：显鋆（上海）投资管理有限公司已更名为上海襄聚私募基金管理有限公司。

除上述情况外，公司各股东之间不存在其他关联关系。

（七）本次公开发行对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响

本次发行前公司总股本为 4,125.00 万股。本次发行 1,375.00 万股，公司本次发行后总股本为 5,500.00 万股，发行完成后公开发行股份数占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行上市后，公司的股权结构不会发生重大变化，实际控制人不会发生变更，亦不会对公司治理结构及生产经营产生重大不利影响。

（八）私募投资基金股东情况

截至本招股意向书签署日，公司共有 27 名股东，其中 12 名股东属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规所规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，该等股东的私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案情况如下：

序号	股东名称	私募投资基金备案编号	私募投资基金管理人名称	管理人登记编号
1	南京俱成	SNC449	南京俱成股权投资管理有限公司	P1069480
2	金浦慕和	SXT906	上海金浦新朋私募基金管理有限公司	P1033734
3	毅达众创	SXC651	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	P1032972
4	新余极目	SLJ847	海南芯禾私募基金管理合伙企业（有限合伙）	P1072962
5	盛宇华天	STH381	上海盛宇股权投资基金管理有限公司	P1001088
6	全德学镂科芯	SZL400	全德学尔私募基金管理（上海）有限公司	P1071902
7	鸿溢盛朗	SB4066	上海襄聚私募基金管理有限公司	P1069965
8	鸿溢盛越	SAAH65	上海襄聚私募基金管理有限公司	P1069965
9	玉澄德菉	SAKE83	昆山市国科创业投资有限公司	P1066716
10	鹏城愿景	SADJ88	浙江银杏谷投资有限公司	P1003808
11	成都励石	SB1172	北京励石投资管理有限公司	P1071072
12	上海励聚	SSJ450	北京励石投资管理有限公司	P1071072

十、董事、高级管理人员及其他核心人员情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于取消公司监事会并制定、修改相关内部治理制度的议案》，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司现任董事会审计委员会成员由上官胜、张莉、程显组成，由上官胜担任召集人。

截至本招股意向书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况如下：

（一）公司董事会成员

截至本招股意向书签署日，公司董事会由 7 名董事组成，包括 3 名独立董事，现任董事会成员具体情况如下：

序号	姓名	任职情况	提名人	任期
1	罗超	董事长、总经理	昆山奔博	2024 年 10 月至 2027 年 10 月
2	徐凯	董事、副总经理	昆山奔博	2024 年 10 月至 2027 年 10 月

序号	姓名	任职情况	提名人	任期
3	毕延文	董事	昆山奔博	2024 年 10 月至 2027 年 10 月
4	程显	职工代表董事	职工代表大会	2026 年 5 月至 2027 年 10 月
5	张荣君	独立董事	董事会	2024 年 12 月至 2027 年 10 月
6	张莉	独立董事	董事会	2024 年 12 月至 2027 年 10 月
7	上官胜	独立董事	董事会	2024 年 12 月至 2027 年 10 月

公司现任董事简历如下：

1、罗超

罗超先生，简历详见本节“五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”之“2、实际控制人”。

2、徐凯

徐凯先生，简历详见本节“五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”之“2、徐凯”。

3、毕延文

毕延文先生，简历详见本节“五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”之“1、毕延文”。

4、程显

程显先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2013 年 1 月，任昆山康龙电子科技有限公司技术部门技术员；2013 年 3 月至 2015 年 11 月，任凯欧光电生产部职员；2015 年 11 月至 2024 年 10 月，历任猎奇有限生产部生产经理、销售经理；2024 年 10 月至 2026 年 5 月，任猎奇智能销售经理、监事会主席；2026 年 5 月至今，任猎奇智能销售经理、职工代表董事。

5、张荣君

张荣君先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

1999 年 7 月至今，历任复旦大学信息科学与工程学院副书记、副院长，复旦大学科学技术研究院产学研合作处处长，复旦大学工程与应用技术研究院副院长，复旦大学生物医学工程与技术创新学院副院长；2021 年 10 月至今，任钰泰半导体股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今，任猎奇智能独立董事。

6、张莉

张莉女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位。2011 年 6 月至 2012 年 6 月，任苏州市吴江生态环境局法治宣传科办事员；2012 年 6 月至今，历任江苏剑桥颐华律师事务所律师助理、律师、合伙人、高级合伙人；2019 年 10 月至 2025 年 11 月，任苏州万祥科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今，任猎奇智能独立董事。

7、上官胜

上官胜先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 7 月至 2008 年 12 月，任大连东展集团有限公司财务部税务会计；2009 年 1 月至 2012 年 12 月，任大信会计师事务所有限公司上海分公司审计部项目经理；2013 年 1 月至 2015 年 5 月，任中汇会计师事务所有限公司上海分所审计部经理；2015 年 6 月至今，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计部项目经理、高级经理、合伙人；2022 年 6 月至今，任上海派智能源股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今，任猎奇智能独立董事。

（二）公司高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。截至本招股意向书签署日，公司现任高级管理人员 5 名，具体情况如下：

序号	姓名	任职情况	任期
1	罗超	董事长、总经理	2024 年 10 月至 2027 年 10 月
2	宋玉华	副总经理	2024 年 10 月至 2027 年 10 月
3	徐凯	董事、副总经理	2024 年 10 月至 2027 年 10 月
4	陈文杰	副总经理	2024 年 10 月至 2027 年 10 月
5	刘正	副总经理、董事会秘书兼财务负责人	2024 年 10 月至 2027 年 10 月

公司高级管理人员简历如下：

1、罗超先生，简历详见本节“五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”之“2、实际控制人”。

2、宋玉华先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2004 年 9 月，任德昌电机（深圳）有限公司生产工程部工程师；2004 年 9 月至 2015 年 11 月，历任博世汽车部件（苏州）有限公司汽车电子控制器研发部研发工程师、博世电池系统研发部项目经理；2015 年 11 月至 2024 年 10 月；历任猎奇有限项目总监、副总经理；2024 年 10 月至 2026 年 5 月，任猎奇智能董事；2024 年 10 月至今，任猎奇智能副总经理。

3、徐凯先生，简历详见本节“五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”之“2、徐凯”。

4、陈文杰先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2019 年 2 月，任上海新宇箴诚电控科技有限公司项目部大客户经理；2019 年 3 月至 2024 年 10 月，任猎奇有限运营副总经理；2024 年 10 月至 2024 年 12 月，任猎奇智能董事、副总经理；2024 年 10 月至今，任猎奇智能副总经理。

5、刘正先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015 年 8 月至 2023 年 11 月，任光大证券股份有限公司投资银行部资深项目经理；2023 年 11 月至 2024 年 10 月，任职于猎奇有限；2024 年 10 月至今，任猎奇智能副总经理、财务负责人、董事会秘书。

（三）核心技术人员

截至本招股意向书签署日，公司现任核心技术人员 4 名，具体情况如下：

序号	姓名	职位
1	葛宏涛	猎奇智能研发总监兼研发一部负责人
2	张学良	猎奇智能研发一部经理
3	李珂	猎奇智能研发一部软件研发经理
4	刘鸿铭	猎奇智能研发二部技术总监

1、葛宏涛先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2016 年 3 月，任富鼎电子科技（嘉善）有限公司自动化设备开发部门课长；2016 年 3 月至 2024 年 1 月，任公司研发总监；2024 年 1 月至今，任公司研发总监兼研发一部负责人。

2、张学良先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2019 年 3 月，任富鼎电子科技（嘉善）有限公司自动化部设计课长；2019 年 3 月至今，历任公司研发产品经理、研发一部经理。

3、李珂先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 6 月至 2018 年 5 月，任武汉亚为电子科技有限公司研发部项目经理；2018 年 6 月至 2023 年 2 月，任公司软件研发经理；2023 年 3 月至 2025 年 12 月，任飞泰智能光谷研发中心经理；2026 年 1 月至今，任公司研发一部软件研发经理。

4、刘鸿铭先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 8 月至 2012 年 5 月，任鸿准精密模具（昆山）有限公司自动化部门工程师；2012 年 5 月至 2015 年 12 月，任凯欧光电自动化部门技术总监；2015 年 12 月至今，历任公司高级工程师、研发二部技术总监。

（四）董事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况

截至本招股意向书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况（在发行人及其子公司的任职除外）如下：

姓名	在发行人任职职务	其他任职单位	职务	任职单位与发行人关系
罗超	董事长、总经理	昆山奔博	执行事务合伙人	公司股东
		昆山合鸣	执行事务合伙人	公司股东
		昆山市玉山镇弘诚翔模具厂	主要经营者	公司实际控制人罗超为其主要经营者，系发行人关联方
毕延文	董事	苏州正合鼎力企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司董事毕延文持有 28.03%合伙份额并担任执行事务合伙人的企业，系发行人关联方
		苏州正合鼎欣企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司董事毕延文持有 13.00%合伙份额并担任执行事务合伙人的企业，系发行人关联方
		苏州正合鼎越企业管理合伙企业（有	执行事务合伙人	公司董事毕延文持有 1.95%合伙份额并担任执行事务合伙人的企

姓名	在发行人任职职务	其他任职单位	职务	任职单位与发行人关系
		限合伙）		业，系发行人关联方
		苏州正合致远投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司董事毕延文持有 80.00%合伙份额并担任执行事务合伙人的企业，系发行人关联方
		苏州榕创企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司董事毕延文持有 3.66%合伙份额并担任执行事务合伙人的企业，系发行人关联方
		西安正奇	执行事务合伙人	公司董事毕延文直接持有 80.00%合伙份额并担任执行事务合伙人的企业，系发行人关联方
		珠海智博驿科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司董事毕延文持有 0.41%合伙份额并担任执行事务合伙人的企业，系发行人关联方
		迈时光电	董事长、总经理	公司董事毕延文直接持有 25.49%股权，并担任董事长、总经理的企业，系发行人关联方
		陕西正合	执行董事、总经理	迈时光电的全资子公司，且公司董事毕延文担任执行董事、总经理的企业，系发行人关联方
		成都迈时光电有限公司	董事	迈时光电的全资子公司，且公司董事毕延文担任董事的企业，系发行人关联方
		珠海迈时	执行董事、总经理	迈时光电的全资子公司，且公司董事毕延文担任执行董事、总经理的企业，系发行人关联方
		苏州迈时	董事	珠海迈时的全资子公司，且公司董事毕延文担任董事，系发行人关联方
		苏州众为光电有限公司	执行董事、总经理	迈时光电的全资子公司，且公司董事毕延文担任执行董事、总经理的企业，系发行人关联方
		成都飞锐特科技有限公司	董事	迈时光电的全资子公司，且公司董事毕延文担任董事的企业，系发行人关联方
陈文杰	副总经理	昆山奔越	执行事务合伙人	公司股东
张荣君	独立董事	钰泰半导体股份有限公司	独立董事	无
上官胜	独立董事	上海派智能源股份有限公司	独立董事	无

除上述人员外，公司董事、高级管理人员与其他核心人员不存在其他兼职情况。

（五）董事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系

截至本招股意向书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员之间

不存在亲属关系。

（六）最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

最近三年，公司董事、高级管理人员与其他核心人员无行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

十一、董事、高级管理人员及其他核心人员签订的重要协议和作出的重要承诺及履行情况

公司与除独立董事之外的其他董事、高级管理人员及其他核心人员签订了《劳动合同书》和《保密、知识产权及竞业限制协议》，与独立董事签署了《独立董事聘任协议书》。为建立健全激励约束长效机制，吸引和留住优秀人才，公司进行了股权激励，作为股权激励对象的董事、高级管理人员及其他核心人员与公司签署了《股权激励协议》。截至本招股意向书签署日，上述合同及协议均有效执行。除上述协议外，公司董事、高级管理人员和其他核心人员未与公司签订对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的其他协议。

董事、高级管理人员作出的重要承诺详见本招股意向书“第十二节 附件”之“附件一：重要承诺”。

十二、董事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况

截至本招股意向书签署日，董事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接及间接持有公司股份的情况如下：

单位：万股

序号	姓名	直接持股		间接持股	
		持股数	持股比例	持股数	持股比例
1	罗超	851.14	20.63%	760.53	18.44%
2	徐凯	-	-	270.62	6.56%
3	宋玉华	-	-	139.46	3.38%
4	毕延文	340.46	8.25%	-	-

序号	姓名	直接持股		间接持股	
		持股数	持股比例	持股数	持股比例
5	程显	-	-	7.73	0.19%
6	陈文杰	25.00	0.61%	14.75	0.36%
7	刘正	29.83	0.72%	-	-
8	葛宏涛	73.66	1.79%	34.03	0.83%
9	张学良	-	-	9.31	0.23%
10	李珂	-	-	9.31	0.23%
11	刘鸿铭	-	-	134.08	3.25%

截至本招股意向书签署日，公司董事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶所持有的公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况

（一）董事的变动情况

最近两年，公司董事变动情况如下：

期间	人数	董事会成员	具体情况
2023 年 1 月至 2024 年 10 月	1	罗超	-
2024 年 10 月至 2024 年 12 月	5	罗超、毕延文、宋玉华、徐凯、陈文杰	猎奇有限整体变更为股份有限公司，为规范治理结构，2024 年 10 月，发行人召开成立大会暨第一次股东会，选举罗超、毕延文、宋玉华、徐凯、陈文杰为公司董事
2024 年 12 月至 2026 年 5 月	7	罗超、毕延文、宋玉华、徐凯、张荣君、上官胜、张莉	为规范公司治理结构，陈文杰辞去公司董事职务；2024 年 12 月 9 日，发行人召开 2024 年第三次临时股东会，选举张荣君、上官胜、张莉为公司独立董事
2026 年 5 月至今	7	罗超、毕延文、徐凯、程显、张荣君、上官胜、张莉	为规范公司治理结构，宋玉华辞去公司董事职务；2026 年 5 月 6 日，发行人召开职工代表大会，选举程显为职工代表董事

（二）监事的变动情况

最近两年，公司监事变动情况如下：

期间	人数	监事会成员	具体情况
2023 年 1 月至 2024 年 10 月	1	毕延文	-
2024 年 10 月至 2026 年 5 月	3	程显、陈庆东、胡雪萍	猎奇有限整体变更为股份有限公司，为规范治理结构，2024 年 10 月，发行人召开成立大会暨第一次股东会，选举程显、陈庆东为公司非职工代表监事；2024 年 10 月，发行人召开职工代表大会，选举胡雪萍为公司职工代表监事
2026 年 5 月至今	0	-	根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于取消公司监事会并制定、修改相关内部治理制度的议案》，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，程显、陈庆东、胡雪萍不再担任公司监事

（三）高级管理人员的变动情况

最近两年，公司高级管理人员变动情况如下：

期间	人数	高级管理人员	具体情况
2023 年 1 月至 2024 年 10 月	4	罗超、宋玉华、徐凯、陈文杰	-
2024 年 10 月至今	5	罗超、宋玉华、徐凯、陈文杰、刘正	猎奇有限整体变更为股份有限公司，为规范治理结构，2024 年 10 月，发行人召开第一届董事会第一次会议，聘任罗超为公司总经理；聘任宋玉华、徐凯、陈文杰、刘正为公司副总经理；聘任刘正为公司董事会秘书兼财务负责人

（四）其他核心人员的变动情况

最近两年，公司其他核心人员为核心技术人员葛宏涛、张学良、李珂、刘鸿铭，未发生变动。

最近两年，公司董事、监事、高级管理人员变动主要系公司整体变更设立股份公司后，根据《公司法》等相关规定完善股份公司治理结构而进行的调整，前述人员变动事宜均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，并已履行了必要的法律程序。最近两年，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未

发生重大不利变化，未对公司管理决策和生产经营造成不利影响。

十四、董事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

截至本招股意向书签署日，除公司及其子公司以外，公司董事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况如下表所示：

姓名	对外投资企业名称	认缴出资金额（万元）	直接持股比例
罗超	昆山奔博	242.32	49.45%
	昆山市玉山镇弘诚翔模具厂	2.00	100.00%
	昆山合鸣	0.50	0.10%
	昆山美满	67.85	11.31%
徐凯	昆山奔博	87.44	17.84%
宋玉华	昆山奔博	45.06	9.20%
毕延文	苏州正合鼎力企业管理合伙企业（有限合伙）	460.37	28.03%
	苏州正合鼎欣企业管理合伙企业（有限合伙）	327.50	13.00%
	苏州正合致远投资管理合伙企业（有限合伙）	168.43	80.00%
	苏州正合鼎越企业管理合伙企业（有限合伙）	46.80	1.95%
	苏州榕创企业管理合伙企业（有限合伙）	10.00	3.66%
	迈时光电	11,282.62	25.49%
	西安正奇	400.00	80.00%
	珠海智博驿科技合伙企业（有限合伙）	0.58	0.41%
	苏州顺融天使创业投资合伙企业（有限合伙）	200.00	6.67%
张莉	苏州市智诚拍卖有限公司	40.00	20.00%
程显	昆山奔博	2.50	0.51%
陈文杰	昆山奔博	4.76	0.97%
	昆山奔越	0.09	0.02%
葛宏涛	昆山奔博	11.00	2.24%
张学良	昆山奔博	3.01	0.61%
李珂	昆山奔博	3.01	0.61%
刘鸿铭	昆山奔博	43.32	8.84%

注：董事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况均包括上述主体之子公司。

除上述情况外，截至本招股意向书签署日，公司董事、高级管理人员和核

心技术人员不存在其他对外投资情况。

上述公司董事、高级管理人员和其他核心人员对外投资企业与公司主营业务不存在相同或相似情况，亦不存在任何利益冲突情形。

十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

（一）薪酬组成、确定依据及所履行的程序

在公司担任具体生产经营职务的董事、监事（曾任）、高级管理人员及其他核心人员在公司领取薪酬，薪酬由基本工资、奖金等组成。未在公司担任生产经营职务的独立董事在公司领取津贴。

公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事、监事（曾任）、高级管理人员的薪酬方案按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制度履行了相应的审议程序。

（二）薪酬总额占发行人利润总额的比例

报告期内，公司董事、监事（曾任）、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额及其占公司同期利润总额的比例如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
薪酬总额（万元）	527.11	962.21	812.38	605.27
利润总额（万元）	17,148.23	20,832.17	20,862.12	9,447.09
薪酬总额/利润总额	3.07%	4.62%	3.89%	6.41%

注 1：薪酬总额未包含股份支付相关费用；
注 2：上表中的薪酬均为相关人员担任上述职务期间内在发行人及子公司处领取的薪酬，从其聘任当月开始计算。

（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其关联企业获得收入的情况

公司董事、监事（曾任）、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其关联企业获得收入的情况如下表所示：

序号	姓名	公司职务	2025 年度税前薪酬（万元）	是否在关联企业领取薪酬
1	罗超	董事长、总经理	123.56	否
2	徐凯	董事、副总经理	109.32	否
3	宋玉华	副总经理、董事（曾任）	93.72	否
4	毕延文	董事	-	是
5	张荣君	独立董事	8.00	否
6	张莉	独立董事	8.00	否
7	上官胜	独立董事	8.00	否
8	程显	职工代表董事、监事会主席（曾任）	37.14	否
9	陈庆东	监事（曾任）	29.31	否
10	胡雪萍	职工代表监事（曾任）	16.24	否
11	陈文杰	副总经理	110.00	否
12	刘正	副总经理、董事会秘书兼财务负责人	99.96	否
13	葛宏涛	核心技术人员	109.92	否
14	张学良	核心技术人员	70.51	否
15	李珂	核心技术人员	57.22	否
16	刘鸿铭	核心技术人员	81.32	否

注：上表中，相关人员最近一年从在发行人及子公司处领取的薪酬均已计入薪酬总额。

（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所享受的其他待遇和退休金计划

除薪酬、社会保险和住房公积金及股权激励外，在公司任职的非独立董事、监事（曾任）、高级管理人员及其他核心人员未享受公司提供的其他待遇和退休金计划，未在除公司和子公司外的其他关联企业领取收入。除独立董事津贴外，公司独立董事未享受公司提供的其他待遇和退休金计划。

十六、公司持股计划及股权激励的情况

（一）股权激励的实施情况

为了建立健全激励约束长效机制，吸引和留住优秀人才，公司对中高级管理人员、管理和技术骨干人员以及对公司有特殊贡献的人员进行了股权激励，以充分调动其积极性和创造性，实现公司可持续发展。股权激励的方式为股权激励对象直接持有公司股份或通过持股平台间接持有公司股份。

截至本招股意向书签署日，通过股权激励被授予股权的具体情况如下：

序号	股东名称	激励对象直接/间接持有股份数量（万股）
1	昆山奔博	222.41
2	葛宏涛	73.66
3	昆山奔越	66.51
4	刘正	29.83
5	陈文杰	25.00

注：昆山奔博激励对象不包含罗超、徐凯、宋玉华、刘鸿铭。

截至本招股意向书签署日，昆山奔博的基本情况及出资结构详见本节“五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”之“1、控股股东”。

葛宏涛、刘正、陈文杰的基本情况详见本节“十、董事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（三）公司高级管理人员”和“（四）核心技术人员”。

昆山奔越的基本情况如下：

企业名称	昆山奔越企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320583MAE4RDKL8X
成立时间	2024 年 11 月 18 日
出资额	569.99 万元
执行事务合伙人	陈文杰
主要经营场所	昆山市花桥镇金洋路 15 号 B2 栋 5 层 A075 号（集群登记）
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2026 年 6 月 30 日，昆山奔越的合伙人出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	陈文杰	0.0857	0.02	普通合伙人
2	何崇文	149.9750	26.31	有限合伙人
3	万楚豪	59.9900	10.52	有限合伙人
4	李方志	29.9950	5.26	有限合伙人
5	周致睿	29.9950	5.26	有限合伙人

序号	合伙人名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
6	王慧洋	29.9950	5.26	有限合伙人
7	郑增超	29.9950	5.26	有限合伙人
8	徐勤	29.9950	5.26	有限合伙人
9	熊晖	14.9975	2.63	有限合伙人
10	倪杰	14.9975	2.63	有限合伙人
11	王强伟	14.9975	2.63	有限合伙人
12	夏杉杉	14.9975	2.63	有限合伙人
13	孟和法	14.9975	2.63	有限合伙人
14	江挺	14.9975	2.63	有限合伙人
15	李龙辉	14.9975	2.63	有限合伙人
16	杜成龙	14.9975	2.63	有限合伙人
17	张斌	14.9975	2.63	有限合伙人
18	林高明	14.9975	2.63	有限合伙人
19	周行	14.9975	2.63	有限合伙人
20	殷仁怀	8.9985	1.58	有限合伙人
21	董浩然	8.9985	1.58	有限合伙人
22	徐宗祥	8.9985	1.58	有限合伙人
23	罗博	8.9985	1.58	有限合伙人
24	陈亮	8.9985	1.58	有限合伙人
合计		**569.9907**	**100.00**	

（二）登记备案情况

昆山奔博、昆山奔越对公司的出资均来源于其合伙人出资，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，不存在将其资产委托给基金管理人进行管理或受托管理资产的情形，不存在以私募投资基金持有发行人股份的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规规定的私募投资基金或者基金管理，无需办理登记备案程序。

（三）股权激励对象股份回购相关规定

根据股权授予方与激励对象签订的股权激励协议，激励对象股份回购相关规定的主要内容如下：

在激励对象服务期内，发生以下情形之一的，股权授予方或其指定的任何

第三方有权回购激励对象取得的部分或全部股权/合伙份额：

回购相关规定	具体情形
1、当激励对象发生下列情形，由股权授予方或其指定的第三方按猎奇智能上一年度经审计的每股净资产价格与激励对象原始认购款孰高值进行回购：	1.1 激励对象因工致残、猎奇智能 IPO 前正常退休或发生《劳动合同法》第四十条第一款、第三款、第四十一条规定的情形解除劳动合同的，或发生《劳动合同法》第三十六条、第三十八条规定的情形而与猎奇智能或其下属公司解除劳动合同的； 1.2 因相关法律法规、国家政策或其他合法原因，导致猎奇智能本协议项下股权激励无法继续实施的。
2、当激励对象发生下列情形，股权授予方或其指定的第三方有权按猎奇智能上一年度经审计的每股净资产价格与激励对象原始认购价款孰低值进行回购：	2.1 因故意或者重大过失给猎奇智能或其下属公司造成重大损失； 2.2 因违反相关法律法规，被治安处罚、采取行政、刑事强制措施，且股权授予方认为影响本职工作的； 2.3 服务期内，激励对象不再和猎奇智能或其下属公司具有劳动合同关系或聘用关系（不包含因本条第一款约定的情形而导致的离职）； 2.4 服务期内激励对象擅自将其享有的合伙份额对外转让、担保、偿还债务或设置其他限制性权利的； 2.5 激励对象在猎奇智能或其下属公司工作期间未能忠实、勤勉尽职，发生侵占或挪用猎奇智能或其下属公司财物、徇私舞弊或发生其他损害猎奇智能或其下属公司利益的情形； 2.6 激励对象违反对掌握的猎奇智能或其下属公司的技术秘密和商业秘密所负有的保密义务，违反保密协议以及猎奇智能或其下属公司的保密规定； 2.7 在猎奇智能或其下属公司任职期间，在任何第三方单位或者个人处兼职或持有任何与猎奇智能或其下属公司经营相同或相似业务的企业的股权或收受前述企业给予的其他利益（猎奇智能书面同意的除外）； 2.8 其他可能对公司上市造成重大不利影响的情形。

（四）股份锁定期

公司历次股权激励中股权授予方与激励对象签订的股权激励协议均约定了服务期。在服务期间内，若发生离职情形，则按照股权激励协议的约定进行回购处理。另外，罗超、昆山奔博、葛宏涛、昆山奔越、刘正、陈文杰均已出具股份锁定的承诺，具体详见本招股意向书“第十二节 附件”之“附件一：重要承诺”。

（五）目前执行情况及上市后行权安排

截至本招股意向书签署日，发行人上述股权激励已实施完毕，不涉及上市

后行权安排。除上述情况外，截至本招股意向书签署日，公司不存在已经制定且尚未实施的股权或期权激励计划，也不存在已经制定且尚在实施的股权或期权激励计划。

（六）对公司经营状况、财务状况、控制权变化的影响情况

公司股权激励有助于公司吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，有助于夯实公司可持续发展的基础。报告期各期，公司因实施股权激励确认的股份支付费用分别为 1,141.84 万元、309.09 万元和 1,025.46 万元。股权激励实施完毕前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

十七、员工及社会保障情况

（一）发行人员工情况

1、员工人数及变化情况

报告期各期末，公司员工人数及变化情况如下：

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
员工总数（人）	1,117	757	518	391

2、员工构成情况

（1）员工专业构成

截至 2026 年 6 月 30 日，公司正式员工专业构成情况如下：

类别	人数（人）	占比
行政及管理人员	117	10.47%
生产人员	831	74.40%
销售人员	18	1.61%
研发人员	151	13.52%
合计	**1,117**	**100.00%**

（2）员工学历构成

截至 2026 年 6 月 30 日，公司正式员工学历构成情况如下：

类别	人数（人）	占比
硕士及以上	24	2.15%
本科	275	24.62%
大专及以下	818	73.23%
合计	**1,117**	**100.00%**

（3）员工年龄构成

截至 2026 年 6 月 30 日，公司正式员工年龄构成情况如下：

类别	人数（人）	占比
30 岁及以下	661	59.18%
31-40 岁	379	33.93%
41-50 岁	60	5.37%
50 岁以上	17	1.52%
合计	**1,117**	**100.00%**

（二）社会保障制度、住房公积金制度执行情况

公司实行劳动合同制。公司与员工按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定签订了劳动合同，并为员工提供了必要的社会保障计划；根据国家及地方的有关规定，公司为员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并为员工缴纳了住房公积金。

报告期各期末，公司缴纳社会保险及住房公积金的情况如下：

项目	缴纳情况		2026.6.30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
员工总人数（人）			1,117	757	518	391
其中：境外员工人数（人）			9	8	1	0
社保	应缴纳人数（人）		1,108	749	517	391
	已缴纳人数（人）		1,065	727	509	375
	已缴纳人数占比		96.12%	97.06%	98.45%	95.91%
	未缴纳人数（人）		43	22	8	16
	未缴纳比例		3.88%	2.94%	1.55%	4.09%
	未缴纳原因	新入职（人）	26	9	0	8
		退休返聘（人）	11	7	6	6
		其他[注]（人）	6	6	2	2

项目	缴纳情况		2026.6.30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
公积金	应缴纳人数（人）		1,108	749	517	391
	已缴纳人数（人）		1,050	728	510	371
	已缴纳人数占比		94.77%	97.20%	98.65%	94.88%
	未缴纳人数（人）		58	21	7	20
	未缴纳比例		5.23%	2.80%	1.35%	5.12%
	未缴纳原因	新入职（人）	43	9	0	13
		退休返聘（人）	11	7	6	6
		其他[注]（人）	4	5	1	1

注：该部分员工未缴纳社保或公积金的原因主要包括：1、在其个人控制的企业里自行缴纳社保或公积金；2、员工入职当月，入职前的上一家公司已缴纳当月社保或公积金。

（三）公司缴纳社会保险及住房公积金的合规性证明

公司遵守国家及地方有关劳动用工和社会保障方面的有关规定。除部分员工因退休返聘、新入职人员手续尚在办理中等合理原因外，均按时缴纳社会保险费、住房公积金。

发行人及其子公司均已取得相关合规证明文件。报告期内，发行人及其子公司不存在因违反社会保险及住房公积金相关法律法规而受到行政处罚情形，相关主管部门未收到任何第三方对发行人关于社会保险、住房公积金问题的投诉、举报或其他性质的主张。

（四）控股股东、实际控制人承诺

公司实际控制人罗超出具了关于缴纳社保、公积金事项的承诺，详见本招股意向书“第十二节 附件”之“附件一：重要承诺”的具体内容。

第五节 业务与技术

一、发行人的主营业务、主要产品和服务情况

（一）主营业务概述

公司是国内领先的高端智能装备制造商，专注于光通信、半导体及汽车自动化等领域智能生产装备的研发、生产和销售。经过多年技术积淀与市场开拓，公司产品已覆盖光模块封装测试的核心环节，包括贴片、耦合、老化测试等关键工序，相关设备是保障光模块传输效率与可靠性的核心装备，并最终应用于数通市场及电信市场。同时，公司依托光通信领域积累的自动化装备技术优势，积极布局半导体、汽车自动化智能装备领域，持续强化综合竞争实力。

光电子信息产业不仅是我国构建新型数字基础设施、推进“数字中国”建设的战略性先导产业，更是支撑人工智能产业发展的核心力量。作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，人工智能已成为国际竞争的新焦点与经济发展的新引擎。伴随人工智能技术的爆发式增长，海量模型参数与训练数据在数万处理器间高速流转，对数据中心内部通信网络提出了极致要求。在此背景下，光模块作为承载数据流动的“算力高速公路”，其核心地位愈发凸显，成为构建现代数据中心的关键基石。

光模块作为我国光电子信息领域的优势产业，是实现产业自主可控的关键支点。公司自设立以来，始终以推动高端光模块封装测试设备国产替代为使命，通过技术追赶与创新突破，为下游光模块及器件厂商提供高性能、高可靠性的封装测试设备，从产业链源头提升我国光通信产业核心竞争力。

公司坚持以“技术赋能客户价值”为导向，通过深度挖掘行业痛点与客户潜在需求，构建了快速响应的产品迭代机制，持续优化设备精度、稳定性及生产效率等核心性能指标，形成了“需求洞察-技术研发-产品落地-服务反馈”的闭环创新体系。凭借卓越的产品品质、持续的技术创新能力及高效优质的配套服务，公司已成为国内光模块智能制造装备的主要供应商之一，产品获得主流市场高度认可，公司设备已广泛应用于中际旭创（300308）、索尔思、光迅科技（002281）、源杰科技（688498）、剑桥科技（603083）、客户三、客户四等光通信行业龙头客户和知名企业，并与 2025 年全球前十光模块厂商（前十厂

商排名来源于 LightCounting）中的九家保持良好合作。根据弗若斯特沙利文数据，2025 年公司光模块贴片设备市场份额排名全球第一，光模块耦合设备市场份额排名全球第二。

此外，公司稳步开拓半导体、汽车自动化等领域客户，公司产品已应用于客户五、先导科技、士兰微（600460）等半导体领域客户，以及索恩格、苏世博、三花智控（002050）等全球领先的汽车零部件供应商。

依托多年在运动控制、机器视觉、软件算法、机械设计等领域的深耕积累和自主创新，目前公司已具备光模块封装全流程核心设备的开发能力，并在贴片设备、耦合设备和老化测试设备等方面已经实现了国产替代。其中共晶贴片设备的设备精度达到±1μm，产品精度达到±3μm，技术水平与国际龙头齐平，耦合设备、固晶贴片设备性能处于国内领先水平，助推客户提升工艺及效率，实现智能化生产的目标。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有发明专利共 55 项，并以技术诀窍（Know-How）和商业机密的形式保有众多工艺及专有技术。公司坚持自主创新战略，核心技术实现完全自主可控，先后获得江苏省专精特新中小企业（2022 年）、国家级专精特新“小巨人”（2023 年）、“江苏瞪羚企业”（2024 年）、国家级专精特新“重点小巨人”（2025 年）等荣誉，自主研发的自动耦合设备、共晶贴片设备被江苏省工业和信息化厅评为“首台（套）重大装备”。

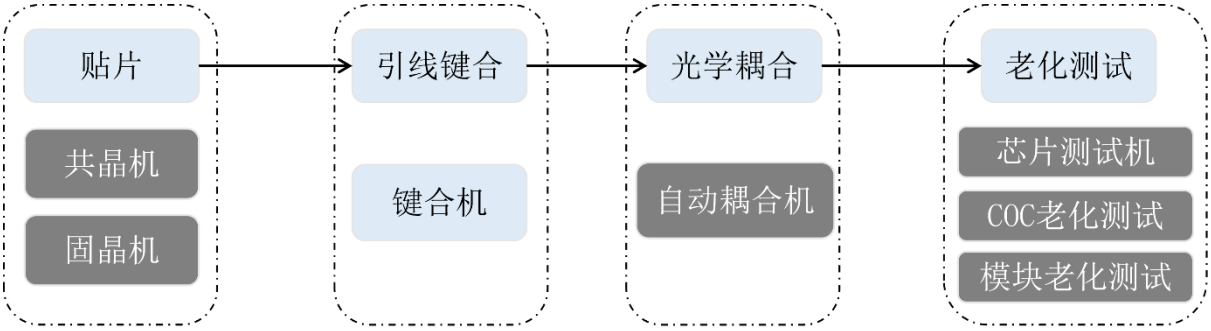
公司以“技术驱动产业升级”为目标，依托“技术+客户”双轮驱动策略，构建产品技术壁垒，把握优质客户资源，持续深化光通信领域的核心竞争力优势，并加速半导体市场拓展。通过自主创新与国产替代，致力于成为全球领先的高端智能装备解决方案提供商。

（二）主要产品

自设立以来，公司深耕于智能制造装备领域，产品种类不断丰富，应用领域持续拓展。公司主要产品为光模块封装测试设备，并成功开拓半导体及汽车自动化智能装备领域。

光模块封测过程的步骤繁多，工艺极其复杂，主要包括贴片、引线键合、

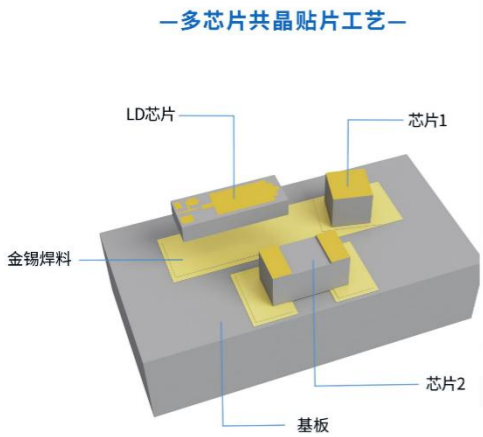
光学耦合以及老化测试，公司产品主要应用于其中的贴片、光学耦合、老化测试这三个核心环节，这些环节是保证光模块产品生产质量及效率的关键。光模块封测工艺流程及公司产品应用环节示意图如下：

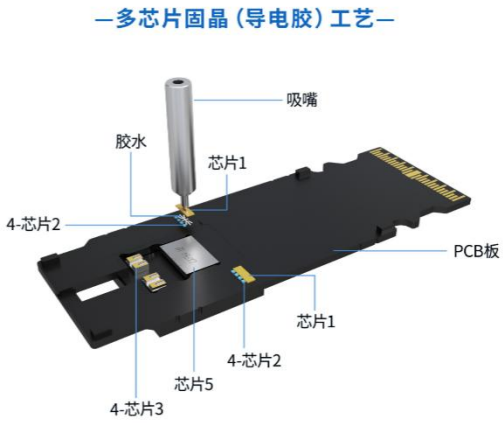


标灰色部分为公司适用环节对应的产品

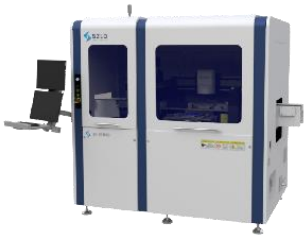
1、贴片设备

贴片工艺主要是指在光模块封测过程中，将光电器件如激光器驱动芯片、激光器芯片、探测器芯片等各类光电芯片精确地固定在载体上（如 PCB、陶瓷基板等）。根据工艺不同，贴片工艺可分为共晶和固晶两种方式。共晶贴片利用低熔点合金材料（如 AuSn 焊料），在高温加压下使芯片与基板形成共晶结合，适用于激光器、功率器件等高散热、高可靠场景需求的封装，工艺复杂，需精准温控和压力控制。固晶贴片是利用导电银胶在芯片底部和基板上进行粘接，使用范围广、效率高，适用于电芯片、PD 等大批量、常规场景的装贴。





公司贴片设备主要产品情况如下：

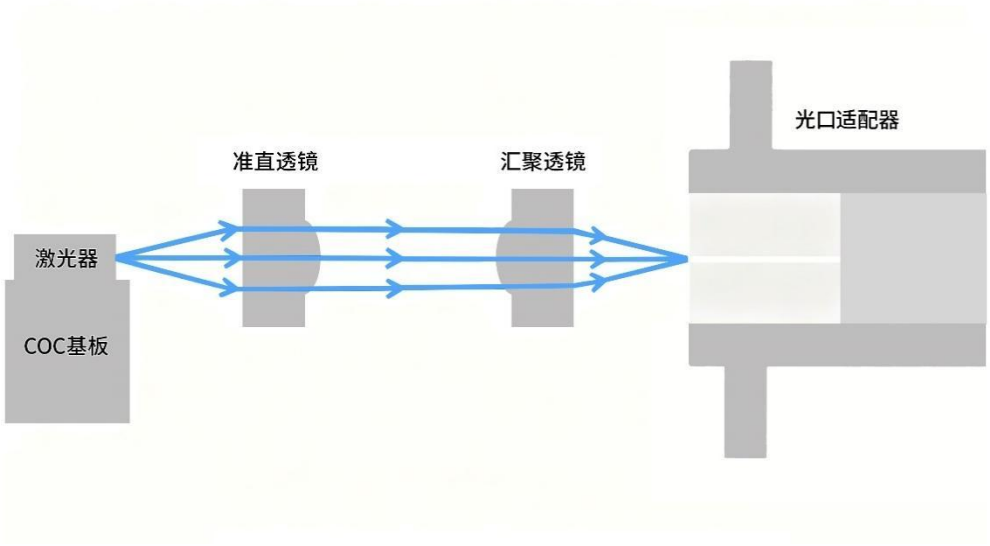
产品类别	产品图示	产品型号	产品功能及特点	主要应用领域
共晶贴片设备		HP-EB3300	（1）共晶贴片机适用于激光器、微波射频等高功率密度芯片的贴装，具有较高的可靠性； （2）设备采用气浮运动平台，无机械磨损，精度稳定性高； （3）设备具备共晶贴片和银胶贴片工艺，支持混合工艺贴装需求，兼容 Gel-PAK 和蓝膜上料方式； （4）双焊台并行作业，生产效率高；配备吸贴工具自动更换系统，适用于 COC、COS，最高支持 1.6T 速率光模块； （5）设备精度±1μm，加工精度±3μm； （6）支持多芯片贴装、倒装共晶（选配）	光通信；大功率激光器
		H3-EB10C	（1）兼容共晶贴片和银胶贴片工艺； （2）具有带刮擦及多段温控功能的共晶焊接&环氧点胶吸贴工具自动更换系统；（3）H3 系列设备采用开放式平台，可快速满足客户定制化需求，并可拓展至 UV，激光辅助键合，TCB 热压键合等； （4）适用于 COC，微波射频芯片批量生产及研发测试	光通信；半导体微波射频
固晶贴片设备		HS-DB2000	（1）设备采用双系统机构，系统一支持点胶&蘸胶，能够满足不同种芯片对胶量的需求；系统二支持多芯片贴装，能够自动更换吸嘴； （2）设备基板传输系统配备可自由调节宽度的输送线；芯片供料系统搭载 8 英寸晶圆上料系统&自动换晶圆装置，支持 Gel-PAK、华夫盒等供料需求，具有较高的灵活性； （3）设备精度±3μm，加工精度±7μm	光通信；半导体微波射频
		LQ-VADB30P	（1）针对光通信行业多芯片贴装需求而开发，设备具备正贴、背贴、实时对准贴装方式。满足不同基准，不同精度的芯片贴装需求，具备胶工艺芯片贴装一站式解决能力； （2）高精度模式下，设备精度	光通信；激光雷达

产品类别	产品图示	产品型号	产品功能及特点	主要应用领域
			±1.5μm，加工精度±3-5μm； （3）设备采用双系统机构； （4）设备采用转盘式供料系统，具有切料速度快的优势	
		H3-DB10B	（1）设备支持银胶贴片的工艺，具备点胶&蘸胶、吸贴工具支持自动更换； （2）H3 系列设备采用开放式平台，扩展能力强； （3）设备精度±3μm，加工精度±5μm	光通信
		HS-DB3000	系 HS-DB2000 升级版本，UPH 大幅提升，效率更高。设备尺寸缩小，空间利用率提高 30%	光通信、半导体微波射频
		H3-DB20HF	设备支持预热、预压、吸嘴加热及大压力贴装等功能，适用于 SiC 模块的研发测试或批量生产	功率半导体
		LQ-DA1201	（1）针对集成电路及分立式组件应用而开发的全自动固晶设备，设备集成了超快速和高精度的优点。结合创新的“伺服反冲技术”和大尺寸多路视觉系统，提升了设备的精度和稳定性； （2）设备支持胶工艺贴片与 DAF 工艺，同时兼容 LF 与 Substrate 供料系统，配备 UP-Look 背拍识别以及在线测量系统。适用于 QFN、TSOP、QFP、BGA、CSP-BGA、SiP-BGA、FBGA 和 LGA 等产品的封装。	IC 封装

2、耦合设备

光子与电子不同，电子可以沿着金属导体稳定传输，光子在空间中会发生散射、折射、反射等作用，因此光信号要通过光纤来进行传输。激光器芯片产生的光源需要通过微透镜对光束进行准直、聚焦后才能最大限度的进入到光纤

中。耦合是光模块封装工时最长、最易产生不良品的步骤，它直接影响光模块的性能。耦合的目的是将光高效高质的从一端耦合进入到另一端，耦合的流程一般为：对准、透镜耦合、胶水固定、验证耦合效率。耦合过程示意图如下：



公司耦合设备主要产品情况如下：

产品类别	产品图示	产品功能及特点	主要应用领域
耦合设备		耦合设备集成耦合、点胶、UV固化等功能，实现对耦合数据进行处理，实现生产数据的可追溯性； 采用自研的耦合算法，消除人工生产时人为因素的影响，提高产能； 公司目前耦合设备最高可支持1.6T 光模块生产	光通信、大功率激光器

注：耦合设备具有非标定制化的特点，不同客户产品需求和性能不同

3、老化测试设备

老化测试是光模块生产的核心工序之一，贯穿光模块生产的全过程，涉及芯片 LIV 与光谱测试、COC&OE 老化测试、模块老化测试等。老化过程主要通过模拟产品在实际使用过程中可能遇到的各种环境条件和工作状态，如高温、低温等，加速产品的老化过程，从而在较短时间内评估产品的可靠性。测试过程主要对目标对象的性能指标进行测试，并根据测试结果对产品进行分类。老

化与测试这两种工序也可以结合在一起对产品指标进行评估。

公司老化测试设备主要产品情况如下：

产品类别	产品图示	产品型号	产品功能及特点	主要应用领域
COC 老化测试设备		LQ-BI74P	设备主要应用于 COC 器件的在40℃-125℃的老化与测试； 主体采用框架式结构，可根据需求选择层数（7、11 或其他），载具采用可分离式“抽屉”形式，每个抽屉可独立控温。载具采用标准快插式电气接口，可根据不同产品设计不同载具在同一平台内测试； 设备具备老化过程中在线监测 LIV 特性，相比传统外置测量设备具备更高的灵活性与可靠性。	光通信
芯片测试设备		LQ-LDTS2000	设备应用于通信行业激光芯片的光电性能检测与分选。设备支持常温 25℃，高温 85℃条件下前光、背光的 LIV 参数和光谱参数。满足 DFB 、EML、CW 高功率芯片的测试需求	光通信
模块老化测试设备		TEC	模块老化测试设备，用于模块的老化训练和测试，设备自动化程度高。	光通信
模块老化测试设备		QTEC	模块老化测试设备，用于模块的老化训练和测试，设备自动化程度高，测试容量大	光通信

4、自动化设备及整线解决方案

基于公司战略，公司以光模块封装设备研发作为核心战略方向，同时逐步向集成电路、汽车自动化等领域拓展，构建多赛道协同的业务布局。随着下游客户对生产效率的要求持续提升，行业正从“单一设备供应”向“整线交付方

案”转型。客户不再满足于采购孤立设备，更需要能覆盖全生产流程、实现高效协同的一体化解决方案，以降低整合成本、提升整体产线效率。

同时，随着 AI 技术飞速迭代，直接推动数据中心流量呈指数级飙升。作为数据中心运行效率的关键组件，光模块的生产效能已成为行业突破的核心瓶颈，这也对光模块封装设备的技术实力与交付能力提出更高要求。

为精准匹配客户对整线方案的需求，依托公司在自动化设备领域的深厚技术积淀，公司推出自动化系统及整线解决方案业务，将既有自动化技术与行业场景深度结合，为汽车自动化和光通信等行业客户提供从设备选型、产线规划到落地运维的全流程服务，形成“核心设备+整线方案”的双业务支撑，进一步巩固市场竞争力。

公司自动化设备及整线解决方案主要产品情况如下：

产品类别	产品图示	产品功能及特点	主要应用领域
油泵自动化生产线		实现了从原材料到定子绕线，测试，转子磁钢，主轴压装。总装线定转子热配，拧紧到成品的定子线，转子线，总装线以及自动测试下线包装的全自动化。	汽车自动化
高压同步转子线		主要用于汽车高压转子的自动装配和检测，实现了转子自动装磁钢，转子加热，转子轴压装，注塑，尺寸检查，动平衡，充磁磁通检测，自动下线等全自动化。	汽车自动化
光模块设备整线解决方案		光模块生产核心工序贴片、耦合、老化测试等全流程系统解决方案，提高光模块生产效率	光通信

（三）主要业务收入构成

报告期内，公司分产品类型的主营业务收入情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
贴片设备	8,229.93	14.16%	24,370.66	34.93%	23,718.09	43.71%	9,008.98	31.22%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
耦合设备	26,679.79	45.90%	16,250.69	23.29%	15,102.99	27.84%	9,076.06	31.45%
老化测试设备	13,277.12	22.84%	7,514.76	10.77%	3,999.73	7.37%	4,865.21	16.86%
自动化设备及整线解决方案	3,155.29	5.43%	13,564.67	19.44%	6,746.98	12.43%	3,352.59	11.62%
配件及其他	6,779.32	11.66%	8,061.57	11.56%	4,690.93	8.65%	2,557.12	8.86%
合计	**58,121.44**	**100.00%**	**69,762.36**	**100.00%**	**54,258.73**	**100.00%**	**28,859.97**	**100.00%**

（四）主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事光通信、半导体、汽车自动化等领域智能生产装备的研发、生产和销售。基于客户个性化需求，公司通过专业化技术研发与精密设计、制造，根据客户的需求，为下游光通信、半导体、汽车等领域客户提供多品类智能制造装备，帮助客户显著提升生产效率、缩减人工成本，助力客户生产向“自动化、智能化和信息化”转型升级。

公司坚持以“技术赋能客户价值”为导向，通过深度挖掘行业痛点与客户潜在需求，构建了快速响应的产品迭代机制，持续优化设备精度、稳定性及生产效率等核心性能指标，形成了“需求洞察-技术研发-产品落地-服务反馈”的闭环创新体系。凭借卓越的定制化开发能力与全周期技术服务，公司与中际旭创、光迅科技、源杰科技、剑桥科技、客户三、客户四等国内外龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系，在核心客户供应链中占据重要份额。

依托“技术+客户”双轮驱动策略，公司已构建起覆盖产品技术壁垒、行业 know-how 经验及优质客户资源的核心竞争优势，为持续盈利能力奠定坚实基础。未来公司将继续深化“设备+技术+服务”的一体化解决方案能力，强化在高端智能装备领域的国产替代领先地位，保障公司的持续盈利能力。

2、研发模式

公司以各产品事业部下属的研发部门为核心，结合市场发展趋势、行业契合度及自身技术优势，对新业务领域、新产品方向进行工艺或技术研发储备，不断推动光通讯等领域海外设备的国产替代进程。

（1）前期调研及分析

针对公司的战略目标和市场发展目标，公司销售部门和研发部门负责了解市场需求，收集有关新产品、新技术、新工艺、新设备等技术信息，并将收集到的各类技术信息以汇总给研发部门参考。

（2）立项阶段

公司各产品事业部下属的研发部门对收集的信息进行整理甄别，根据公司现有技术能力、研发资源和投入产出情况，评价公司现有技术和工艺的适应度，拟定项目立项书。项目立项书经审批通过后，立项完成。

（3）设计、装配样机及验证阶段

研发部门基于整体方案设计，结合设备的技术路线和工艺的实现路径，对研发设备进行设备主机设计、结构设计和细化设计，并形成设备的 3D 结构图纸。研发装配调试人员根据图纸和技术指标对研发设备进行组装、调试、测试，并制定装配工艺，提供测试过程数据。软件研发人员同步编写软件。设备装配完成后，开展设备的测试工作，主要测试设备硬件性能及设备参数指标，完成场内测试后发送客户处进行装料测试。客户测试期间不断反馈测试数据，公司基于客户反馈调试设备，并最终完成测试。

3、销售模式

公司采取直销的销售模式，报告期内存在少量代理和贸易商销售收入。直销模式下，由公司与客户进行前期接触、技术洽谈，双方达成意向后，公司直接与客户签订合同、发货给客户。公司项目订单的获得主要通过开发存量客户新需求、存量客户推荐、市场推广、参加行业展会等方式获得。贸易商模式下，贸易商在获取终端客户需求后下订单。公司与贸易商之间为买断式销售，公司向贸易商销售产品后的风险由贸易商自行承担。对于公司而言，直销客户和贸易商客户在货源安排、交付和结算条件等方面不存在明显差异。代理模式下，公司与代理商签订代理协议，代理商负责公司部分客户开发以及客户关系维护，订单意向达成后，公司与终端客户直接签订合同，并向代理商支付代理费用。

光模块封装测试设备及自动化设备具有个性化、非标准化的特点，不同客户在产品细节、参数、适用场景等方面需求不同。因此，在客户开发新产品、

规划生产线的前期就需要公司直接与客户沟通以获取需求信息，通常需反复轮沟通才能研发和设计出满足客户需求的设备。同时，光通信下游客户市场集中度较高，全球光模块厂商 CR10 占比超过 80%。因此公司采取直销模式，以缩短销售流程、准确定位客户需求、提升产品开发的时效性和准确性，优化客户服务和体验，增强客户黏性。

公司建立了完善的销售网络体系，配备了一批高素质的销售人员和市场拓展人员，营销管理部下设市场拓展部和销售部两个部门，其中市场拓展部主要负责市场推介材料的制作与推广，销售部主要负责已有客户的维护和新客户的获取工作。针对需求集中的大客户建立专人负责机制，与客户保持良好的合作关系，能够快速响应客户需求。

4、采购模式

公司的原材料采购分为标准件采购和定制件采购。公司生产所需的标准件采用标准件采购模式，即根据订单需求直接面向供应商进行标准件采购，并对常用的标准件进行适度比例的备货。而对于公司生产所需的定制件采用定制化采购模式，即根据客户订单，将设计团队图纸交由供应商定制化生产相关部件或模块，并明确相关参数指标要求。

公司制定了较为完善的采购控制程序，根据采购流程，采购部根据各部门的采购需求对供应商进行遴选，筛选符合要求的供应商进行询价。供应商报价后采购部门进行比价议价，综合报价、产品质量、交期等因素，确定最终供应商，并由采购部门负责人进行审批。审批流程完成后，采购部与供应商签订合同，供应商根据合同约定发货至公司指定地点。采购物品到货后，由仓库管理人员签收并分类入库。

为规范公司供应商管理，公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商及采购过程。采购部通过收集公开资料、资质审核、经营状况审核、质量体系审核等流程，对供应商的产品质量、供货能力、交货及时性、服务能力和价格等因素进行多角度综合考察，建立公司的合格供应商名录。

5、生产模式

公司主要从事光通信、半导体、汽车自动化等领域智能生产装备的研发、

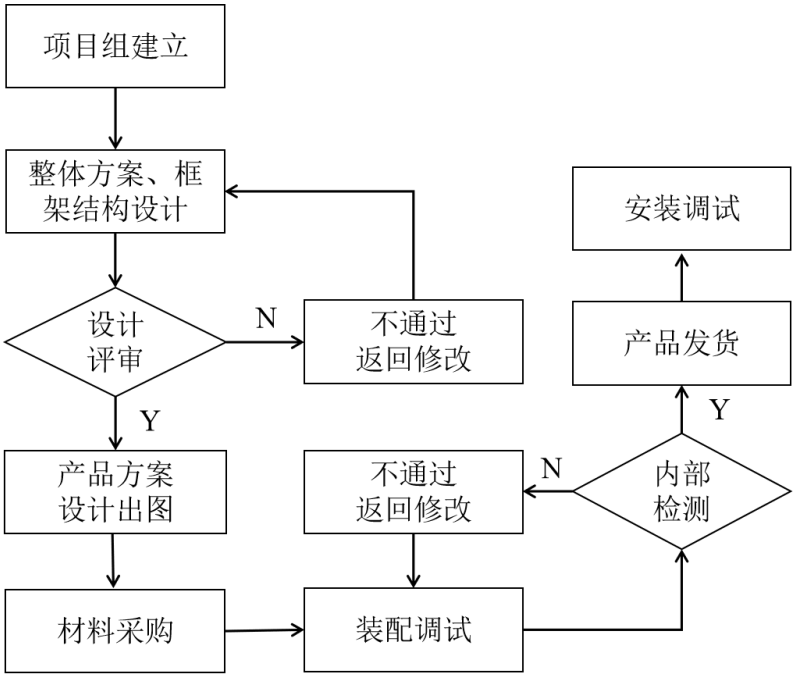
生产和销售。不同客户订单在适用场景、技术要求等方面存在个性化差异，因此公司主要采用以销定产的生产管理模式，根据客户需求情况进行生产调度、管理和控制，同时对部分标准机型进行适度比例的备货生产。公司主要生产流程情况如下：

（1）启动阶段：销售部接到客户订单或发起备货需求，运营中心协调组织生产部、设计部门、采购部、销售部等组建项目组，进行项目启动会。项目组根据合同约定的相关技术指标，确定项目生产主计划；

（2）设计阶段：针对非标准化产品，通常由项目组统筹公司各部门制定整体设计方案，并根据项目计划，对人员、设备等进行评估和分工，协调设计总体方案。整体方案设计完成并通过设计评审后，设计部门依据客户需求、整体方案和项目时间计划进行产品方案设计。设计阶段工作内容主要包括整体方案设计、产品框架结构设计、机械设计、电气设计、软件设计等。标准化产品则不涉及设计阶段，直接进入采购和装配调试流程。

（3）采购和装配调试阶段：生产部负责根据项目优先级及库存物料情况，制定生产计划及安排项目生产人员，进行设备的装配、电气接线及调试工作。采购部负责制定采购计划，并按计划进行采购，设计部门负责设备软件的编写工作。设备软硬件完成后，生产部门进行设备的售前测试工作，内部测试通过后，组织相关人员进行发货。设备运抵客户指定地点后，公司相关人员进行设备安装及现场调试，以满足客户的设备验收要求。

公司生产流程具体如下：



6、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司结合国家产业政策、上下游发展情况、光通信、半导体领域专用设备行业自身特点、公司自身技术及业务发展阶段等因素，形成了目前的经营模式。报告期内，公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来亦将与行业总体趋势基本一致，不会发生重大变化。

（五）公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

公司自设立起即确立“技术自主化、装备国产化”的发展战略，以攻克光通信高端封装测试设备核心技术为使命，致力于打破欧美厂商在高速率光模块封测设备领域的长期垄断，实现光模块设备的国产替代。通过持续十余年的技术深耕，公司构建了涵盖光通信、半导体等不同领域的跨领域技术协同体系，形成了“核心技术自主可控、产品矩阵持续拓展”的发展路径，主营业务始终聚焦高端智能装备的研发、生产和销售。目前，公司已成为国内光模块封装测试智能制造装备领域的主要供应商之一，细分市场份额和技术水平处于国内领先水平，体现了公司战略定位的高度一致性。

公司主要产品、主要客户的演进情况如下图所示：



（1）以自动化业务的技术积累为基础，迅速实现核心技术从 0 到 1 的突破

公司创始团队长期看好光通信行业的发展前景，自公司设立之初就将公司的发展重心聚焦于光通信领域。依托创始团队在自动化装备领域积累的运动控制、机械设计等底层技术，公司精准切入光通信设备赛道，并于 2016 年成功研发首台具有完全自主知识产权的光模块耦合设备，实现 0.5 微米级的设备精度，并向中际旭创完成交付。同期推出的 100G COC 老化测试设备，实现了国内 25G 激光器芯片老化设备的替代，初步建立国产设备技术口碑。

（2）由低速率、中精度产品向高速率、高精度光模块封装设备转变

公司成立之初，公司交付的光模块耦合设备和贴片设备主要针对 100G 及以下光模块产品。依托公司对行业发展动向和客户需求的敏锐感知，公司精准定位自身发展方向，前瞻性布局高精度贴装技术。随着公司在力控技术、视觉引导技术等核心技术方面的积累和突破，产品持续迭代更新，设备精度不断提升，以满足不断升级的市场需求。

目前公司最新一代 EB3300 共晶贴片机的设备精度能够达到±1μm，性能可对标 MRSI 等国际龙头，能够满足当下主流的 800G、1.6T 光模块的大规模量产需求。2023 年迭代推出 LQ-VADB30 系列实时对准固晶贴片机，使用了公司研发的高精度视觉对准技术及算法，在兼顾效率的同时，相对于以往设备贴装精度和可靠性更高，满足光模块行业不断迭代的技术需求。2025 年固晶贴片设备进一步迭代，推出 LQ-VADB30P 和 HS-DB3000，性能较上一代产品均有大幅提升，实现对 BESI、ASMPT 等国际龙头的比肩。

公司第三代耦合设备于 2023 年实现交付，主要应用于 800G、1.6T 单模光模块产品，核心下游场景覆盖大规模数据中心及 AI 算力中心。随着产品技术参数达到国内一流水平（实现±0.05 微米级的设备精度），叠加高性价比优势，相关设备已获得行业龙头客户的批量采购认可，成为其高速率光模块量产的核心装备。

面向未来技术演进，公司基于硅光集成、光电共封装的技术需求，依托自主研发的 H3 贴装平台和实时对准贴装平台，开展前瞻性技术研发。当前重点推进激光共晶、激光辅助键合（LAB）、倒装热压等先进封装工艺：①激光共晶、激光辅助键合工艺：利用激光局部加热特性，对基板上的硅光芯片实施精准回流焊接，减少温度对周围器件的影响；②倒装热压工艺：通过 Bondhead 脉冲加热技术（最大升温速率 100℃/s），在氮气保护气氛中实现芯片到芯片，芯片到基板，芯片到晶圆的键合，减少互联距离，节约空间尺寸。解决未来产品对更高带宽的需求。

（3）由光通信行业向半导体行业其他领域延伸

半导体行业可以划分为集成电路、分立器件、光电器件和传感器四大类。其中光模块中使用的光电芯片归属于光电子器件这一分类。而半导体其他领域的封装测试工艺流程与光模块领域较为接近，都需要进行芯片贴装、键合、测试等环节。因此，光模块领域的封装测试设备在底层原理、技术方面存在一定的共通性，底层技术如运动控制、视觉技术、机械设计等方面具有较强的延展性。

公司依托于现有高精密运动平台技术、高精度高动态压力控制技术、脉冲加热技术、高精度视觉对准技术等核心技术，逐步向半导体行业其他领域拓展。目前公司推出的固晶和共晶设备，可适用于半导体微波射频领域，并实现向客户五等射频行业知名客户批量供货。针对 IC 行业单芯片、多芯片、倒装、倒装热压超声等贴装形式，公司正在开展 IC 高速固晶机、TCB 设备等新设备的研发，部分产品如 TCB 设备已形成样机在客户处验证，公司 SiC 预烧结设备已通过士兰微验证。

自设立以来，公司始终专注高端智能装备“研发-生产-销售”的主航道，

主营业务未发生重大变化。核心技术围绕机械控制、机器视觉、压力控制、温度控制、软件算法等维度持续迭代，产品形态从单一耦合设备拓展至全流程设备矩阵，应用领域从光通信延伸至半导体，均基于底层技术的横向复用与纵向深化，体现战略执行的连续性与技术演进的逻辑性。

（六）主要业务经营情况和核心技术产业化情况

1、主要业务经营情况

公司主要从事光通信、半导体、汽车自动化等领域智能生产装备的研发、生产和销售。近年来下游市场光模块销量快速增长，带动公司主营业务实现高速增长。报告期内，公司主要业务经营情况良好，收入规模和净利润水平保持快速增长。

2、核心技术产业化情况

自成立以来，公司专注于光模块封装设备技术的研发，经多年积累，已攻克掌握高精密运动平台技术、高精度，高动态压力控制技术、脉冲加热技术、高精度视觉对准技术、视觉引导技术、耦合算法、COC 老化测试技术等核心技术，并具备光模块封装全流程核心设备的开发能力。其中贴片、耦合等设备已处于国际或国内领先水平，各项参数指标均处于行业前列，相关设备填补了国产设备的空白，打破了欧美设备厂商垄断市场的局面，有效实现了光通信领域国产设备的替代。

公司一贯将技术创新、产品创新作为企业发展的核心驱动力，以创新驱动发展，已建成能持续创新创造的研发机制，具备高效的研发成果产业化能力。报告期内，核心技术产品对应收入占营业收入的比例如下表所示：

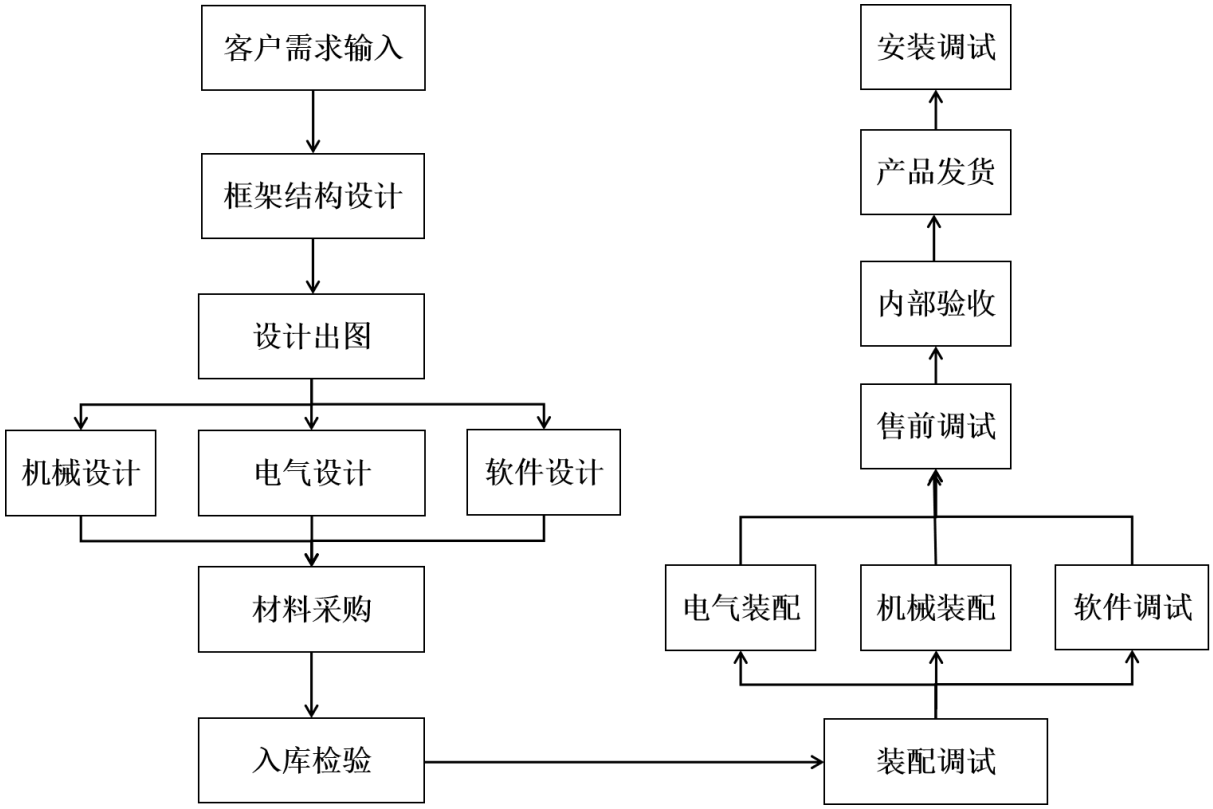
单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品收入	51,342.12	61,700.79	49,567.80	26,302.85
营业收入	58,144.73	69,779.24	54,292.61	28,918.30
占比	88.30%	88.42%	91.30%	90.96%

（七）主要产品的工艺流程图

发行人聚焦光通信、半导体、汽车自动化等领域智能生产装备的研发、生

产与销售，产品生产流程主要涵盖设计、装配、调试检测等环节，核心技术深度贯穿于产品设计、精密装配、整机精度调试、精度与效率检测等关键工序。经过多年技术积累，公司已形成高精密运动平台技术、高精度高动态压力控制技术、脉冲加热技术、视觉引导技术、耦合算法等多领域自主研发的核心技术体系。公司通过持续优化产品设计、材料选型及软件研发，提升产品装配工艺与成品检测的精密度，确保产品达到设计性能指标，公司主要工艺流程情况如下：



公司设计环节深度融合多学科技术，从机械结构、运动控制、电气系统、操作软件等维度构建全流程设计体系，涵盖整机方案规划、模块化部件设计、零部件定制开发、UI 界面适配及数据追溯系统搭建等核心环节。设计过程中，以整机布局优化为起点，将设备拆解为标准化功能模块（如光学耦合模块、精密贴装模块），为后期升级维护提供便捷接口。同时，借助建模软件与仿真工具，开展机械运动轨迹模拟、结构应力分析、热力学传导计算、震动模态仿真等，通过多维度验证确保设计方案的可靠性与工艺兼容性。

在装配与调试环节，公司针对成熟机型建立标准化作业流程（SOP），对关键工序（如光学器件对位、伺服电机校准）制定量化控制指标，依托激光干

涉仪、千分表、准直仪、大理石基准装配台等精密仪器，实现微米级精度控制。通过“三检制度”（自检、互检、专检）构建质量管控体系，针对不同设备类型（如 800G 光耦合机、共晶贴片机）制定差异化检查清单，覆盖装配精度、电气连接、软件功能等核心维度。此外，通过 MES 系统集成数据追溯模块，实时采集生产过程中的关键参数（如焊接温度曲线、压力波动数据、视觉识别误差值），并与工艺标准数据库进行动态比对，确保产品质量的可追溯性与一致性。

（八）具有代表性的业务指标情况

结合公司所处的行业和自身经营的特点，公司营业收入、主营业务毛利率及研发费用为对公司具有重要意义的财务业务指标，其变动对公司业绩变化具有较强预示作用，营业收入、毛利率和研发费用分析详见本招股意向书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”、“（四）毛利及毛利率分析”和“（五）期间费用分析”。

（九）主营业务符合产业政策和国家经济发展战略

公司所处的光通信行业属于国家鼓励发展行业，公司产品作为光通信、半导体及汽车自动化行业的重要设备，受到国家产业政策大力推动。近年来，国家已将其作为优先发展鼓励项目并制定了一系列扶持政策，发行人主营业务符合我国战略新兴产业发展规划和制造业高质量发展规划。

光电子信息产业不仅是我国构建新型数字基础设施、推进“数字中国”建设的战略性先导产业，更是支撑人工智能产业发展的核心力量。作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，人工智能已成为国际竞争的新焦点与经济发展的新引擎。伴随人工智能技术的爆发式增长，海量模型参数与训练数据在数万处理器间高速流转，对数据中心内部通信网络提出了极致要求。光模块作为承载数据流动的“算力高速公路”，其核心地位愈发凸显，成为构建现代数据中心的关键基石。

1、锚定国家战略方向，光通信产业成为 AI 时代核心支撑

光通信产业作为数字经济的核心基础设施与战略性新兴产业，是国家重点培育的创新发展领域，更是支撑人工智能产业规模化扩张的核心底座。近年来

《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”国家信息化规划》等政策文件明确将光通信列为核心发展方向，提出“加速通信网络芯片、器件和设施的产业化应用”“推动 5G 网络、数据中心、物联网等领域光通信技术升级”，尤其强调要强化光通信技术对人工智能基础设施的支撑能力，为行业构建了广阔的政策支持体系与市场空间。在国家战略驱动下，我国光通信产业链已形成从芯片设计、模块制造到系统集成的完整生态，技术创新与 AI 训练集群、智能算力中心等应用场景拓展协同推进，成为新质生产力发展的重要引擎。

2、聚焦技术自主突破，公司赋能 AI 基础设施建设

公司作为光通信及半导体封装测试设备领域的高新技术企业，其核心产品更是人工智能基础设施自主化建设的关键支撑。依托自主研发的高精密运动平台技术、高精度压力动态控制技术、脉冲加热技术等核心技术，公司成功突破欧美企业在高速光模块封装测试设备领域的技术垄断，实现共晶贴片、耦合等核心设备的国产化替代。其中，公司 EB3300 共晶贴片机设备精度达±1 微米，与国际龙头比肩，LQ-VADB30P 固晶贴片机兼顾效率与精度，为 800G/1.6T 等适配 AI 大模型训练的高速光模块量产提供关键装备支撑，有力推动我国光通信产业自主可控发展。根据“十四五”规划对高性能光模块封装技术的重点部署，公司产品作为产业链核心设备，不仅保障光通信产业竞争力，更对 AI 时代算力网络安全自主具有不可替代的战略意义。

发行人紧扣时代脉搏，积极投身于新质生产力的培育与发展。公司通过持续的研发投入和技术创新，不断提升产品的性能和技术水平，为光模块制造企业提供高效、高精度的生产解决方案，助力产业链突破 AI 算力需求激增带来的技术瓶颈，抢占市场先机。这不仅有助于推动我国光通信产业向平台化、规模化、高标准的发展阶段迈进，更有助于夯实人工智能产业创新发展的底层硬件基础，切实符合国家战略对光通信产业发展的要求。

二、发行人所处行业基本情况

（一）所处行业及确定依据

公司主要从事自动化智能设备的研发、生产和销售，产品主要应用于光通信、半导体、汽车自动化等行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-

2017），公司所处行业为“C35 专用设备制造业”中的半导体器件专用设备制造（行业代码：C3562）。根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司所处的行业细分领域为“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门、自律组织及监管体制

公司所处行业的主管部门为工信部和国家发改委，行业的自律组织为中国半导体行业协会、中国电子专用设备工业协会与中国自动化学会。

工信部的主要职责为研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目等。

国家发改委的主要职责为信息产业的发展规划和宏观管理，其下属高技术产业司负责监测高技术产业发展动态，研究拟订高新技术产业化战略、规划、重点领域和政策措施。

中国半导体行业协会和中国电子专用设备工业协会主要负责贯彻落实政府产业政策；开展产业及市场研究，向会员单位和政府主管部门提供咨询服务；行业自律管理；代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。

中国自动化学会主要负责促进自动化科学技术的创新开发和应用，推进自动化科技人才的培养；组织开展对自动化科学技术和产业发展战略的研究，提出咨询建议；承担自动化科技及相关领域的科技论证、评估、咨询、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审，科技文献的编审，参与标准的制订；组织开展自动化科技及相关领域的国内外学术交流活动；举办自动化科技及相关领域的展览会或展示会等任务。

国家工信部、发改委和上述行业协会共同构成本行业的监管体制，行业内企业在主管部门产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，遵守行业相关法律、法规与政策，执行行业规范与标准，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

2、行业法律法规及政策

光通信产业是我国现代化信息基础设施建设的重点领域，属于国家鼓励发展行业，公司产品作为光通信、半导体等领域的重要设备，受到国家产业政策大力推动。近年来，国家已将其作为优先发展鼓励项目并制定了一系列扶持政策。

序号	发布时间	发布机关	法律法规及政策	主要内容
1	2025.03	工信部、国家标准化管理委员会	国家智能制造标准体系建设指南	强调人工智能、数字孪生、工业数据流通等技术与智能制造的深度融合，推动智能制造行业发展
2	2025.01	工信部	关于开展万兆光网试点工作的通知	到 2025 年底，在有条件、有基础的城市和地区，聚焦小区、工厂、园区等重点场景，开展万兆光网试点。以试点工作为牵引，推动产业链各方加快协同解决目前万兆光网落地应用中的重点难点问题，带动我国万兆光网核心技术和关键设备取得突破，促进构建万兆光网成熟产业链和完备产业体系，有序引导万兆光网从技术试点逐步走向部署应用
3	2024.12	国家发展改革委、工信部、国家数据局	《国家数据基础设施建设指引》（发改数据〔2024〕1853 号）	推动国家枢纽节点和需求地之 400G/800G 高带宽全光连接，引导电信运营商等提升“公共传输通道”效能，推进算网深度融合；推动传统网络设施优化升级，有序推进 5G 网络向 5G-A 升级演进，全面推进 6G 网络技术研发创新
4	2024.08	工信部等十一部门	《工业和信息化部等十一部门关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》（工信部联通信〔2024〕165 号）	优化布局算力基础设施。各地要实施差异化能耗、用地等政策，引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署。支持数据中心集群与新能源基地协同建设，推动算力基础设施与能源、水资源协调发展。加强本地数据中心规划，合理布局区域性枢纽节点，逐步提升智能算力占比。鼓励企业发展算力云服务，探索建设全国或区域服务平台
5	2024.06	中国电子元件行业协会	《中国光电子器件产业技术发展路线图（2023-2027 年）》	争取到 2027 年，中国本土企业的光电子器件销售总额达到 7300 亿元；产业结构进一步调整，产业链配套能力有所提升，企业竞争实力明显增强，标准化水平大幅提高
6	2024.01	工信部等七部门	《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》（工信部联科	深入推进 5G、算力基础设施、工业互联网、物联网、车联网、千兆光网等建设，前瞻布局 6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究，构建高速泛

序号	发布时间	发布机关	法律法规及政策	主要内容
			〔2024〕12 号）	在、集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施
7	2023.12	发改委	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	鼓励新一代通信网络基础设备：100Gb/s 及以上光传输系统建设
8	2023.10	工信部等六部门	《算力基础设施高质量发展行动计划》（工信部联通信〔2023〕180 号）	明确提升算力高效运载能力，强化算力接入网络能力，提升枢纽网络传输效率。推动算力网络国家枢纽节点直连网络骨干节点，逐步建成集群间一跳直达链路，加快 400G/800G 高速光传输网络研发部署，推动城域光传输设备向综合接入节点和用户侧部署，加快实现大带宽、低时延的全光接入网络广泛覆盖
9	2023.06	工信部	《制造业可靠性提升实施意见》	重点提升电子整机装备用 SoC/MCU/GPU 等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学元器件、光通信器件、新型敏感元件及其它相关领域的产品可靠性
10	2023.02	中共中央、国务院	《数字中国建设整体布局规划》	加快 5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用
11	2022.07	发改委、住建部	《“十四五”全国城市基础设施建设规划》（建城〔2022〕57 号）	加快建设“千兆城市"。严格落实新建住宅、商务楼宇及公共建筑配套建设光纤等通信设施的标准要求，促进城市光纤网络全覆盖
12	2021.11	工信部	《“十四五”信息通信行业发展规划》（工信部规〔2021〕164 号）	到 2025 年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升，成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石
13	2021.03	工信部	《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》（工信部规〔2021〕34 号）	大力推动以 5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络作为制造强国和网络强国建设不可或缺的“两翼”和“双轮”发展，加强网络建设互促、应用优势互补和业务融合创新
14	2021.01	工信部	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》（工信部电子〔2021〕5 号）	重点发展高速光通信芯片、高速高精度光探测器、高速直调和外调制激光器、高速调制器芯片、高功率激光器、光传输用数字信号处理器芯片、高速驱动器和跨阻抗放大器芯片

3、主要法律法规、行业政策对发行人经营发展的影响

上述国家产业政策的出台，为行业和公司发展创造了良好的制度及政策环境。一方面，国家出台了一系列政策鼓励光模块产业和集成电路封测产业发展，

为光模块领域和半导体封测领域发展提供了财政、税收、技术、人才等多方面支持。另一方面，国家大力推进“数字中国”建设，加快构建全国一体化大数据中心体系，提升算力高效运载能力，加快千兆光网与 5G 网络协同建设及 5G 网络向 5G-A 升级演进，促进了光通信及半导体领域的发展，为公司带来持续的市场需求。公司受益于政府政策对行业的引导以及光模块及半导体封装市场规模的不断扩大，自身规模和竞争力也不断提升。

（三）行业发展态势

公司主要从事智能自动化设备的研发、生产和销售，产品主要应用于光通信、半导体、汽车自动化等领域，各细分领域行业发展情况如下：

1、光通信行业概况

（1）光通信行业整体概况

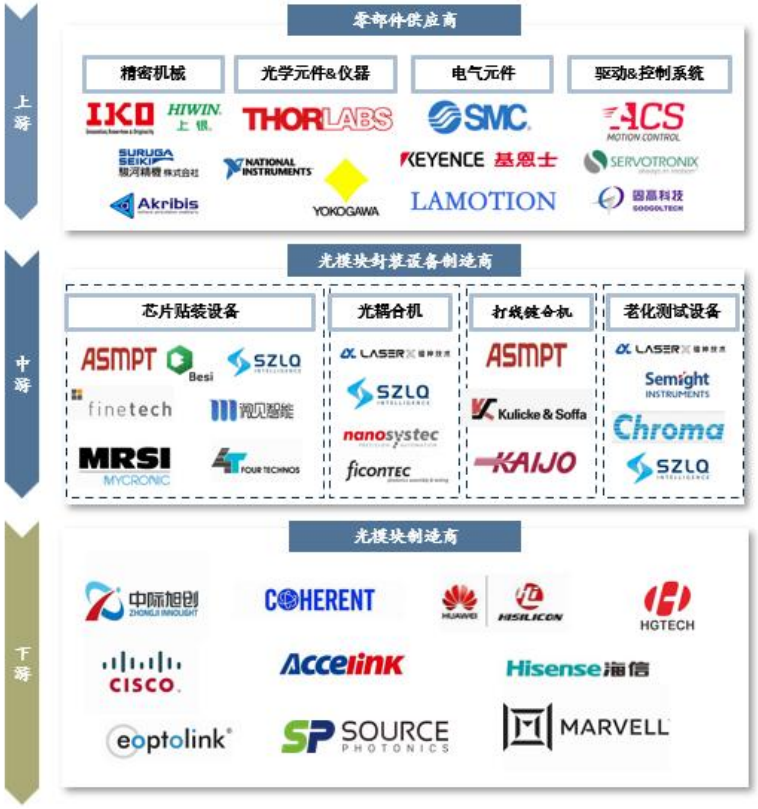
①公司所属行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性

光通信，即光纤通信，利用光纤作为传输介质、光波作为信息载体的通信技术。相较传统的电缆传输介质，光纤通信具有传输带宽更大、传输容量更高、中继距离更远、信号损耗更低的显著优势，是信息传输方式的革命性突破。目前，光通信已经成为世界最主流的信息传输方式，广泛应用于云计算、大数据、人工智能等数通市场和接入网、无线网等电信市场。

A.光通信产业链整体架构

光通信产业链上游主要包括光通信芯片、光通信组件、光模块等。发行人的产品主要应用于其中光模块的生产制造环节，属于光模块封装测试设备厂商。产业链中游主要为光模块和光通信设备等，下游为大数据、人工智能等应用市场。

B.发行人所处细分领域的上下游结构



来源：弗若斯特沙利文

发行人的上游主要包括精密机械（如机械导轨、滑台等）、光学元件（如镜头、光源等工业视觉系统）、电气元件（如传感器、气缸等）及驱动、控制系统。上游行业成熟度较高，供应链体系稳定且竞争充分，因此本行业的原材料采购需求可以得到合理满足。未来，上游设备零部件技术水平的持续提升将推动光模块封装测试设备在综合性能、生产成本等方面的进一步优化。

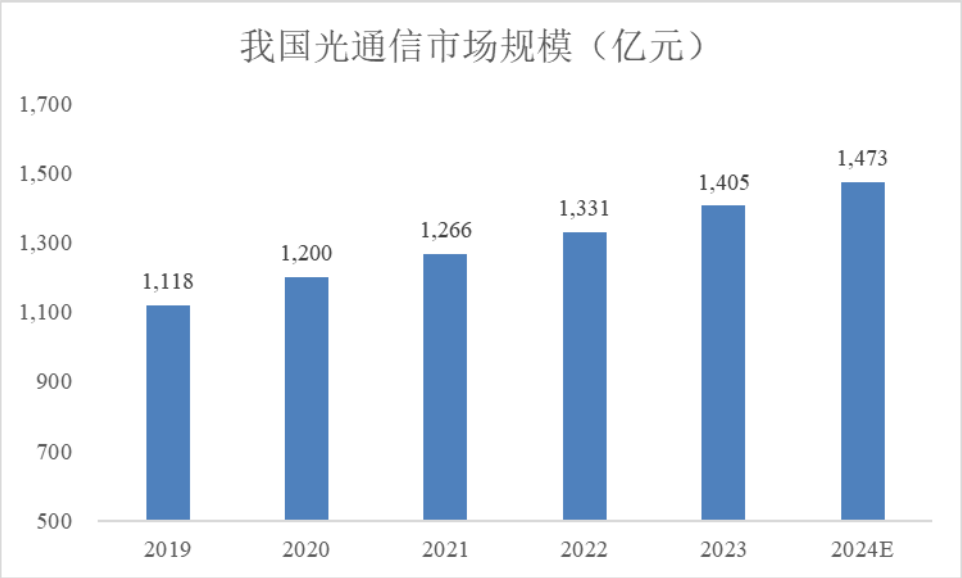
发行人下游则是光模块制造商，其需求受数据中心、电信及新兴场景驱动。近年来，受人工智能、云计算、数据中心等应用市场的需求爆发推动，下游客户对光模块专用设备的需求量快速增加，且对产品性能、精度等指标的要求不断提升，推动光模块封装测试设备行业市场规模持续增长，技术迭代不断加速。

②光通信市场规模

近年来，光通信行业正迎来新的高度发展机遇。人工智能、5G/5G-A、云计算等新一代信息技术的加速演进，数据处理、存储与传输需求呈现爆发式增长，为我国光通信行业带来了新一轮发展机遇。作为数据中心搭建的基础，光

通信行业在下游需求扩张推动下将保持稳步增长态势。据中商产业研究院数据，2021-2023 年我国光通信市场规模分别为 1,266 亿元、1,331 亿元、1,405 亿元，预计 2024 年达到 1,473 亿元，2021 年至 2024 年复合增长率为 5.18%。

我国光通信市场规模如下图所示：



数据来源：中商产业研究院

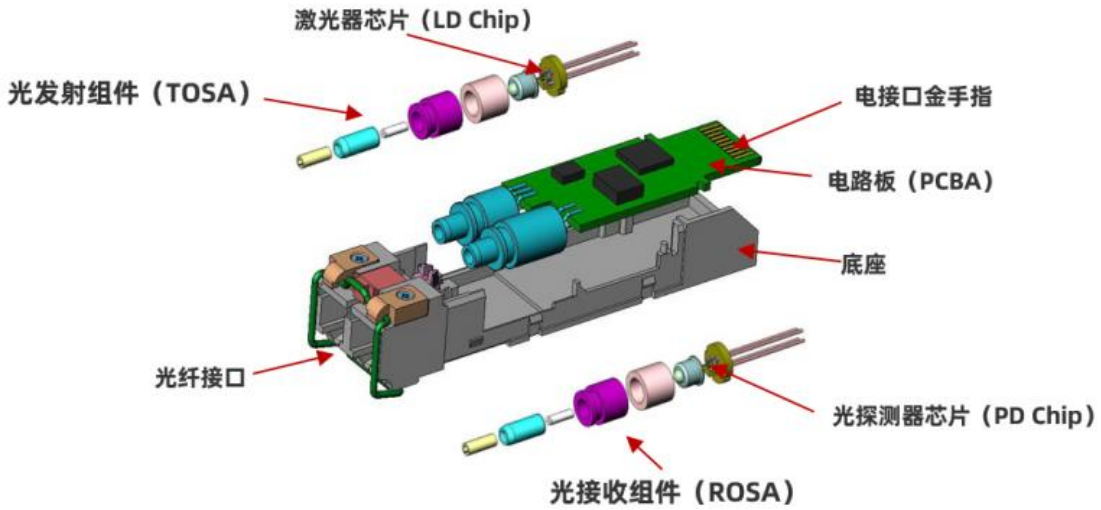
随着各行业数字化转型加速及智能家居、智能城市等新兴场景对网络基础设施要求的提升，未来光通信市场有望持续稳健增长，驱动行业内企业加大研发投入、提升技术水平以满足日益增长的市场需求。

（2）光模块行业概况

①光模块介绍

光模块是光通信中实现光电转换和电光转换的核心器件，通常由光发射组件（TOSA）、光接收组件（ROSA）、驱动电路和光接口等封装而成。在光通信系统中，光模块是系统物理层的基础构成单元，在系统设备中的成本占比超过 50%。

光模块结构示意图如下：



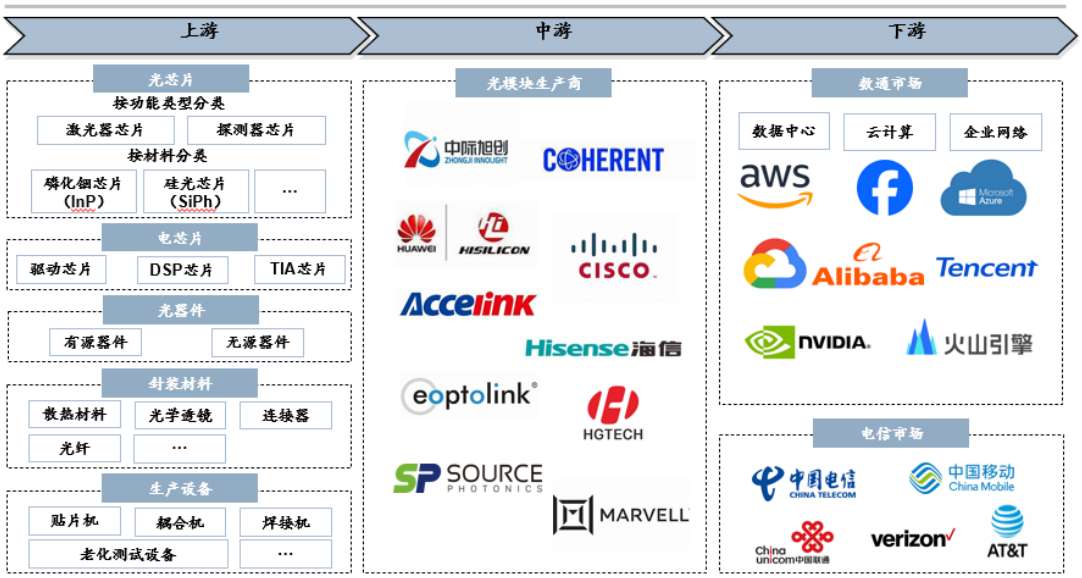
来源：IMT-2020（5G）推进组

光模块根据传输速率可以分为低速模块、中高速模块和超高速模块三类，其中低速模块的传输速率 1G/2.5G/10G，广泛用于传统以太网、接入网等领域；中高速模块的传输速率为 25G/40G/100G，主要应用于 5G 前传、数据中心内部互联等；超高速模块的传输速率可达 400G/800G/1.6T，可支撑 AI 算力中心、骨干网扩容等应用。

②光模块产业链概况及市场规模

光模块的上游主要包括光芯片、电芯片、光器件、封装材料、设备等，中游为光模块的制造和封装。光模块厂商将上游的光芯片、电芯片等零部件集成，完成光模块的设计、制造与封装。生产的主要流程包括芯片贴装、光路耦合、封装成型和测试验证。根据 LightCounting 统计，2025 年全球前十大光模块企业中的中国企业已占据七席，光模块已成为我国光电子信息领域的优势产业。光模块的下游主要为数通市场和电信市场两大应用场景。

光模块产业链示意图如下：



来源：弗若斯特沙利文

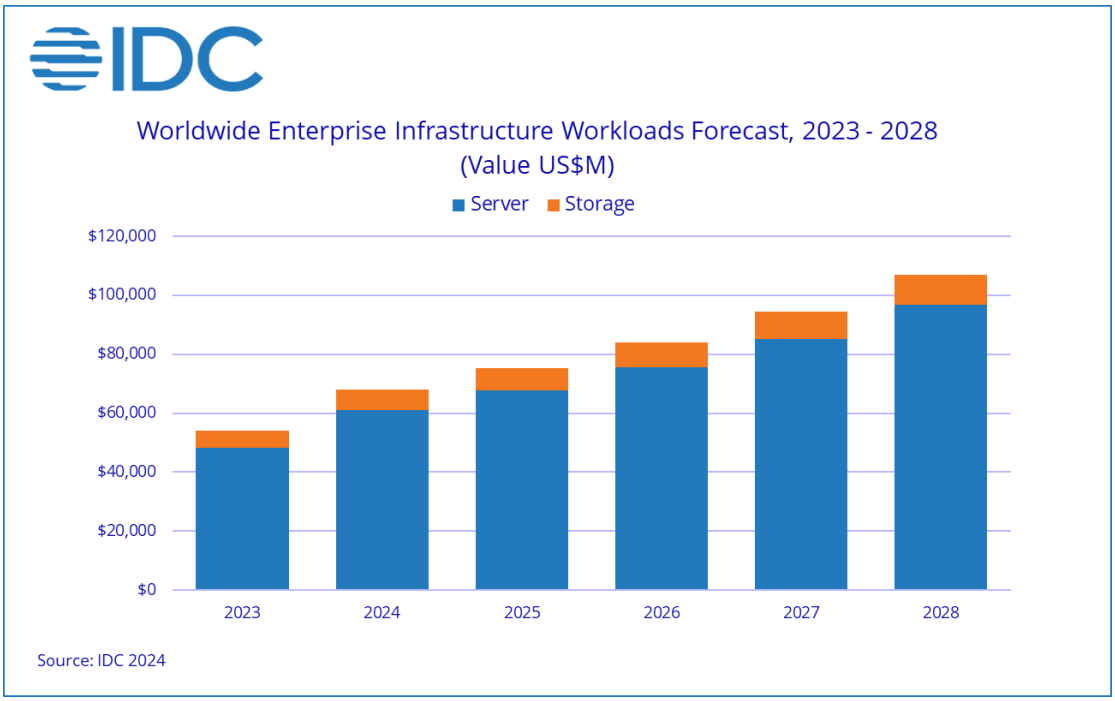
数通市场以数据中心、云计算、企业网络为核心场景，聚焦高速数据传输与算力互联，是光模块增长最快的市场。高带宽、低延时和高密度是数通市场对光模块的核心需求，光模块速率以 400G/800G 为主，并向 1.6T 演进，并且受到 AI 算力与云计算的需求驱动，技术迭代较快，需求快速增长。微软、谷歌、Meta、阿里巴巴、腾讯、字节跳动等国内外云厂商数据中心采购量逐年增长。

国际数据公司（IDC）最新报告显示，全球 AI 基础设施市场正经历着前所未有的高速增长，预计到 2028 年，其支出将突破 1,000 亿美元大关。2024 年上半年，全球各组织在 AI 计算与存储硬件方面的投资同比飙升 37%，总额高达 318 亿美元。其中，AI 服务器成为投资重点，占 AI 基础设施总支出的 89%，同比增长同样达到 37%。

海外云服务巨头，如微软、谷歌、Meta 等，对人工智能的投入已从早期的“技术探索”成功迈向“规模化商业落地”阶段。Counterpoint 数据显示，2023 年微软在人工智能相关基础设施上的投入居首，其资本支出的 13.3%用于此领域，谷歌紧随其后，占其资本支出的 6.8%。微软已宣布将人工智能深度集成至现有产品套件中。进入 2025 年，全球 AI 基础设施军备竞赛愈发激烈，微软、亚马逊、谷歌、Meta 四大云厂商合计资本开支预计突破 3,000 亿美元，创历史新高。这场千亿美元级别的投资狂潮，正强有力地加速光模块技术的迭代更新，

刺激超高速率光模块需求的快速增长。

全球 AI 基础设施市场规模如下图所示：

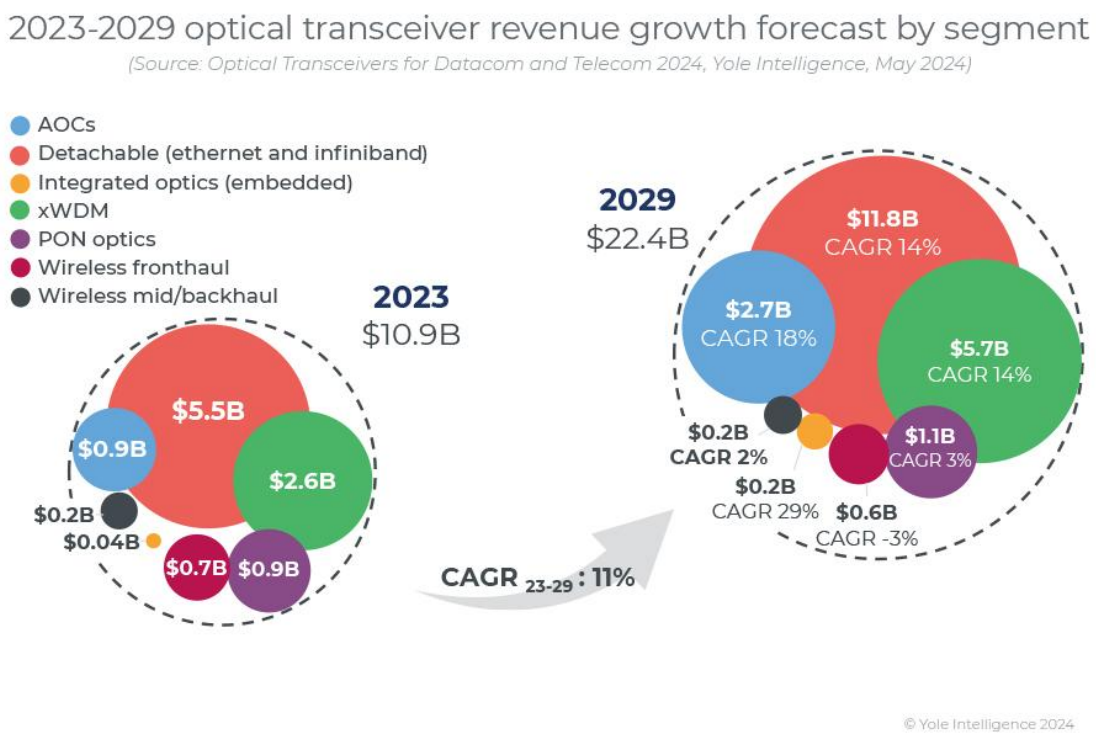


数据来源：IDC

在电信市场光模块主要服务于运营商网络，覆盖无线网（5G/6G）、接入网、骨干网等场景，速率以 25G/100G 为主，400G 主要用于骨干网。电信市场主要受到 5G 网络建设、国家宽带等网络升级的政策驱动，需求刚性增长较为平缓。随着国家“双千兆”网络战略推动 50G-PON 光模块试点，华为技术、中兴在 5G 前传/中传领域主导国产方案，叠加工业互联网领域光纤传感光模块在智能制造中应用等因素，电信市场光模块需求总体将维持稳定增长。

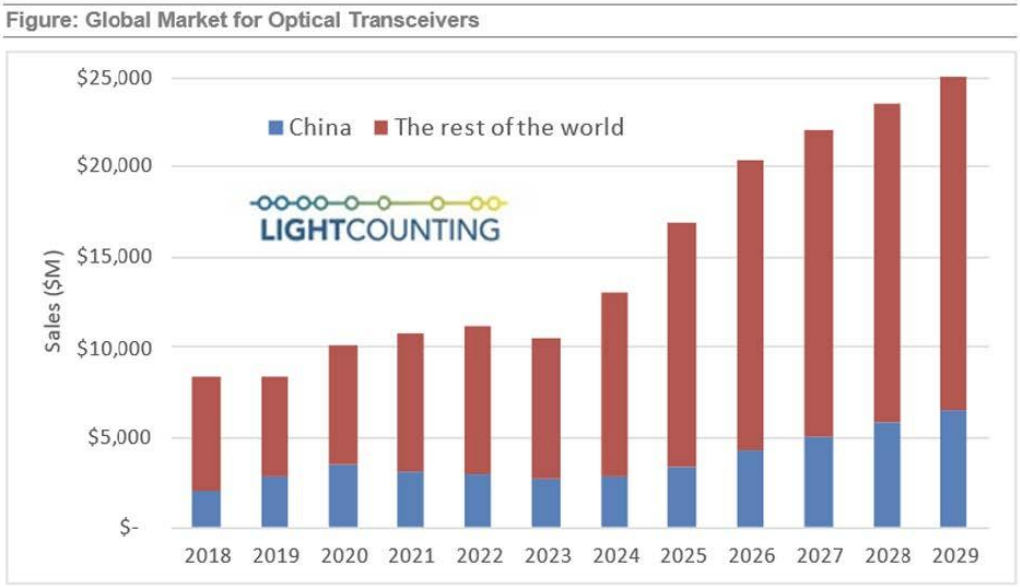
根据 Yole 发布的数据显示，受益于 AI 大模型催生的算力需求爆发，全球光模块市场规模从 2020 年的 87.8 亿美元跃升至 2023 年的 109 亿美元，年复合增长率达 7.5%。未来五年，随着 AI 基础设施建设与云厂商资本开支的双重拉动，预计 2029 年全球光模块市场规模将突破 224 亿美元，2024-2029 年复合增长率 11%。其中，作为数据中心互联的核心器件，数通光模块正以 AI 算力需求为引擎，进入技术迭代与规模爆发的双重周期，数通市场将保持年均 14.8%以上增速，2029 年规模预计达 147.0 亿美元，占整体市场 65.8%。

全球光模块市场规模增长情况如下图所示：



数据来源：Yole

在国内市场方面，光模块作为数字经济底座的核心器件，近年来保持快速增长势头。根据 LightCounting 的数据显示，中国光模块市场规模从 2018 年的 21 亿美元跃升至 2023 年的 27 亿美元，年复合增长率 5.8%。未来，随着“东数西算”、《"双千兆"网络协同发展行动计划》和 AI 训练集群的部署等因素推动，预计 2024 年至 2029 年，中国光模块的部署量将占全球部署量的 20%-25%，2029 年中国光模块规模将突破 65 亿美元，中国光模块市场规模增长情况如下图所示：



数据来源：LightCounting

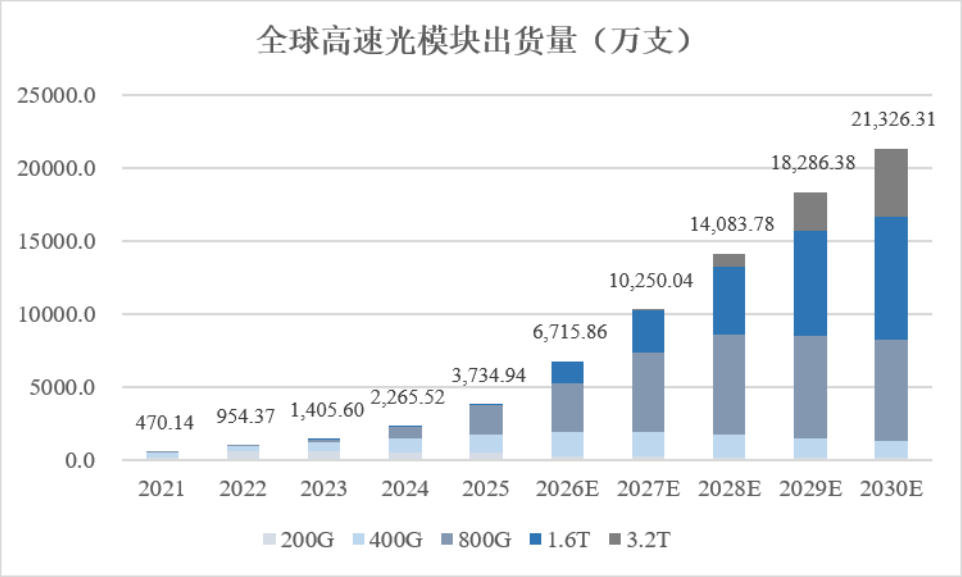
③光模块行业发展趋势

受 AI、云计算、大数据、物联网等新一轮技术的商业化应用推动，光模块行业技术正处于快速升级革新的阶段，光模块行业向高速率化、集成化、智能化方向发展，硅光、CPO 等新技术有望重塑产业格局。

A.技术迭代速度不断加快

高速光模块的速率演进是光通信技术发展的核心脉络，其每一次升级都标志着对更高带宽、更低功耗和更优能效的突破。AI 技术的规模化应用（从文本处理向图像、音视频等多元场景延伸）驱动数据流量爆发式增长，叠加 AI 大模型训练对算力基础设施的海量需求，显著提升对高速率光模块的市场需求。英伟达、谷歌、微软、亚马逊、字节跳动、阿里巴巴等国内外巨头加速布局 AI 算力中心，直接带动 800G、1.6T 超高速光模块的需求提升。

当前 800G 模块已进入规模化交付阶段，1.6T 光模块产品进入头部云厂商测试验证，而 3.2T 技术路径已进入预研阶段，下游应用场景对光模块的速率要求不断提升，技术迭代速度不断加快。预计 800G/1.6T 的高速率光模块将主导未来五年市场的增长，到 2030 年 800G 及以上光模块的市场规模将增长至 20,035.97 万支，占整体高速光模块出货量的 93.95%。



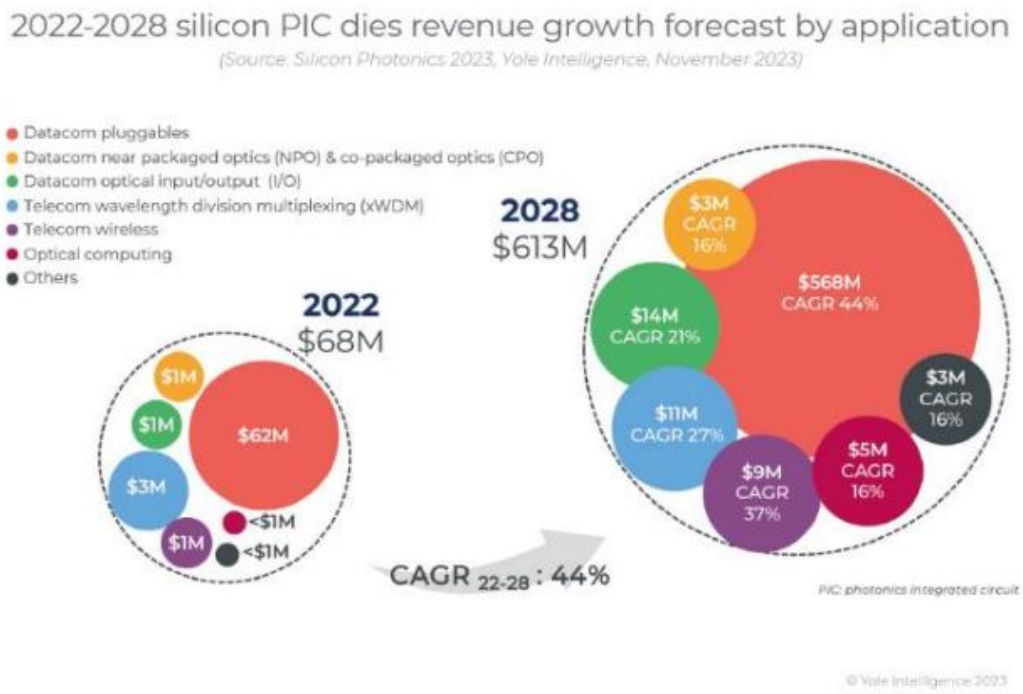
数据来源：LightCounting、弗若斯特沙利文

B.硅光、CPO 等新技术引领产业变革

随着数据中心及 AI 算力基础设施的规模化建设，下游客户对光模块的降本增效与低功耗需求愈发迫切。传统技术主要通过多通道方案实现 100G 以上光模块速度的提升，在 800G 及以上速率场景面临激光器芯片速率瓶颈与成本劣势，催生硅光、CPO、LPO 等新技术加速渗透。

线性直驱（LPO）技术通过简化 DSP 芯片设计，使 800G 模块功耗较传统方案大幅降低。CPO 技术则通过光电共封装技术缩短电芯片与光芯片距离较大幅度提升带宽，降低功耗。硅光模块通过 CMOS 工艺整合激光器、调制器，并且硅基材料逐步替代加工更加复杂磷化铟材料，硅光模块凭借高集成度、低功耗优势，在 800G 及以上市场渗透率逐渐提升，是光模块的重要发展方向之一。根据 Yole 数据，2022 年全球硅光芯片市场价值为 6,800 万美元，随着 800G 可插拔模块在数据中心及 AI 算力场景的应用拓展，预计 2028 年市场规模将突破 6 亿美元，2022-2028 年年复合增长率达 44%，成为高速光模块技术演进的核心方向之一。

全球硅光模块增长情况如下图所示：



数据来源：Yole、中原证券研究所

（3）光模块封测设备行业概况

①光模块封装设备介绍

公司所处细分行业为光模块封装设备行业，位于光模块产业链上游，是支撑光模块制造的关键环节。作为保障光通信设备质量与可靠性的核心载体，光模块封装测试工艺复杂且流程精密，涵盖贴片、引线键合、光学耦合、封装及老化测试等多个关键环节，涉及固晶贴片机、共晶机、光耦合机、芯片/模块老化测试设备等专业装备。

公司产品主要应用于贴片、光学耦合、老化测试三大核心制造环节，其中贴片机作为单台设备价值量最高的环节，直接决定光芯片与电芯片的贴装精度（影响模块性能的关键参数）。随着 400G、800G 及 1.6T 高速率光模块的规模化应用，其对高精度贴片机、耦合设备及智能化老化测试系统的需求持续增长，推动行业高端设备市场快速扩容。

②光模块封装设备行业产业链概况

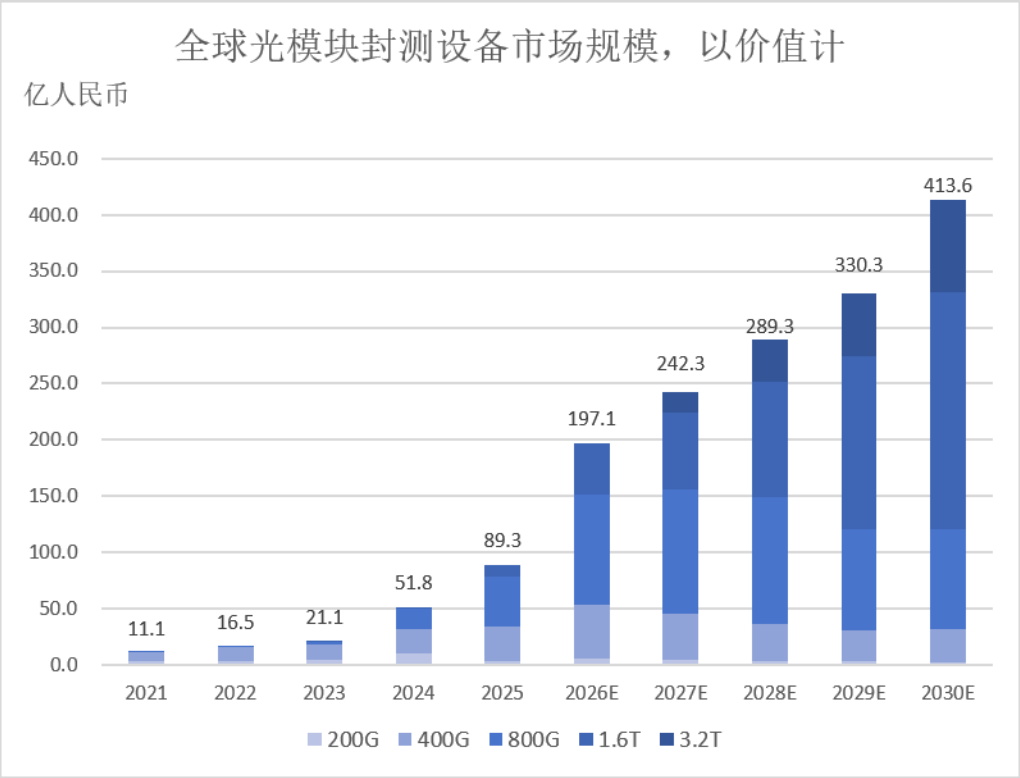
光模块封测设备厂商的上游主要包括精密机械（如机械导轨、滑台等）、光学元件（如镜头、光源等工业视觉系统）、电气元件（如传感器、气缸等）

及驱动、控制系统供应商。中游则是光模块封测设备的研发与生产厂商，主流设备包括芯片贴装设备、耦合设备、引线键合设备、老化测试设备等，下游则是光模块制造商。其需求受数据中心、电信及新兴场景驱动。

③光模块封装设备行业市场规模

受益于 AI 算力需求爆发，全球高速率光模块封测设备市场呈现跨越式增长。据弗若斯特沙利文数据，全球市场规模从 2021 年 11.1 亿元增至 2025 年 89.3 亿元，年复合增长率达 68.42%，其中 800G 光模块设备市场规模从 2022 年 0.1 亿元激增到 2025 年 43.6 亿元，成为增长最快的细分领域。

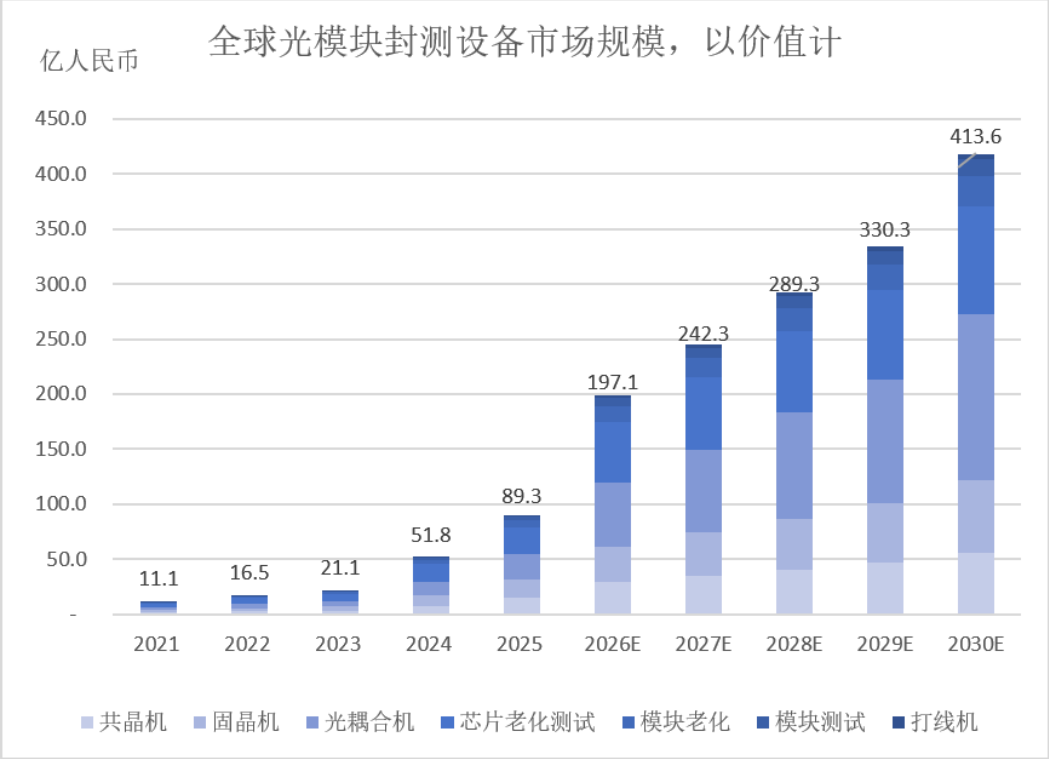
在 AI 服务器扩产驱动下，800G 和 1.6T 光模块设备需求将持续提升，2026 年 800G 和 1.6T 光模块封测设备市场规模分别预计达 98.5 亿元及 45.3 亿元。随着技术迭代与下游需求共振，2030 年全球高速率光模块封装设备市场规模有望突破 413.6 亿元，2026-2030 年复合增长率 20.5%。



数据来源：弗若斯特沙利文

光模块封测设备中，固晶贴片机、共晶机、光耦合机是最核心的设备，单价也相对较高。受人工智能、大数据、云计算产业拉动，光模块封测设备需求快速增加，其中固晶机全球市场规模在 2025 年达到 16.6 亿人民币，预计其市

场规模在 2030 年达 66.0 亿人民币，2026 年到 2030 年复合增长率为 19.2%。全球光耦合机全球市场规模在 2025 年达到 23.1 亿人民币，预计 2030 年全球市场规模为 150.8 亿元人民币。芯片老化测试设备是光模块封测设备中价值占比最高的设备，2025 年其全球市场规模为 24.9 亿人民币，占高端光模块封测设备总市场的 27.9%。



数据来源：弗若斯特沙利文

④光模块封装设备行业发展趋势

随着云计算、数据中心及 5G 通信网络的爆发式增长，光模块正加速向 800G/1.6T 及以上超高速率迭代。2025 年 1.6T 产品已进入谷歌、Meta 等头部企业的预商用测试阶段。光模块封测设备行业展现出三大趋势：

A.高精度与高速率制造设备成为核心

为满足光模块中光电共封装的亚微米级贴装要求，设备厂商通过高刚性运动平台、多轴联动视觉系统和热膨胀补偿算法实现精度跃升。部分国产厂商的贴片机加工精度已达±3μm，支持多芯片贴装；耦合设备已能达到最小运动增量 50nm；高速率方面，通过优化贴装系统轨迹曲线&降低工艺消耗时间（如共晶提升升降温速率）。从而满足日益增长的需求。

B.集成化整线交付与智能化生产加速渗透

当前光模块封测设备行业正加速迭代，核心呈现两大发展方向，既适配高速光模块技术升级需求，也响应下游客户生产效率提升诉求。

一方面，在 800G/1.6T 光模块的规模化生产中，由于硅光技术的高速率、低功耗等优点，未来高速率光模块将采用硅光芯片，光模块封测设备需兼容硅光、CPO 光电共封测等复杂封测工艺，并通过多工艺平台整合提升功能密度。与此同时，下游客户对生产效率的需求持续升级，行业正从“孤立设备供应”向“整线交付方案”转型。客户不再满足于单独采购设备，更需要覆盖“工艺设计-设备部署-生产运维”全流程的一体化方案，以此降低不同设备间的整合成本，提升产线整体协同效率，适配高速光模块大规模量产的节奏。

另一方面，智能化成为提升封测设备核心竞争力的关键方向之一。随着智能化控制技术逐步普及，如贴片机通过基于 PID 补偿算法，提升设备精度稳定性。并集成 MES 与 AGV 上下料系统，做到设备信息互联，物料智能调度。且智能化程度从单站向多站衍进，并最终迈向整厂智能化。

C.国产设备替代率持续提升

在政策支持与市场需求双重驱动下，国产光模块封测设备正快速突破“卡脖子”环节。一方面，国内厂商通过自主创新填补高端设备空白。另一方面，产业链协同效应显现，全球前十大光模块厂商中七家为中国企业，带动生产设备国产化率不断提升，同时也可以保护产业链稳定，防止国际政治对于供应链上游可能出现的影响。随着 3D 先进封装需求增长，国产设备厂商有望在贴片、光耦合等领域进一步替代海外龙头，实现从“跟跑”到“领跑”的跨越。

2、半导体行业概况

（1）半导体行业概况

半导体是一种材料，其导电性能介于导体和绝缘体之间，可以在一定条件下控制电流的流动。半导体作为现代科技产业的基石，广泛应用于计算机、通信、消费电子、汽车、工业控制、医疗等诸多领域，是推动全球数字化、智能化发展的核心驱动力，半导体可分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器四大类，发行人封装测试设备可用于其中的集成电路和光电器件行业。

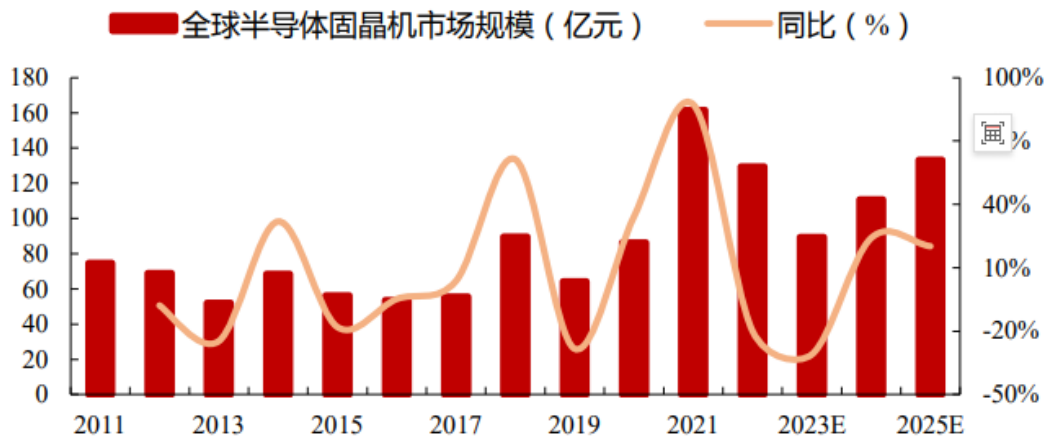
全球半导体贸易统计组织（WSTS）数据显示，2024 年全球半导体市场规模已达 6,305 亿美元。同时，根据 WSTS 预测，2025 年全球半导体市场规模约为 7,956 亿美元，同比增长 26.2%，保持较为强劲的市场需求。

（2）半导体封装设备行业概况

半导体工艺流程复杂，对设备依赖度较高，设备性能直接影响半导体制造的性能、效率及良率，所以半导体设备具有技术壁垒高、研发周期长、研发投入高、制造难度大、客户验证壁垒高等特点。在半导体产业链中，封装测试处于晶圆制造过程中的后道环节，在芯片制造完后，将晶圆进行封装测试。封装的作用包含对芯片的支撑与机械保护、电信号的互连与引出、电源的分配、热管理、功能集成及系统测试等。

半导体封装设备是确保芯片功能与可靠性的关键环节，涵盖从晶圆切割到成品测试的全流程。目前，典型封装流程包括划片-减薄-固晶-键合-塑封-切筋成型-测试，相对应的设备则主要为：划片机（切割晶圆）、固晶机/贴片机（芯片贴装）、引线键合机（电气连接）、塑封机（封装保护）、测试机（性能验证）。

全球封测市场规模稳定增长，先进封装贡献主要增量。未来汽车电子、人工智能、数据中心等应用领域的快速发展将推动全球封测市场持续高走。而在半导体封测设备市场规模方面，根据 SEMI 及东吴证券的测算数据，2021 年全球封装设备规模达到 490 亿元，2022 年和 2023 年受传统封装市场逐渐饱和的影响，市场规模有所回落。但 2024 年随着 AI、新能源、光伏等新兴行业的需求扩大，先进封装需求的上升将带动市场进入稳步回升期。根据 SEMI 预测，2024 年全球半导体封装设备市场规模有望达 59.5 亿美元，折合人民币约 430.8 亿元。而根据 SEMI 及华西证券研报显示，贴片机在全球半导体封装设备中的价值占比约为 32%，预计 2025 年全球市场规模约 133 亿元人民币。



数据来源：SEMI、华西证券

（3）半导体封装设备行业发展趋势

①市场规模持续增长，先进封装驱动加速

随着全球半导体市场对高性能、高密度芯片需求的增加，半导体封装设备市场规模正在迅速扩大。特别是在 5G 通信、人工智能、物联网、自动驾驶等新兴技术的推动下，对更小尺寸、更高集成度和更好性能的先进封装解决方案的需求愈发强烈。这促进了如倒装芯片（Flip Chip）、晶圆级封装（WLP）、硅通孔（TSV）等技术的发展，并带动了相关先进封装设备市场的增长。面对这一趋势，封装设备制造商不断加大研发投入，开发支持新技术的设备，以保持竞争力。同时，封装工艺复杂性的增加对设备精度和效率提出了更高的要求，为高端封装设备提供了广阔的应用前景。

②国产化率提升，本土企业迎发展机遇

近年来，半导体封装设备领域的国产化率显著提升，为本土企业带来了新的发展机遇。随着国家政策的支持和一系列扶持措施的出台，本土企业在技术研发上的投入不断增加，取得了重要突破。国际贸易形势的变化也促使更多国内企业重视供应链的安全性和自主性，倾向于采购国产设备，这为本土企业创造了有利的市场环境。

3、智能装备制造行业概况

（1）智能装备制造业概况

智能制造是依托新一代信息技术，贯穿设计、生产、管理、服务等全制造

环节，具备信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等核心功能的先进制造模式。作为其核心实现载体，智能制造装备集成机械系统、运动控制、电气控制、传感器及信息管理等多领域技术，通过智能化手段显著减少人力依赖，提升生产精度、质量及效率，已广泛应用于汽车制造、半导体、消费电子、医疗健康、仓储物流等领域。

从细分行业来看，智能装备制造业可分为三个行业，上游为关键零部件行业，主要生产精密减速机、伺服系统及机器人控制器等核心部件，中游为工业机器人行业，下游为自动化设备行业。公司所处的自动化设备行业，核心业务为依据客户工艺要求进行自动化设备的研发设计与生产制造，通过整合智能控制技术、精密机械系统等技术，为客户提供智能化解决方案，助力实现制造过程的自动化、柔性化、数字化升级。

（2）自动化设备行业概况

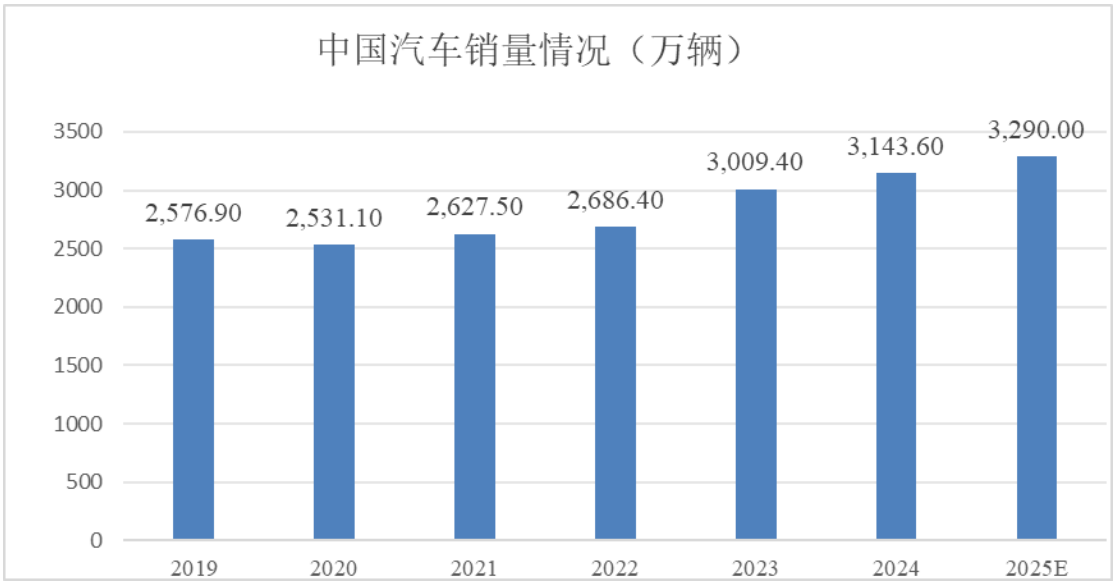
自动化设备商核心服务于终端用户及细分市场，基于客户特定应用场景与工艺需求，提供定制化系统集成与软件开发服务。行业以非标准化产品为主要业务形态，需结合场景特性进行定制化设计，因此要求企业具备深厚的产品设计能力、丰富项目经验及精准的工艺需求理解，进而提供覆盖多领域的标准化与个性化智能装备解决方案。

公司自动化设备及整线解决方案业务的核心下游领域为汽车制造业及光通信行业，主要服务于汽车零部件厂商及光模块厂商的自动化生产流程。下游行业的产品需求直接决定市场需求强度，其快速增长将有效拉动行业市场容量扩张，形成显著的需求传导效应。

（3）主要应用领域行业发展概况

①下游汽车制造业市场空间广阔

我国汽车制造业呈现稳健增长态势，为自动化设备行业提供广阔市场空间。根据中国汽车工业协会数据，2019-2024 年我国汽车销量年均复合增长率达 4.06%，尽管 2020 年短期承压，但随着新能源汽车渗透率快速提升，市场逐步释放增长动能，带动整体汽车销量稳步回升。据中国汽车工业协会预测，2025 年中国汽车总销量将达到 3,290 万辆，同比增长 4.7%。



数据来源：国家统计局、中商产业研究院、中国汽车工业协会

汽车零部件制造作为产业链关键环节，其规模扩张与汽车产销量呈强正相关。我国汽车零部件行业销售规模预计从 2019 年 3.57 万亿元增至 2024 年 4.6 万亿元，复合增长率 5.26%。根据国家统计局、弗若斯特沙利文预测数据显示，预计 2029 年中国乘用车零部件制造业营业收入达到 5.2 万亿元。长期来看，汽车电动化、智能化趋势持续深化，零部件制造的精密化、自动化需求同步提升，为自动化设备行业创造持续增长空间。

②汽车产业转型升级驱动智能制造需求

我国汽车产业高质量发展依赖成本控制、质量提升与效率优化，对生产过程的自动化、智能化、信息化提出更高要求。从精密零部件加工到整车装配，均需高精度自动化设备保障品质稳定性与生产效率。

当前，互联网、大数据与人工智能技术深度融合，推动汽车产业向数智化转型。汽车制造企业加速引入智能随行小车、高精度传感器、工业机器人及自动化生产线等先进装备，实现生产流程的智能化升级。

同时，用户个性化需求成为汽车制造商在市场竞争中脱颖而出的重要着力点，倒逼车企制造模式变革。汽车企业需具备快速响应能力，在车型定制、配置组合等方面实现柔性化生产，这对自动化设备的模块化设计、工艺兼容性及数据协同能力提出更高要求。智能制造装备作为柔性生产的核心载体，其市场需求将随产业转型持续扩大。

（4）行业未来发展趋势

①制造过程逐步自动化、集成化、数字化、信息化

对标德国“工业 4.0”战略，我国制造业正加速从传统生产模式向智能化转型，核心呈现四大技术趋势。四大趋势以数据驱动为核心，适配多品种小批量生产模式，满足个性化产品的设计与制造需求，成为行业技术升级的必然方向：

自动化：智能装备可根据生产指令自主完成制造流程，通过传感器与自适应算法实现制造对象及环境的动态适配，显著提升生产过程优化能力；

集成化：推动技术集成与系统集成双轮发展，将工艺技术、硬件设备、工业软件深度融合，实现生产装备与智能网络的高度互联；

数字化：借助虚拟仿真技术在生产前完成工艺验证与流程优化，生产中通过数据中台实现全流程实时管控，最终构建高效柔性生产线，缩短产品上市周期；

信息化：信息技术与制造技术深度融合，将感知技术、软件技术等应用到生产设备中，实现装备性能的提升和自动化。

②经济结构调整、人口结构变化推动制造业变革

我国经济增长方式从粗放型向集约型转变过程中，人口老龄化加剧与人口红利衰减导致社会用工成本持续上升，倒逼传统制造业加速自动化改造。未来随着我国经济结构深化调整与传统产业升级推进，制造业对智能化改造的需求将持续释放，为智能制造装备创造广阔市场空间。

③个性化定制驱动智能制造模式变革

个性化定制是当前汽车工业的发展潮流，更是我国汽车工业在智能制造时代获取竞争优势的重要途径。智能制造是实现大规模个性化定制生产的重要基础，智能制造具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能，具备以智能工厂为载体、以关键制造环节智能化为核心、以端到端数据流为基础、以网通互联为支撑的特征，实现了高质量保证的智能化、自动化、柔性化和信息化的生产，智能制造成套装备成为我国汽车产业实现大规模个性化定制的软硬件基础。

（四）所属细分行业技术水平及特点、进入本行业主要壁垒

1、行业技术水平和技术特点

公司深耕光通信、半导体、汽车自动化等领域智能生产装备，所处的智能制造装备行业长期呈现“国际龙头主导、国内企业快速追赶”的竞争格局。国际知名厂商凭借数十年技术积累与完整产品矩阵占据高端市场，而我国企业通过吸收国外先进技术并结合本土需求开展定制化研发，在光模块封装测试设备等细分领域实现突破。

以光通信行业为例，我国光模块封装测试设备行业起步较晚，早期技术与产品性能落后于海外厂商，长期以来相关设备受欧美设备厂商所主导。但随着国内光模块产业的高速发展，国产设备商从中低精度产品切入市场，通过密集而高效的研发与技术积累，不断缩短和海外龙头厂商的差距。随着行业内厂商在精密运动平台、视觉定位、压力控制等核心技术领域取得突破，逐步掌握光芯片测试、光耦合、共晶焊接、多芯片贴装等关键工艺，显著提升行业整体技术实力与国产化率。

整体来看，公司所处的智能制造装备行业及细分行业呈现出以下几个方面的特点：

（1）技术综合性强

公司所处的智能制造装备行业是技术综合性较强的制造产业，综合运用了控制系统设计、精密制造技术、视觉定位、软件设计等技术，属于多学科和先进技术的综合集成。而随着下游光模块市场技术的快速迭代，光模块封测设备对工艺设备在精度、速度、泛用性、智能化程度提出了更高要求，新工艺、多路线的协同发展也衍生出新工艺设备，路线向 2.5D、WLP 等先进封装工艺迈进。

（2）专业化程度要求，技术门槛高

公司设备的下游应用场景主要为光模块行业，封测设备主要针对光电子器件的装贴和检测。光芯片能量密度较高，对温度高度敏感。从芯片测试，到芯片封装（共晶焊接），再到器件级的老化测试，需要对光芯片特性及封装测试工艺有较深的理解，与传统 IC 封装有较大的区别。同时，光模块耦合封装需要对光电转换回路有较深的理解，从而方便根据产品特性要求搭建闭环回路，实

施光学器件空间位姿的调整，调整最小运动增量达 50-100nm。

此外，光模块封装中，需要将不同尺寸的芯片按照光电回路要求进行贴装，涉及多尺寸多精度的融合，同时因为芯片材料的原因，对压力更为敏感。贴装过程对力的控制及监控也是设备能稳定生产的一个重要因素。

综上，光模块领域的封装测试设备需要对光模块行业本身有较为深刻的理解，对光模块产品的主要工艺和技术发展趋势有充分的认知和技术储备，具有较高的技术门槛。

（3）产品需求定制化

公司所处的智能制造装备行业具有较强的个性化和定制化特征，需要根据不同客户对产品速率、应用场景等方面的不同要求，定制个性化解决方案。因此行业内企业需要深刻了解和熟悉设备不同种类光模块的生产工艺和下游客户的需求，以满足下游模块商对封装测试设备的个性需求。

2、进入本行业的主要壁垒

（1）技术壁垒

智能制造装备行业属于典型的跨学科技术密集型行业，核心技术的深度积累与持续创新能力是构建竞争优势的核心要素。企业不仅需掌握机械设计、电控系统、视觉定位、软件算法等多维度技术，更要深度跟踪下游行业技术变革，通过多技术融合创新满足下游行业的快速发展和变化。

受益于 AI 及数据中心的迅速发展，下游光模块行业对高速率光模块需求迅速增长，并且速率迭代越来越快，因此对光模块设备厂商技术迭代的要求也同步提高。例如在 800G/1.6T 光模块的规模化生产中，由于硅光技术的高速率、低功耗等优点，硅光技术成为未来高速率光模块的发展方向之一。因此光模块封测设备需兼容硅光、CPO、液冷封装等复杂封测工艺，并通过多工艺平台整合提升功能密度。行业内企业必须建立从核心部件设计研发到工艺算法开发的全技术链条，同步储备激光辅助键合（LAB）、倒装热压等前沿工艺研发能力，对潜在进入者形成显著技术壁垒。

（2）客户壁垒

光通讯设备的性能和可靠性直接影响到通讯系统的稳定性，因此，设备在投入市场前必须经过客户的严格检测和认证，包括性能验证、质量保证及适配性评估。光通信下游客户，特别是大型光通讯设备商、运营商、模块商等，通常有着严格的供应商认证流程。新进入者需经过严格的供应商资质审核以及长期合作之后才能获取客户的认可和采购订单，进入成本和门槛较高。

而合作多年的合格光模块设备供应商的产品质量稳定、配合度较高，可提高光模块厂商对下游终端用户的服务与体验，因此已经与客户形成了稳定的合作关系，替换难度较大，客户更倾向于与长期合作的供应商建立深厚的合作关系，进而形成强大的客户粘性。

（3）人才壁垒

智能制造装备行业技术的复杂性要求企业整合机械工程、控制工程、光学技术、软件工程等多学科人才，并培育兼具行业工艺理解与产品开发能力的复合型团队。行业新进入者在短时间内难以建立具有高速率模块封装工艺经验与跨领域技术整合能力的专业团队，形成了较高的人才壁垒，使得其在技术创新、产品研发、市场拓展等方面面临较大挑战。

（4）资金壁垒

由于智能制造装备通常功能要求多样化，生产过程复杂，因此需要投入大量资金进行研发，对企业资金实力有较高要求。企业需在尚未形成经济效益之前，进行大量资金投入，用于研发、设备购置、厂房建设和技术改造等。此外，随着光通讯技术的快速更新迭代，企业还需持续投入资金进行新产品研发、生产设备升级换代，以确保在技术和市场中的竞争力，从而形成较高的资金壁垒。

（五）面临机遇与风险、行业周期性特征，以及上述情况在报告期内的变化和未来可预见的变化趋势

1、面临的机遇

（1）国家政策支持与资金助力

近年来，国家出台了一系列政策鼓励光模块产业和集成电路封测产业发展，

为光模块领域和半导体封测领域提供了政策、税收、技术、人才等多方面的支持。如《基础电子元器件产业发展行动计划》、《国家数据基础设施建设指引》等文件明确提出了对光通信器件研发的大力支持。此外，地方政府也积极响应中央政策，通过设立专项产业基金、提供税收优惠等措施，促进产业集聚和发展，从而加速国产化进程。

在智能装备制造方面，国家接连出台了相关政策来实现制造强国战略，《“十四五”智能制造发展规划》等文件明确指出：以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，强化工业基础能力，促进产业转型升级。国家大力的政策支持为公司业务拓展提供了有力保障。

（2）下游市场需求持续快速增长

随着全球光通信市场的快速发展，尤其是 5G 通信、数据中心建设以及人工智能（AI）等新兴技术的广泛应用，对高速率、高带宽光模块的需求日益增加。以 ChatGPT 为代表的大模型训练对算力的需求呈指数级增长，直接推动超算集群和数据中心互联需求，算力需求的激增和 AI 服务器的部署直接拉动了光模块的大规模应用。

根据弗若斯特沙利文数据显示，受益于 AI 大模型催生的算力需求爆发，全球光模块市场规模从 2020 年的 87.8 亿美元跃升至 2023 年的 109 亿美元，年复合增长率达 7.3%，预计 2029 年全球光模块市场规模将突破 224 亿美元。根据中商产业研究院数据显示，2022 年中国光通信市场规模约为 1,331 亿元，预计到 2024 年将达到 1,473 亿元。

国内外光模块市场需求的高速增长，带动光模块设备需求量的大幅增加，特别是随着 800G 光模块的大规模部署以及预计于 2025 年商用的 1.6T 产品，行业内的扩产需求变得尤为旺盛。光模块、光芯片行业龙头企业如中际旭创、源杰科技都已有明确的国内外扩产规划，为光模块设备厂商的发展创造良好机遇。

（3）供应链安全需求和国产替代加速推进

长期以来，光通讯封装设备市场主要由美国、日本、德国等欧美国家占据，国内厂商长期依赖进口设备，高端光模块封测设备的国产化率仍不足 20%，国内设备厂商仍有巨大的渗透空间。面对国际形势的不确定性，保障供应链的安

全性和稳定性成为各大模块厂商的重要考虑因素之一。近年来随着以发行人为代表的国内设备厂商的技术研发和工艺积累，技术水平逐步向国际领先水平靠近。国内设备厂商依靠性价比、高效的客户服务等优势，逐渐打破了进口垄断的局面。通过持续的技术创新和市场拓展，国内光模块设备企业有望在这一快速增长的市场中占据一席之地。

（4）下游应用领域市场更新换代迅速，对设备厂商提出新的需求

光通信产业下游需求升级迅速，技术发展日新月异。尤其是 5G 通信、数据中心建设以及人工智能（AI）等新兴技术的广泛应用，对高速率、高带宽光模块的需求日益增加，光模块速率逐渐从 800G 向 1.6T 演进。未来，随着光通信产业快速的升级换代，下游厂商将对光模块封装设备的性能及可靠性提出更高的要求。同时，随着光模块速率不断上升，未来高速率光模块将可能采用硅光技术、CPO 等新技术，因此光模块封测设备需兼容硅光、CPO 等复杂封测工艺。

国产光模块厂商在市场上的主导地位给国内设备厂商提供了更多施展的空间，国内设备厂商能够更快更深度地直接接触并服务下游光模块制造商，提供更为定制化和便捷的服务，更快地解决客户的技术难题，从而有望实现弯道超车，这种技术驱动的产业进化让国产厂商拥有了更强的创新能力与竞争机会。

2、面临的风险与挑战

（1）高端专业人才稀缺

智能制造装备行业属于资金与技术密集型行业，涉及如机械控制、精密测量、机器视觉、软件等多个技术领域。同时，相关技术人员需要对下游领域的制造流程、生产工艺、技术迭代和未来趋势有深刻理解，以满足客户个性化需求。我国智能制造装备行业发展时间较短，行业高素质专业技术人才的储备仍显不足，相关人才培养难度较大、周期较长，高端复合型技术人才短缺制约了行业的快速发展。

（2）国际头部厂商具备先发优势

长期以来，光模块、半导体封装测试设备市场长期被 BESI、ASMPT 等国际龙头企业所主导，且其在经营规模、技术积累、客户资源、产品覆盖范围等

方面都存在较大的先发优势。而我国光模块封装设备行业起步较晚，在技术积累和产品性能上与国外厂商存在一定差距，尤其是在高端设备领域仍有较大提升空间。国产厂商需要进一步提升自身产品竞争力，以性能、可靠性、价格和本土化服务等优势逐渐赢得客户信任。

3、行业周期性特征

发行人所处的专用设备行业属于光通信、半导体产业链上游，行业的发展受下游光通信、半导体行业需求波动影响。因此，若未来宏观经济出现周期性波动引发终端需求疲软，或生产工艺更新迭代速度减缓引发光模块、半导体制造厂商对设备需求下滑，可能导致上游专用设备行业发展状况呈现一定的周期性波动。

（六）公司创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新和业态创新情况

1、公司创新、创造、创意特征

公司主要从事自动化智能设备的研发、生产和销售，产品主要应用于光通信、半导体、汽车自动化等领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C35 专用设备制造业”中的半导体器件专用设备制造（行业代码：C3562）。公司在多个方面均体现出明显的创新性、创造性和创意性特征，具体如下：

（1）聚焦光模块封装测试领域，坚持自主创新，保障核心技术自主可控

公司自成立以来，深耕光模块封装设备领域，坚持以产业发展方向和客户需求为导向，高度重视自主创新和技术研发，持续投入大量资金和人力，确保关键核心技术自主可控。截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有发明专利共 55 项，并以技术诀窍（Know-How）和商业机密的形式保有众多工艺及专有技术。

依托多年在运动控制、光学视觉、自动化控制软件及设备机械结构等领域的深耕积累和自主创新，目前公司已具备光模块封装全流程设备的开发能力，并在贴片设备、耦合设备和老化测试设备等方面已经实现了国产替代。其中共晶贴片设备的设备精度达到±1μm，产品精度达到±3μm，技术指标与国际龙头齐平。耦合设备、固晶贴片设备精度及效率指标处于国内领先水平，相关产品得到国内主流市场的高度认可，公司设备已广泛应用于中际旭创、光迅科技、

源杰科技等光模块、光芯片龙头厂商。

公司创始团队具有十余年自动化和光通信行业从业经验，公司目前已建立了一支以葛宏涛为核心的技术团队，研发人员超 100 人，专业领域涵盖机械控制、软件设计、光学视觉等多个领域，具备根据市场需求和行业发展趋势，进行快速产品迭代升级的研发能力。

（2）强化技术创新能力，丰富公司产品领域，储备行业前沿技术

半导体行业可以划分为集成电路、分立器件、光电器件和传感器四大类。其中光模块中使用的光电芯片归属于光电子器件这一分类。而半导体其他领域的封装测试工艺流程与光模块领域较为接近，都需要进行芯片贴装、键合、测试等环节。因此，光模块领域的封装测试设备在底层原理、技术方面存在一定的共通性，底层技术如运动控制、视觉技术、机械设计等方面具有较强的延展性。公司依托于在光模块封装测试设备领域的技术积累，逐步向半导体行业其他领域拓展。目前公司推出的固晶和共晶设备，可适用于半导体微波射频领域，并实现向客户五等射频行业知名客户批量供货，公司研发的 SiC 预烧结设备已通过士兰微验证。

此外，公司研发团队针对硅光方案之后的先进封装发展方向，储备了大量的技术和设计工艺，目前公司已针对 TCB、LAB、Reflow 等先进封装工艺设计出新的设备方案，并通过模块优化和下游客户调研不断调整设备工艺。公司集中公司研发技术资源积极攻关重大难点，其中 TCB 设备已在客户处送样试验。公司坚持以技术创新为核心，不断提升产品性能和产品覆盖领域，以满足不断变化的市场发展趋势和下游客户需求。

2、公司促进新技术、新产业、新业态、新模式与传统产业深度融合情况

（1）紧跟光通信技术迭代趋势，深化产业融合创新

公司所处的光通信行业正经历技术革新与市场需求爆发的双重驱动，光模块作为核心传输器件，其封装技术迭代速度加快，对光模块封装测试设备的精度、效率及工艺适配性提出更高要求。近年来，随着 AI 算力需求激增、数据中心向 800G/1.6T 超高速率演进，以及硅光集成、光电共封装（CPO）等新兴技术的兴起，光模块行业呈现三大显著变化：

①速率与集成度升级：高速率光模块（800G/1.6T）对芯片贴装精度要求提升至±3 微米级，需同步优化耦合、测试等全流程工艺；②工艺革新加速：硅光芯片倒装焊、激光辅助键合（LAB）等先进封装技术逐渐普及，传统封装设备亟需向高精度、多工艺兼容方向升级；③国产设备替代率持续提升：在政策支持与市场需求双重驱动下，国产光模块封测设备正快速突破“卡脖子”环节。一方面，国内厂商通过自主创新填补高端设备空白。另一方面，产业链协同效应显现，中国企业在光模块领域的优势带动生产设备国产化率不断提升。

针对上述行业变革，公司依托自主研发的通用软件平台与核心技术优势，积极推进产品迭代与产业融合。一方面，公司基于 CPO、硅光等新技术需求，依托于 H3 贴装平台和实时对准贴装平台，开展前瞻性研发，包括激光辅助键合（LAB）、倒装热压等先进封装相关工艺，解决未来硅光芯片倒装及 PD 阵列倒装焊接的需求。同时，公司积极对现有设备功能进行升级，研发适配硅光模块的全自动耦合测试系统。

另一方面，公司通过跨领域技术复用，将光通信领域积累的高精度运动控制、压力控制、视觉引导等技术应用于半导体光电器件封装，进行 IC 高速固晶机、多功能高速贴片设备、倒装贴片设备、热压超声焊设备等新设备的研发。

公司通过持续的技术研发与产品迭代，不仅满足光模块行业对高性能封装测试设备的迫切需求，更以技术融合创新推动光通信、半导体等领域的协同发展，为传统制造向高端化、智能化转型提供核心装备支撑。

（2）自主研发通用软件平台，赋能产业融合升级

公司自主研发的通用软件平台紧密围绕光模块贴片设备核心需求，以“标准化架构+模块化应用”为设计理念，通过分层架构实现技术能力与贴片工艺场景的深度协同，成为推动光模块制造产业智能化升级的关键引擎。平台聚焦光模块贴片核心环节，涵盖高精度运动控制、微米级视觉定位、贴片工艺智能编排、参数与配方管理、生产数据统计分析、用户管理六大核心模块，构建起覆盖光模块贴片设备全生命周期的数字化解决方案。

在技术架构层面，平台采用分布式系统设计，针对光模块贴片设备对精度（±1 微米级）与效率的严苛要求，集成 20+标准化功能模块与开放式脚本接口，

实现设备功能的“即插即用”快速开发。通过预设的标准化工艺流程模板，显著降低开发复杂度与开发周期。根据不同元件特性设置的参数，自动适配贴片压力、速度等工艺参数，确保贴装良率稳定。同时，平台内置的智能算法库融合传统视觉与深度学习模型，将视觉功能进一步扩展至缺陷检测、目标提取、分类、OCR 等方面。

在应用场景层面，平台兼具标准化开发与深度定制双重能力：一方面，通过预设的光模块贴片功能流程与界面模板，保障基础贴片业务的高效执行；另一方面，基于客户对特殊封装工艺、定制化界面交互的需求，支持可视化编程与二次开发，实现不同速率（100G-1.6T）、不同封装形式（COB/COC）光模块贴片设备的个性化配置。目前，该平台已成功应用于公司 DB3000 高速固晶机、LQ-VADB30 固晶贴片机等核心产品，助力中际旭创、索尔思、光迅科技等客户实现光模块贴片工序的自动化调试、生产数据实时监控及工艺参数智能优化，推动光模块制造向智能化、柔性化转型。

该平台的研发与应用，不仅实现了光模块贴片设备技术的自主可控，更通过数据驱动的决策模式，推动光通信制造流程再造与产业协同创新，切实促进新技术与传统光模块制造产业的深度融合，为我国光通信产业高质量发展提供技术支撑。

三、行业竞争情况及发行人行业地位

（一）行业竞争格局

1、光模块封装测试设备行业竞争格局

（1）我国光模块行业发展历程

光电子信息产业是我国构建新型数字基础设施、全面建设“数字中国”、驱动经济社会创新发展的战略性和先导性行业，光模块作为我国光电子信息领域的优势产业，是我国实现光电子信息产业自主发展的关键一环，也是目前在国际市场上占据优势的一环。我国光模块行业的发展也并非一帆风顺，期间也经历了从落后到追赶，然后再到主导全球市场的艰辛奋斗历程。我国光模块行业的发展大致可以分为三个阶段：

①技术萌芽和积累期（2010 年以前）

20 世纪 90 年代至 2010 年，美国、日本企业主导光模块产业，以客户三、客户四为代表的西方厂商垄断高速率光模块技术。根据 LightCounting 报告显示，2010 年国内光模块厂商仅占全球市场份额的 15%，全球前十大光模块厂商中仅有一家中国企业，而光模块封装设备国产化率极低，高端光芯片、高精度测试设备基本依赖进口。

②技术突破期（2010 年-2021 年）

随着国家政策的支持和引导，国内光模块企业不断加速追赶海外龙头的步伐。以中际旭创、光迅科技、华为技术、索尔思等为代表的国内光模块厂商持续大力投入研发，在光模块技术上不断迎来突破，逐渐在国际市场上崭露头角。根据 LightCounting 报告显示，2021 年国内光模块厂商占全球市场份额达 51%，全球前 10 光模块厂商中国占据 6 席。

③市场主导期（2021 年至今）

随着我国在通信领域的不断努力，我国光通信行业持续保持着高速发展，光模块企业也稳步提高自身在国际市场的地位。自 2021 年以来，我国光模块企业稳定保持着全球约 50%的市场份额，产品速率不断提速，以适应不断迭代和发展的下游需求。2023 年，全球前十光模块供应商中，中国企业占据 7 家，中际旭创首次位列全球第 1，华为技术排名第 3，光迅科技排名第 5，我国光模块行业实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越。

（2）我国光模块行业的高速发展带动国产光模块封测设备行业的发展

2010 年以前，我国光模块封装设备国产化率极低，相关封装测试设备受欧美设备厂商所主导。而我国光模块企业的高速发展，也带动了相关封装测试设备企业的茁壮发展。光模块下游应用场景丰富，光模块厂商需要根据不同的应用场景、不同速率要求选择合适的封装工艺，这就导致了光模块封装工艺的复杂性和多样性。因此光模块封装设备存在一定个性化、定制化的特点，需要设备厂商与光模块厂商建立较为紧密的合作关系，从而能够从源头把控光模块的质量和稳定性。

因此，虽然我国光模块封装设备厂商起步较欧美厂商晚，在技术积累和产

品性能上与国外厂商存在一定差距，但在产业发展的初期，国产厂商凭借性价比、对客户的迅捷反应和全面服务占据了一定市场份额。国产厂商通过从中低精度产品切入市场，随着行业内厂商在精密运动平台、视觉定位、压力控制技术、脉冲加热技术、软件平台及算法等技术上的突破，以及对光芯片测试、光耦合、共晶焊接、多芯片贴装等核心工艺能力的掌握，设备国产化率大幅提升。

（3）光模块封测设备国产化率逐渐提高，在部分领域技术水平逐渐与海外龙头齐平

根据弗若斯特沙利文研究报告显示，近年来国内厂商在光模块封测设备中一些技术难度较低的环节已经能够实现超过 80%的国产化替代，并且通过自主研发打破国外技术垄断，在精度、速率等关键参数上取得了较为显著的成功。其中在芯片贴片环节，目前国产化率已经达到 30%，并且国产厂商在高端共晶机领域也占有一席之地。对于精度在±7 微米及以上的中低精度固晶机，国产化率已经达到 70%。对于精度在±3-±5 微米的高精度固晶机，国产化率约为 20%。

目前，全球光模块封测设备市场的竞争格局如下表所示：

设备种类	境外厂商	境内厂商
贴片机	ASMPT、BESI、MRSI、Finetech、Four-Technos	发行人、微见智能
耦合设备	FiconTEC	发行人、镭神技术
老化测试设备	致茂电子	发行人、联讯仪器

2、半导体封装测试设备行业竞争格局

虽然我国集成电路封装测试环节发展成熟度相对较高，但封装设备与测试设备国产化率目前仍较低，全球封装设备呈现寡头垄断格局，TOWA、YAMADA、ASMPT、BESI、DISCO 等公司占据了绝大部分的封装设备市场，行业高度集中。根据华西证券研报显示，在固晶这一环节，不论是对于固晶机整体需求（包括集成电路、LED、光电子等领域，公司目前产品主要应用于其中的光电子细分领域），还是半导体先进封装领域，BESI 和 ASMPT 合计市场份额接近 50%，呈现 BESI 和 ASMPT 双寡头主导的格局。总体来看，国内半导体封装设备具有较大进口替代空间。

（二）行业内主要企业

1、境外竞争对手情况

（1）BESI（BESI.AS）

BE Semiconductor Industries N.V.成立于 1995 年，总部设在荷兰德伊芬市，是全球领先的半导体设备制造商，主要产品包括芯片贴装设备、固晶设备、封装设备、电镀设备等。

（2）ASMPT（00522.HK）

ASM Pacific Technology Ltd.成立于 1975 年，总部设在新加坡，为电子制造过程的主要步骤提供设备及智能制造等解决方案，涉及芯片、先进封装、CMOS 图像传感、LED 及光电子等领域，主要产品包括贴片设备、键合设备、自动光学监测设备、清洗设备等。

（3）MRSI

MRSI Systems 成立于 1984 年，是一家全球领先的全自动、高精度贴片设备制造商，产品应用于电信、数据中心、航空航天与国防、医疗设备、计算机及工业等领域。光通信领域产品主要包括芯片贴片设备、共晶贴片设备、耦合设备等。2018 年迈锐斯（MRSI）被瑞典公司迈康尼电子（Mycronic AB）收购。

（4）Finetech

Finetech 成立于 2006 年，总部位于德国，是一家专注于提供半导体后道封装设备的公司，主要产品包括倒装焊设备、光电贴片机、适应各种工艺的精密贴片设备，以及电子联装中的 SMT 返修工作台设备等。

（5）Four-Technos

Four-Technos 成立于 1994 年，总部位于日本，是一家全球光通信领域的科技企业，以光半导体元件组装设备及配套测试系统为核心业务，产品包括贴片机、键合机、自动主动对准系统等。公司通过全定制化开发模式，为光通信、光学传感等领域提供高精度制造与检测解决方案。

（6）FiconTEC

FiconTEC 成立于 1994 年，总部位于德国，是一家专注于高精度光学组件和光电元件生产设备的制造商，主要从事半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售，为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和相关技术服务。公司于 2025 年被 A 股上市公司罗博特科收购。

（7）致茂电子（2360.TW）

致茂电子成立于 1984 年，总部位于中国台湾，以自有品牌“Chroma”行销全球，提供量测仪器、自动化测试设备及制造资讯管理系统等整合解决方案，主要市场应用包括 AI、半导体/IC、储能、LED、光子学等领域。

2、境内竞争对手情况

（1）微见智能

微见智能成立于 2019 年，总部位于深圳，是专业从事高精度复杂工艺芯片封装设备研发和生产的高科技企业。产品包括高精度固晶机，生产支持多领域核心芯片封装的关键装备，产品应用于光通讯、5G 射频、射频微波等领域。

（2）镭神技术

镭神技术于成立于 2017 年，总部位于深圳，是一家致力于向光通讯、工业激光、芯片制造等行业提供专业的生产加工、组装、测试技术成套解决方案及定制化设备的企业，产品包括光耦合设备、老化测试设备、固晶设备等产品。

（3）联讯仪器

联讯仪器成立于 2017 年，总部位于苏州，专注高速通信、光芯片、电芯片及功率晶圆芯片等领域的测试仪表与设备研发、制造。公司可以提供包括宽带采样示波器、高速误码仪、网络流量测试仪、高精度快速波长计、精密数字源表、低泄漏矩阵开关等高端测试仪器，以及半导体激光器 COC 老化、芯片测试、硅光晶圆测试、SiC 晶圆老化等高端测试设备。

（三）发行人市场地位

公司主要从事光通信、半导体、汽车自动化等领域智能生产装备的研发、

生产和销售，是国内光模块智能制造装备的主要供应商之一，在技术水平、产品指标、客户覆盖等方面均保持较高水平，位于行业内的第一梯队，成功打破了欧美设备厂商在该领域的长期垄断，实现了国产设备的替代。公司系国家级专精特新“重点小巨人”、江苏省专精特新中小企业，公司自动耦合机、共晶贴片设备被江苏省工业和信息化厅评为首台（套）重大装备。

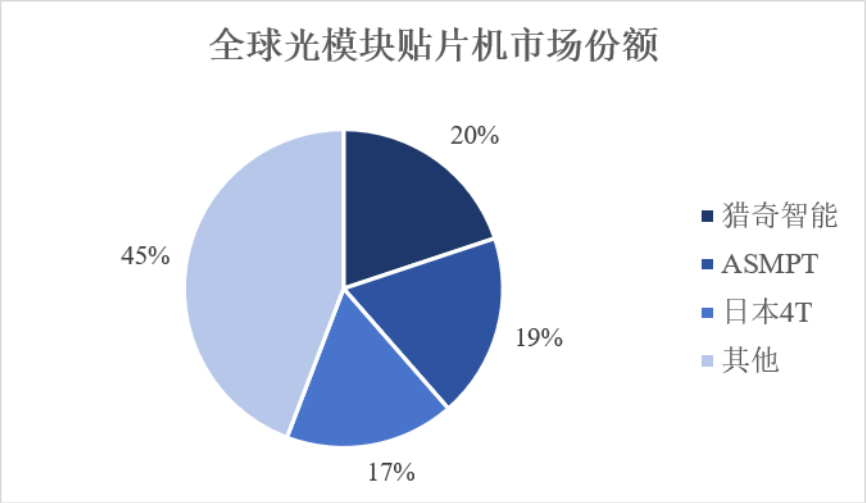
经过多年的发展和积累，公司产品已覆盖光模块封装测试流程的主要核心环节，产品包含中高精度共晶和固晶贴片设备、耦合设备和老化测试设备等，支持最高 1.6T 速率光模块的封装需求。同时，公司根据行业发展趋势，基于未来硅光技术、CPO 等市场需求，积极研发和储备激光辅助键合、倒装热压等先进封装相关工艺，解决未来硅光芯片倒装及 PD 阵列倒装焊接等高端光模块的封装需求。

公司依托领先的产品性能和高效优质的配套服务能力，得到了国内主流市场的高度认可，公司设备已广泛应用于中际旭创、索尔思、光迅科技、源杰科技、剑桥科技、客户三、客户四等光通信行业龙头客户和知名企业，并与 2025 年光模块全球前十厂商（前十厂商排名来源于 LightCounting）中九家企业保持良好合作。

1、细分市场占有率位居行业前列

①光模块贴片设备（按设备数量口径统计）

公司已成为光模块封装设备市场的重要竞争者。根据弗若斯特沙利文数据，2025 年公司光模块贴片设备市场份额为 20%，排名全球第一，已成为行业龙头企业。头部三家企业占据 56%的市场份额，未来随着国产化替代的推进，海外厂商市场份额将有望逐年降低。



数据来源：弗若斯特沙利文

②光模块耦合设备（按设备数量口径统计）

根据弗若斯特沙利文报告，2025 年在光模块耦合设备领域猎奇智能以 23%的市场份额排名第二。



数据来源：弗若斯特沙利文

综上，公司是国内领先的光模块封装测试设备厂商，在光模块设备细分市场占有率处于国内第一梯队。

2、产品应用及核心性能参数对比

公司自设立以来深耕光模块封装测试设备领域，公司产品已覆盖光模块封装测试流程的主要核心环节，产品包含中高精度共晶和固晶贴片设备、耦合设

备和老化测试设备等。公司已掌握了高精密运动平台技术、高精度高动态压力控制技术、脉冲加热技术、高精度视觉对准技术等核心技术。经过多年的技术研发沉淀，公司主要产品的性能标准达到国内领先水平，部分产品技术指标已达到国际龙头企业同等水平，具体对比情况如下：

（1）贴片设备

在光模块封装环节，不同速率产品及内部核心组件的贴装精度要求存在明显差异；光芯片作为光信号收发的核心器件，其贴装精度直接决定后续光耦合效率及信号传输稳定性，是全流程精度要求最高的环节。由于光模块 PCB 尺寸本身较小，大部分高端光模块内部核心光芯片的贴片精度控制仅允许±3μm 之间，为后续的器件耦合工艺提供足够、稳定的对准误差空间；电芯片承担信号处理功能，贴装精度要求次之，电容、电阻等被动元件对贴装精度敏感度相对较低，不同速率光模块及组件加工精度要求如下：

光模块速率	光芯片	电芯片	其他元件
400G	±5μm	±10μm	±15μm-±35μm
800G	±3μm	±10μm	±15μm-±35μm
1.6T	±3μm	±10μm	±15μm-±35μm

来源：弗若斯特沙利文

基于上述特性，行业内存在两种主流生产模式：①差异化设备配置：部分厂商根据元件类型采购不同型号贴片机，分别满足不同精度需求；②高精度设备全覆盖：头部厂商为保障产品一致性与良率，倾向于采用高精度贴装设备完成全品类元件贴装。

公司深度理解行业对贴装精度的分层需求，自主研发的共晶贴片设备加工精度达±3μm 级，固晶贴片加工精度覆盖±3-10μm 区间，可灵活适配不同生产模式。自主研发的多吸嘴动态切换系统和顶针系统，为客户提供兼具精度与效率的最优解决方案。公司光模块贴片设备性能处于国内领先或国际同等水平，具体衡量光模块贴片设备核心竞争力的关键指标及对比情况如下：

①衡量光模块封装设备核心竞争力的关键指标

指标类别	指标名称	指标含义	评价方法
精度	设备精度 XY	设备在 X 轴（水平方向）和 Y 轴（垂直方	在产品需求的精度

指标类别	指标名称	指标含义	评价方法
	（@3σ）	向）上的定位精度，其误差范围通过统计学中的 3σ 原则进行限定； 3σ 是统计学中的三西格玛（Three-Sigma）规则，表示该技术在 99.73%的置信水平下的精度误差情况； 设备精度代表贴片设备自身的制造精度，加工精度代表贴片机装贴不同芯片产品所能实现的精度	范围内，精度误差越小越好。高精度可减少返修率，提升良品率
	加工精度 XY（@3σ）		
	芯片旋转	是指在光模块制造过程中，贴片机将芯片（如激光器、探测器等）放置到基板（PCB 或陶瓷基板）上时，芯片实际方向与理论设计方向的偏差角度； 芯片旋转误差超过一定幅度，可能导致焊接短路或信号传输失败	偏差角度越小精度越高
工艺及兼容性	贴片工艺	贴片工艺主要是指在光模块封测过程中，将光电器件如激光器驱动芯片、激光器芯片、探测器芯片等各类光电芯片通过共晶焊或导电胶精确地固定在载体上（如 PCB、陶瓷基板）；贴片工艺可分为固晶、共晶、多芯片贴片、Flip Chip 等不同工艺	可支持的贴片工艺类型越多，产品的兼容性越强，共晶、Flip Chip、多芯片贴装对设备技术要求更高
	焊台升温速率	共晶焊接过程中，设备从室温升至工作温度的速度以及从工作温度降至室温的速度	升降温速率越高，焊接效率和质量控制越好

②关键参数指标对比情况

A. EB3300（共晶贴片设备）

关键指标参数		发行人 EB3300	MRSI HVM3	微见智能 MV-15H-M
精度	设备精度	±1μm	±1.5μm	±1.5μm
	加工精度	±3μm	未披露	±3μm
	芯片旋转	±0.02°	未披露	0.02°
工艺及兼容性	焊台升降温速率	100℃/S（升温） 60℃/S（降温）	未披露	50℃/S（升温）
	贴片工艺	支持固晶、共晶、倒装	支持固晶、共晶、倒装	支持共晶

注 1：竞争对手机型信息、核心技术指标均来自其公司官网的公开产品资料，下同
注 2：设备精度、加工精度均采用 3σ 标准，下同

B. LQ-VADB30P（固晶贴片设备）

关键指标参数		发行人 VADB30P	ASMPT Photon Pro	微见智能 MV-50A
精度	设备精度	±1.5μm	未披露	未披露
	加工精度	±3μm	±3μm	±5μm

关键指标参数		发行人 VADB30P	ASMPT Photon Pro	微见智能 MV-50A
	芯片旋转	±0.1°	±0.1°	未披露

C. DB2000/3000（固晶贴片设备）

关键指标参数		发行人 DB2000	BESI Datacon 2200 evo
精度	设备精度	±3μm	未披露
	加工精度	±7μm	±10μm
	芯片旋转	±0.02°	未披露

（2）耦合设备

在光模块耦合设备领域，技术路线有所分化，行业竞争围绕精度、效率与工艺兼容性三大核心维度展开深度博弈。不同技术路线在工艺适应性上呈现显著差异。在精度层面，硅光子芯片、超高速率光模块（如 800G/1.6T）的耦合环节要求 0.05μm 级的重复定位精度，需采用主动耦合技术实现动态优化。中高速率光模块（如 100G/200G）的耦合精度要求为 0.1μm 重复定位精度，可通过被动对准技术实现成本与性能的平衡。在兼容性方面，硅光子兼容封装需支持硅基光波导与光纤的三维耦合，设备需集成高精度视觉识别+纳米级位移控制模块。而 TO、BOX 等传统封装形式，设备需具备多夹具快速切换+多光源适配能力。

公司深度洞察行业技术发展趋势，自主研发的光耦合设备在核心参数上实现多维度突破，相关技术水平处于国内第一梯队，现有产品支持最高 1.6T 速率光模块耦合。具体衡量光模块耦合设备核心竞争力的关键指标及对比情况如下：

①衡量光模块耦合设备核心竞争力的关键指标

指标类别	指标名称	指标含义	评价方法
精度	XYZ 轴分辨率	光耦合设备在三维空间中执行精密运动时的最小可控步长，决定了设备在水平（X/Y）和垂直（Z）方向上的定位精度	分辨率精度误差数值越小，代表精度越高
	X/Y/Z 轴重复精度	在相同操作条件下，设备或系统多次移动到同一目标位置时，实际到达位置的一致性或偏差程度。它反映设备重复执行相同定位任务时的稳定性和可靠性	精度越高，性能越好

②关键参数指标对比情况

关键指标参数	发行人	镭神技术	FiconTEC
X/Y/Z 轴重复精度	±0.05μm	±0.05μm（单模） ±0.3μm（多模）	±0.02μm
XYZ 轴分辨率	10nm	未披露	5nm
设备性能及特有技术	支持全自动，配备直线电机	未披露	全自动，配备直线电机
	自研耦合算法实现快速螺旋找光，压感快速触底算法提高耦合效率； 开放式逻辑编辑平台提高产品兼容性		fast alignment 技术， 能做到一维和二维快速扫描

注：光耦合设备具有较强的定制化特点，不同公司的产品因下游客户需求不同，产品在规格和参数上会存在较大差异。

（3）老化测试设备

①衡量光模块老化测试设备核心竞争力的关键指标

指标类别	指标名称	指标含义	评价方法
容量	层数	设备能负载大抽屉的数量	层数越多，单次能测试的芯片数量越多，效率越高
	芯片数/载具	每个鱼骨夹具上能夹持物料的数量	每个鱼骨夹具上能夹持物料的数量越多，效率越高
温度测试	温度范围	设备能达到的最低温度到最高温度	温度测试范围大，设备测试适用场景越广
	温度稳定性	设备温度稳定后，2H 内测温点（Max – Min）的值	温度偏差越小，温控性能越好
	温度均匀性	设备温度稳定后，同个抽屉三点测温（Max – Min）的值	不同位置温度差异越小，温控性能越好
ACC 测试	电流精度	设置电流输出和实际电流输出误差	误差越小，电流精度越高
	电流分辨率	能实现最小电流主动调节的能力	分辨率数值越小，性能越好

②关键参数指标对比情况

设备型号		发行人- BI74P	致茂电子 Chroma-58604	联讯仪器-BI6202
设备容量	层数	7 层/11 层（可选配）	7 层	11 层
	载具数/层	4	4	4
	芯片数/载具	32/48	32	48
温度	范围	40-125℃	45-125℃	40-120℃
	稳定性	0.5℃	1℃	0.5℃

设备型号		发行人- BI74P	致茂电子 Chroma-58604	联讯仪器-BI6202
	均匀性	±1℃@40℃-100℃；±1.5℃@100℃-125℃	±（1℃+1.2% ΔT）	±1℃@40℃-100℃ ±1.5℃@100℃-120℃
ACC 测试	电流精度	<0.2%F.S.	<0.2%F.S.	0.5% F.S.
	电流分辨率	0.1mA	未披露	0.15mA
LIV 测试	是否支持	是	是	是

公司老化测试设备在主要核心技术指标方面已经达到市场主流机型水平，与国内外竞争对手处于相同水平，报告期内已获得中际旭创、源杰科技等国内知名客户的订单。

（四）公司的竞争优势与劣势

1、竞争优势

（1）技术及研发优势

①丰富的行业经验和技术储备

公司自成立以来，坚持自主正向研发，主要研发骨干均具有十年以上自动化智能设备研发经验，对设备机械结构及自动化技术拥有较深的理解。同时，公司深耕光模块封装设备领域近十年，对光通信领域尤其是光模块产品拥有深刻的理解和认知，对光模块封装设备的运动控制系统、视觉系统及软件等核心构成方面总结了较为丰富的开发设计经验。

经多年积累，公司已攻克掌握高精密运动平台技术、高精度，高动态压力控制技术、脉冲加热技术、视觉引导技术、耦合算法、COC 老化测试技术等核心技术，形成发明专利 55 项，并具备光模块封装全流程设备的开发能力。其中贴片、耦合等设备已处于国际或国内领先水平，各项参数指标均处于行业前列。

②强大的研发团队和成熟的研发流程

报告期内，公司累计研发投入超过 16,000 万元。经过多年持续的研发投入和发展，公司建立了一套完善的研发制度和流程，组建了一支兼具技术积累与创新能力的研发团队。团队成员覆盖光学、机械、电子、软件等多个学科背景，并具备丰富的行业经验，为公司产品的高效创新提供了有力支撑。

（2）快速识别客户需求的洞察能力和快速交付的响应能力

公司与主要客户建立了深度合作关系，通过定期交流和技术对接机制，精准了解客户需求并及时调整产品研发方向。通过与客户的深度协作，助力公司多维度精准洞察业务线索，从市场战略、储备技术、产品方案预研、物料供应商预沟通、产线设计等全方位进行前瞻性布局，大幅提升公司产品开发及交付环节的快速响应能力。

同时，公司通过模块化设计，能够快速响应客户的多样化和定制化需求。例如，公司贴片设备可支持多种芯片封装工艺，并兼容不同的上料方式（如 Gel-PAK 和蓝膜上料），满足不同客户的个性化需求。

（3）产品布局全面、设备性能优异

公司依托于自身在行业内的丰富经验和自主可控的核心技术，对行业趋势进行及时跟踪和准确把握，在国内较早的推出了各类光模块封装测试设备，并对原有产品进行优化迭代及不断开发新的产品。经过多年的发展和积累，公司产品已覆盖光模块封装测试流程的主要核心环节，包括贴片、耦合、老化测试等重要环节，其中共晶贴片设备贴片精度达到标准片±1μm 级别，与国际龙头齐平，耦合设备可根据客户个性化需求，满足 COC 及 TX、RX 阵列等多元件耦合工艺，能够实现±0.05μm 级别高精度作业，实现了相关设备的国产替代。丰富的产品种类和优异的产品性能，使公司具有更强的市场竞争力和抗风险能力。

（4）领先的市场地位和优质的客户资源

公司长期深耕光通信等产业，客户资源丰富。公司自成立以来，长期服务于下游龙头厂商，公司设备已广泛应用于中际旭创、索尔思、光迅科技、源杰科技、剑桥科技、客户三、客户四等光通信行业龙头客户和知名企业，与 2025 年光模块全球前十榜单（前十厂商排名来源于 LightCounting）中九家企业形成合作关系。在光模块领域，考虑到更换光模块设备供应商可能带来的质量稳定性和下游客户体验的问题，下游光模块厂商通常具有较强的黏性，以保证其自身产品的市场竞争力。

同时，公司逐步开拓半导体、汽车自动化等领域客户，公司产品已应用于

客户五、先导科技、士兰微等半导体领域客户，以及索恩格、苏世博、三花智控等全球领先的汽车零部件供应商，强化公司持续经营能力和抗风险能力。

（5）完善的供应链

光模块及半导体封装测试设备属于高精密的自动化装备，研发和生产均需使用大量的高精度元器件，对产品机械结构的精度和材质要求高。经过多年的沉淀，公司与国内外供应商建立了较为稳定的合作关系，培育与建设成了较为完善的原材料、零部件供应体系，主要核心原材料、零部件都开发了多家供应商，有利于保证公司产品部件来源的稳定性及可靠性。

2、竞争劣势

（1）融资能力需进一步加强

公司资金实力有限，融资渠道受限。公司自成立以来，专注于产品研发及业务拓展，与同行业上市公司相比，公司缺乏资本市场的融资渠道，融资渠道相对单一，且融资成本较高。由于光通信、半导体行业具有投资规模大、研发难度高、产品质量取得客户认可时间周期长等特点，随着公司业务规模的进一步扩大，公司亟待扩产满足下游客户需求，因此融资渠道单一、资金实力不足将会制约公司的发展。

（2）较国际竞争对手在经营规模、产品种类、市场地位等方面存在差距

国际竞争对手，尤其是欧美日等国际厂商，受益于起步早、发展时间长、技术积累丰富等因素，目前主导着光通信、半导体设备市场。公司由于起步较晚，尽管部分技术指标已达到或接近行业龙头厂商技术水平，但产品的成熟度、稳定性等较境外龙头厂商仍存在差距，仍然需要在不断的应用、研发中提升产品的综合性能。同时公司在企业规模、资金实力、技术积累、产品丰富度、客户资源和市场地位等方面与国际巨头相比仍存在差距，在抗风险能力上存在一定劣势。

（3）人才储备需进一步充实

公司设备产品涉及多学科融合、技术门槛高、研发难度大，因此对相关人才的专业水平要求较高，培养难度较大、周期较长。未来随着公司发展，公司

仍需不断培养和引进专业研发人才。同时，随着公司业务规模的快速扩大，需要大量补充生产、管理、营销等方面的人才，以满足公司持续增长的业务需求。虽然公司在持续推进人才梯队建设，加强外部人才引进，但整体而言公司高端人才储备仍显不足。

（五）发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况

1、同行业可比公司选取标准

报告期内，公司主要产品涵盖贴片设备、耦合设备、老化测试设备等光模块封装测试设备，上述业务占公司主营业务当期收入的比例超过 70%。其余自动化设备及整线解决方案业务和零部件业务收入占比较低，因此同行业可比公司主要选取光模块封装测试设备行业的可比公司。考虑同行业部分企业未上市而缺乏公开披露信息，在选取可比公司市优先选择已上市或有公开信息披露的同行业可比公司。

公司同行业可比公司的选取标准包括：（1）主营业务、主要产品品类与公司存在相同或相似的情形；（2）主要产品应用领域与公司存在相同或相似情形。

目前 A 股尚无光模块细分领域的封装测试设备企业，因此无完全可比的同行业 A 股上市公司。ASMPT 和 BESI 分别为港股和荷兰上市公司，系全半导体封装测试设备领域的龙头企业，主要产品包括半导体封装测试设备，产品广泛应用于集成电路、光电子、分立器件等半导体细分领域，是公司在光模块贴片设备领域的主要竞争对手及追赶目标。致茂电子和联讯仪器的主要产品包括自动化测试设备，与公司老化测试设备具有较强的可比性，因此将其选为可比公司。

FiconTEC 主要从事半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售，为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和相关技术服务。FiconTEC 于 2025 年被 A 股上市公司罗博特科（300757.SZ）收购，成为其子公司。其业务与公司具有较强的可比性，因此将其选为可比公司。

考虑到 BESI、ASMPT 等可比公司并非 A 股上市公司，其信息披露要求和

格式与境内存在一定差异。为提高可比公司财务数据的可比性，选择同为贴片设备行业的 A 股上市公司新益昌作为可比公司。新益昌的产品主要包括 LED 固晶机、电容器老化测试设备等，虽然与公司所处细分行业不同，但同属贴片设备这一半导体后道设备行业大类，将其作为可比公司具有合理性。

基于上述综合考量，发行人选择了 6 家国内外企业作为可比公司。

公司名称	主要产品	竞争领域
BESI（BESI.AS）	芯片贴装设备、固晶设备、封装设备、电镀设备等半导体后道封测设备	贴片设备
ASMPT（0522.HK）	贴片设备、键合设备、自动光学监测设备、清洗设备等半导体后道封测设备	贴片设备
致茂电子（2360.TW）	量测仪器、自动化测试设备等	老化测试设备
新益昌（688383.SH）	LED 固晶机、电容器老化测试设备等	贴片设备
FiconTEC	光电子器件自动化微组装、耦合以及测试设备	贴片设备、耦合设备
联讯仪器	电子测量仪器和半导体测试设备	老化测试设备

除上述可比公司外，发行人在主要产品参数对比时额外选择了 MRSI、微见智能、镭神技术共 3 家企业进行比较，上述企业尚未上市，因此未进行关键经营数据的对比。

2、经营情况和经营指标对比

发行人和同行业可比公司的主要经营情况和经营指标对比如下：

公司名称	主要经营指标	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
BESI	营业收入（万欧元）	43,474.50	59,133.10	60,747.30	57,886.20
	净利润（万欧元）	14,058.10	13,164.10	18,199.20	17,708.40
	毛利率（%）	64.74	63.29	65.18	64.92
ASMPT	营业收入（万元）	773,235.32	1,240,684.94	1,225,065.63	1,331,915.85
	净利润（万元）	50,678.07	81,473.51	31,691.31	64,477.64
	毛利率（%）	41.10	37.75	39.98	39.28
致茂电子	营业收入（万元）	541,550.10	631,616.96	481,549.53	432,163.64
	净利润（万元）	195,762.64	266,066.81	120,368.52	94,773.90
	毛利率（%）	61.48	61.55	59.00	57.60
FiconTEC	营业收入（万元）	-	-	12,807.96	38,244.00
	净利润（万元）	-	-	-3,452.50	986.05

公司名称	主要经营指标	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
	毛利率（%）	-	-	40.64	41.62
新益昌	营业收入（万元）	54,650.04	72,684.99	93,387.04	104,016.95
	净利润（万元）	4,747.30	-12,523.09	3,513.50	5,537.76
	毛利率（%）	36.68	29.34	31.83	33.49
联讯仪器	营业收入（万元）	153,114.90	119,406.84	78,862.99	27,579.31
	净利润（万元）	56,684.04	17,390.23	14,088.30	-5,670.31
	毛利率（%）	70.79	58.84	63.63	60.50
发行人	**营业收入（万元）**	**58,144.73**	**69,779.24**	**54,292.61**	**28,918.30**
	净利润（万元）	**14,831.17**	**18,155.76**	**18,056.52**	**8,150.30**
	毛利率（%）	**40.28**	**42.96**	**50.33**	**48.81**

注 1：数据来源于招股意向书、公开披露文件和 WIND

注 2：FiconTEC 2024 年数据为罗博特科收购报告书中披露的 2024 年 1-7 月数据，未有 2025 年全年数据和 2026 年 1-6 月数据

3、市场地位对比

公司名称	市场地位
BESI（BESI.AS）	全球领先的半导体设备制造商，产品包括芯片贴装设备、固晶设备、封装设备、电镀设备等半导体后道封测设备，系全球半导体后道封测设备龙头企业之一，产品种类丰富，技术水平、技术储备、客户资源、经营规模等方面全球领先
ASMPT（0522.HK）	全球领先的半导体设备制造商，产品包括贴片设备、键合设备、自动光学监测设备、清洗设备等半导体后道封测设备，系全球半导体后道封测设备龙头企业之一，产品种类丰富，技术水平、技术储备、客户资源、经营规模等方面全球领先
致茂电子（2360.TW）	以自有品牌“Chroma”行销全球，提供量测仪器、自动化测试设备及制造资讯管理系统等整合解决方案，主要市场应用包括 AI、半导体/IC、储能、LED、光子学等领域
新益昌（688383.SH）	为国内 LED 固晶机市场龙头企业，凭借技术积累与定制化服务能力，长期占据主导地位，尤其在 Mini LED 领域市占率领先，主要产品包括 LED 固晶机、电容器老化测试设备等，并逐步向 IC 固晶设备、焊线机行业拓展
FiconTEC	全球光子及半导体自动化封装和测试领域知名的设备制造商之一，主要产品包括光电子器件自动化微组装、耦合以及测试设备，应用于客户包括英伟达、Finisar、Lumentum 等知名客户
联讯仪器	电子测量仪器和半导体测试设备领域知名企业，在通信测试仪器领域，市场份额位列市场第三，在电性能测试仪器领域，国内市场位列本土企业第一，在中国光电子器件测试设备市场中，市场份额位列第一
发行人	公司是国内光模块智能制造装备的主要供应商之一，在技术水平、产品指标、客户覆盖等方面均保持较高水平，位于行业内的第一梯队，打破了欧美设备厂商在该领域的长期垄断，实现了国产设备的替代。公司设备已广泛应用于中际旭创、光迅科技、源杰科技等光模块、光芯片龙头厂商。发行人在光模块贴片设备领域市场份额排名全球第一，系国内领先的光模块智能制造装备

4、技术实力与核心竞争力指标对比

发行人与同行业可比公司的核心竞争力相关指标对比情况详见本节“三、行业竞争情况及发行人行业地位”之“（三）发行人市场地位”相关内容。

四、发行人销售情况和主要客户

（一）主要产品的产能、产量和销量

公司专注于光通信、半导体、汽车自动化等领域智能生产装备的研发、生产与销售。由于不同客户的订单在应用场景、技术参数等方面存在个性化差异，公司需针对具体需求进行定制化设计、生产。不同于标准化产品的批量生产模式，公司不同产品具有较大差异，公司根据客户需求和订单采取柔性生产方式组织生产。公司生产流程主要涵盖设计、装配、调试检测等环节，生产线并非传统、专用、标准化的生产线，因此不存在针对单类产品的设计产能，以“台”作为产能计算单位难以准确反映公司的业务实质。报告期内，公司产量和销量情况如下：

单位：台/套

分类	年份	产量	销量	产销率
贴片设备	2026 年 1-6 月	124	124	100.00%
	2025 年度	320	320	100.00%
	2024 年度	322	322	100.00%
	2023 年度	100	100	100.00%
耦合设备	2026 年 1-6 月	364	364	100.00%
	2025 年度	185	185	100.00%
	2024 年度	152	152	100.00%
	2023 年度	100	100	100.00%
老化测试设备	2026 年 1-6 月	1,637	1,637	100.00%
	2025 年度	744	744	100.00%
	2024 年度	1,199	1,199	100.00%
	2023 年度	981	981	100.00%
自动化设备及整线解决方案	2026 年 1-6 月	43	43	100.00%
	2025 年度	162	162	100.00%
	2024 年度	88	88	100.00%

分类	年份	产量	销量	产销率
	2023 年度	91	91	100.00%

注：为便于说明及比较贴片设备、耦合设备的产销量信息，以 2023 年贴片设备、耦合设备产销量（台）分别指数化为 100、100，作为报告期内数据基数计算贴片设备、耦合设备各期相对变动幅度。

公司产品具有非标定制化特点，需在客户现场安装调试完毕经客户终验收通过后确认收入，此时方可确认为产成品并结转主营业务成本。因此，公司的产量等于销量，产销率为 100%。

（二）报告期内主要客户

报告期内，公司主要客户销售具体情况如下：

单位：万元

报告期	排名	客户名称	主要销售内容	销售金额	占比
2026 年 1-6 月	1	中际旭创	光模块封装测试设备	37,682.31	64.81%
	2	东山精密	光模块封装测试设备	8,399.74	14.45%
	3	剑桥科技	光模块封装测试设备	2,095.14	3.60%
	4	钧恒科技	光模块封装测试设备	1,482.40	2.55%
	5	牧野汽车	配件	1,462.88	2.52%
	前五大客户合计			**51,122.47**	**87.92%**
2025 年度	1	中际旭创	光模块封装测试设备	37,277.97	53.42%
	2	索恩格	自动化设备及整线解决方案	7,059.21	10.12%
	3	索尔思	光模块封装测试设备	4,569.15	6.55%
	4	苏世博	自动化设备及整线解决方案	3,890.49	5.58%
	5	客户五	半导体封装测试设备	2,606.99	3.74%
	前五大客户合计			**55,403.81**	**79.40%**
2024 年度	1	中际旭创	光模块封装测试设备	31,949.52	58.85%
	2	光迅科技	光模块封装测试设备	6,097.74	11.23%
	3	索恩格	自动化设备及整线解决方案	3,404.29	6.27%
	4	客户五	半导体封装测试设备	1,890.91	3.48%
	5	苏世博	自动化设备及整线解决方案	1,629.17	3.00%
	前五大客户合计			**44,971.63**	**82.83%**
2023 年度	1	中际旭创	光模块封装测试设备	17,985.30	62.19%
	2	客户五	半导体封装测试设备	3,273.09	11.32%
	3	源杰科技	光模块封装测试设备	3,115.80	10.77%

报告期	排名	客户名称	主要销售内容	销售金额	占比
	4	索恩格	自动化设备及整线解决方案	1,991.75	6.89%
	5	牧野汽车	配件	578.08	2.00%
	前五大客户合计			**26,944.02**	**93.17%**

注 1：同一实际控制人控制的客户合并计算营业收入
注 2：东山精密包括原索尔思，以及 2026 年新交易主体盐城东山精密制造有限公司

报告期各期，公司向前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为 93.17%、82.83%、79.40%和 87.92%，客户集中度较高，主要系下游光模块产业竞争格局较为集中。

据 LightCounting、弗若斯特沙利文统计，2025 年中际旭创光模块全球市场份额排名第一，其中 800G 及以上光模块市场份额超过 40%，市场领先地位显著。同时，中国前十光模块供应商在全球市场的占有率超过 55%，公司客户集中度较高及与下游光模块行业竞争格局较为集中的发展现状相一致。

光模块封装设备行业具有高度的技术门槛和定制化需求，下游客户通常会选择少数几家具备技术和生产能力的供应商进行长期合作。公司通过长期的技术积累和定制化服务，与主要客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司主要产品为智能制造装备，其需求受下游客户扩产节奏、产品结构变化、下游终端市场需求变化等因素影响，各年度存在一定波动。

报告期内，公司前五大客户有所变化，主要系公司拓展新客户及下游客户需求波动影响。其中索尔思、剑桥科技、钧恒科技系公司新拓展客户，随着双方合作的深入，交易规模保持增长。源杰科技、光迅科技向公司采购的主要产品为光模块封装测试设备，上述客户根据其自身或终端的扩产周期调整其采购节奏和计划，导致报告期内公司对其销售规模有所波动。

公司及其董事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东与前五大客户之间不存在关联关系。公司对报告期内与中际旭创的交易情况比照关联交易披露，具体详见本招股意向书“第八节 公司治理与独立性”之“九、其他参照关联交易披露的交易”。

（三）公司对中际旭创的依赖对公司持续经营能力不构成重大不利影响

根据《监管规则适用指引——发行类第 5 号》之“5-17 客户集中”，发行

人来自单一客户主营业务收入或毛利贡献占比超过 50%的，一般认为发行人对该客户存在重大依赖。

报告期各期，发行人向前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为93.17%、82.83%、79.40%和 87.92%，客户集中度较高，其中对中际旭创的销售收入占比分别为 62.19%、58.85%、53.42%和 64.81%，占比超过 50%。因此，发行人对中际旭创存在重大依赖。但该情形不会对发行人未来持续经营能力构成重大不利影响，具体原因如下：

1、发行人客户集中度较高与下游行业集中度较高特征一致，不存在下游行业较为分散而发行人自身客户较为集中的情况

全球光模块行业呈现集中度较高的竞争格局。根据 LightCounting、弗若斯特沙利文相关数据，2025 年中际旭创光模块市场份额排名全球第一，其中800G 及以上光模块市场份额超过 40%，市场领先地位显著。同时，中国前十光模块供应商占全球市场的占有率超过 55%，行业集中度较高，其中包含公司主要客户索尔思、光迅科技等。发行人主要客户均为光模块行业内优质企业，因此，发行人客户集中度较高与下游行业高度集中的竞争格局一致。

同时，下游客户主要为国内光模块厂商的光通信产业链企业，如联讯仪器、优迅股份等，亦普遍存在客户集中度相对较高的特征。2023 年至 2025 年，联讯仪器、优迅股份前五大客户收入占比情况如下：

序号	公司名称	主要产品	前五大客户收入占比		
			2025 年	2024 年	2023 年
1	联讯仪器（688808.SH）	电子测量仪器、半导体测试设备	-	44.21%	52.81%
2	优迅股份（688807.SH）	光通信领域电芯片	60.59%	53.30%	55.24%
3	发行人	光模块封测设备	79.40%	82.83%	93.17%

注：联讯仪器未披露 2025 年数据。

综上，公司客户集中度较高与下游行业发展趋势一致，与同行业公司不存在显著差异。

2、中际旭创为光模块行业龙头企业、A 股上市公司，经营状况良好且具有良好的透明度，不存在重大不确定性风险

中际旭创集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，为云数据中心客户提供高速光模块、为电信设备商客户提供 5G 光模块及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造和全面交付能力等优势，中际旭创在行业内保持着出货量和市场份额的领先优势。据 LightCounting 数据，2025 年中际旭创光模块全球市场份额排名第一。

同时，中际旭创作为深圳证券交易所创业板上市公司，具有良好的信息透明度和顺畅的融资渠道。报告期内，中际旭创的经营业绩持续高速增长，2023 年、2024 年和 2025 年，中际旭创营业收入分别为 107.18 亿元、238.62 亿元和 382.40 亿元。

综上所述，中际旭创作为光模块行业龙头企业、创业板上市公司，报告期内经营业绩良好且具有良好的透明度，不存在重大不确定性风险。

3、发行人与中际旭创合作关系具有历史基础，双方合作具有稳定性及可持续性

发行人与中际旭创的合作具备深厚的历史基础和坚实的业务基础。发行人自设立之初便聚焦光模块封测设备赛道，发展战略与中际旭创产业升级需要高度契合。发行人成立初期即与中际旭创建立合作关系，2016 年发行人自主研发首台光模块耦合设备，通过中际旭创验证并实现销售，顺利切入其供应链体系。后续依托持续研发投入与技术积累，发行人陆续推出耦合设备、COC 老化测试设备、光模块贴片设备等核心产品，均通过中际旭创严格验证，逐步实现高端进口光模块封测设备的导入，积累了双方深厚的历史合作基础。

光模块封测设备直接影响光模块核心性能，行业普遍存在产品导入验证周期长、切换成本高等特征，客户粘性强。发行人为中际旭创产品研发提供配套设备支持，相关产品也广泛应用于其规模化量产环节，产品质量、交付保障等均通过长期量产验证，进一步夯实了双方长期稳定的合作基础。

与此同时，受益于 AI 大模型与算力基础设施建设带动的高速光模块需求爆

发，全球光模块行业保持快速增长。中际旭创作为全球光模块龙头企业，在可插拔光模块领域占据领先地位，同时积极布局 CPO、NPO 等前沿技术，市场龙头地位稳固。受近期 AI 需求推动，其自身的业务规模持续增长。2025 年其营业收入为 382.40 亿元，较去年同比增长 60.25%。根据其公开披露信息，其正在积极推进扩产工作，以保障其未来持续订单的交付。因此，中际旭创对上游封测设备的采购需求具备行业支撑与长期持续性。

综上所述，下游光模块行业景气度持续向上、客户产能扩张稳步推进，叠加公司与中际旭创间长期稳定的历史合作、发行人优异的产品品质、持续的技术创新能力及高效优质的配套服务，发行人与中际旭创间的合作关系具有稳定性和可持续性。

4、发行人与中际旭创之间不存在关联关系，公司业务获取方式具有独立性、与中际旭创间交易的定价具有公允性

截至本招股意向书出具日，发行人与中际旭创不存在关联关系。中际旭创作为全球光模块行业龙头企业，具有完善的供应商管理体系。

公司与中际旭创的合作全程均遵循公开、公平的市场化手段或方式。中际旭创根据自身生产需求发起采购需求，要求各家供应商报价，中际旭创结合供应商资质针对产品价格、性能指标、交货周期等进行对比，通过内部审批后发起采购。公司与中际旭创签订合同/订单后，由公司直销给中际旭创，公司业务获取方式具有独立性。

发行人与中际旭创之间相关交易遵循市场定价原则。发行人综合考虑生产运营成本，结合市场竞争环境、产品生命周期等进行报价，并最终经协商后确定产品价格，具有公允性。

5、发行人已广泛开拓其他客户，能够独立面向市场获取业务

报告期内，发行人在巩固与中际旭创合作的同时，坚持客户多元化战略，公司设备已广泛应用于索尔思、光迅科技、源杰科技、剑桥科技、客户三、客户四等光通信行业龙头客户和知名企业，并与 2025 年全球前十光模块厂商（前十厂商排名来源于 LightCounting）中的九家保持良好合作。

报告期内，发行人除中际旭创外的营业收入金额分别为 10,933.00 万元、

22,343.09 万元、32,501.27 万元和 20,462.42 万元；对应营业收入合计占比分别为 37.81%、41.15%、46.58%和 35.19%，客户收入结构持续优化。整体来看，发行人已广泛开拓除中际旭创外的其他客户，能够独立面向市场获取业务。

综上所述，发行人来自中际旭创的营业收入占比较高不会对公司持续经营能力构成重大不利影响。

五、发行人采购情况和主要供应商

（一）主要原材料采购情况

公司采购的原材料主要分为机械类、电气类、气动/液动类、加工件及其他。其中机械类主要包括电机、滑台等，电气类主要包括驱动器、控制卡等，气动/液动类主要包括气缸、液压缸等，加工件及其他主要包括龙门、机架等定制件及耗材、钣金件等辅料。

公司采购的主要原材料包括标准件和定制件两类。其中标准件由公司直接向供应商采购，定制件系公司向供应商提供图纸、技术参数等具体要求，由供应商自行采购相关原材料进行生产。

报告期内，公司原材料采购金额分别为 26,050.17 万元、27,318.59 万元、86,226.12 万元和 143,064.55 万元，采购规模总体随收入规模扩大呈现快速增长态势。

报告期内，公司主要原材料采购的具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
机械类	54,464.19	38.07%	29,326.80	34.01%	11,071.74	40.53%	11,405.03	43.78%
电气类	46,434.79	32.46%	29,206.33	33.87%	8,079.27	29.57%	8,625.62	33.11%
气动/液动类	6,096.29	4.26%	3,315.90	3.85%	1,004.06	3.68%	1,182.95	4.54%
加工件及其他	36,069.28	25.21%	24,377.09	28.27%	7,163.53	26.22%	4,836.57	18.57%
合计	**143,064.55**	**100.00%**	**86,226.12**	**100.00%**	**27,318.59**	**100.00%**	**26,050.17**	**100.00%**

报告期内，公司各类原材料采购金额占采购总额的比例存在一定波动，主要系受当年采购计划、产品类型结构等因素的影响导致。

（二）主要原材料采购价格

报告期内，公司采购的原材料品种、型号和规格较多，采购价格受品牌、原材料规格型号等因素的影响，即使是同种类型的原材料，也会因为供应商品牌、材质、性能和规格不同而有一定的价格差异。同时，随着公司原材料采购量增加，供应商也会给予更优惠的价格。公司主要原材料的平均采购单价变化如下：

单位：元/套、件、个

原材料大类	采购项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
机械类	滑台类	2,126.03	2,661.90	2,388.45	2,859.70
	电机类	814.67	731.52	1,020.49	931.93
电气类	驱动控制类	1,091.36	1,386.90	1,633.13	1,949.09
	传感器类	238.52	136.18	297.52	326.28
气动/液动类	液压类	79.47	1,411.05	487.96	492.51
	气缸类	191.09	250.90	447.67	697.46

报告期内，公司各类原材料采购单价总体随着采购规模上升呈逐年下降趋势，其中驱动控制类、气缸、滑台类等原材料采购单价下降主要系采购选型变化及随着采购量上升，公司议价能力提升，供应商给予更优惠的价格。公司电机类原材料采购价格呈稳定下降趋势主要系公司议价能力上升及通过国产供应商进行进口替代，综合采购成本下降。2023 年公司传感器类原材料采购单价较高，主要系公司当年根据产品设计需求，购买较多单价较高的激光传感器，导致传感器单价上升。随着公司采购规模的快速增长，公司与供应商重新调整了定价，价格逐渐呈下降趋势，2026 年 1-6 月单价有所回升，主要系采购选型变化影响。2025 年液压类材料采购单价大幅上升，主要系公司根据客户定制化需求采购单价较高的液压缸所致，2026 年 1-6 月采购单价大幅下降，系液压类物料主要用于非标自动化设备，当期自动化设备所需物料以机械压力表等低值液压附件为主，其单价相对低于液压缸等液压类材料。

（三）主要能源采购情况

报告期内，公司生产经营所耗用能源主要为电力，公司电力采购情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
用电量（万度）	204.48	221.53	121.80	92.82
电费（万元）	145.45	176.56	96.26	73.90
平均单价（元/度）	0.71	0.80	0.79	0.80

公司的核心技术在于产品结构设计、软件研发、设备组装调试等方面，公司机器设备、房屋及建筑物等固定资产规模较小，能源消耗与公司产量之间关联性较小。

（四）报告期内主要供应商

报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下：

单位：万元

年度	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占比
2026 年 1-6 月	1	星微科技	驱动控制类、控制套件	7,311.06	5.11%
	2	奥普瑞	加工件	5,612.29	3.92%
	3	建祥机电	气动/液动阀类	4,762.28	3.33%
	4	供应商二	焊台	4,417.46	3.09%
	5	上海冉涵	驱动控制类	4,361.96	3.05%
	前五大供应商合计			**26,465.06**	**18.50%**
2025 年度	1	奥普瑞	加工件	5,040.29	5.85%
	2	星微科技	驱动控制类、控制套件	3,992.29	4.63%
	3	瑞鑫力	加工件	2,774.62	3.22%
	4	恩茂欣	控制套件	2,698.95	3.13%
	5	南央国际	滑台类	2,586.96	3.00%
	前五大供应商合计			**17,093.11**	**19.82%**
2024 年度	1	星微科技	驱动控制类、控制套件	1,786.74	6.54%
	2	奥普瑞	加工件	1,588.27	5.81%
	3	津微光电	滑台类	1,007.62	3.69%
	4	上海骏煦	滑台类	978.93	3.58%
	5	南央国际	滑台类	922.61	3.38%
	前五大供应商合计			**6,284.18**	**23.00%**
2023 年度	1	星微科技	驱动控制类、控制套件	2,710.62	10.41%
	2	上海骏煦	滑台类	1,811.71	6.95%
	3	供应商二	焊台	1,625.31	6.24%

年度	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占比
	4	奥普瑞	加工件	1,124.76	4.32%
	5	南央国际	滑台类	860.26	3.30%
	前五大供应商合计			**8,132.66**	**31.22%**

注：同一实际控制人控制的采购合并计算

报告期内，公司向前五大供应商的采购金额分别为 8,132.66 万元、6,284.18 万元、17,093.11 万元和 26,465.06 万元，占比分别为 31.22%、23.00%、19.82%和 18.50%。报告期内，公司不存在向单个供应商采购金额占公司当期采购总额的比例超过 50%或严重依赖于少数供应商的情况。截至本招股意向书签署日，公司董事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方、持有公司 5%以上股份的股东与上述供应商不存在关联关系。

前五大供应商中，公司与津微光电、南央国际和瑞鑫力都具有较长的合作历史。津微光电为日本神津精机的代理商，南央国际为日本中央精机的代理商，随着公司贴片设备销售规模扩大，公司向其采购滑台数量快速增长，导致对其采购规模增加，从而进入报告期前五大供应商。瑞鑫力系公司耦合设备、QTEC 设备的主要加工件供应商之一，随着公司业务规模快速增长，对其采购金额快速增加，从而进入报告期前五大供应商。

六、发行人的主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

1、固定资产情况

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具和办公及电子设备等。截至 2026 年 6 月 30 日，公司主要固定资产具体情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	账面价值	成新率
房屋及建筑物	3,503.33	3,024.45	86.33%
机器设备	2,894.20	2,493.53	86.16%
运输工具	860.01	280.60	32.63%
办公及电子设备	950.18	410.66	43.22%
合计	**8,207.73**	**6,209.24**	**75.65%**

注：成新率=账面价值/账面原值×100%，下同。

2、房屋建筑物

（1）自有房屋建筑物

截至报告期末，公司拥有的房屋建筑物情况如下：

序号	权利人	不动产权证号	坐落	使用期限	用途	建筑面积（㎡）	其他权利
1	飞泰智能	鄂（2021）武汉市蔡甸不动产权第0003216号	蔡甸区大集街竹林四路79号	至2068.8.21	工业	8,858.21	抵押
2	瑞森联	鄂（2025）武汉市洪山不动产权第0047693号	洪山区青菱大道648号东湖高新德成科创中心18厂房栋一单元1层（1）号	至2071.8.25	工业	813.89	无
3	瑞森联	鄂（2025）武汉市洪山不动产权第0047692号	洪山区青菱大道648号东湖高新德成科创中心18厂房栋一单元2层（1）号	至2071.8.25	工业	813.89	无
4	瑞森联	鄂（2025）武汉市洪山不动产权第0047690号	洪山区青菱大道648号东湖高新德成科创中心18厂房栋一单元3层（1）号	至2071.8.25	工业	813.89	无
5	瑞森联	鄂（2025）武汉市洪山不动产权第0047691号	洪山区青菱大道648号东湖高新德成科创中心18厂房栋一单元4层（1）号	至2071.8.25	工业	813.89	无
6	瑞森联	鄂（2025）武汉市洪山不动产权第0047694号	洪山区青菱大道648号东湖高新德成科创中心18厂房栋一单元5层（1）号	至2071.8.25	工业	813.89	无

注：根据飞泰智能与武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行于2025年4月29日签订的《最高额抵押合同》，飞泰智能已将该房屋及其所涉土地使用权抵押给武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行，为飞泰智能自2025年4月29日至2027年4月29日期间办理约定的各类业务所形成的债权提供担保，担保债权的最高余额为人民币1,980万元。

（2）发行人的房产租赁情况

截至报告期末，发行人与生产经营相关的主要房屋承租具体如下：

序号	租赁物产权证编号	承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积（m2）	租赁期限	用途
1	苏（2023）昆山市不动产权第 3015526 号	猎奇智能	昆山高新科技服务有限公司	昆山市玉山镇新塘路 826 号	6,953.12	2024.4.1-2027.3.31、2025.10.1-2028.9.30	办公、生产
2	鄂（2016）武汉市东开不动产权第 0052234 号	瑞森联	武汉东湖高新运营发展有限公司	武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A1 栋 A 座 103 和 A1 栋 A 座 501 房屋	758.77	2024.4.22-2027.4.21	办公
3	鄂（2021）武汉市江夏不动产权第 0033380 号	飞泰智能	武汉微格创意产业园运营管理有限公司	武汉市江夏区藏龙岛经济开发区九凤西路 4 号研发中心大楼 3 楼 312 房及 313 房	266	2022.2.24-2027.3.23	办公
4	苏（2019）昆山市不动产权第 3026373 号	猎奇智能	昆山盛唐通风设备有限公司	昆山市玉山镇红杨路 1328 号 2 号厂房一楼南面第 1-6 卡厂房	2300	2024.12.1-2027.11.30	生产
5	苏（2021）昆山市不动产权第 3003340 号	凯欧光电	昆山高新科技服务有限公司	昆山市玉山镇寰庆路 2980 号中节能（昆山）循环经济产业园 27 号楼第一层	974.86	2025.10.1-2028.9.30	办公、生产
6	苏（2024）昆山市不动产权第 3017756 号	猎奇智能	昆山嘉航资产管理有限公司	昆山市新塘路 699 号 1 号厂房一层、三层	7,710.25	2026.3.16-2029.3.15	生产
7	苏（2019）昆山市不动产权第 3026373 号	猎奇智能	昆山盛唐通风设备有限公司	昆山市玉山镇红杨路 1328 号 2 号厂房一楼对应仓库（三楼北）	2,000.00	2026.3.1 至 2028.2.29	生产
8	苏（2019）昆山市不动产权第 3026373 号	猎奇智能	昆山盛唐通风设备有限公司	昆山市玉山镇红杨路 1328 号 2 号厂房四楼	6,240.00	2026.1.1 至 2027.12.31	生产
9	苏（2021）昆山市不动产权第 3003340 号	凯欧光电	昆山高新科技服务有限公司	昆山市玉山镇寰庆路 2980 号中节能（昆山）循环经济产业园 27 号楼三层	1,177.78	2026.2.10-2029.2.9	办公、生产

（二）主要无形资产

1、土地使用权

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人拥有的土地使用权情况如下：

序号	权利人	不动产权证号	坐落	使用期限	用途	宗地面积（㎡）	其他权利
1	飞泰智能	鄂（2021）武汉市蔡甸不动产权第 0003216 号	蔡甸区大集街竹林四路 79 号	至 2068 年 8 月 21 日	工业	7,314.00	抵押
2	猎奇智能	苏（2026）昆山市不动产权第 3010906 号	昆山高新区北门路东侧、龙胜路南侧	至 2056 年 2 月 10 日	工业	23,318.00	无

注：根据飞泰智能与武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行于 2025 年 4 月 29 日签订的《最高额抵押合同》，飞泰智能已将该房屋及其所涉土地使用权抵押给武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行，为飞泰智能自 2025 年 4 月 29 日至 2027 年 4 月 29 日期间办理约定的各类业务所形成的债权提供担保，担保债权的最高余额为人民币 1,980 万元。

2、专利权

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司已获授权的发明专利共计 55 项、实用新型专利 74 项。截至报告期末，发行人部分专利涉及质押，该等专利的具体情况详见本招股意向书“第十二节 附件”之“附件二：发行人主要无形资产详细情况”。

3、商标权

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的境内外注册商标共计 3 项。该等商标的具体情况详见本招股意向书“第十二节 附件”之“附件二：发行人主要无形资产详细情况”。

4、软件著作权

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的软件著作权共计 47 项。该等软件著作权的具体情况详见本招股意向书“第十二节 附件”之“附件二：发行人主要无形资产详细情况”。

5、域名

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的域名共计 1 项。该等域名的具体情况详见本招股意向书“第十二节 附件”之“附件二：发行人主要无形资产详细情况”。

（三）特许经营权

截至 2026 年 6 月 30 日，公司未拥有特许经营权。

（四）主要业务资质

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人已取得生产经营所必需的相关许可、资质、认证，具体情况如下：

序号	证书类型	证书备案编号	发证机关	有效期至	持有人
1	高新技术企业证书	GR202432012264	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2027.12.15	猎奇智能
2	高新技术企业证书	GR202342003390	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2026.11.13	飞泰智能
3	海关进出口货物收发货人备案回执	3223969573	昆山海关	长期有效	猎奇智能
4	海关进出口货物收发货人备案回执	42019630H1	汉阳海关	长期有效	飞泰智能
5	海关进出口货物收发货人备案回执	4201944006	汉阳海关	长期有效	云琦精密
6	质量管理体系认证	U23Q2SZ8008185R2M	卡狄亚标准认证（北京）有限公司	2026.12.05	猎奇智能
7	质量管理体系认证	17422Q21270R1S	华信创（北京）认证中心有限公司	2028.08.29	凯欧光电
8	质量管理体系认证	60822Q0865R0S	秉奕国际认证有限公司	2028.03.02	飞泰智能
9	质量管理体系认证	93125Q1607R0S	万佳标准认证（湖北）有限公司	2028.05.07	云琦精密
10	环境管理体系认证	17422E20752R1S	华信创（北京）认证中心有限公司	2028.08.29	凯欧光电
11	固定污染源排污登记回执	91320583MA1MBH7J5A001X	/	2028.05.23	猎奇智能
12	固定污染源排污登记回执	91320583593918342 3001Y	/	2028.12.06	凯欧光电
13	固定污染源排污登记回执	91420114MA4KXQKF3L001X	/	2030.12.11	飞泰智能
14	固定污染源排污登记回执	91320583MA278CFT6R001Z	/	2030.09.02	云琦精密

发行人已取得现阶段从事生产经营活动所必需的全部资质、许可和认证，

截至本招股意向书签署日，上述资质证书均在有效期内，不存在被吊销、撤销、注销、撤回的重大法律风险或者到期无法延续的风险。

七、发行人主要产品或服务的核心技术

（一）核心技术情况

1、核心技术、技术来源、技术先进性及具体表征

（1）核心技术基本情况

公司专注于光模块封装设备的性能提升，并具备光模块封装全流程设备的开发能力，其中贴片、耦合等设备已处于国际或国内领先水平，各项参数指标均处于行业前列，相关设备填补了国产设备的空白，打破了欧美设备厂商垄断市场的局面，有效实现了光通信领域国产设备的替代。公司一贯将技术创新、产品创新作为企业发展的核心驱动力。经过多年发展，公司已建成能持续创新的研发机制，实现了软硬件结合、多学科交叉的核心技术，相关技术已广泛应用于公司主流产品，各核心技术具体情况如下表所示：

（2）产品核心技术

核心技术名称	所处阶段	主要应用设备	技术来源	专利保护
高精密运动平台技术	量产	贴片设备、耦合设备	自主研发	发明专利 6 项
高精度，高动态压力控制技术	量产	贴片设备	自主研发	发明专利 4 项
脉冲加热技术	量产	贴片设备	自主研发	发明专利 7 项
高精度视觉对准技术	量产	贴片设备、耦合设备	自主研发	发明专利 3 项
贴片机软件框架平台	量产	贴片设备	自主研发	软件著作权 2 项
视觉引导技术	量产	耦合设备、自动化设备	自主研发	发明专利 3 项
耦合算法	量产	耦合设备	自主研发	发明专利 7 项
自适应贴合技术	量产	贴片设备、耦合设备	自主研发	发明专利 1 项
光纤夹持自由旋转角度控制技术	量产	耦合设备	自主研发	发明专利 4 项
COC 老化测试技术	量产	老化测试设备	自主研发	发明专利 2 项
柔性生产技术	量产	自动化设备	自主研发	商业秘密

（3）核心技术的先进性

核心技术名称	技术特点及技术先进性
高精密运动平台技术	高精密运动平台技术主要通过精密机械设计、仿真，利用直驱技术、直线导向技术（机械或气浮导轨）、光栅反馈技术、电机驱动控制技术，并结合高精密测量（自准直仪器、激光干涉仪、振动传感器）、1D 和 2D 补偿技术、运控轨迹算法，实现了基于应用场景的高精密运动平台，相比传统方案，平台适应性更好，性能更强。该核心技术需综合设计仿真、材料选型、精密制造和组装、量测及检验标定方法等多领域技术。 ①高精密气浮运动平台 该技术根据气浮平台的负载、行程、精度等需求，综合运用仿真、材料选型等技术，开发精密气浮模组。通过流体动力学、结构力学等数字仿真，采用高精度导向件（如精密机械导轨、气浮导轨）、直驱电机、光栅尺，在满足额定负载参数条件下，实现气浮刚性系数的设计优化，并将气浮导轨直线度误差控制在±1.5μm 范围内。装配过程采用激光准直仪建立空间三维基准坐标系，把控对准精度，运用激光干涉仪闭环反馈系统，对气浮模组进行动态性能标定，达成单轴亚微米级运动控制能力，为高精度贴装提供保障。
	②高精密高速双龙门柔性机械运动平台 公司属于国内少数将柔性双驱龙门技术及气浮运动平台应用到贴片机的光模块设备商，自主设计研发的高精度柔性机械龙门，实现龙门双向直线度、重复定位精度在 1 微米以内，对行业内双驱龙门设备的三大技术瓶颈展开创新突破： A.双驱同步控制难题 开发柔性龙门结构，采用“单侧刚性连接+高强度柔性膜片联动”设计。当双电机速度产生微量差异时，柔性膜片通过弹性形变吸收位移差； B.横梁负载与运动效率矛盾 通过模拟仿真，在保持横梁刚性和负载的前提下，将横梁质量降至传统结构的 1/3，实现横梁轻量化，突破传统龙门“重负载低效率” 的性能上限，使龙门系统加速度提升至 4G-6G，龙门 X/Y 轴速度及加速度性能较普通龙门提升 20%-100%； C.温飘导致的精度劣化 创新性采用硅铝合金替代传统航空铝作为龙门主材，降低龙门形变量和温飘影响。
高精度，高动态压力控制技术	该技术主要分开环压力和闭环压力。针对开环压力，创新性的采用双音圈电机与双导向结构一体化设计结构，通过一体化设备大大提升其动态性能，响应度达 ms 级，实现了压力开环动态跟随工艺（200ms 内 5 段压力变化，切压力过程可控）；针对闭环压力，在机械结构上采用无摩擦阻尼的双自由度导向设计，内置桥接式压力传感器。 内置压力传感器，在控制系统搭建压力模拟量环和位移环的双闭环控制，实现位移模式下快速运动到目标、压力模式下的精准探力，并能够实现实时动态压力控制（最低 5g 微力控制）。
脉冲加热技术	该技术利用电脉冲，通过控制脉宽和脉冲幅度，来实现高速温度下高精度温度控制。公司自主设计的基于多段 PID 控制与前瞻控制的温控技术，有效控制温度过冲。利用 AIN or SIC 等高导热绝缘耐磨材料，作为载体可实现芯片或基板的快速加热，满足焊接对温度控制的需求。该技术为解决热压键合工艺控制而开发，通过此技术实现快速升温，能够根据工艺曲线实时调整并防止末端温度过冲，满足共晶焊接和热压键合对温度控制的要求。通过 PID 脉冲加热，实现 100℃/S 的技术升降温，满足共晶焊接的苛刻工艺需求。
高精度视	该技术利用棱镜透射和反射原理，通过视觉空间标定对准和实时对准技术，

核心技术名称	技术特点及技术先进性
觉对准技术	实现两个贴合物体件平面位置和角度信息（X/Y/θ）高精度的调整。结合（玻璃芯片和玻璃基板）技术和亚像素处理技术实现贴装后位置信息精确测量校准； 通过高精度视觉对准技术，对准后短行程内贴片，排除机械平台的误差，实现亚微米的高精度贴装。该技术为解决高精度贴装前位置对准，目前应用于 1.5μm 的设备，相比传统技术可靠性更高，此技术能够支撑亚微米贴片设备开发。
贴片机软件框架平台	贴片机软件框架平台是公司自主研发高通用性、模块化工业软件平台。该平台采用分层架构设计，涵盖运动控制、机器视觉、工艺编排、参数与配方管理、数据统计与分析、用户管理等 6 大核心模块，支持从单机设备到复杂并线系统的快速开发，缩短了设备开发周期，降低了设备开发难度与门槛。通过内置 20+标准化功能模块与开放式脚本接口，平台兼具标准开发与深度定制双重能力，可在保证功能流程标准化的同时满足不同客户对界面交互、工艺流程的个性化需求
视觉引导技术	该技术主要针对贴片和耦合过程中的视觉定位技术，在 2D 图像处理、深度学习视觉技术方面形成丰富技术积累。采用固定式多角度的结构，搭配独特的位移算法，缩小图像识别误差，提高视觉组件运行速率并提高识别精度 ①2D 图像处理技术 自主研发的亚像素级定位测量技术，基于灰度梯度优化亚像素边缘检测算法，实现亚像素重复定位精度，支持反光/低对比度场景下的模糊定位补偿，解决金属外壳、透明基材等复杂工况的识别难题 ②图像拼接技术 采用多相机（5 相机）标定+非线性畸变校正技术，实现 90mm×18mm 范围的全景拼接，拼接误差＜1 个像素，可以应用于 PCB 整板检测、硅片全尺寸测量等场景
耦合算法	该技术主要基于高精度多轴运动系统，与反馈系统，通过光斑、光路特性、光对位置敏感程度，胶水固化等工艺要求，开发基于从工艺角度出发的算法库。算法也针对耦光轨迹进行了优化，通过运动轴集成数据采集模块提升实时采集效率。创新耦光算法多维寻优，实时耦合数据通过二维曲线拟合，三维参数选代优化以逼近最佳值。客户可根据产品情况搭配与组合，实现在保证效率的同时提高产品一次耦合良率。
自适应贴合技术	该技术融合自主研发的气浮机构与耦合贴装算法，通过压缩空气在腔体内生成微米级限压气隙，形成刚性气膜实现零接触悬浮。实现两个产品端面自适应贴合功能，贴合后平面度达到 2μm，兼具高精度、无摩擦、免润滑、静音运行等特性，相比传统测量与校准技术更简单高效。
光纤夹持自由旋转角度控制技术	该技术使用自行研究设计的夹套结构，搭配的旋转结构，以及电机控制技术，夹持产品时保证其旋转时的同心度及旋转角度的精度，自制的旋转结构，承载轴向负载并承受径向负载
COC 老化测试技术	该技术采用创新的“抽屉”式设计结构，与高密度探针供电技术，使每个抽屉成为单独的控制对象，可以控温、供电、采集，并通过标准化快插电气接口与夹具，满足不同产品的测试需求。同一主机可支持多款产品的老化（DFB、EML、EML+SOA、针对硅光应用的大功率激光器）；备除老化功能外，支持老化过程中的 LIV 测试
柔性生产技术	该技术依据柔性生产的要求与猎奇标准化设备开发的经验，以工艺和工序为支撑点，以柔性传输和 AGV 为纽带，并通过与统一的标准化框架系统结合，从而实现多产品，多机型的快速换型生产，有效缩短了产线待机时间，产线投资减少，回报率大幅提升。通过 MES 与软件系统，实现数据的高效

核心技术名称	技术特点及技术先进性
	上传，满足信息化管理的需求；

2、核心技术所处阶段、在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况

发行人紧紧围绕核心技术进行日常生产，最终体现在发行人各类产品中。报告期内，发行人运用核心技术生产制造的产品收入占全部营业收入比例较高，具体如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品收入	51,342.12	61,700.79	49,567.80	26,302.85
营业收入	58,144.73	69,779.24	54,292.61	28,918.30
占比	88.30%	88.42%	91.30%	90.96%

3、核心技术保护措施

公司拥有的核心技术为公司持续发展的关键，公司高度重视对核心技术的保护，为防止技术泄密，公司建立了知识产权管理制度，对专利申请流程进行了规范，保证公司的技术研发成果可以及时申请知识产权保护。目前，公司已针对核心技术申请了多项专利，具体情况详见本节“七、发行人主要产品或服务的核心技术”之“（一）核心技术情况”之“1、核心技术、技术来源、技术先进性及具体表征”。

（二）科研实力和成果情况

1、技术研发平台

公司始终以行业需求为导向、以研发创新为重心。公司高精密光模块自动化设备工程技术研究中心获得江苏省省级工程技术研究中心认定。

2、主要奖项、荣誉

截至 2026 年 6 月 30 日，公司获得主要奖项、荣誉的具体情况如下

序号	奖项名称	颁发时间	颁发单位
1	江苏省星级上云企业	2025	江苏省科技厅
2	湖北省创新型中小企业	2025	湖北省经济和信息化厅

序号	奖项名称	颁发时间	颁发单位
3	江苏瞪羚企业	2024	江苏省科技厅
4	国家级专精特新“小巨人”企业	2023	国家工信部
5	江苏省专精特新企业	2022	江苏省工信厅
6	创新型中小企业	2022	苏州市工业和信息化局
7	江苏省新产品新技术认定（光模块自动耦合机）	2018	江苏省经信委
8	江苏省首台（套）重大装备（光模块自动耦合机）	2018	江苏省工业和信息化厅
9	高新技术产品认定（光模块自动耦合机）	2017	江苏省科技厅
10	江苏省民营科技企业	2017	江苏省民营科技企业协会
11	江苏省科技型中小企业	2016	江苏省科技厅
12	江苏省首台（套）装备（全自动芯片共晶贴片机）	2025	江苏省工信厅
13	国家级专精特新“重点”小巨人	2025	国家工信部

3、技术成果

依托在光模块封装设备多年技术研发积累，公司在产品技术研发方面取得了多项成果，并形成了多项专利技术及非专利技术。截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有专利 129 项，包括发明专利 55 项、实用新型专利 74 项；拥有软件著作权 47 项。

（三）研发情况介绍

1、在研项目

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人从事的主要在研项目情况如下：

序号	项目名称	研发内容及拟达到目标	所处阶段
1	IC 高速固晶机的研发	开发应用于 IC 固晶行业的高速高精度封装设备，支持银浆贴片与 DAF 工艺，同时兼容 LF 与 Substrate 供料	验证测试阶段
2	DH3 系统倒装贴片设备的研发	开发新一代高精度大尺寸倒装贴片设备，支持 WLP 和 PLP 工艺，提升工艺延展能力	验证测试阶段
3	热压超声焊设备的研发	开发热压超声倒装设备，利用超声能量、压力、以及热量的相互作用，实现芯片端口之间的直接互连，属于先进半导体封装设备	验证测试阶段
4	智能激光监测平台	基于光学低相干原理技术，研制出高性能激光加工在线监测系统，能够实现结构检测、特征寻径、特征跟踪以及激光熔池动态监测、加工质量检测的全周期监测。为新能源电池、汽车零部件、航空航天零件激光加工提供质量监测功能，提升激光加工的工艺质量	验证测试阶段

序号	项目名称	研发内容及拟达到目标	所处阶段
5	超快玻璃焊接平台的研发	开发高运动精度玻璃焊接设备，能够准确寻找焊接焦点位置，并能实时补偿焊接过程中激光焦点高度，实现玻璃或玻璃与异种材质的稳定焊接	验证测试阶段
6	硅光芯片耦合设备的研发	开发硅光芯片耦合设备，采用变倍视觉引导系统、端面力控控制组件、大理石气浮减震系统、高精度六轴闭环步进耦合模组搭配自研智能找光算法、自动点胶模组、自动 UV 固化模组，实现 FA 与硅光芯片耦合全流程自动化，提高设备做料效率	验证测试阶段
7	多层扁线电机定子智能装配柔性生产线研发	开发多层扁线电机定子智能装配生产线，包含扁线上料校直工站、激光去漆工站、送线裁切及 2D 折弯工站、双工位 3D 成型工站及插线工站，可以在满足高效生产的前提下兼容多种不同的扁线规格	验证测试阶段
8	Burn in 4.0 老化测试设备的研发	开发支持 LIV 测试功能的大容量 COC 老化设备，项目包含基于风冷，最大供电电流为 500mA 64 位 COC 老化设备（带 LIV），和基于水冷，最大供电电流为 1000mA 96 位 COC 老化设备（带 LIV），实现单位厂房面积下，产能大幅提升的需求	验证测试阶段

2、研发投入情况

报告期内，公司研发投入及其占营业收入的比例情况请详见本招股意向书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（五）期间费用分析“之”3、研发费用分析”。

3、合作研发项目

报告期内，公司不存在合作研发的情况。

（四）核心技术人员、研发人员情况

1、研发人员构成情况

公司的研发人员认定标准为从事研发活动的人员，包括直接从事研发活动的专业人员以及与研发活动密切相关的人员。对于既从事研发活动又从事非研发活动的人员，发行人将上述人员认定为研发人员的标准为当期研发活动工时占比不低于 50%。报告期各期末公司研发人员构成情况如下：

单位：人

项目	2026 年 6 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
研发人员	151	133	114	49
员工人数	1,117	757	518	391
研发人员占比	13.52%	17.57%	22.01%	12.53%

报告期各期，研发人员学历分布情况如下：

单位：人

学历	2026 年 6 月末		2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	人数	比例	人数	比例	人数	比例	人数	比例
硕士及以上	20	13.25%	21	15.79%	16	14.04%	4	8.16%
本科	82	54.30%	66	49.62%	54	47.37%	26	53.06%
大专及以下	49	32.45%	46	34.59%	44	38.60%	19	38.78%
合计	**151**	**100%**	**133**	**100%**	**114**	**100%**	**49**	**100%**

2、核心技术人员概况

截至报告期末，公司共有 4 名核心技术人员，报告期内，公司核心技术人员未发生变动。核心技术人员简历及重要科研成果与奖项等情况详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“十、董事、高级管理人员及其他核心人员情况”。

核心技术人员对公司研发的具体贡献如下：

核心技术人员	研发贡献
葛宏涛	公司研发总监，根据行业发展方向，主导研发产品规划与决策，并参与重大项目与核心技术的攻关。主导多款贴片和耦合设备开发，攻克高精密运动平台、高精度视觉对准、脉冲加热等核心技术，并推进贴片设备开发平台搭建，完成公司研发体系建立，为公司主要技术路线确立和核心技术的攻关起到关键作用。
刘鸿铭	公司创始人之一，从事高精度装备开发 20 年，其中光通讯行业从业 10 年，拥有丰富光模块封装产品开发经验，负责光模块产品空间光路耦合设备研发与工艺研发，主导公司创立初期 100G 光模块全自动耦合封装设备开发及 200G 至 1.6T 光模块耦合设备封装开发和迭代，并成功将耦合装备拓展至激光陀螺仪，Y 波导，激光雷达，大功率激光器等产品，提升激光领域耦合装备覆盖面，对公司耦合设备业务具有重大贡献。
张学良	公司研发一部经理，侧重机械设计方向，主持高精度共晶贴片设备开发工作，实现±1um 共晶贴片设备的进口替代。攻克多芯片共晶、倒装共晶、大尺寸自适应共晶等核心工艺，成功导入多个光模块头部企业，并将应用拓展至大功率激光行业。目前正主导公司 IC 高速固晶机、高精度倒装贴片设备开发，推进公司贴片设备业务向 IC 封装领域拓展。
李珂	公司研发一部软件研发经理，侧重软件开发方向，负责公司高精度共晶设备、多芯片贴装设备的软件开发，主导贴片设备软件平台 2.0 搭建，并带领团队推动此软件平台应用于公司多款核心设备。同时，负责牵头开放视觉平台、运动控制平台、力控等关键技术攻关，打造标准化、模块化、可扩展的软件核心框架，持续推进软件 3.0 平台开发，打造系统级贴片设备软件平台，提升国产装备竞争力，为公司设备软件平台搭建具有重大贡献。

3、发行人对核心技术人员实施的约束激励措施

（1）富有竞争力的薪资待遇水平

为调动核心技术人员的积极性，公司建立了较为完善的创新激励机制，给予核心技术人员合理的回报，公司定期对薪酬体系与薪资待遇水平进行市场化调整，提供具有市场竞争力的薪酬与福利水平，且全部核心技术人员已持有公司股份，保持公司对先进人才的持续吸引。

（2）必要的约束机制

在劳动协议之外，公司及其子公司还结合现行有效的法律法规，与核心技术人员签署保密协议、竞业限制协议，就核心技术人员在任职期间及离职以后保守公司商业秘密和竞业限制的有关事项进行了约定，对核心技术人员进行约束，保护公司股东利益。

（五）公司保持技术创新的机制、技术储备及技术创新安排

公司自成立以来，始终坚持自主研发、持续创新，一方面公司坚持以市场需求为导向，预判行业发展和客户需求变化趋势，积极布局前沿技术，提前进行技术储备；另一方面持续创新优化现有技术，提升现有技术水平、产品性能。公司建立了较为完善的技术创新机制，对未来技术储备及技术创新做了合理安排，具体情况如下：

1、坚持以客户需求为导向

公司根据自身行业及研发模式的特点，建立了以事业部为基础的研发体系，将各研发部门下沉至各个事业部，以更好的理解和应对下游客户需求变化和行业发展趋势，从而快速响应市场变化，缩短新产品、新技术的研发及产业化应用周期，为公司的业务拓展打下坚实基础。同时，公司建立了完善的研发流程管理体系，在确定客户需求的基础上，由技术骨干人员带领团队根据研发需求进行技术储备和积累，并在研发需求挖掘、评审、立项、验证等方面制定了相应的内控制度以推动公司技术创新。

2、构建完善研发激励机制及人才引进机制

公司建立了完善的人才激励机制以吸引优秀技术人才加入公司研发工作，

增强公司对研发人员的凝聚力。通过常态化的学习培训，加快研发人员的知识更新和研发人才梯队培养。公司建立了结果导向制的考核机制，对成绩优异的员工给予加薪、绩效奖金、股权激励等激励，调动研发人员的创新积极性。同时，公司积极拓宽人才引进渠道，加强外部人才引进机制的建设。

3、技术储备情况

公司顺应国家战略导向、行业发展趋势，并结合客户需求，坚持自主创新和进行技术储备，具体情况如下：

（1）顺应行业技术发展趋势，开展前沿技术研发

基于硅光、CPO 等光模块技术需求，公司依托于 H3 和实时对准贴装平台，正在研发激光辅助键合、倒装热压等先进封装相关工艺，解决未来光模块向更高带宽，更高集成度衍进。激光辅助键合工艺利用激光局部加热的特性，对位于基板或晶圆上的芯片进行局部加热，减少温度对周围器件的影响，实现选择性回流与激光共晶的工艺需求。倒装热压工艺通过对 Bondhead 采用脉冲加热技术，最大升温速率达到 100℃/S，实现芯片在氮气气氛中进行热压焊接，解决了芯片倒装原位贴装与高密度互联的需求。基于硅光方案，公司正在研发全自动硅光芯片耦合测试设备，实现卡夹式全自动上下料，更好地满足客户硅光芯片测试需求。

（2）依托现有技术，向 IC 领域贴片设备拓展

公司依托于现有高精密运动平台技术、高精度高动态压力控制技术、脉冲加热技术、高精度视觉对准技术等核心技术，积极向 IC 领域贴片设备拓展，针对 IC 行业单芯片、多芯片、倒装、倒装热压超声等贴装形式，正在开展 IC 高速固晶机、多功能高速贴片设备、DH3 系统倒装贴片设备、热压超声焊设备等新设备的研发，目前已有部分样机在客户处验证。公司 SiC 预烧结设备已通过士兰微验证。

八、发行人环境保护以及安全生产情况

（一）发行人生产经营中涉及的主要污染物、主要处理设施及处理能力

发行人主要从事光通信、半导体、汽车自动化设备等领域智能生产装备的

研发、生产和销售，经查阅《环境保护综合名录（2021 年版）》等相关法律法规及规范性文件，发行人及其子公司所处行业不属于重污染行业。公司及其子公司的业务产品的生产流程主要为装配及调试，排放的主要污染物主要包括废水、废气、固体废弃物。同时，生产过程中会产生一定的噪声。

公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力如下表所示：

分类	处理污染物	环保设施及处理能力	运行情况
废水	生活污水等	通过园区污水管网排入市政污水管网	正常
	生产过程中产生的废切削液、废清洗剂、废酒精、废硝酸、废煤油等	委托有危废处理资质第三方机构回收处理	
废气	陶瓷脱脂废气	通过相应净化设施处理后通过废气排放口合规排放	正常
固废	生活垃圾	收集堆放，由园区部门统一处理或由环卫部门运往垃圾处理厂作无害化处理	正常
	生产过程中产生的废铝屑、废钢屑、废无铅铜屑、废陶瓷等材料	集中收集交由物资回收公司处理	
噪音	噪音	低噪型设备，定期测试，符合噪声标准	正常

报告期内，公司严格按照国家和地方标准处理相关污染物，不对周边环境产生不利影响。报告期内，公司及其子公司的生产经营未因违反环境保护方面的规定而被环保主管部门禁止或处以行政处罚。

（二）安全生产情况

发行人历来重视安全生产，为持续加强安全生产，发行人根据自身实际情况制定了生产管理制度，明确安全生产管理责任、规范安全生产流程，防范安全生产事故的发生，保障员工人身安全和权益，维护厂区安全生产秩序。报告期内，发行人及其子公司未发生重大安全生产事故或受到安全生产相关的行政处罚。

九、发行人境外经营和境外资产情况

发行人除在中国大陆生产、经营外，还在新加坡和泰国分别设立子公司新加坡芯泰和泰国飞泰，主要系企业出海发展和开拓海外客户市场。境外子公司的基本情况请详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人控

股子公司、参股公司及分公司”的相关内容。

除上述业务外，公司未在中国境外进行生产经营，也未在境外拥有其他资产。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节披露或引用的财务会计数据及相关财务信息，非经特别说明，均引自经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告或根据其计算得出。除另有注明外，本节讨论与分析所用数据均指合并口径或根据其计算得出。

本节对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解公司报告期的会计政策、财务状况、经营成果和现金流量，公司提醒投资者关注和阅读本招股意向书所附财务报告及审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、发行人财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项　目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	321,296,629.82	167,234,529.38	164,958,776.88	185,974,381.07
交易性金融资产	105,391,257.08	300,841,878.57	335,278,825.78	65,054,933.61
应收票据	9,722,923.16	9,758,522.55	6,947,434.58	1,094,740.80
应收账款	281,808,010.34	190,767,486.82	120,790,825.34	109,291,141.07
应收款项融资	708,376.00	2,587,095.81	5,704,605.69	3,429,764.79
预付款项	131,930,891.89	33,181,769.90	5,923,860.60	5,829,516.66
其他应收款	3,513,511.45	3,617,094.95	2,378,064.46	1,297,795.14
存货	1,988,665,099.76	826,683,050.63	310,739,428.88	261,478,018.52
合同资产	15,370,144.32	15,121,396.54	7,042,650.20	1,366,055.21
其他流动资产	108,556,950.12	21,321,219.50	1,541,701.35	1,336,125.92
流动资产合计	**2,966,963,793.94**	**1,571,114,044.65**	**961,306,173.76**	**636,152,472.79**
非流动资产：				
固定资产	62,166,960.97	51,263,538.43	27,340,549.87	20,649,458.51
在建工程	398,840.66	-	-	-
使用权资产	9,799,594.49	5,574,696.55	6,340,298.26	1,854,140.88
无形资产	11,594,949.80	3,323,921.22	2,631,159.84	2,106,465.03
长期待摊费用	2,661,425.47	1,742,986.22	1,132,259.67	801,453.74
递延所得税资产	5,900,150.50	3,848,262.05	2,726,362.20	2,209,647.57

项　目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
其他非流动资产	1,539,794.60	844,044.60	1,442,203.00	423,064.00
非流动资产合计	**94,061,716.49**	**66,597,449.07**	**41,612,832.84**	**28,044,229.73**
资产总计	**3,061,025,510.43**	**1,637,711,493.72**	**1,002,919,006.60**	**664,196,702.52**
流动负债：				
短期借款	-	-	-	6,006,833.33
应付票据	122,555,242.00	26,788,406.40	14,828,190.50	15,456,643.75
应付账款	964,161,010.14	423,638,043.25	46,207,860.10	93,134,374.89
合同负债	900,258,548.29	348,776,041.19	296,988,691.70	230,982,445.27
应付职工薪酬	28,815,760.00	27,474,588.17	21,145,688.11	14,196,972.48
应交税费	18,388,528.67	19,080,585.79	11,349,561.10	13,554,475.91
其他应付款	1,474,877.56	1,361,531.75	515,360.02	337,556.87
一年内到期的非流动负债	15,286,005.36	3,722,437.11	2,566,478.70	2,163,611.05
其他流动负债	120,044,331.28	44,612,663.29	37,128,867.90	29,180,236.89
流动负债合计	**2,170,984,303.30**	**895,454,296.95**	**430,730,698.13**	**405,013,150.44**
非流动负债：				
长期借款	-	9,850,000.00	-	-
租赁负债	3,889,568.30	2,402,605.94	3,078,328.95	63,469.70
预计负债	9,396,619.12	6,360,145.48	3,126,493.52	1,396,007.89
非流动负债合计	**13,286,187.42**	**18,612,751.42**	**6,204,822.47**	**1,459,477.59**
负债合计	**2,184,270,490.72**	**914,067,048.37**	**436,935,520.60**	**406,472,628.03**
所有者权益：				
股本	41,250,000.00	41,250,000.00	41,250,000.00	11,308,333.00
资本公积	369,175,031.51	364,348,263.47	354,093,647.44	120,244,725.31
其他综合收益	-44,557.41	-16,617.30	34,626.83	-
盈余公积	20,625,000.00	20,625,000.00	15,524,845.53	5,654,166.50
未分配利润	446,338,064.20	297,655,511.81	155,399,651.40	120,618,867.16
归属于母公司所有者权益合计	877,343,538.30	723,862,157.98	566,302,771.20	257,826,091.97
少数股东权益	-588,518.59	-217,712.63	-319,285.20	-102,017.48
所有者权益合计	**876,755,019.71**	**723,644,445.35**	**565,983,486.00**	**257,724,074.49**
负债和所有者权益总计	**3,061,025,510.43**	**1,637,711,493.72**	**1,002,919,006.60**	**664,196,702.52**

（二）合并利润表

单位：元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	**581,447,285.99**	**697,792,432.51**	**542,926,097.04**	**289,183,021.62**
其中：营业收入	581,447,285.99	697,792,432.51	542,926,097.04	289,183,021.62
二、营业总成本	**413,593,407.16**	**505,167,286.14**	**352,293,111.10**	**205,727,797.44**
其中：营业成本	347,264,486.19	398,031,009.91	269,689,485.74	148,028,362.06
税金及附加	1,754,008.98	2,217,822.14	3,921,318.49	957,558.37
销售费用	7,214,483.10	10,805,520.30	8,132,588.94	4,966,613.94
管理费用	22,030,820.04	35,201,860.16	25,582,580.07	27,195,548.74
研发费用	34,252,745.50	58,287,357.60	44,962,650.83	24,638,783.96
财务费用	1,076,863.35	623,716.03	4,487.03	-59,069.63
其中：利息费用	279,034.84	363,981.01	289,538.35	479,679.93
利息收入	227,026.77	232,325.75	327,986.96	537,781.82
加：其他收益	8,596,825.69	16,919,710.35	17,537,086.47	5,391,148.95
投资收益（损失以“-”号填列）	1,853,011.23	5,801,511.28	3,810,673.43	830,884.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	391,257.08	841,878.57	278,825.78	54,933.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,691,376.61	-5,471,173.60	-1,272,608.84	4,824,689.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,577,295.27	-1,824,556.48	-1,912,279.54	21,827.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,088.84			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**171,475,389.79**	**208,892,516.49**	**209,074,683.24**	**94,578,708.60**
加：营业外收入	22,602.36	4,500.14	499.29	228,273.95
减：营业外支出	15,700.73	575,323.87	453,965.06	336,069.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**171,482,291.42**	**208,321,692.76**	**208,621,217.47**	**94,470,912.83**
减：所得税费用	23,170,544.99	26,764,105.31	28,055,984.40	12,967,876.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**148,311,746.43**	**181,557,587.45**	**180,565,233.07**	**81,503,036.69**
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	148,311,746.43	181,557,587.45	180,565,233.07	81,503,036.69
（二）按所有权归属				

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
分类				
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	148,682,552.39	182,356,014.88	180,782,500.79	81,604,594.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-370,805.96	-798,427.43	-217,267.72	-101,557.39
六、其他综合收益的税后净额	**-27,940.11**	**-51,244.13**	**34,626.83**	**-**
七、综合收益总额	**148,283,806.32**	**181,506,343.32**	**180,599,859.90**	**81,503,036.69**
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	148,654,612.28	182,304,770.75	180,817,127.62	81,604,594.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-370,805.96	-798,427.43	-217,267.72	-101,557.39
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	3.6044	4.4014	5.1652	不适用
（二）稀释每股收益（元/股）	3.6044	4.4014	5.1652	不适用

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,162,422,242.03	745,781,426.30	655,702,815.31	423,495,820.99
收到的税费返还	4,383,723.68	10,004,834.27	13,873,500.45	3,208,169.87
收到其他与经营活动有关的现金	10,089,688.55	15,515,606.11	13,724,159.66	14,248,763.06
经营活动现金流入小计	1,176,895,654.26	771,301,866.68	683,300,475.42	440,952,753.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,040,872,643.01	552,162,865.76	351,423,509.67	194,381,820.96
支付给职工以及为职工支付的现金	89,491,472.27	117,682,448.67	87,853,279.69	49,728,434.53
支付的各项税费	35,081,346.90	37,104,929.37	60,671,330.56	15,287,590.14
支付其他与经营活动有关的现金	23,834,952.44	35,121,659.81	41,571,792.94	32,843,312.77
经营活动现金流出小计	1,189,280,414.62	742,071,903.61	541,519,912.86	292,241,158.40
经营活动产生的现金流量净额	**-12,384,760.36**	**29,229,963.07**	**141,780,562.56**	**148,711,595.52**
二、投资活动产生的现金流量				

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	565,000,000.00	820,000,000.00	570,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,402,389.74	6,080,337.06	3,865,607.04	830,884.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,390.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	566,562,779.74	826,080,337.06	573,865,607.04	190,830,884.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,728,662.26	31,269,971.23	12,928,293.06	2,970,496.08
投资支付的现金	370,000,000.00	785,000,000.00	840,000,000.00	255,000,000.00
投资活动现金流出小计	394,728,662.26	816,269,971.23	852,928,293.06	257,970,496.08
投资活动产生的现金流量净额	**171,834,117.48**	**9,810,365.83**	**-279,062,686.02**	**-67,139,611.19**
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	900,000.00	139,568,643.00	78,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	900,000.00	-	-
取得借款收到的现金	-	10,000,000.00	-	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	10,900,000.00	139,568,643.00	84,500,000.00
偿还债务支付的现金	50,000.00	50,000.00	6,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,465.16	35,180,863.06	15,201,355.52	12,346,611.16
支付其他与筹资活动有关的现金	4,372,875.68	6,065,566.22	4,192,325.47	4,290,495.13
筹资活动现金流出小计	4,557,340.84	41,296,429.28	25,393,680.99	31,637,106.29
筹资活动产生的现金流量净额	**-4,557,340.84**	**-30,396,429.28**	**114,174,962.01**	**52,862,893.71**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-676,747.09**	**-615,377.20**	**115,958.32**	**20,136.50**
五、现金及现金等价物净增加额	**154,215,269.19**	**8,028,522.42**	**-22,991,203.13**	**134,455,014.54**
加：期初现金及现金等价物余额	158,480,984.46	150,452,462.04	173,443,665.17	38,988,650.63

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
六、期末现金及现金等价物余额	312,696,253.65	158,480,984.46	150,452,462.04	173,443,665.17

二、会计师事务所审计意见类型

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2026 年 6 月 30 日、2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2026 年 1-6 月、2025 年度、2024 年度、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了标准无保留意见的容诚审字[2026]215Z0869 号《审计报告》。

发行人会计师认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2026 年 6 月 30 日、2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2026 年 1-6 月、2025 年度、2024 年度、2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、关键审计事项

关键审计事项是发行人会计师根据职业判断，认为对报告期内财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，发行人会计师不对这些事项单独发表意见。具体事项和审计应对如下：

（一）收入的确认

1、事项描述

猎奇智能主要从事光通信、半导体、汽车自动化等领域智能生产装备的研发、生产和销售。2026 年 1-6 月、2025 年度、2024 年度、2023 年度，猎奇智能合并财务报表中营业收入金额分别为 58,144.73 万元、69,779.24 万元、54,292.61 万元、28,918.30 万元。由于收入是公司的关键业绩指标之一，存在猎奇智能管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此发行人会计师将收入的确认认定为关键审计事项。

2、审计应对

发行人会计师对收入的确认实施的相关程序主要包括：

（1）获取猎奇智能销售与收款相关的内部控制制度，了解和评价内部控制设计的合理性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）选取样本检查销售合同、订单，识别与商品所有权上的控制权转移相关的合同条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）选取收入交易相关的样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售产品出库单、签收单、验收单、发票以及银行收款回单或收款凭证，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

（4）执行分析程序，主要包括营业收入变动分析和毛利率波动分析，并结合应收账款等报表项目的审计，分析营业收入是否存在异常情况；

（5）对于重要客户的销售收入执行了函证程序，对当期确认的收入金额进行函证，并对主要客户进行背景调查及现场走访，确认收入交易的真实性及完整性；

（6）对资产负债表日前后确认的收入，选取样本核对至客户验收单等支持性文件，以评价收入是否记录于恰当的会计期间。

（二）应收账款及合同资产减值损失的计提

1、事项描述

猎奇智能 2026 年 6 月 30 日、2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日应收账款及合同资产账面价值合计分别为 29,717.82 万元、20,588.89 万元、12,783.35 万元、11,065.72 万元，分别占资产总额的 9.71%、12.57%、12.75%、16.66%。由于应收账款及合同资产合计金额重大，应收账款及合同资产减值损失的评估需要管理层作出重大判断，因此发行人会计师将应收账款及合同资产减值损失的计提认定为关键审计事项。

2、审计应对

发行人会计师对应收账款及合同资产减值损失的计提实施的相关程序主要包括：

（1）了解和评价与应收账款及合同资产减值损失的计提相关的关键内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）通过对管理层的访谈，了解和评估公司的应收账款及合同资产减值损失的计提政策，并与同行业上市公司应收账款及合同资产减值损失的计提进行对比分析，评估公司计提政策的合理性；

（3）选取金额重大或高风险的应收账款及合同资产，独立测试其可收回性；在评估应收账款及合同资产的可回收性时，检查相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力等；

（4）获取公司减值损失计提表，检查计提方法是否按照计提政策执行，运用预期信用损失模型重新计算减值损失计提金额是否准确。

四、分部信息

公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部。因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

五、财务报表的编制基础及合并报表范围

（一）财务报表编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。

2、持续经营能力评价

公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响公司持续经营能力的事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、合并报表范围

截至报告期末，公司纳入合并报表范围的控股子公司如下：

序号	子公司全称	子公司类型	直接/间接持股比例
1	武汉飞泰智能设备有限公司	全资子公司	直接持股 100%
2	昆山凯欧光电科技有限公司	全资子公司	直接持股 100%
3	苏州峻博软件有限公司	全资子公司	直接持股 100%
4	武汉云琦精密制造有限公司	控股子公司	直接持股 70%
5	武汉瑞森联科技有限公司	全资子公司	直接持股 100%
6	XINTAI SEMICONDUCTOR EQUIPMENT PTE.LTD.	全资子公司	直接持股 100%
7	FEITAI SEMICONDUCTOR EQUIPMENT CO.,LTD.	全资子公司	新加坡芯泰持股 99.9950%，猎奇智能持股 0.0050%

2、报告期内合并报表范围变化情况

（1）合并范围增加

序号	公司名称	股权取得方式	股权取得时点
1	瑞森联	设立	2024 年 3 月
2	新加坡芯泰	设立	2023 年 8 月
3	泰国飞泰	设立	2023 年 8 月
4	凯欧光电	同一控制下企业合并	2023 年 12 月

（2）合并范围减少

报告期内无合并范围减少的情况。

六、报告期内采用的重要会计政策及会计估计

（一）重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额 100 万元以上（含）的款项
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或转回金额 100 万元以上（含）的款项
重要的应收款项实际核销	单项核销金额 100 万元以上（含）的款项
重要的投资活动有关的现金	金额超过 1,000.00 万元的投资

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的其他应收款项	单项计提金额 100 万元以上或占其他应收账款余额 10%以上的款项
期末账龄超过 1 年的重要应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款金额大于 500 万元以上（含）的款项
期末账龄超过 1 年的重要其他应付账款	单项账龄超过 1 年的其他应付款金额大于 100 万元以上（含）的款项
期末账龄超过 1 年的重要合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债金额大于 500 万元以上（含）的款项
重要的子公司、非全资子公司	公司将营业收入/净利润/总资产/净资产超过集团营业收入/净利润/总资产/净资产的 10%，且经营业务、未来发展战略、持有资质或证照对公司具有重要影响的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司
承诺及或有事项	单个事项金额超过 100 万元
重要的资产负债表日后调整事项	资产负债表日后调整事项金额占当期利润总额的 5%以上

（二）报告期内采用的重要会计政策及会计估计

1、企业合并的会计处理方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号合并财务报表》编制。

2、收入

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在

相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能

会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①需要安装调试验收的设备销售

本公司与客户之间的需要安装调试验收的设备销售，属于在某一时点履行履约义务。在设备全部安装调试到位，并取得购货方的验收证明后确认销售收入。

②无需安装调试验收的产品

境内：本公司与客户之间的无需安装调试验收的产品销售，属于在某一时点履行履约义务。在购货方产品签收时确认销售收入。

境外：境外销售采取 CIF 的贸易方式，以完成报关装船或报关后客户确认接收产品作为出口收入的确认时点。

3、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，

以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1　银行承兑汇票

应收票据组合 2　商业承兑汇票

应收票据组合 3　财务公司承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1　应收合并范围内关联方客户

应收账款组合 2　应收一般客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1　应收利息

其他应收款组合 2　应收股利

其他应收款组合 3　押金和保证金

其他应收款组合 4　备用金和个人借款

其他应收款组合 5　代扣员工社保公积金及其他

其他应收款组合 6　合并范围内关联方

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

划分为组合的应收款项融资，均为银行承兑汇票， 因银行承兑汇票信用等级较高，不存在坏账风险，不计提预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1　未到期的质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：应收账款、其他应收款账龄按照入账日期至资产负债表日的时间确认。

项　目	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

B.债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估

信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分

摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本节“六、报告期内采用的重要会计政策及会计估计”之“（二）报告期内采用的重要会计政策及会计估计”之“4、公允价值计量”。

4、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

（1）估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括：市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可

观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

（2）公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（1）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（2）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（3）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为

其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

本公司按照组合计提存货跌价准备的情况如下：

组合类别	组合类别确定依据	可变现净值计算方法和确定依据
需要经过加工的材料存货	后续用于生产产成品的主要原材料	完工产品预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定
产成品、商品和用于出售的材料	直接用于出售的存货	销售合同售价

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

6、合同资产及合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“六、报告期内采用的重要会计政策及会计估计”之“（二）报告期内采用的重要会计政策及会计估计”之“3、金融工具”。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和

合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

7、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常

营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

8、固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

（1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类　别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
办公及电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

9、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

10、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

11、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付系以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

12、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

13、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

但同时满足上述两个条件，且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用该项豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的

除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

②以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

（4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵

销后的净额列示：

①本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

②递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

14、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

（3）本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

A.租赁负债的初始计量金额；

B.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

C.承租人发生的初始直接费用；

D.承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见本节“六、报告期内采用的重要会计政策及会计估计” 之“（二）报告期内采用的重要会计政策及会计估计”之“10、预计负债”。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类　别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	3		33.33

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容:

A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；

C.购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

D.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

E.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

（4）本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本，收入和销售成本的差额作为销售损益。

（5）租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

A.本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

a.租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

b.其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B.本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分

类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

（6）售后租回

本公司按照本节“六、报告期内采用的重要会计政策及会计估计”之“（二）报告期内采用的重要会计政策及会计估计”之“2、收入”的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

① 本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照本节“六、报告期内采用的重要会计政策及会计估计” 之“（二）报告期内采用的重要会计政策及会计估计”之“3、金融工具”对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

② 本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照“六、报告期内采用的重要会计政策及会计估计” 之“（二）报告期内采用的重要会计政策及会计估计”之“3、金融工具”对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

15、重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相

关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

执行《企业会计准则解释第 17 号》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

保证类质保费用重分类

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。

本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为 0，对 2023 年度合并及母公司比较财务报表的相关项目调整如下：

单位：万元

受影响的报表项目	2023 年度（合并）		2023 年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
销售费用	820.11	496.66	568.20	300.23
营业成本	14,479.38	14,802.84	13,808.10	14,076.08

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

七、非经常性损益

（一）非经常性损益的具体内容及金额

发行人会计师对公司报告期的非经常性损益情况进行了鉴证，并出具了

《关于苏州猎奇智能设备股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（容诚专字[2026]215Z0617 号）。

报告期内，经发行人会计师核验的非经常性损益明细表如下：

单位：万元

项　目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4.91	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	411.03	682.39	362.76	216.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	224.43	664.34	408.95	88.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	0.78	42.15
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-125.32
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-	-	-1,020.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.69	-57.08	-4.65	-10.78
非经常性损益总额	641.06	1,289.65	767.84	-808.86
减：非经常性损益的所得税影响数	94.96	192.78	115.61	50.45
非经常性损益净额	546.10	1,096.88	652.23	-859.32
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	0.44	-0.04	-	-0.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	545.66	1,096.92	652.23	-859.32

（二）非经常性损益对当期经营成果的影响

报告期内，非经常性损益对当期经营成果的影响情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	545.66	1,096.92	652.23	-859.32
归属于母公司股东的净利润	14,868.26	18,235.60	18,078.25	8,160.46
归属于公司普通股股东的非经	3.67%	6.02%	3.61%	-10.53%

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
常性损益净额占归属于公司普通股股东的净利润的比例				
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	14,322.59	17,138.68	17,426.02	9,019.78

报告期内，公司非经常性损益主要系股份支付、政府补助和银行理财收益，对当期经营成果影响相对较小。

八、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策

（一）主要税种和税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	应税收入按适用税率计算销项税	0、6、7、9、13
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	5
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2、12
企业所得税	应纳税所得额	15、17、20、25

报告期内，公司及子公司的企业所得税税率情况如下：

纳税主体名称	所得税税率			
	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
猎奇智能	15%	15%	15%	15%
飞泰智能	15%	15%	15%	15%
峻博软件	25%	25%	25%	25%
凯欧光电	25%	25%	25%	25%
云琦精密	25%	25%	25%	25%
瑞森联	25%	25%	25%	-
新加坡芯泰	17%	17%	17%	17%
泰国飞泰	20%	20%	20%	20%

（二）税收优惠

1、企业所得税

本公司于 2021 年 11 月 30 日获得高新技术企业资格，证书编号为 GR202132008643，有限期为三年，2021-2023 年度按 15%所得税税率征收企业

所得税；本公司 2024 年通过高新技术企业复审，证书编号为 GR202432012264，2024-2026 年度按 15%所得税税率征收企业所得税。

武汉飞泰智能设备有限公司 2023 年通过高新技术企业复审，证书编号为 GR202342003390，2023-2025 年度按 15%所得税税率征收企业所得税，2026 年正处于高新技术企业资格复审阶段。根据税务机关的相关规定，武汉飞泰智能设备有限公司在复审期间暂按 15%的企业所得税税率计缴所得税。

根据泰国相关税法，本公司的子公司泰国飞泰免征企业所得税 8 年，自该公司产生业务收入之日起算。

2、增值税

①根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起实施软件增值税即征即退优惠政策，即对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，本公司自 2018 年 10 月起享受软件增值税即征即退优惠。

上述返还的增值税于实际收到时计入其他收益。

②根据财政部、国家税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财税[2023]43 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

上述返还的增值税于实际抵减时计入其他收益。

③根据财政部、国家税务总局《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税[2023]17 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。

上述返还的增值税于实际抵减时计入其他收益。

（三）税收政策及税收优惠变化的影响

报告期内，公司及子公司适用企业所得税、增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等各项税种。其中，企业所得税和增值税系公司及

各子公司适用的主要税种。

报告期内，公司税收政策不存在重大变化。公司适用的税收政策整体较为稳定，相关税收政策的变化不会对公司经营成果产生重大影响。

九、主要财务指标

（一）财务指标

报告期内，发行人主要财务指标如下：

财务指标	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
流动比率（倍）	1.37	1.75	2.23	1.57
速动比率（倍）	0.45	0.83	1.51	0.93
资产负债率（母公司）	72.06%	57.63%	41.20%	56.88%
资产负债率（合并）	71.36%	55.81%	43.57%	61.20%
应收账款周转率（次/年）	4.92	4.48	4.72	4.17
存货周转率（次/年）	0.49	0.70	0.94	0.78
息税折旧摊销前利润（万元）	17,865.99	21,678.48	21,526.99	10,233.71
利息保障倍数（倍）	640.28	595.59	743.49	213.34
归属于母公司所有者的净利润（万元）	14,868.26	18,235.60	18,078.25	8,160.46
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	14,322.59	17,138.68	17,426.02	9,019.78
研发投入占营业收入的比例	5.89%	8.35%	8.28%	8.52%
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-0.30	0.71	3.44	13.15
每股净现金流量（元/股）	3.74	0.19	-0.56	11.89
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	21.27	17.55	13.73	22.80

注：上述部分主要财务指标的计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值，2026 年 1-6 月数据已折算全年，下同

4、存货周转率=营业成本/存货平均账面价值，2026 年 1-6 月数据已折算全年，下同

5、息税折旧摊销前利润=利润总额＋利息支出（财务费用项下）-利息收入（财务费用项下）＋折旧与摊销

6、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出（财务费用项下）

7、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加/（减少）额/期末股本总额

10、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额

（二）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，发行人报告期内的每股收益、净资产收益率如下：

财务指标	期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
按照归属于母公司所有者的净利润	2026 年 1-6 月	18.57%	3.6044	3.6044
	2025 年度	28.79%	4.4014	4.4014
	2024 年度	53.60%	5.1652	5.1652
	2023 年度	42.16%	不适用	不适用
按照扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2026 年 1-6 月	17.89%	3.4721	3.4721
	2025 年度	27.06%	4.1355	4.1355
	2024 年度	51.67%	4.9789	4.9789
	2023 年度	46.60%	不适用	不适用

注：上述指标的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率=P0÷（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

2、基本每股收益=P0÷S=P0÷（S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益=P1÷（S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

4、公司于 2024 年整体变更为股份公司，因此 2023 年不适用基本每股收益、稀释每股收益。

十、经营成果分析

（一）报告期内的经营情况概述

报告期内，公司整体实力和盈利能力不断增强，公司的具体经营情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	58,144.73	69,779.24	54,292.61	28,918.30
营业成本	34,726.45	39,803.10	26,968.95	14,802.84
营业利润	17,147.54	20,889.25	20,907.47	9,457.87
利润总额	17,148.23	20,832.17	20,862.12	9,447.09
净利润	14,831.17	18,155.76	18,056.52	8,150.30
归属于母公司股东的净利润	14,868.26	18,235.60	18,078.25	8,160.46
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	14,322.59	17,138.68	17,426.02	9,019.78

（二）营业收入分析

1、营业收入构成及其变动分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	58,121.44	99.96%	69,762.36	99.98%	54,258.73	99.94%	28,859.97	99.80%
其他业务收入	23.28	0.04%	16.89	0.02%	33.88	0.06%	58.34	0.20%
合计	**58,144.73**	**100.00%**	**69,779.24**	**100.00%**	**54,292.61**	**100.00%**	**28,918.30**	**100.00%**

公司是国内领先的高端智能装备制造商，专注于光通信、半导体及汽车产业等领域智能生产装备的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务收入占当期营业收入的比例分别为 99.80%、99.94%、99.98%和 99.96%，主营业务收入占比较高且保持稳定。公司其他业务收入主要来自租赁收入等，占同期营业收入的比例较低。

报告期各期，公司主营业务收入分别为 28,859.97 万元、54,258.73 万元、

69,762.36 万元和 58,121.44 万元，整体呈上升趋势，主要原因如下：

（1）AI 浪潮带动下游需求旺盛

公司主要产品为光模块封装测试设备，覆盖光模块封装测试的核心环节，包括贴片、耦合、老化测试等关键工序。

随着全球光通信市场的快速发展，尤其是数据中心建设、人工智能（AI）、5G 通信等新兴技术的广泛应用，对高速率、高带宽光模块的需求日益增加。以 ChatGPT 为代表的大模型训练对算力的需求呈指数级增长，直接推动超算集群和数据中心互联需求，算力需求的激增和 AI 服务器的部署直接拉动了光模块的大规模应用。

在下游光模块市场规模迅速增长的背景下，全球高速率光模块封测设备市场呈现跨越式增长。据弗若斯特沙利文数据，全球市场规模从 2020 年 5.9 亿元增至 2024 年 51.8 亿元，年复合增长率达 71.8%。在良好的市场环境下，公司抓住下游行业高速发展的机遇，报告期内实现了自身业绩的快速增长。

（2）公司不断拓展优质客户，积累客户资源

公司坚持以“技术赋能客户价值”为导向，通过深度挖掘行业痛点与客户潜在需求，构建了快速响应的产品迭代机制。凭借卓越的产品品质、持续的技术创新能力及高效优质的配套服务，公司已成为国内光模块智能制造装备的主要供应商之一，产品获得主流市场高度认可，公司设备已广泛应用于中际旭创、索尔思、光迅科技、源杰科技、剑桥科技、客户三、客户四等行业龙头客户和知名企业，并与 2025 年全球前十光模块厂商（前十厂商排名来源于 LightCounting）中的九家保持良好合作。

此外，公司依托于在光模块封装测试设备领域的技术积累，逐步向半导体行业其他领域拓展。公司稳步开拓半导体、汽车等领域客户，公司产品已应用于客户五、先导科技、士兰微等半导体领域客户，以及索恩格、苏世博、三花智控等全球领先的汽车零部件供应商。通过与下游行业知名客户的紧密合作，公司持续获得大额订单，带动营业收入逐年增长。

2、主营业务收入分产品分析

报告期内，公司主营业务收入按产品类别构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
贴片设备	8,229.93	14.16%	24,370.66	34.93%	23,718.09	43.71%	9,008.98	31.22%
耦合设备	26,679.79	45.90%	16,250.69	23.29%	15,102.99	27.84%	9,076.06	31.45%
老化测试设备	13,277.12	22.84%	7,514.76	10.77%	3,999.73	7.37%	4,865.21	16.86%
自动化设备及整线解决方案	3,155.29	5.43%	13,564.67	19.44%	6,746.98	12.43%	3,352.59	11.62%
配件及其他	6,779.32	11.66%	8,061.57	11.56%	4,690.93	8.65%	2,557.12	8.86%
合计	**58,121.44**	**100.00%**	**69,762.36**	**100.00%**	**54,258.73**	**100.00%**	**28,859.97**	**100.00%**

根据产品类别不同，公司主要产品包括贴片设备、耦合设备、老化测试设备、自动化设备及整线解决方案、配件及其他。报告期内，公司主营业务收入结构基本稳定，贴片设备、耦合设备、老化测试设备、自动化设备及整线解决方案是公司最主要的四类产品，占当期主营业务收入的比例各期合计均在 80%以上。其中，贴片设备、耦合设备、老化测试设备是光模块封装测试的核心设备。

（1）贴片设备

报告期内，贴片设备的销售收入、销量以及单价的具体情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收入（万元）	8,229.93	24,370.66	23,718.09	9,008.98
销量（台）	124	320	322	100
单价（万元/台）	73.38	84.43	81.64	100

注：为便于说明及比较贴片设备销量、单价信息，以 2023 年贴片设备销量（台）、单价（万元/台）分别指数化为 100、100.00，作为报告期内数据基数计算各期相对变动幅度。

报告期内，公司贴片设备销售收入分别为 9,008.98 万元、23,718.09 万元、24,370.66 万元和 8,229.93 万元，呈快速增长态势。贴片是光模块生产过程中的核心环节之一，受益于下游光模块行业扩产需求旺盛，带动贴片设备销量迅速增长。

报告期内，2024 年贴片设备平均单价下降，主要系伴随着共晶、固晶主力

机型销量的快速提升，公司基于产品周期、市场拓展等商业因素考量，对主要客户的销售定价同比有所下调所致。2025 年贴片设备平均单价与 2024 年差异不大。2026 年 1-6 月贴片设备平均单价下降，主要系固晶机中本期确认收入的项目中包含部分单价相对较低的无源器件贴装机型（工艺要求低、非主要应用领域）所致。

（2）耦合设备

报告期内，耦合设备的销售收入、销量以及单价的具体情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收入（万元）	26,679.79	16,250.69	15,102.99	9,076.06
销量（台）	364	185	152	100
单价（万元/台）	80.81	96.76	109.68	100

注：为便于说明及比较耦合设备销量、单价信息，以 2023 年耦合设备销量（台）、单价（万元/台）分别指数化为 100、100.00，作为报告期内数据基数计算各期相对变动幅度。

报告期内，公司耦合设备销售收入分别为 9,076.06 万元、15,102.99 万元、16,250.69 万元和 26,679.79 万元，呈快速增长态势。耦合是光模块生产过程中的核心环节之一，主要受益于下游光模块行业扩产需求旺盛，带动耦合设备销量迅速增长。

耦合设备具有非标定制化的特点，各年单价变动主要系不同类型的耦合设备结构性变动所致。2024 年，耦合设备单价整体呈上升趋势，主要原因系随着 AI 需求爆发，客户对于全平台兼容耦合设备需求大幅增长，该类设备相对于单功能耦合设备销售价格更高，从而使得耦合设备单价提升。2025 年耦合设备单价降低的原因主要系部分客户对设备方案需求的变化，相应设备单价较低所致。2026 年 1-6 月耦合设备单价降低的原因主要系耦合设备领域部分新开发客户的部分早期订单当期验收，该等项目在前期进行商务谈判时基于市场拓展因素定价偏低所致。

（3）老化测试设备

报告期内，老化测试设备的销售收入、销量以及单价的具体情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收入（万元）	13,277.12	7,514.76	3,999.73	4,865.21

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销量（台）	1,637	744	1,199	981
单价（万元/台）	8.11	10.10	3.34	4.96

报告期内，公司老化测试设备销售收入分别为 4,865.21 万元、3,999.73 万元、7,514.76 万元和 13,277.12 万元，整体呈增长态势。主要受益于下游光模块行业扩产需求旺盛，带动老化测试设备销量迅速增长。公司销售的老化测试设备包括芯片老化测试设备、模块老化测试设备两大类，其中芯片老化测试设备由于设备工艺较复杂、芯片应用场景的技术要求更高，其单价相对较高。

2023-2024 年，老化测试设备单价变动原因主要系芯片、模块老化测试设备收入结构变动所致，2023 年单价较高的芯片老化测试设备收入占比增加，带动平均单价提升，2024 年芯片老化测试设备收入占比降低，因此平均单价下降。2025 年，公司老化测试设备销量下降、单价上升的原因主要系公司对模块老化测试设备进行了产品升级，将原有的四台设备整合为一台整机。2026 年 1-6 月，由于下游客户需求增长，公司模块老化测试设备销量上升，收入占比增加，因此老化测试设备平均单价有所下降。

（4）自动化设备及整线解决方案

报告期内，自动化设备及整线解决方案的销售收入、销量以及单价的具体情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收入（万元）	3,155.29	13,564.67	6,746.98	3,352.59
销量（套/台）	43	162	88	91
单价（万元）	73.38	83.73	76.67	36.84

报告期内，公司自动化设备及整线解决方案销售收入分别为 3,352.59 万元、6,746.98 万元、13,564.67 万元和 3,155.29 万元，呈快速增长态势，主要系公司与主要客户索恩格、苏世博等合作顺利，客户需求逐年增长所致。公司在自动化设备及整线解决方案方面有较为深厚的积淀，能够根据不同客户需求定制开发自动化设备及整线解决方案，设备种类和配置较为多样化，因此报告期内单价存在一定的波动。2023 年单价较低，主要系客户下订单时将整条产线分拆成多个工位或多台设备的情形较多，因此统计的销量较高所致，2024、2025 年、

2026 年 1-6 月分拆的情况较少，因此平均单价上升较多。

3、主营业务收入构成按区域分析

报告期内，公司主营业务收入分区域构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
内销	48,982.18	84.28%	62,102.24	89.02%	52,308.46	96.41%	28,646.83	99.26%
华东	41,912.91	72.11%	46,334.50	66.42%	35,698.38	65.79%	21,667.24	75.08%
其他	7,069.26	12.16%	15,767.74	22.60%	16,610.07	30.61%	6,979.58	24.18%
外销	9,139.27	15.72%	7,660.12	10.98%	1,950.27	3.59%	213.14	0.74%
总计	**58,121.44**	**100.00%**	**69,762.36**	**100.00%**	**54,258.73**	**100.00%**	**28,859.97**	**100.00%**

注：内销收入为注册地在境内的客户收入，外销收入为注册地在境外以及境内保税区的客户收入。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于境内华东地区的销售，主要原因系公司主要客户中际旭创、客户五、苏世博等的生产经营地集中在华东区域所致。

报告期内，公司外销收入占比呈上升趋势，主要原因系 TeraHop（Thailand）Co.,Ltd.、保税区企业索尔思光电（成都）有限公司等客户需求上升所致。

4、主营业务收入按季度划分情况

报告期内，公司主营业务收入分季度变动情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	22,031.89	37.91%	10,044.94	14.40%	4,600.26	8.48%	2,726.89	9.45%
第二季度	36,089.55	62.09%	14,581.87	20.90%	11,033.55	20.34%	5,114.17	17.72%
第三季度	-	-	14,515.19	20.81%	21,805.28	40.19%	6,753.22	23.40%
第四季度	-	-	30,620.36	43.89%	16,819.63	31.00%	14,265.68	49.43%
合计	**58,121.44**	**100.00%**	**69,762.36**	**100.00%**	**54,258.73**	**100.00%**	**28,859.97**	**100.00%**

报告期内，公司下半年收入占比相对较高，主要原因系公司客户以上市公

司、大型国企和外企为主，其投资决策有严格的预算管理制度，年初通常是预算审批及采购执行阶段，下半年则进入验收阶段。

5、第三方回款情况

报告期内，公司第三方回款的总体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
第三方回款金额	-	-	26.10	15.26
营业收入	58,144.73	69,779.24	54,292.61	28,918.30
第三方回款金额占营业收入比例	-	-	0.05%	0.05%

报告期内，公司第三方回款金额较小，占营业收入比例分别为 0.05%、0.05%、0 和 0，占比较低。第三方回款系客户众恒光电出于自身资金安排，指定其同一控制的其他企业迈时光电代为支付货款，具有商业合理性。

（三）营业成本分析

1、营业成本的构成情况

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	34,726.19	100.00%	39,789.08	99.96%	26,957.62	99.96%	14,784.94	99.88%
其他业务成本	0.26	0.00%	14.02	0.04%	11.33	0.04%	17.90	0.12%
合计	**34,726.45**	**100.00%**	**39,803.10**	**100.00%**	**26,968.95**	**100.00%**	**14,802.84**	**100.00%**

报告期内，公司的营业成本主要来自于主营业务，其他业务成本占比较小，营业成本的规模与构成与营业收入总体一致。

2、主营业务成本分产品构成及变动情况

报告期内，公司主营业务成本按产品类型构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
贴片设备	3,854.58	11.10%	9,624.70	24.19%	9,586.76	35.56%	3,668.37	24.81%
耦合设备	14,099.80	40.60%	7,476.96	18.79%	6,868.14	25.48%	3,589.62	24.28%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
老化测试设备	10,473.10	30.16%	6,571.75	16.52%	1,973.87	7.32%	3,043.00	20.58%
自动化设备及整线解决方案	2,189.09	6.30%	10,401.16	26.14%	4,767.62	17.69%	2,423.33	16.39%
配件及其他	4,109.61	11.83%	5,714.51	14.36%	3,761.23	13.95%	2,060.62	13.94%
合计	**34,726.19**	**100.00%**	**39,789.08**	**100.00%**	**26,957.62**	**100.00%**	**14,784.94**	**100.00%**

报告期各期，公司主营业务成本分别为 14,784.94 万元、26,957.62 万元、39,789.08 万元和 34,726.19 万元，随着业务规模的持续扩大总体呈上升趋势。

3、主营业务成本分项目构成及变动情况

报告期内，公司主营业务成本按照成本性质划分的具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	29,915.72	86.15%	33,131.62	83.27%	22,399.72	83.09%	12,109.87	81.91%
直接人工	2,091.93	6.02%	4,337.07	10.90%	3,295.81	12.23%	1,827.11	12.36%
制造费用	1,210.24	3.49%	1,288.65	3.24%	961.18	3.57%	780.67	5.28%
劳务成本	1,508.31	4.34%	1,031.75	2.59%	300.91	1.12%	67.29	0.46%
合计	**34,726.19**	**100.00%**	**39,789.08**	**100.00%**	**26,957.62**	**100.00%**	**14,784.94**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用和劳务成本构成，以直接材料为主。其中，直接材料主要为机械类、电气类、气动/液动类、加工件及其他等，直接人工主要为设计、生产及安装调试人员的工资薪酬等，制造费用主要包括间接材料、生产管理人员工资薪酬、差旅费、折旧及租赁物业费等，劳务成本主要为对外采购的外包服务费等。

报告期各期，公司的直接材料成本分别为 12,109.87 万元、22,399.72 万元、33,131.62 万元和 29,915.72 万元，随业务规模增长呈逐年上升趋势，占主营业务成本比例分别为 81.91%、83.09%、83.27%和 86.15%，各期占比较为稳定。

报告期各期，公司的直接人工成本分别为 1,827.11 万元、3,295.81 万元、4,337.07 万元和 2,091.93 万元，随业务规模增长呈逐年上升趋势，占主营业务成本比例分别为 12.36%、12.23%、10.90%和 6.02%。2023 年以来，发行人业务

规模显著增长，公司一方面不断优化业务流程，提高人均产值，另一方面也同步进行了人员扩充以满足业务需求，但由于对劳务外包用工的使用亦随之有所扩大，导致直接人工成本占比呈下降趋势。

报告期各期，发行人制造费用以生产管理人员工资薪酬、租赁物业费等为主，支出相对固定，因此占比随业务规模扩大呈下降趋势。

报告期内，随公司业务规模扩大发行人将部分基础装配工序外包以灵活满足生产需求，因此产生部分劳务成本，金额及占比呈上升趋势。

（四）毛利及毛利率分析

1、营业毛利的构成情况

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	**23,395.26**	**99.90%**	**29,973.27**	**99.99%**	**27,301.11**	**99.92%**	**14,075.03**	**99.71%**
贴片设备	4,375.35	18.68%	14,745.96	49.19%	14,131.33	51.72%	5,340.61	37.84%
耦合设备	12,579.98	53.72%	8,773.73	29.27%	8,234.86	30.14%	5,486.44	38.87%
老化测试设备	2,804.01	11.97%	943.01	3.15%	2,025.86	7.41%	1,822.22	12.91%
自动化设备及整线解决方案	966.21	4.13%	3,163.51	10.55%	1,979.36	7.24%	929.26	6.58%
配件及其他	2,669.71	11.40%	2,347.06	7.83%	929.70	3.40%	496.50	3.52%
其他业务毛利	**23.02**	**0.10%**	**2.87**	**0.01%**	**22.55**	**0.08%**	**40.44**	**0.29%**
合计	**23,418.28**	**100.00%**	**29,976.14**	**100.00%**	**27,323.66**	**100.00%**	**14,115.47**	**100.00%**

报告期内，公司的营业毛利主要来自于主营业务，其他业务毛利占比较小。2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-6 月，公司主营业务毛利分别为 14,075.03 万元、27,301.11 万元、29,973.27 万元和 23,395.26 万元，随着业务规模的持续扩大总体呈显著提升态势。

2、综合毛利率情况

报告期内，公司综合毛利率及其变动情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
主营业务毛利率	40.25%	42.96%	50.32%	48.77%
其他业务毛利率	98.87%	17.01%	66.56%	69.32%

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合计	40.28%	42.96%	50.33%	48.81%

报告期各期，公司综合毛利率分别为 48.81%、50.33%、42.96%及 40.28%，各期之间存在一定波动，与主营业务毛利率水平基本一致。公司部分年度其他业务收入毛利率较高，主要系相关收入来自设备、厂房租赁等所致。

3、主营业务毛利率分产品构成及变动情况

报告期内，公司分产品类型的毛利率及收入占比情况如下：

单位：%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
贴片设备	53.16	14.16	60.51	34.93	59.58	43.71	59.28	31.22
耦合设备	47.15	45.90	53.99	23.29	54.52	27.84	60.45	31.45
老化测试设备	21.12	22.84	12.55	10.77	50.65	7.37	37.45	16.86
自动化设备及整线解决方案	30.62	5.43	23.32	19.44	29.34	12.43	27.72	11.62
配件及其他	39.38	11.66	29.11	11.56	19.82	8.65	19.42	8.86
合计	**40.25**	**100.00**	**42.96**	**100.00**	**50.32**	**100.00**	**48.77**	**100.00**

报告期内，公司主营业务毛利率总体存在一定波动。不同期间内综合毛利率水平受产品结构变动、细分产品毛利率变动等因素综合影响。其中，分产品类型毛利率变动情况如下：

（1）报告期各期，公司贴片设备的毛利率分别为 59.28%、59.58%、60.51%和 53.16%，2024 年、2025 年同比保持稳定；2026 年 1-6 月有所下降。公司贴片设备包括共晶机、固晶机两大类，其中共晶机的毛利率总体略高于固晶机，具体主要受型号、客户等因素影响。2026 年 1-6 月，贴片设备毛利率相较 2025 年下降 7.34 个百分点，一方面系受共晶机与固晶机结构性因素影响，当期验收的共晶机收入占贴片设备比重下降，另一方面固晶机中本期确认收入的项目中包含部分毛利率相对较低的无源器件贴装机型（工艺要求低、非主要应用领域），导致贴片设备整体毛利率有所下降。

（2）报告期各期，公司耦合设备的毛利率分别为 60.45%、54.52%、53.99%和 47.15%，2024 年同比有所下降，2025 年同比基本保持稳定；2026 年 1-6 月，

耦合设备毛利率有所下降，主要系耦合设备领域部分新开发客户的部分早期订单当期验收，该等项目在前期进行商务谈判时基于市场拓展因素定价偏低所致。耦合设备的非标准化程度相对较高，不同项目之间会因产品方案不同进而导致项目报价、制造成本及毛利率存在差异。

（3）报告期各期，公司老化测试设备的毛利率分别为 37.45%、50.65%、12.55%和 21.12%，各期之间存在一定波动。公司老化测试设备包括芯片老化测试设备、模块老化测试设备两大类，应用场景以及单位售价、毛利率水平等存在一定差异。2025 年，公司老化测试设备的毛利率较 2024 年显著下降，主要系模块老化测试设备当期进行设备改型导致平均单位成本上升所致。2026 年 1-6 月，公司老化测试设备的毛利率相较 2025 年显著回升，主要系当期高毛利芯片老化测试设备产品在下游客户处成功验证推进，该等业务收入占比显著上升的结构性因素所致。

（4）报告期各期，公司自动化设备及整线解决方案的毛利率分别为 27.72%、29.34%、23.32%和 30.62%，各期之间存在一定波动。公司自动化设备及整线解决方案业务主要包括汽车、半导体、光通信等领域的各类自动化设备及整线解决方案，根据客户需求进行定制化开发，不同项目产线的售价、成本构成存在较大差异。相较贴片设备、耦合设备等业务，自动化设备及整线解决方案业务整体而言毛利率较低。

4、同行业可比上市公司的毛利率对比

报告期内，公司与同行业可比上市公司的综合毛利率对比情况如下：

公司名称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
BESI（BESI.AS）	64.74%	63.29%	65.18%	64.92%
ASMPT（0522.HK）	41.10%	37.75%	39.98%	39.28%
致茂电子（2360.TW）	61.48%	61.55%	59.00%	57.60%
新益昌（688383.SH）	36.68%	28.66%	31.26%	32.84%
FiconTEC	/	/	40.64%	41.62%
联讯仪器	70.79%	58.84%	63.63%	60.50%
平均值	**54.96%**	**50.02%**	**49.95%**	**49.46%**
发行人	40.25%	42.96%	50.32%	48.77%

注：数据来源为 Wind、可比公司定期报告或其招股意向书，下同；FiconTEC 未披露 2024

年数据，系 2024 年 1-7 月数据。

同行业可比上市公司中，因不同企业产品结构、经营模式、业务规模等情况差异，毛利率存在一定差异。整体来看，公司毛利率水平与同行业可比公司平均值无显著差异。

（五）期间费用分析

报告期内，公司期间费用具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例	金额	占营业收入的比例
销售费用	721.45	1.24%	1,080.55	1.55%	813.26	1.50%	496.66	1.72%
管理费用	2,203.08	3.79%	3,520.19	5.04%	2,558.26	4.71%	2,719.55	9.40%
研发费用	3,425.27	5.89%	5,828.74	8.35%	4,496.27	8.28%	2,463.88	8.52%
财务费用	107.69	0.19%	62.37	0.09%	0.45	0.00%	-5.91	-0.02%
合计	**6,457.49**	**11.11%**	**10,491.85**	**15.04%**	**7,868.23**	**14.49%**	**5,674.19**	**19.62%**
合计（剔除股份支付影响）	**5,996.83**	**10.31%**	**9,512.65**	**13.63%**	**7,587.27**	**13.97%**	**4,554.02**	**15.75%**

报告期内，公司期间费用合计金额分别为 5,674.19 万元、7,868.23 万元、10,491.85 万元和 6,457.49 万元，随公司业务规模扩大整体呈上升趋势。报告期各期，公司期间费用合计占营业收入的比例分别为 19.62%、14.49%、15.04%和 11.11%；剔除股份支付影响后，报告期各期公司期间费用合计占营业收入的比例分别为 15.75%、13.97%、13.63%和 10.31%，其中 2026 年 1-6 月下降较多，主要系当期收入规模显著扩大，管理费用率、研发费用率下降所致。

1、销售费用分析

（1）销售费用明细及变动分析

报告期各期，公司销售费用构成明细情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	372.86	51.68%	445.99	41.27%	321.96	39.59%	249.89	50.31%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
业务招待费	176.16	24.42%	250.18	23.15%	252.42	31.04%	146.08	29.41%
广告展览费	64.43	8.93%	113.77	10.53%	5.05	0.62%	2.58	0.52%
差旅费	29.17	4.04%	50.81	4.70%	68.83	8.46%	24.35	4.90%
股份支付	23.12	3.20%	53.24	4.93%	44.49	5.47%	18.65	3.75%
样品费	27.93	3.87%	123.53	11.43%	46.40	5.70%	6.66	1.34%
居间费用	-	-	6.00	0.56%	51.15	6.29%	36.70	7.39%
折旧摊销	1.93	0.27%	3.29	0.30%	2.42	0.30%	1.39	0.28%
其他	25.85	3.58%	33.74	3.12%	20.54	2.53%	10.36	2.09%
合计	**721.45**	**100.00%**	**1,080.55**	**100.00%**	**813.26**	**100.00%**	**496.66**	**100.00%**
占当期营业收入比例	1.24%	/	1.55%	/	1.50%	/	1.72%	/

报告期各期，公司销售费用金额分别为 496.66 万元、813.26 万元、1,080.55 万元及 721.45 万元，占营业收入比重分别为 1.72%、1.50%、1.55%及 1.24%，主要由销售人员职工薪酬、业务招待费等构成。报告期内，伴随公司业务规模的逐步扩大，公司销售人员数量及差旅、招待支出等有所增加，销售费用的整体金额呈上升趋势，销售费用占营业收入的比重各期总体保持稳定。

此外，2025 年以来公司为进一步加强客户拓展、扩大全球市场影响力，更加积极参加美国光网络与通信研讨会及博览会（OFC）、中国国际光电博览会（CIOE）等各项重要展会活动，因此广告展览费支出有所增加。

（2）与同行业可比公司的对比情况

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
BESI（BESI.AS）	/	/	/	/
ASMPT（0522.HK）	9.54%	10.85%	11.29%	10.80%
致茂电子（2360.TW）	9.21%	13.35%	16.19%	15.77%
新益昌（688383.SH）	4.93%	9.22%	7.22%	9.31%
FiconTEC	/	/	22.72%	13.54%
联讯仪器	2.97%	6.10%	6.62%	11.79%
平均值	**6.66%**	**9.88%**	**12.81%**	**12.24%**
中位数	**7.07%**	**10.04%**	**11.29%**	**11.79%**
发行人	1.24%	1.55%	1.50%	1.72%

注：BESI 销售费用和管理费用合并披露，因此无法区分销售费用率；FiconTEC 未披露 2024 年数据，系 2024 年 1-7 月数据。

报告期内，公司销售费用率低于同行业可比公司平均值，主要系公司销售人员数量及相应薪酬等支出均较低所致。公司销售人员规模较小，截至 2025 年末占员工总数的比例不足 3%。报告期内，公司客户集中于光通信行业，且下游客户行业集中度较高，前述销售活动相关支出较低具备合理性；而同行业可比公司的相关产品涉及下游行业更多、需要维护的客户范围更广，因此销售投入相对更大。

2、管理费用分析

（1）管理费用明细及变动分析

报告期各期，公司管理费用主要项目及所占比例如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	1,231.40	55.89%	1,765.88	50.16%	1,460.89	57.10%	1,043.98	38.39%
咨询服务费	308.33	14.00%	365.90	10.39%	311.37	12.17%	157.25	5.78%
业务招待费	93.67	4.25%	263.05	7.47%	202.11	7.90%	160.67	5.91%
股份支付	133.73	6.07%	266.63	7.57%	57.95	2.27%	1,041.07	38.28%
办公及水电费	101.02	4.59%	224.85	6.39%	136.73	5.34%	112.66	4.14%
折旧摊销	137.67	6.25%	135.69	3.85%	96.65	3.78%	74.04	2.72%
租赁费	39.10	1.77%	116.07	3.30%	91.11	3.56%	27.41	1.01%
差旅费	30.20	1.37%	103.38	2.94%	110.35	4.31%	69.19	2.54%
其他	127.97	5.81%	278.73	7.92%	91.10	3.56%	33.29	1.22%
合计	**2,203.08**	**100.00%**	**3,520.19**	**100.00%**	**2,558.26**	**100.00%**	**2,719.55**	**100.00%**
占当期营业收入比例	3.79%	/	5.04%	/	4.71%	/	9.40%	/
占当期营业收入比例（剔除股份支付影响）	3.56%	/	4.66%	/	4.61%	/	5.80%	/

报告期各期，公司管理费用分别为 2,719.55 万元、2,558.26 万元、3,520.19 万元和 2,203.08 万元，占营业收入比例分别为 9.40%、4.71%、5.04%和 3.79%。公司管理费用主要由职工薪酬、股份支付等构成。报告期内，公司管理人员规模总体较为稳定，管理人员职工薪酬随经营规模的扩大呈增长趋势。2023 年，

管理费用中股份支付金额为 1,041.07 万元，占当期管理费用的比例较高，主要系实际控制人罗超因股权受让一次性确认的股份支付费用。

（2）与同行业可比公司的对比情况

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
BESI（BESI.AS）	/	/	/	/
ASMPT（0522.HK）	6.70%	8.34%	8.77%	6.82%
致茂电子（2360.TW）	5.67%	6.92%	7.04%	7.33%
新益昌（688383.SH）	4.30%	7.32%	5.85%	5.09%
FiconTEC	/	/	30.12%	17.11%
联讯仪器	5.38%	8.61%	7.66%	11.48%
平均值	**5.51%**	**7.80%**	**11.89%**	**9.57%**
平均值（不含 FiconTEC）	**5.51%**	**7.80%**	**7.33%**	**7.68%**
中位数	**5.53%**	**7.83%**	**7.66%**	**7.33%**
发行人	3.56%	4.66%	4.61%	5.80%

注：BESI 销售费用和管理费用合并披露，因此无法区分管理费用率；FiconTEC 未披露 2024 年数据，系 2024 年 1-7 月数据；联讯仪器、发行人已剔除股份支付影响。

报告期内，同行业可比公司中 FiconTEC 因购买日识别出非专利技术无形资产导致管理费用中摊销金额较高因此管理费用率较高，剔除该公司后，公司管理费用率与其他同行业可比公司较为接近，不存在重大差异。

3、研发费用分析

（1）研发费用明细及变动分析

报告期内，公司研发费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,189.27	63.92%	3,607.10	61.88%	2,827.64	62.89%	1,156.19	46.93%
材料费	791.12	23.10%	1,312.55	22.52%	1,281.81	28.51%	937.93	38.07%
股份支付费用	303.81	8.87%	659.32	11.31%	178.52	3.97%	60.45	2.45%
差旅费	51.50	1.50%	109.37	1.88%	81.99	1.82%	30.13	1.22%
租赁与物业费	35.85	1.05%	84.38	1.45%	53.77	1.20%	34.99	1.42%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
折旧与摊销	40.20	1.17%	30.19	0.52%	54.60	1.21%	159.64	6.48%
其他	13.52	0.39%	25.82	0.44%	17.93	0.40%	84.53	3.43%
合计	**3,425.27**	**100.00%**	**5,828.74**	**100.00%**	**4,496.27**	**100.00%**	**2,463.88**	**100.00%**

报告期内，公司研发费用分别为 2,463.88 万元、4,496.27 万元、5,828.74 万元和 3,425.27 万元，占当期营业收入的比例分别为 8.52%、8.28%、8.35%和 5.89%。

报告期内，公司不存在研发费用资本化的情形，研发投入金额即为当期费用化的研发费用金额，公司研发投入的计算口径与研发费用一致。公司 2023-2025 年累计研发投入为 12,788.88 万元，不低于 5,000 万元，占最近三年累计营业收入的比例为 8.36%，最近三年研发投入复合增长率为 53.81%。

报告期内研发费用持续增长，主要系公司不断加大研发投入以保持和提升产品竞争优势，研发人员投入以及材料费随之增加。报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬和材料费等组成。

研发费用职工薪酬主要为参与公司研发项目的研发人员薪酬，报告期内研发薪酬支出分别为 1,156.19 万元、2,827.64 万元、3,607.10 万元和 2,189.27 万元，占研发费用比例分别为 46.93%、62.89%、61.88%和 63.92%。报告期内职工薪酬增长较快，主要系为了保持和提升产品竞争优势，公司持续增加研发人员投入，对专业研发人员数量的需求不断增大，导致研发薪酬支出大幅增加。

材料费主要系公司研发项目所耗用的材料投入。报告期内，研发直接材料分别为 937.93 万元、1,281.81 万元、1,312.55 万元和 791.12 万元，占研发费用比例为 38.07%、28.51%、22.52%和 23.10%。材料费金额持续增长，主要系报告期内随着公司研发项目数量的增加和复杂程度的提升，研发所需物料相应增加所致。

（2）研发费用率与同行业可比公司分析

公司研发费用占营业收入比例与同行业可比公司对比情况具体如下：

公司名称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
BESI（BESI.AS）	10.69%	13.69%	12.23%	9.75%
ASMPT（0522.HK）	11.70%	14.02%	15.70%	13.76%
致茂电子（2360.TW）	6.55%	7.93%	10.10%	9.36%
新益昌（688383.SH）	10.34%	14.68%	10.45%	9.28%
FiconTEC	-	-	13.04%	7.84%
联讯仪器	16.32%	23.44%	24.27%	37.97%
平均数	**11.12%**	**14.75%**	**14.30%**	**14.66%**
中位数	**10.69%**	**14.02%**	**12.64%**	**9.56%**
发行人	**5.89%**	**8.35%**	**8.28%**	**8.52%**

注：FiconTEC 披露的 2024 年数据为 2024 年 1-7 月。

报告期各期，发行人研发费用率分别为 8.52%、8.28%、8.35%和 5.89%，低于同行业可比公司研发费用率中位数，主要由于公司规模整体相对于同行业公司较小且未上市，资金实力相对有限，因此将有限的资源集中投入于新产品研发及产品迭代的相关研发工作，研发策略较为聚焦。公司的研发投入保持逐年提升的状态，能够充分满足公司各项研发活动的开展。

（3）公司主要研发项目情况

报告期各期，公司累计研发投入在 300 万元以上的主要研发项目情况如下：

单位：万元

序号	研发项目	报告期研发投入金额	截至报告期末研发状态
1	IC 高速固晶机的研发	1,361.21	在研
2	多功能高速贴片设备的研发	1,127.35	已完成
3	Burn in 4.0 老化测试设备的研发	923.43	在研
4	实时对准贴片设备的研发	820.46	已完成
5	H3 系列贴片设备的研发	792.43	已完成
6	智能激光监测平台的研发	724.20	在研
7	老化测试设备的研发	722.14	已完成
8	热压超声焊设备的研发	574.25	在研
9	DH3 系统倒装贴片设备的研发	557.61	在研
10	微组装工艺研发	502.23	已完成
11	超快玻璃焊接平台的研发	433.52	在研
12	贴片机软件平台 2.0 的研发	393.33	已完成

序号	研发项目	报告期研发投入金额	截至报告期末研发状态
13	水导激光切割平台的研发	391.10	已完成
14	多层扁线电机定子智能装配柔性生产线研发	375.82	在研
15	贴片机软件平台 3.0 的研发	342.82	已完成
16	硅光芯片耦合设备的研发	333.97	在研
17	CW 高功率激光器芯片测试设备的研发	306.36	已完成
18	在线式共晶设备的研发	308.55	已完成
19	大功率激光器共晶贴片设备的研发	301.51	已完成

4、财务费用分析

报告期各期，公司财务费用主要项目如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	27.90	36.40	28.95	47.97
减：利息收入	22.70	23.23	32.80	53.78
汇兑损益	81.60	38.11	-7.45	-2.01
银行手续费	20.89	11.10	6.75	1.92
其他	-	-	5.00	-
合计	**107.69**	**62.37**	**0.45**	**-5.91**
占营业收入比例	0.19%	0.09%	0.00%	-0.02%

报告期各期，公司财务费用分别为-5.91 万元、0.45 万元、62.37 万元和 107.69 万元，主要由利息支出、汇兑损益等构成。报告期内，公司财务费用金额及占营业收入比例均较小，一方面系公司经营现金流较好且期内取得外部投资，有息负债规模较小所致，另一方面公司销售模式以内销为主，因此汇兑损益亦较小。2025 年以来，公司外销收入占比同比显著上升，汇兑损益金额有所增加。

（六）其他影响利润的主要项目分析

1、其他收益

报告期内，公司其他收益明细情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度

软件退税	426.32	715.89	1,042.08	302.08
个税手续费返还	10.28	9.09	3.60	1.80
政府补助	411.03	682.39	362.76	216.50
增值税加计抵减	12.05	284.60	345.27	18.73
合计	**859.68**	**1,691.97**	**1,753.71**	**539.11**

报告期各期，公司其他收益分别为 539.11 万元、1,753.71 万元、1,691.97 万元及 859.68 万元，主要系与日常活动相关的政府补助和公司销售设备中嵌套软件的增值税即征即退。

2、投资收益

报告期各期，公司投资收益金额分别为 83.09 万元、381.07 万元、580.15 万元和 185.30 万元，主要系处置交易性金融资产取得的投资收益。

3、减值损失

（1）信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失分别为 482.47 万元、-127.26 万元、-547.12 万元和-469.14 万元，均为应收账款坏账损失、应收票据坏账损失及其他应收款坏账损失。

（2）资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失分别为 2.18 万元、-191.23 万元、-182.46 万元和-257.73 万元，均为存货跌价损失和合同资产减值损失。

4、资产处置损益

报告期内，公司资产处置损益分别为 0、0、0 和 4.91 万元，主要系运输设备处置，金额较小。

5、营业外收入

报告期内，公司营业外收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
盘盈利得	-	0.10	-	-

违约金	0.80	-	-	-
其他	1.46	0.35	0.05	22.83
合计	**2.26**	**0.45**	**0.05**	**22.83**

报告期内，公司营业外收入金额较小，对公司经营成果影响较小。

6、营业外支出

报告期内，公司营业外支出构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产毁损报废损失	-	0.23	4.65	3.93
罚款、违约金及滞纳金、公益性捐赠支出及其他	1.57	57.30	40.75	29.68
合计	**1.57**	**57.53**	**45.40**	**33.61**

报告期内，公司营业外支出金额较小，主要系公司非流动资产毁损报废损失、罚款、违约金及滞纳金、公益性捐赠支出等。

（七）纳税情况

1、报告期内公司缴纳的主要税费

发行人报告期内主要税种缴纳情况如下：

单位：万元

期间	项目	企业所得税	增值税
2026 年 1-6 月	期初未交数	1,641.44	-1,421.81
	本期应交数	2,522.24	-7,621.99
	本期已交数	2,546.13	888.92
	期末未交数	1,617.55	-9,932.72
2025 年度	期初未交数	784.99	151.98
	本期应交数	2,788.60	2.07
	本期已交数	1,932.15	1,575.86
	期末未交数	1,641.44	-1,421.81
2024 年度	期初未交数	889.54	344.54
	本期应交数	2,857.27	2,554.05
	本期已交数	2,961.82	2,746.61

期间	项目	企业所得税	增值税
	期末未交数	784.99	151.98
2023 年度	期初未交数	407.43	321.17
	本期应交数	1,191.50	744.79
	本期已交数	709.40	721.42
	期末未交数	889.54	344.54

2、所得税费用与会计利润的关系

报告期内，公司所得税费用构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
当期所得税费用	2,522.24	2,788.60	2,857.27	1,191.50
递延所得税费用	-205.19	-112.19	-51.67	105.28
合计	**2,317.05**	**2,676.41**	**2,805.60**	**1,296.79**

其中，所得税费用与会计利润的关系如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利润总额	17,148.23	20,832.17	20,862.12	9,447.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,572.23	3,124.83	3,129.32	1,417.06
子公司适用不同税率的影响	-2.91	-182.94	-84.12	-20.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	101.30	211.91	83.03	189.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4.71	-0.01	-19.20	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	213.69	448.78	380.77	50.63
研发费用加计扣除	-555.38	-926.16	-684.19	-340.03
所得税税率变动的影响	-7.17	-	-	-
所得税费用	2,317.05	2,676.41	2,805.60	1,296.79

3、税金及附加

报告期内，公司税金及附加构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
城市维护建设税	52.25	93.32	203.19	45.21
教育费附加	22.39	40.00	87.11	19.43
地方教育附加	14.93	26.67	58.03	12.96
房产税	12.83	16.76	12.07	8.26
城镇土地使用税	2.98	1.75	1.10	0.59
车船使用税	0.42	-	-	-
印花税	69.59	43.28	30.64	9.32
合计	**175.40**	**221.78**	**392.13**	**95.76**

报告期内，公司税金及附加金额分别为 95.76 万元、392.13 万元、221.78 万元和 175.40 万元，主要由城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、房产税、城镇土地使用税、印花税等组成。

十一、资产质量分析

（一）资产总体分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	296,696.38	96.93%	157,111.40	95.93%	96,130.62	95.85%	63,615.25	95.78%
非流动资产	9,406.17	3.07%	6,659.74	4.07%	4,161.28	4.15%	2,804.42	4.22%
资产总计	**306,102.55**	**100.00%**	**163,771.15**	**100.00%**	**100,291.90**	**100.00%**	**66,419.67**	**100.00%**

报告期内，公司业绩规模迅速扩大，总资产规模呈现增长趋势。报告期各期末，公司资产总额分别为 66,419.67 万元、100,291.90 万元、163,771.15 万元和 306,102.55 万元，其中流动资产占资产总额的比例分别为 95.78%、95.85%、95.93%和 96.93%，主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货等经营性流动资产。

（二）流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司流动资产的具体构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	32,129.66	10.83%	16,723.45	10.64%	16,495.88	17.16%	18,597.44	29.23%
交易性金融资产	10,539.13	3.55%	30,084.19	19.15%	33,527.88	34.88%	6,505.49	10.23%
应收票据	972.29	0.33%	975.85	0.62%	694.74	0.72%	109.47	0.17%
应收账款	28,180.80	9.50%	19,076.75	12.14%	12,079.08	12.57%	10,929.11	17.18%
应收款项融资	70.84	0.02%	258.71	0.16%	570.46	0.59%	342.98	0.54%
预付款项	13,193.09	4.45%	3,318.18	2.11%	592.39	0.62%	582.95	0.92%
其他应收款	351.35	0.12%	361.71	0.23%	237.81	0.25%	129.78	0.20%
存货	198,866.51	67.03%	82,668.31	52.62%	31,073.94	32.32%	26,147.80	41.10%
合同资产	1,537.01	0.52%	1,512.14	0.96%	704.27	0.73%	136.61	0.21%
其他流动资产	10,855.70	3.66%	2,132.12	1.36%	154.17	0.16%	133.61	0.21%
合计	**296,696.38**	**100.00%**	**157,111.40**	**100.00%**	**96,130.62**	**100.00%**	**63,615.25**	**100.00%**

公司的流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货构成。报告期各期末，上述四项合计占流动资产的比重均超过 90%。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	-	1.53	0.38	-
银行存款	31,266.39	15,843.33	16,041.93	17,344.34
其他货币资金	863.28	878.59	453.57	1,253.10
合计	**32,129.66**	**16,723.45**	**16,495.88**	**18,597.44**
其中：存放在境外的款项总额	228.50	311.68	466.26	0.10

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 18,597.44 万元、16,495.88 万元、16,723.45 万元和 32,129.66 万元，占当期流动资产的比例分别为 29.23%、17.16%、10.64%和 10.83%。2026 年 6 月末，公司货币资金余额增加主要系公司业务规模快速增长、在手订单金额上升，合同预收款及合同验收款增加所致。

2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,539.13	30,084.19	33,527.88	6,505.49
其中：结构性存款等银行理财产品	10,539.13	30,084.19	33,527.88	6,505.49
合计	**10,539.13**	**30,084.19**	**33,527.88**	**6,505.49**

报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 6,505.49 万元、33,527.88 万元、30,084.19 万元和 10,539.13 万元，占当期流动资产的比例分别为 10.23%、34.88%、19.15%和 3.55%，主要系使用暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品，投资目的主要系提高资金利用效率和收益。该类理财产品一般持有期限较短，投资风险较低，可回收性良好，对公司资金安排或流动性不存在较大影响。2024 年末、2025 年末交易性金融资产余额显著提升的原因主要系公司收入增长、经营积累增加，利用暂时闲置资金购买银行理财产品增加所致。2026 年 6 月末交易性金融资产余额下降主要系公司收回银行理财所致。

3、应收票据

（1）应收票据情况

单位：万元

种类	2026 年 6 月 30 日			2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	469.31	23.47	445.84	228.76	11.44	217.32
商业承兑汇票	559.42	32.97	526.45	263.34	13.17	250.18
财务公司承兑汇票	-	-	-	535.11	26.76	508.35
合计	**1,028.73**	**56.44**	**972.29**	**1,027.21**	**51.36**	**975.85**
种类	**2024 年 12 月 31 日**			**2023 年 12 月 31 日**		
	账面余额	**坏账准备**	**账面价值**	**账面余额**	**坏账准备**	**账面价值**
银行承兑汇票	480.06	-	480.06	109.47	-	109.47
商业承兑汇票	-	-	-	-	-	-
财务公司承兑汇票	226.34	11.66	214.68	-	-	-
合计	**706.40**	**11.66**	**694.74**	**109.47**	**-**	**109.47**

发行人部分客户存在票据形式回款的情形，主要包括银行承兑汇票、商业承兑汇票、财务公司承兑汇票。报告期各期末，公司应收票据的账面价值分别为 109.47 万元、694.74 万元、975.85 万元和 972.29 万元。报告期各期末应收票据账面价值总体呈上升趋势，主要系业务规模增长所致。

（2）报告期各期末公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

报告期各期末，公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据情况如下：

单位：万元

种类	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	301.07	-	215.53
合计	**-**	**301.07**	**-**	**215.53**
种类	**2024 年 12 月 31 日**		**2023 年 12 月 31 日**	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	152.84	-	66.96
合计	**-**	**152.84**	**-**	**66.96**

4、应收账款

（1）应收账款变动分析

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款账面余额	29,883.31	20,313.71	12,819.58	11,540.40
坏账准备	1,702.51	1,236.96	740.50	611.28
应收账款账面价值	**28,180.80**	**19,076.75**	**12,079.08**	**10,929.11**

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 10,929.11 万元、12,079.08 万元、19,076.75 万元和 28,180.80 万元。2025 年末、2026 年 6 月末公司应收账款账面价值较 2024 年末增加较多，主要系业务规模快速增长所致。

（2）应收账款坏账准备计提情况

单位：万元

类 别	2026 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备	29,883.31	100	1,702.51	5.70	28,180.80
合计	**29,883.31**	**100**	**1,702.51**	**5.70**	**28,180.80**
类 别	**2025 年 12 月 31 日**				
	账面余额		**坏账准备**		**账面价值**
	金额	**比例（%）**	**金额**	**计提比例（%）**	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备	20,313.71	100	1,236.96	6.09	19,076.75
合计	**20,313.71**	**100**	**1,236.96**	**6.09**	**19,076.75**
类 别	**2024 年 12 月 31 日**				
	账面余额		**坏账准备**		**账面价值**
	金额	**比例（%）**	**金额**	**计提比例（%）**	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备	12,819.58	100.00	740.50	5.78	12,079.08
合计	**12,819.58**	**100.00**	**740.50**	**5.78**	**12,079.08**
类 别	**2023 年 12 月 31 日**				
	账面余额		**坏账准备**		**账面价值**
	金额	**比例（%）**	**金额**	**计提比例（%）**	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备	11,540.40	100.00	611.28	5.3	10,929.11
合计	**11,540.40**	**100.00**	**611.28**	**5.3**	**10,929.11**

报告期内，公司应收账款坏账计提金额分别为 611.28 万元、740.50 万元、1,236.96 万元和 1,702.51 万元。报告期各期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失，对应收账款计提坏账准备。

（3）应收账款账龄结构分析

报告期各期末，采用账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄列示如下：

单位：万元

账龄	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
1 年以内	27,740.20	92.83%	18,033.78	88.78%	12,167.43	94.91%	11,048.01	95.73%
1 至 2 年	1,873.21	6.27%	1,908.26	9.39%	360.10	2.81%	449.62	3.90%
2 至 3 年	105.99	0.35%	220.55	1.09%	257.72	2.01%	37.32	0.32%
3 至 4 年	119.46	0.40%	145.66	0.72%	28.87	0.23%	5.45	0.05%
4 至 5 年	39.00	0.13%	-	-	5.45	0.04%	-	-
5 年以上	5.45	0.02%	5.45	0.03%	-	-	-	-
小计	**29,883.31**	**100.00%**	**20,313.71**	**100.00%**	**12,819.58**	**100.00%**	**11,540.40**	**100.00%**

报告期各期末，公司账龄在 1 年以内的应收账款余额占按组合计提的应收账款余额的比例均超过 88%，应收账款流动性较好、回收风险较小。

（4）坏账准备计提政策与同行业可比公司对比分析

公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司对比分析如下：

账龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
BESI（BESI.AS）	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露
ASMPT（0522.HK）	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露
致茂电子（2360.TW）	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露
新益昌（688383.SH）	5%	10%	20%	100%	100%	100%
FiconTEC	5%	10%	30%	50%	80%	100%
联讯仪器	5%	10%	30%	60%	80%	100%
平均值	5%	10%	27%	70%	87%	100%
发行人	**5%**	**10%**	**30%**	**50%**	**80%**	**100%**

数据来源：同行业可比公司披露的年度报告、招股意向书或重组报告书。

报告期内，公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司不存在重大差异，应收账款坏账准备计提政策合理。

（5）应收账款与合同资产前五名客户情况

报告期各期末，公司应收账款与合同资产前五大情况具体如下：

①2026 年 6 月 30 日

单位：万元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中际旭创	15,331.46	-	15,331.46	48.67	767.29
东山精密	3,998.66	-	3,998.66	12.69	199.93
苏世博	1,255.97	332.30	1,588.27	5.04	88.07
索恩格	1,338.37	-	1,338.37	4.25	151.58
钧恒科技	1,293.71	32.00	1,325.71	4.21	66.29
合计	**23,218.17**	**364.30**	**23,582.47**	**74.86**	**1,273.16**

②2025 年 12 月 31 日

单位：万元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中际旭创	6,827.40	-	6,827.40	31.17	355.18
索恩格	2,860.83	-	2,860.83	13.06	228.06
索尔思	2,087.79	-	2,087.79	9.53	104.39
苏世博	1,182.93	414.27	1,597.20	7.29	89.87
先导科技	1,491.38	69.70	1,561.08	7.13	108.13
合计	**14,450.33**	**483.97**	**14,934.30**	**68.18**	**885.63**

③2024 年 12 月 31 日

单位：万元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
光迅科技	5,372.61	118.80	5,491.41	40.49	276.78
中际旭创	2,174.26	-	2,174.26	16.03	109.53
先导科技	915.72	134.28	1,050.00	7.74	52.50
索尔思	763.05	-	763.05	5.63	38.15
索恩格	724.49	-	724.49	5.34	70.81
合计	**9,950.13**	**253.08**	**10,203.21**	**75.23**	**547.78**

④2023 年 12 月 31 日

单位：万元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中际旭创	9,411.40	-	9,411.40	80.55	470.57
源杰科技	476.66	-	476.66	4.08	24.18
索恩格	458.40	-	458.40	3.92	30.57
光迅科技	315.31	25.40	340.71	2.92	21.28
华为技术	293.80	-	293.80	2.51	14.69
合计	**10,955.58**	**25.40**	**10,980.98**	**93.98**	**561.29**

注：受同一实际控制人控制的客户合并披露。东山精密包括原索尔思，以及 2026 年新交易主体盐城东山精密制造有限公司。

5、应收款项融资

（1）应收款项融资情况

报告期各期末，公司应收款项融资情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日公允价值	2025 年 12 月 31 日公允价值	2024 年 12 月 31 日公允价值	2023 年 12 月 31 日公允价值
应收票据	70.84	258.71	570.46	342.98

（2）报告期各期末公司已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资

单位：万元

种类	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	639.58	-	258.71	-
种类	**2024 年 12 月 31 日**		**2023 年 12 月 31 日**	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	221.33	-	-	-

6、合同资产

报告期内，公司合同资产主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日			2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	1,620.43	83.41	1,537.01	1,591.73	79.59	1,512.14
项目	2024 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	741.33	37.07	704.27	144.12	7.52	136.61

报告期各期末，公司合同资产账面余额为 144.12 万元、741.33 万元、1,591.73 万元和 1,620.43 万元，系未到期的质保金。

7、预付款项

公司预付款项主要为向供应商预付的货款。报告期各期末，公司预付款项金额分别为 582.95 万元、592.39 万元、3,318.18 万元和 13,193.09 万元，占当期流动资产的比例较小。2025 年末及 2026 年 6 月末，公司预付账款金额同比增幅较大，主要系公司经营规模上升、在手订单充足，为及时满足订单交付及备货需求，相应增加对部分零部件供应商预付款所致。

8、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款余额情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
押金和保证金	134.72	270.00	148.53	77.05
备用金和个人借款	71.32	27.85	59.35	40.38
代扣员工社保公积金及其他	174.13	94.17	49.28	45.32
小计	**380.17**	**392.02**	**257.17**	**162.75**
减：坏账准备	28.82	30.31	19.36	32.97
合计	**351.35**	**361.71**	**237.81**	**129.78**

报告期各期末，公司其他应收款的账面价值分别为 129.78 万元、237.81 万元、361.71 万元和 351.35 万元，占当期流动资产比例分别为 0.20%、0.25%、0.23%和 0.12%，占比较低。

9、存货

（1）存货构成情况

报告期各期末，公司存货账面价值具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	44,475.71	22.36%	14,875.24	17.99%	3,021.95	9.73%	3,284.41	12.56%
在产品	58,856.58	29.60%	26,739.95	32.35%	8,165.76	26.28%	9,849.48	37.67%
库存商品	161.77	0.08%	70.34	0.09%	35.78	0.12%	-	-
发出商品	95,368.10	47.96%	40,974.43	49.56%	19,850.46	63.88%	13,013.92	49.77%
委托加工物资	4.35	0.00%	8.35	0.01%	-	-	-	-
合计	**198,866.51**	**100.00%**	**82,668.31**	**100.00%**	**31,073.94**	**100.00%**	**26,147.80**	**100.00%**

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 26,147.80 万元、31,073.94 万元、82,668.31 万元和 198,866.51 万元，占流动资产的比例分别为 41.10%、32.32%、52.62%和 67.03%。公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品和发出商品，报告期内，随着公司生产和销售规模的扩大，存货整体规模随之有所增加。

（2）存货跌价准备计提情况

报告期各期末，各类型存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,694.25	218.54	44,475.71
在产品	59,285.85	429.27	58,856.58
库存商品	161.77	-	161.77
发出商品	95,532.28	164.18	95,368.10
委托加工物资	4.35	-	4.35
合计	**199,678.50**	**811.99**	**198,866.51**
项目	**2025 年 12 月 31 日**		
	账面余额	**跌价准备**	**账面价值**
原材料	15,030.22	154.98	14,875.24

在产品	27,140.74	400.79	26,739.95
库存商品	70.34	-	70.34
发出商品	41,008.52	34.09	40,974.43
委托加工物资	8.35	-	8.35
合计	**83,258.17**	**589.86**	**82,668.31**
项目	**2024 年 12 月 31 日**		
	账面余额	**跌价准备**	**账面价值**
原材料	3,199.65	177.70	3,021.95
在产品	8,575.32	409.56	8,165.76
库存商品	35.78	-	35.78
发出商品	20,011.88	161.42	19,850.46
合计	**31,822.63**	**748.69**	**31,073.94**
项目	**2023 年 12 月 31 日**		
	账面余额	**跌价准备**	**账面价值**
原材料	3,377.01	92.61	3,284.41
在产品	10,181.42	331.95	9,849.48
库存商品	-	-	-
发出商品	13,216.46	202.55	13,013.92
合计	**26,774.90**	**627.10**	**26,147.80**

报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 627.10 万元、748.69 万元、589.86 万元和 811.99 万元，占当期存货账面余额的比例分别为 2.34%、2.35%、0.71%和 0.41%。公司于报告期各期末对各类存货进行减值测试，对于成本大于可变现净值的存货相应计提跌价准备。

（3）存货跌价准备同行业可比公司比较情况

报告期各期末，公司存货跌价准备计提比例与同行业可比公司比较如下：

公司简称	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
新益昌（688383.SH）	8.06%	9.66%	7.40%	4.91%
FiconTEC	/	/	4.07%	5.34%
联讯仪器	3.06%	3.90%	3.76%	3.51%
平均值	**5.56%**	**6.78%**	**5.08%**	**4.59%**
发行人	0.41%	0.71%	2.35%	2.34%

注：FiconTEC 未披露 2024 年数据，系 2024 年 7 月末数据。

2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司存货跌价准备计提比例分别为 2.34%、2.35%、0.71%及 0.41%。其中，2023 年末以来低于行业均值，主要原因系公司报告期内销售规模逐步扩大，期末存货大部分存在销售订单对应或可参考同类产品预计售价，存货可变现净值普遍高于存货账面成本，存货发生减值的情况较少所致。

10、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
增值税借方余额重分类	9,932.72	1,580.24	68.74	0.92
未验收项目预开票销项税金	510.19	146.64	85.43	132.69
上市发行中介费	412.78	405.24	-	-
合计	**10,855.70**	**2,132.12**	**154.17**	**133.61**

报告期各期末，公司其他流动资产期末余额分别为 133.61 万元、154.17 万元、2,132.12 万元和 10,855.70 万元，占当期流动资产的比例较小，主要系增值税借方余额重分类、未验收项目预开票销项税金和上市发行中介费。2026 年 6 月末，其他流动资产期末余额增加较多的原因主要系公司在手订单充足，为及时满足订单交付增加原材料采购，进项税额增加，因此增值税借方余额重分类增加所致。

（三）非流动资产构成及变动分析

报告期内，公司非流动资产的构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	6,216.70	66.09%	5,126.35	76.98%	2,734.05	65.70%	2,064.95	73.63%
在建工程	39.88	0.42%	-	-	-	-	-	-
使用权资产	979.96	10.42%	557.47	8.37%	634.03	15.24%	185.41	6.61%
无形资产	1,159.49	12.33%	332.39	4.99%	263.12	6.32%	210.65	7.51%
长期待摊费用	266.14	2.83%	174.30	2.62%	113.23	2.72%	80.15	2.86%

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
递延所得税资产	590.02	6.27%	384.83	5.78%	272.64	6.55%	220.96	7.88%
其他非流动资产	153.98	1.64%	84.40	1.27%	144.22	3.47%	42.31	1.51%
合计	**9,406.17**	**100.00%**	**6,659.74**	**100.00%**	**4,161.28**	**100.00%**	**2,804.42**	**100.00%**

报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、使用权资产、无形资产构成，上述三项合计占非流动资产的比例均超过 80%。

1、固定资产

（1）固定资产构成情况

报告期各期末，公司固定资产分类列示如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
固定资产	6,209.24	5,126.35	2,734.05	2,064.95
固定资产清理	7.45	-	-	-
合计	**6,216.70**	**5,126.35**	**2,734.05**	**2,064.95**

报告期各期末，公司固定资产的具体分类情况如下表所示：

单位：万元

2026 年 6 月 30 日			
项目	**原值**	**累计折旧**	**账面价值**
房屋及建筑物	3,503.33	478.88	3,024.45
机器设备	2,894.20	400.67	2,493.53
运输工具	860.01	579.41	280.60
办公及电子设备	950.18	539.53	410.66
合计	**8,207.73**	**1,998.49**	**6,209.24**
2025 年 12 月 31 日			
项目	**原值**	**累计折旧**	**账面价值**
房屋及建筑物	3,503.33	395.68	3,107.65
机器设备	1,827.07	308.65	1,518.42
运输工具	840.99	552.57	288.41
办公及电子设备	694.71	482.84	211.87

合计	**6,866.10**	**1,739.74**	**5,126.35**
2024 年 12 月 31 日			
项目	**原值**	**累计折旧**	**账面价值**
房屋及建筑物	1,685.88	308.41	1,377.47
机器设备	1,150.77	173.77	977.00
运输工具	710.93	483.69	227.24
办公及电子设备	756.76	604.41	152.35
合计	**4,304.34**	**1,570.28**	**2,734.05**
2023 年 12 月 31 日			
项目	**原值**	**累计折旧**	**账面价值**
房屋及建筑物	1,685.88	228.33	1,457.55
机器设备	518.58	107.36	411.22
运输工具	514.05	433.19	80.86
办公及电子设备	654.49	539.17	115.32
合计	**3,373.00**	**1,308.06**	**2,064.95**

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 2,064.95 万元、2,734.05 万元、5,126.35 万元和 6,216.70 万元，占当期非流动资产的比例分别为 73.63%、65.70%、76.98%和 66.09%。报告期内，固定资产账面价值增加，主要系子公司瑞森联新购置厂房、公司增加机器设备等投入。

报告期各期末，公司固定资产运行状况良好，不存在重大减值情形，无需计提减值准备。

（2）固定资产折旧政策及同行业可比公司比较分析

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，与同行业可比公司的对比情况如下：

公司名称	类别	折旧年限（年）	残值率（%）
BESI	房屋及建筑物	15-30	未披露
	机器设备	2-10	未披露
	办公家具及设备	3-10	未披露
ASMPT	楼宇	22.22-50	未披露
	机器设备	3-10	未披露
	家私、装置及设备	5-10	未披露

公司名称	类别	折旧年限（年）	残值率（%）
致茂电子	未披露		
新益昌	房屋及建筑物	20/30	5
	机器设备	10	5
	运输工具	4	5
	办公家具	5	5
	电子设备	3	5
	模具	3	5
FiconTEC	房屋及建筑物	30	5
	通用设备	3-5	5
	专用设备	3-10	5
	运输工具	4	5
联讯仪器	机器设备	5-10	5
	运输设备	4	5
	电子设备	2-5	0/5
	器具、家具	3-5	5
发行人	房屋及建筑物	20	5
	办公及电子设备	3	5
	机器设备	3-10	5
	运输工具	4	5

注：同行业可比公司披露的年度报告、招股意向书或重组报告书。

经对比，公司与同行业上市公司重要固定资产的折旧年限基本一致，不存在重大差异。

2、在建工程

报告期内，公司在建工程分别为 0、0、0 和 39.88 万元，主要系公司总部园区建设前期投入，占当期非流动资产的比例分别为 0、0、0 和 0.42%，金额及占比较小。

3、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产具体情况如下：

单位：万元

2026 年 6 月 30 日			
项目	**原值**	**累计折旧**	**账面价值**
房屋及建筑物	1,737.43	757.47	979.96
合计	**1,737.43**	**757.47**	**979.96**
2025 年 12 月 31 日			
项目	**原值**	**累计折旧**	**账面价值**
房屋及建筑物	601.70	44.23	557.47
合计	**601.70**	**44.23**	**557.47**
2024 年 12 月 31 日			
项目	**原值**	**累计折旧**	**账面价值**
房屋及建筑物	1,049.19	415.16	634.03
合计	**1,049.19**	**415.16**	**634.03**
2023 年 12 月 31 日			
项目	**原值**	**累计折旧**	**账面价值**
房屋及建筑物	779.32	593.91	185.41
合计	**779.32**	**593.91**	**185.41**

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 185.41 万元、634.03 万元、557.47 万元和 979.96 万元，占当期非流动资产的比例分别为 6.61%、15.24%、8.37%和 10.42%，主要为公司生产经营活动中租赁的房屋及建筑物。

4、无形资产

报告期各期末，公司无形资产具体情况如下：

单位：万元

2026 年 6 月 30 日			
项目	**原值**	**累计摊销**	**账面价值**
土地使用权	1,052.32	42.35	1,009.97
计算机软件	253.74	104.21	149.52
合计	**1,306.06**	**146.56**	**1,159.49**
2025 年 12 月 31 日			
项目	**原值**	**累计摊销**	**账面价值**
土地使用权	187.69	28.47	159.23
计算机软件	253.74	80.57	173.17

合计	**441.43**	**109.04**	**332.39**
2024 年 12 月 31 日			
项目	**原值**	**累计摊销**	**账面价值**
土地使用权	187.69	24.71	162.98
计算机软件	145.14	45.01	100.14
合计	**332.84**	**69.72**	**263.12**
2023 年 12 月 31 日			
项目	**原值**	**累计摊销**	**账面价值**
土地使用权	187.69	20.96	166.73
计算机软件	74.42	30.51	43.91
合计	**262.12**	**51.47**	**210.65**

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 210.65 万元、263.12 万元、332.39 万元和 1,159.49 万元，占当期非流动资产的比例分别为 7.51%、6.32%、4.99%和 12.33%，主要为土地使用权及计算机软件。2026 年 6 月末，公司无形资产账面价值增加主要系公司获取土地使用权所致。报告期各期末，公司无形资产状况良好，不存在减值情形。

5、长期待摊费用

2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-6 月，公司长期待摊费用主要系公司房屋的装修费用，账面价值分别为 80.15 万元、113.23 万元、174.30 万元和 266.14 万元，占当期非流动资产的比例分别为 2.86%、2.72%、2.62%和 2.83%，金额及占比较小。

6、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产

报告期各期末，公司未经抵销的递延所得税资产构成情况如下：

单位：万元

项 目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	895.40	134.31	669.45	100.42
信用减值准备	1,787.77	270.51	1,313.18	195.10
内部交易未实现利润	387.34	58.10	1.10	0.99

产品质量保证	939.66	140.95	636.01	95.40
租赁负债	926.87	149.95	601.81	84.03
合计	**4,937.04**	**753.83**	**3,221.56**	**475.94**
项　目	**2024 年 12 月 31 日**		**2023 年 12 月 31 日**	
	可抵扣暂时性差异	**递延所得税资产**	**可抵扣暂时性差异**	**递延所得税资产**
资产减值准备	785.75	117.86	634.62	95.19
信用减值准备	771.52	117.29	644.25	97.05
内部交易未实现利润	36.56	5.48	20.07	3.01
产品质量保证	312.65	46.90	139.60	20.94
租赁负债	564.48	90.02	222.71	33.41
合计	**2,470.96**	**377.56**	**1,661.25**	**249.60**

发行人递延所得税资产主要是由资产减值准备、信用减值准备、租赁负债、可抵扣亏损、产品质量保证、内部交易未实现利润等所引起的可抵扣暂时性差异形成。

（2）未经抵销的递延所得税负债

报告期各期末，公司未经抵销的递延所得税负债构成情况如下：

单位：万元

项目	**2026 年 6 月 30 日**		**2025 年 12 月 31 日**	
	应纳税暂时性差异	**递延所得税负债**	**应纳税暂时性差异**	**递延所得税负债**
交易性金融资产公允价值变动	39.13	5.87	84.19	12.63
使用权资产	979.96	157.94	557.47	78.49
合计	**1,019.09**	**163.81**	**641.66**	**91.12**
项目	**2024 年 12 月 31 日**		**2023 年 12 月 31 日**	
	应纳税暂时性差异	**递延所得税负债**	**应纳税暂时性差异**	**递延所得税负债**
交易性金融资产公允价值变动	27.88	4.18	5.49	0.82
使用权资产	634.03	100.74	185.41	27.81
合计	**661.91**	**104.92**	**190.91**	**28.64**

发行人递延所得税负债主要是由交易性金融资产公允价值变动、使用权资产等所引起的应纳税暂时性差异形成。

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

报告期各期末，公司以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
递延所得税资产	590.02	384.83	272.64	220.96
递延所得税负债	-	-	-	-

7、其他非流动资产

2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司其他非流动资产主要包括预付工程设备款，账面价值分别为 42.31 万元、144.22 万元、84.40 万元和 153.98 万元，占当期非流动资产的比例分别为 1.51%、3.47%、1.27%和 1.64%。

（四）资产周转能力分析

1、公司资产周转能力情况

报告期各期，公司主要资产周转能力指标如下：

单位：次

营运能力指标	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率	4.92	4.48	4.72	4.17
存货周转率	0.49	0.70	0.94	0.78

2、资产周转能力同行业对比分析

报告期内，公司与同行业可比公司资产周转能力对比如下：

（1）应收账款周转率

单位：次

可比公司	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
BESI（BESI.AS）	4.07	2.15	3.74	3.97
ASMPT（0522.HK）	4.39	4.03	3.86	3.82
致茂电子（2360.TW）	4.42	3.78	3.79	3.70
新益昌	2.59	1.57	1.44	1.43

可比公司	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
（688383.SH）				
FiconTEC	-	-	5.77	9.03
联讯仪器	3.92	3.32	4.04	2.45
平均值	**3.88**	**2.97**	**3.77**	**4.07**
发行人	4.92	4.48	4.72	4.17

注：发行人及同行业公司数据均已年化处理。

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 4.17、4.72、4.48 和 4.92，总体略高于行业平均水平，主要原因系公司下游客户信用良好、付款稳定，应收账款回款情况良好。

（2）存货周转率

单位：次

可比公司	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
BESI（BESI.AS）	2.77	2.09	2.16	2.20
ASMPT（0522.HK）	1.54	1.39	1.29	1.30
致茂电子（2360.TW）	2.02	1.63	1.75	1.68
新益昌（688383.SH）	0.70	0.62	0.93	1.11
FiconTEC	/	/	0.51	0.96
联讯仪器	1.08	1.11	1.09	0.87
平均值	**1.62**	**1.37**	**1.29**	**1.35**
发行人	0.49	0.70	0.94	0.78

注：各同行业可比公司相关数据已经年化处理；FiconTEC 未披露 2024 年数据，系 2024 年 1-7 月数据。

报告期各期，公司存货周转率分别为 0.78、0.94、0.70 和 0.49，略低于同行业可比公司均值，主要系同行业上市公司如 BESI、ASMPT 等业务更加多元化，而公司报告期内主营业务收入增长的驱动力主要来自光通信行业，对该行业的产品交付、在手订单及扩产需求更为敏感，相应原材料采购及备货需求同步增长，期末在产品和发出商品金额增长较多所致。

十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债总体分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	217,098.43	99.39%	89,545.43	97.96%	43,073.07	98.58%	40,501.32	99.64%
非流动负债	1,328.62	0.61%	1,861.28	2.04%	620.48	1.42%	145.95	0.36%
负债总计	**218,427.05**	**100.00%**	**91,406.70**	**100.00%**	**43,693.55**	**100.00%**	**40,647.26**	**100.00%**

报告期内，随着公司业绩规模的增长，负债规模呈现同步上升趋势。报告期各期末，公司负债总额分别为 40,647.26 万元、43,693.55 万元、 91,406.70 万元和 218,427.05 万元，其中流动负债占负债总额的比例分别为 99.64%、98.58%、97.96%和 99.39%，主要包括合同负债及应付账款等经营性流动负债。

1、流动负债构成及变化分析

报告期各期末，公司的流动负债具体构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	-	-	-	-	-	-	600.68	1.48%
应付票据	12,255.52	5.65%	2,678.84	2.99%	1,482.82	3.44%	1,545.66	3.82%
应付账款	96,416.10	44.41%	42,363.80	47.31%	4,620.79	10.73%	9,313.44	23.00%
合同负债	90,025.85	41.47%	34,877.60	38.95%	29,698.87	68.95%	23,098.24	57.03%
应付职工薪酬	2,881.58	1.33%	2,747.46	3.07%	2,114.57	4.91%	1,419.70	3.51%
应交税费	1,838.85	0.85%	1,908.06	2.13%	1,134.96	2.63%	1,355.45	3.35%
其他应付款	147.49	0.07%	136.15	0.15%	51.54	0.12%	33.76	0.08%
一年内到期的非流动负债	1,528.60	0.70%	372.24	0.42%	256.65	0.60%	216.36	0.53%
其他流动负债	12,004.43	5.53%	4,461.27	4.98%	3,712.89	8.62%	2,918.02	7.20%
合计	**217,098.43**	**100.00%**	**89,545.43**	**100.00%**	**43,073.07**	**100.00%**	**40,501.32**	**100.00%**

报告期各期末，公司流动负债余额分别为 40,501.32 万元、43,073.07 万元、89,545.43 万元和 217,098.43 万元。流动负债主要由合同负债及应付账款构成，上述负债合计占流动负债的比例各报告期末分别为 80.03%、79.68%、86.26%和

85.88%。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
保证借款	-	-	-	600.00
保证、抵押借款	-	-	-	-
借款利息	-	-	-	0.68
合计	**-**	**-**	**-**	**600.68**

公司短期借款在 2023 年末的余额为 600.68 万元，占当期流动负债的比例为 1.48%，其余报告期内各期末的余额均为 0 万元，主要系 2023 年末公司用于保障日常营运资金需求的短期借款。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据余额情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	12,255.52	2,678.84	1,482.82	1,545.66
合计	**12,255.52**	**2,678.84**	**1,482.82**	**1,545.66**

报告期各期末，公司应付票据均为银行承兑汇票，余额分别为 1,545.66 万元、1,482.82 万元、2,678.84 万元和 12,255.52 万元，占流动负债的比例分别为 3.82%、3.44%、2.99%和 5.65%。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付货款	95,104.26	42,150.77	4,578.00	9,250.08
应付服务费	1,237.09	196.86	42.78	63.35
应付工程设备款	74.76	16.17	-	-

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
合计	**96,416.10**	**42,363.80**	**4,620.79**	**9,313.44**

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 9,313.44 万元、4,620.79 万元、42,363.80 万元和 96,416.10 万元，占当期流动负债的比例分别为 23.00%、10.73%、47.31%和 44.41%。报告期各期末，公司应付账款均主要为应付货款，无账龄超过 1 年的重要应付账款。报告期内，随着公司生产经营规模逐步扩大，原材料采购金额随之增长，导致报告期各期末对供应商应付账款规模整体呈增长趋势。

（4）合同负债

报告期各期末，公司合同负债具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预收商品款	90,025.85	34,877.60	29,698.87	23,098.24

报告期各期末，公司合同负债分别为 23,098.24 万元、29,698.87 万元、34,877.60 万元和 90,025.85 万元，系预收商品款。报告期内合同负债整体呈上升趋势，主要系公司经营规模持续扩大所致。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
短期薪酬	2,881.25	2,747.29	2,114.40	1,419.70
离职后福利—设定提存计划	0.33	0.17	0.17	-
合计	**2,881.58**	**2,747.46**	**2,114.57**	**1,419.70**

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 1,419.70 万元、2,114.57 万元、2,747.46 万元和 2,881.58 万元，占当期流动负债的比例分别为 3.51%、4.91%、3.07%和 1.33%，主要为已计提未发放的工资、奖金等。

（6）应交税费

报告期各期末，公司应交税费具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
增值税	-	158.43	220.72	345.47
企业所得税	1,617.55	1,641.44	784.99	889.54
个人所得税	47.83	65.71	79.80	104.61
城市维护建设税	108.41	10.53	19.29	5.07
教育费附加	12.66	7.52	13.78	3.62
房产税	10.60	3.76	4.19	1.80
城镇土地使用税	4.95	0.29	0.29	0.15
印花税	36.86	20.37	11.90	5.19
合计	**1,838.85**	**1,908.06**	**1,134.96**	**1,355.45**

报告期各期末，公司应交税费分别为 1,355.45 万元、1,134.96 万元、1,908.06 万元和 1,838.85 万元，主要包括应交增值税、企业所得税、房产税、城市维护建设税及代扣代缴个人所得税等。

（7）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
往来借款	-	-	-	0.10
员工报销款	40.73	40.73	0.73	13.05
代扣员工社保公积金及其他	106.76	95.43	50.81	20.60
合计	**147.49**	**136.15**	**51.54**	**33.76**

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 33.76 万元、51.54 万元、136.15 万元和 147.49 万元，占当期流动负债的比例分别为 0.08%、0.12%、0.15%和 0.07%，占比较低。

（8）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债的余额分别为 216.36 万元、

256.65 万元、372.24 万元和 1,528.60 万元，占当期流动负债的比例分别为 0.53%、0.60%、0.42%和 0.70%，主要系一年内到期的租赁负债、一年内到期的长期借款。

（9）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 2,918.02 万元、3,712.89 万元、4,461.27 万元和 12,004.43 万元，占当期流动负债的比例分别为 7.20%、8.62%、4.98%和 5.53%。公司其他流动负债主要为待转增值税销项税额和未终止确认的已背书未到期商业票据。2026 年 6 月末，其他流动负债增加主要系公司业务规模快速增长、在手订单金额上升，合同预收款增加，进而待转销项税额增加所致。

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
待转销项税额	11,703.36	4,245.73	3,560.05	2,851.06
未终止确认的已背书未到期商业票据	301.07	215.53	152.84	66.96
合计	**12,004.43**	**4,461.27**	**3,712.89**	**2,918.02**

2、非流动负债构成及变化分析

报告期内，公司非流动负债的构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	-	-	985.00	52.92%	-	-	-	-
租赁负债	388.96	29.28%	240.26	12.91%	307.83	49.61%	6.35	4.35%
预计负债	939.66	70.72%	636.01	34.17%	312.65	50.39%	139.60	95.65%
合计	**1,328.62**	**100.00%**	**1,861.28**	**100.00%**	**620.48**	**100.00%**	**145.95**	**100.00%**

报告期各期末，公司非流动负债余额分别为 145.95 万元、620.48 万元、1,861.28 万元和 1,328.62 万元。2023 年末、2024 年末，公司非流动负债由租赁负债和预计负债构成，2025 年末，公司非流动负债由长期借款、租赁负债和预计负债构成。2026 年 6 月末，公司非流动负债由租赁负债和预计负债构成。公司非流动负债科目具体分析如下：

（1）长期借款

公司长期借款在 2025 年末的余额为 985.00 万元，主要系飞泰智能为保障日常营运资金新增的保证借款及其产生的利息。

（2）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债余额分别为 6.35 万元、307.83 万元、240.26 万元和 388.96 万元，主要系公司报告期各期末尚未支付的租赁付款额。

（3）预计负债

报告期各期末，公司预计负债分别为 139.60 万元、312.65 万元、636.01 万元和 939.66 万元。公司预计负债主要系产品质量保证金。报告期内，公司预计负债规模持续增长，与公司业务规模变动趋势相匹配。

（二）偿债能力分析

1、最近一期末主要债务情况

最近一期末，公司主要债务系应付账款和合同负债，不存在关联方借款。截至最近一期末，公司应付账款和合同负债的情况详见本节“十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（一）负债总体分析”之“1、流动负债构成及变化分析”。

截至报告期末，公司不存在逾期未偿还款项，不存在借款费用资本化情形。

2、未来十二个月内可预见的需偿还负债和利息情况

截至报告期末，公司未来十二个月内预计需偿还的流动负债金额合计为 110,736.67 万元，主要为应付账款等。报告期内，公司到期的借款本金及利息均已按期归还，银行资信状况良好，与主要金融机构和供应商保持长期良好合作关系，债务融资渠道通畅，且公司经营规模稳步增长，可预见的未来发生无法偿还负债和利息的风险较低。

3、主要偿债指标分析

报告期内，公司与偿债有关的财务指标如下：

财务指标	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日

财务指标	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.37	1.75	2.23	1.57
速动比率（倍）	0.45	0.83	1.51	0.93
资产负债率（母公司）	72.06%	57.63%	41.20%	56.88%
资产负债率（合并）	71.36%	55.81%	43.57%	61.20%

2023 年末及 2024 年末，公司流动比率、速动比率呈现上升趋势，资产负债率整体呈现下降趋势，主要系公司业绩规模持续上升，收入及盈利增加，货币资金等流动资产金额上升。2025 年末、2026 年 6 月末与 2024 年末相比，流动比率、速动比率呈现下降趋势，资产负债率呈上升趋势，主要系公司经营规模上升、在手订单充足，为及时满足订单交付增加原材料采购及备货，应付账款、存货同步增加所致。

报告期各期末，公司与同行业可比上市公司的偿债能力指标比较如下：

项目	名称	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	BESI	4.28	5.55	5.98	5.02
	ASMPT	3.07	3.58	3.71	2.53
	致茂电子	1.67	2.85	2.12	1.87
	新益昌	1.24	1.30	1.52	1.67
	FiconTEC	-	-	1.00	1.08
	联讯仪器	2.60	1.92	2.01	2.26
	平均值	**2.57**	**3.04**	**2.72**	**2.41**
	发行人	**1.37**	**1.75**	**2.23**	**1.57**
速动比率（倍）	BESI	3.73	4.88	5.36	4.34
	ASMPT	1.88	2.29	2.24	1.48
	致茂电子	1.21	1.99	1.45	1.32
	新益昌	0.61	0.70	0.92	1.13
	FiconTEC	-	-	0.20	0.32
	联讯仪器	2.01	1.25	1.36	1.70
	平均值	**1.89**	**2.22**	**1.92**	**1.72**
	发行人	**0.45**	**0.83**	**1.51**	**0.93**
资产负债率（合	BESI	50.70%	62.61%	59.39%	53.00%
	ASMPT	36.46%	34.52%	35.41%	34.05%

项目	名称	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
并）	致茂电子	47.08%	30.94%	31.78%	32.75%
	新益昌	60.36%	58.53%	50.88%	46.83%
	FiconTEC	-	-	95.35%	87.16%
	联讯仪器	38.77%	50.13%	47.66%	41.08%
	平均值	**46.67%**	**47.35%**	**53.41%**	**49.15%**
	发行人	**71.36%**	**55.81%**	**43.57%**	**61.20%**

报告期内各期末，发行人流动比率、速动比率略低于可比公司平均值，上述公司主要为上市公司，资金相对雄厚。报告期内，公司资产负债率呈先降后升的趋势，截至 2026 年 6 月末，发行人资产负债率高于可比公司平均值，主要原因系主要系公司经营规模上升、在手订单充足，为及时满足订单交付增加原材料采购及备货，应付账款、存货同步增加所致。

（三）现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,238.48	2,923.00	14,178.06	14,871.16
投资活动产生的现金流量净额	17,183.41	981.04	-27,906.27	-6,713.96
筹资活动产生的现金流量净额	-455.73	-3,039.64	11,417.50	5,286.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67.67	-61.54	11.60	2.01
现金及现金等价物净增加额	15,421.53	802.85	-2,299.12	13,445.50
期初现金及现金等价物余额	15,848.10	15,045.25	17,344.37	3,898.87
期末现金及现金等价物余额	31,269.63	15,848.10	15,045.25	17,344.37

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	116,242.22	74,578.14	65,570.28	42,349.58
收到的税费返还	438.37	1,000.48	1,387.35	320.82

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收到其他与经营活动有关的现金	1,008.97	1,551.56	1,372.42	1,424.88
经营活动现金流入小计	**117,689.57**	**77,130.19**	**68,330.05**	**44,095.28**
购买商品、接受劳务支付的现金	104,087.26	55,216.29	35,142.35	19,438.18
支付给职工以及为职工支付的现金	8,949.15	11,768.24	8,785.33	4,972.84
支付的各项税费	3,508.13	3,710.49	6,067.13	1,528.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,383.50	3,512.17	4,157.18	3,284.33
经营活动现金流出小计	**118,928.04**	**74,207.19**	**54,151.99**	**29,224.12**
经营活动产生的现金流量净额	**-1,238.48**	**2,923.00**	**14,178.06**	**14,871.16**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 14,871.16 万元、14,178.06 万元、2,923.00 万元和-1,238.48 万元，主要由销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、接受劳务支付的现金等构成。2023 年至 2024 年，经营活动产生的现金流量净额为正，主要系公司业绩规模持续上升，经营活动产生的现金有结余；2025 年、2026 年 1-6 月，经营活动产生的现金流量净额下降幅度较大，主要原因系下游客户的付款政策有所调整，以及应对产品订单交付增加备货所致。

报告期内，公司经营性现金流量与净利润之间的匹配关系如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	**14,831.17**	**18,155.76**	**18,056.52**	**8,150.30**
加：资产减值准备	257.73	182.46	191.23	-2.18
信用减值准备	469.14	547.12	127.26	-482.47
固定资产折旧	277.64	357.25	267.23	296.57
使用权资产折旧	293.63	339.69	302.63	266.02
无形资产摊销	37.53	39.31	18.25	5.75
长期待摊费用摊销	103.75	96.89	80.60	224.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/（收益）	-4.91	-	-	-
固定资产报废损失/（收益）	-	0.12	4.65	3.93
公允价值变动损失/（收益）	-39.13	-84.19	-27.88	-5.49
财务费用（收益以“－”号填列）	154.30	128.91	21.50	45.95
投资损失/（收益）	-185.30	-580.15	-381.07	-83.09

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
递延所得税资产的减少/（增加）	-205.19	-112.19	-51.67	105.28
存货的减少/（增加）	-116,315.50	-51,741.15	-5,087.82	-14,416.79
经营性应收项目的减少/（增加）	-27,056.48	-3,610.11	3,791.66	9,202.70
经营性应付项目的增加	125,660.45	38,177.81	-3,444.13	10,418.74
其他	482.68	1,025.46	309.09	1,141.84
经营活动产生的现金流量净额	**-1,238.48**	**2,923.00**	**14,178.06**	**14,871.16**

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	56,500.00	82,000.00	57,000.00	19,000.00
取得投资收益收到的现金	140.24	608.03	386.56	83.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16.04	-	-	-
投资活动现金流入小计	**56,656.28**	**82,608.03**	**57,386.56**	**19,083.09**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,472.87	3,127.00	1,292.83	297.05
投资支付的现金	37,000.00	78,500.00	84,000.00	25,500.00
投资活动现金流出小计	**39,472.87**	**81,627.00**	**85,292.83**	**25,797.05**
投资活动产生的现金流量净额	**17,183.41**	**981.04**	**-27,906.27**	**-6,713.96**

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-6,713.96 万元、-27,906.27 万元、981.04 万元和 17,183.41 万元。报告期内，2023 年度、2024 年度投资活动产生的现金流量净额为负，主要系公司购买结构性存款等理财产品的金额上升所致。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	-	90.00	13,956.86	7,850.00
取得借款收到的现金	-	1,000.00	-	600.00

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
筹资活动现金流入小计	**-**	**1,090.00**	**13,956.86**	**8,450.00**
偿还债务支付的现金	5.00	5.00	600.00	1,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13.45	3,518.09	1,520.14	1,234.66
支付其他与筹资活动有关的现金	437.29	606.56	419.23	429.05
筹资活动现金流出小计	**455.73**	**4,129.64**	**2,539.37**	**3,163.71**
筹资活动产生的现金流量净额	**-455.73**	**-3,039.64**	**11,417.50**	**5,286.29**

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 5,286.29 万元、11,417.50 万元、-3,039.64 万元和-455.73 万元，主要系吸收股东投资款、分配股利、利润或偿付利息支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金。

（四）重大资本性支出分析

1、报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司重大资本性支出主要是采购机器设备发生的资本性支出。报告期各期，“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项下的现金流出分别为 297.05 万元、1,292.83 万元、3,127.00 万元和 2,472.87 万元。

2、未来可预见的重大资本性支出情况

本次募集资金投资项目的投资支出情况详见本招股意向书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”相关内容。

（五）流动性变化趋势及应对措施

报告期内，公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货等组成，其中，货币资金主要为银行存款，应收账款的账龄较短，回款情况稳定。报告期各期末，公司的流动资产整体变现能力较强，流动性较好。公司负债以流动负债为主，主要系短期借款及公司经营过程中形成的经营性负债，其中应付账款、应付票据为公司正常经营活动中形成的商业信用负债。报告期内，公司经营业绩持续向好，盈利能力不断增强。2023 年末及 2024 年末，公司流动比率、速动比率呈现上升趋势，资产负债率整体呈现下降趋势，主要系公司业绩规模持续上升，收入及盈利增加，货币资金等流动资产金额上升。2025 年末、2026 年 6 月末，流动比率、速动比率呈现下降趋势，资产负债率呈上升趋势，主要系公

司经营规模上升、在手订单充足，为及时满足订单交付增加原材料采购及备货，应付账款、存货同步增加所致。

目前，公司已建立了完善的资金管理制度，通过强化内部控制和实行合理监督以提高营运资金使用效率，防范流动性风险。未来，公司将通过公开发行股票、申请中长期贷款、提高应收账款回款速度等方式降低财务杠杆、优化债务结构和改善经营活动现金流，以降低公司的流动性风险。

（六）报告期内股利分配情况

报告期内，公司共完成 3 次股利分配。

2023 年 7 月 28 日，公司 2023 年第七次股东会会议审议通过《关于同意公司利润分配方案的议案》，同意以决议时点的公司股权结构，向全体股东分配现金股利（含税）合计 1,200.00 万元。

2024 年 2 月 20 日，公司 2024 年第一次股东会会议审议通过《关于同意公司利润分配方案的议案》，同意以决议时点的公司股权结构，向全体股东分配现金股利（含税）合计 1,500.00 万元。

2025 年 6 月 25 日，公司 2024 年年度股东会审议通过《关于同意公司利润分配方案的议案》，同意以决议时点的公司股权结构，向全体股东分配现金股利（含税）合计 3,500.00 万元。

（七）持续经营能力分析

猎奇智能系国内领先的高端智能装备制造商，专注于光通信、半导体及汽车自动化等领域智能生产装备的研发、生产和销售。经过多年技术积淀与市场开拓，公司产品已覆盖光模块封装测试的核心环节，包括贴片、耦合、老化测试等关键工序，相关设备是保障光模块传输效率与可靠性的核心装备，并最终应用于数通市场及电信市场。同时，公司依托光通信领域积累的自动化装备技术优势，积极布局半导体、汽车自动化智能装备领域，持续强化综合竞争实力。

报告期内，公司业绩持续增长，营收规模不断提升，盈利能力不断增强，经营能力具有较强的可持续性。

随着公司的上市，法人治理结构将得到进一步完善，各项制度将得到更加

有效的执行，从而有利于公司市场竞争力的提升和盈利能力的加强，因此公司具备持续经营能力。公司报告期内的经营策略以及未来经营计划详见本招股意向书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”之“五、未来发展规划”。

结合公司的业务和产品定位、报告期经营以及未来经营计划，管理层认为公司在持续经营能力方面不存在重大不利变化，相关风险因素详见本招股意向书“第三节 风险因素”。

十三、重大资产业务重组或股权收购合并事项

报告期内，发行人不存在重大资产业务重组或股权收购合并事项。

十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项

（一）资产负债表日后事项

截至本招股意向书签署日，公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

（二）或有事项

2025 年 5 月，MRSI 以公司销售的产品侵犯其发明专利为由，将公司诉至深圳市中级人民法院，具体情况详见本招股意向书“第十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼与仲裁事项”之“（一）公司重大诉讼或仲裁事项”。2026 年 6 月 30 日，深圳市中级人民法院出具民事判决书（（2025）粤 03 民初 7154 号），法院认定原告 MRSI 主张的侵权事实不能成立，对原告 MRSI 的诉讼请求不予支持，判决驳回原告 MRSI 的全部诉讼请求。

2026 年 10 月 15 日，发行人收到《中华人民共和国最高人民法院上诉案件应诉通知书》（（2026）最高法知民终 692 号），中华人民共和国最高人民法院已受理 MRSI 的上诉申请。截至本招股意向书签署日，该案件尚在审理中，具体情况详见本招股意向书“第十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼与仲裁事项”之“（一）公司重大诉讼或仲裁事项”。

除上述事项以外，截至本招股意向书签署日，发行人不存在需要披露的其他或有事项。

（三）其他重要事项

截至本招股意向书签署日，发行人不存在需要披露的其他重要事项。

（四）重大担保、诉讼事项

截至本招股意向书签署日，发行人不存在需要披露的重大担保以及前述或有事项以外的其他诉讼事项。

十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

自财务报告审计基准日至本招股意向书签署日，公司整体经营情况正常。公司经营模式、主要原材料及其采购价格、主要产品及其销售价格、主要客户及供应商的构成、公司适用税收政策未发生重大不利变化，公司亦未出现其他可能影响公司正常经营或可能影响投资者判断的重大不利事项。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金运用方案

本次募集资金投资项目已经发行人第一届董事会第五次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过，由董事会根据项目的轻重缓急情况安排实施。发行人本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额
1	高端智能装备制造建设项目	58,240.78	58,240.78
2	研发中心建设项目	25,100.61	25,100.61
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		**91,341.39**	**91,341.39**

在本次发行上市募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。若募集资金金额小于上述项目拟投资金额，不足部分由公司自有或自筹资金进行投资，以保证项目的顺利实施；若本次发行实际募集资金超过上述项目投资需求，超过部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

（二）募集资金投资项目审批情况

公司本次募集资金投资项目已履行了内部决策程序，并取得了相关机构备案或登记，具体情况如下表所示：

序号	项目名称	项目备案编号	环评备案编号
1	高端智能装备制造建设项目	昆高投备（2025）378 号	不适用
2	研发中心建设项目		不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用

高端智能装备制造建设项目的产品生产工艺主要为产品的组装、调试、检测等，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）规定，该项

目免于环评管理，无需办理环境影响评价审批或者备案手续。

研发中心建设项目为研发类项目，不涉及生产过程，不产生废气、废水、危险废物。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）的规定，研发中心建设项目免于环评管理，无需办理环境影响评价审批或者备案手续。

（三）募集资金使用管理制度

公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了募集资金管理制度，明确了公司应建立募集资金管理的相关制度，对募集资金使用的授权、决策程序、风险控制措施及信息披露方式等内容进行了明确的规定。公司将严格遵循专户存放、规范使用、严格监督的原则进行募集资金的使用和管理。

（四）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响和业务创新创造创意性的支持作用

公司一直致力于光通信、半导体及汽车产业等领域智能生产装备的研发、生产和销售，本次募集资金投资项目主要为研发中心和智能化生产线建设，其中高端智能装备制造建设项目为新建智能化生产线，扩大公司现有产能，以满足光通信、半导体和汽车产业等下游市场对智能生产装备持续增长的需求。

研发中心建设项目主要为加大对光模块封装测试设备的研发投入力度，进一步提升公司的研发能力，有利于促进公司产品的持续优化、升级，提升公司在市场中的竞争力。通过在微组装工艺、IC 高速固晶贴片设备、高精度倒装贴片设备、TCB 热压键合封装设备、PLP 封装工艺贴片设备等方面开展系列研究，巩固公司的技术优势，强化公司核心竞争力。

综上所述，本次募集资金投资项目，有利于提升发行人研发能力，优化产品的综合性能、加速公司产品迭代，通过规模效应降低发行人产品的生产成本，扩大发行人产品在下游应用市场的覆盖范围、品牌认知及市场占有率，有利于促进公司长期、稳定和健康发展，上述项目均对公司业务的创新、创造和创意性提供了有力的支持。

（五）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次募集资金投资项目由公司自主实施，且均围绕公司现有主营业务进行，

募投项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

二、募集资金投资项目的确定依据

（一）与公司生产规模相适应

发行人主要从事光通信、半导体、汽车自动化设备等领域智能生产装备的研发、生产和销售。自设立以来，发行人始终致力于推动高端光模块封装测试设备的国产替代，向下游光模块厂商、器件厂商提供性能优越、高可靠性的封装测试设备，从源头提升我国光通信产业的核心竞争力。经过多年的发展和积累，发行人产品已覆盖光模块封装测试流程的主要核心环节。凭借过硬的产品质量、技术创新能力和高效优质的配套服务能力，发行人已成为国内领先的光模块智能制造装备制造商。

受下游数据中心、云计算、AI 需求驱动，800G/1.6T 超高速率光模块需求快速增长，下游光模块厂商对光模块封装测试设备的产能、精度等要求快速提升。发行人需通过本次募投项目扩大高精度贴片机、光耦合设备等核心光模块封装测试设备的产能，推进智能产线数字化升级，加大研发投入，持续迭代和升级核心技术，保持公司核心竞争力，本次募集资金规模与公司现有生产经营规模相匹配。

（二）与公司财务状况相适应

报告期内，公司具备较强的盈利能力，经营规模保持稳步增长，现金流稳健，整体财务状况良好。随着公司经营规模的扩张，产能扩充和研发投入相关的资金需求不断增加。本次募集资金到位后，可以有效满足公司经营规模快速增长带来的资金需求，使公司财务结构进一步优化，抗风险能力得以增强。随着本次募集资金投资项目的顺利实施，公司的整体盈利能力也将进一步提升。

（三）与公司技术水平相适应

公司深耕光模块封装测试设备领域十年，始终以客户需求和行业前沿技术为导向，经过持续的研发投入和产品开发经验积累，在精密运动控制、光耦合算法、视觉引导技术等方面形成超过 50 项核心专利。公司系国家高新技术企业、国家级专精特新“重点小巨人”企业，公司高精密光模块自动化设备工程技术

研究中心获得江苏省省级工程技术研究中心认定。公司本次募集资金投资项目基于现有生产能力和技术储备，可进一步提升公司产能和核心产品研发能力。公司深厚的技术积累和专业的研发团队能够为本次募集资金投资项目的实施提供良好基础。

（四）与公司管理能力相适应

经过多年行业深耕，公司在产品研发、技术迭代、生产工艺及销售服务等环节积累了深厚经验。核心管理层具备行业前瞻性与战略洞察力，依托完善的公司治理体系，建立起覆盖全业务流程的规范管理制度。公司严格遵循上市公司标准运作，持续优化治理结构，强化内控管理，充分发挥股东会、董事会的协同监督职能，为经营稳健增长与战略目标实现筑牢根基，也为本次募投项目的高效推进提供坚实保障。

（五）与公司发展目标相适应

本次募集资金投资项目紧密围绕公司光模块封装测试设备业务布局，建成后将显著提升核心产品的研发创新与规模化生产能力，加速信息化、智能化升级进程，全面增强公司的市场竞争力与行业话语权。

综上，本次募集资金规模和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平、管理能力和发展目标相匹配，兼具市场前景与盈利潜力，符合国家产业政策及法规要求。项目落地后，将进一步优化公司资金使用效率，夯实持续盈利基础，助力公司实现高质量发展目标。

三、本次募集资金投资项目实施的可行性及与主要业务、核心技术之间的关系

（一）本次募集资金投资项目实施的可行性

1、国家鼓励光通信和半导体行业发展，项目具备政策可行性

光通信产业是我国现代化信息基础设施建设的重点领域，属于国家鼓励发展行业，公司产品作为光通信、半导体等领域的重要设备，受到国家产业政策大力推动。近年来，国家出台了一系列政策鼓励光模块产业和集成电路封测产业发展，为光模块领域和半导体封测领域发展提供了财政、税收、技术、人才

等多方面支持。

2021 年和 2022 年，中央网络安全和信息化委员会和国务院先后颁布《“十四五”国家信息化规划》、《“十四五”数字经济发展规划》等政策文件，明确将光通信列为核心发展方向，提出“加速通信网络芯片、器件和设施的产业化应用”“推动 5G 网络、数据中心、物联网等领域光通信技术升级”，为行业构建了广阔的政策支持体系与市场空间。

2023 年，工信部等五部委联合发布的《制造业可靠性提升实施意见》明确要求提升半导体封装设备自主化水平，重点支持高精度贴片机等关键设备的研发突破，并通过专利布局和技术标准制定推动行业规范化发。2024 年，国家发改委发布《国家数据基础设施建设指引》，推动国家枢纽节点和需求地之 400G/800G 高带宽全光连接，传统网络设施优化升级，驱动封装设备向高精度、高集成方向升级。

综上，公司所处的光通信和半导体智能制造装备行业属于国家重点扶持的产业，多年来一直受到国家及相关部门的高度重视。国家良好的宏观政策为公司本次募集资金投资项目的实施提供了积极的外部环境和政策机遇，项目实施具备政策可行性。

2、公司丰富技术积累和行业经验为项目实施奠定基础

公司自成立以来，坚持自主正向研发，主要研发骨干均具有十年以上自动化智能设备研发经验，对设备机械结构及自动化技术拥有较深的理解。同时，公司深耕光模块封装设备领域十年，对光通信领域尤其是光模块产品拥有深刻的理解和认知，对光模块封装设备的运动控制系统、视觉系统及软件等核心构成方面总结了较为丰富的开发设计经验。

经多年积累，公司已攻克掌握高精密运动平台技术、高精度，高动态压力控制技术、脉冲加热技术、视觉引导技术、耦合算法、COC 老化测试技术等核心技术，形成超过 50 项发明专利，并具备光模块封装全流程设备的开发能力。其中贴片、耦合等设备已处于国际或国内领先水平，各项参数指标均处于行业前列。

公司自成立以来便重视人才储备和培养，经过多年的发展和积累，公司已

形成了一支实力强劲的研发队伍。公司研发团队项目研发经验丰富，具备机械控制、光学、材料以及软件等多学科交叉的复合专业背景，可为本次募集资金投资项目的实施奠定坚实的人才基础。

3、优质的客户资源为项目实施提供保障

公司长期深耕光通信等产业，客户资源丰富。公司自成立以来，长期服务于下游龙头厂商，公司设备已广泛应用于中际旭创、索尔思、光迅科技、源杰科技、剑桥科技、客户三、客户四等行业龙头客户和知名企业，与 2025 年光模块全球前十榜单（前十厂商排名来源于 LightCounting）中九家企业形成合作关系。

同时，公司逐步开拓半导体、汽车产业等领域客户，公司产品已应用于客户五、先导科技、士兰微等半导体领域客户，以及索恩格、苏世博、三花智控等全球领先的汽车零部件供应商，强化公司持续经营能力和抗风险能力。

综上，公司优质的客户资源，为项目的顺利实施提供了坚实的市场基础。

（二）本次募集资金投资项目与主要业务、核心技术之间的关系

发行人主要从事光通信、半导体、汽车自动化设备等领域智能生产装备的研发、生产和销售。本次募集资金拟投向的高端智能装备制造建设项目、研发中心建设项目均围绕公司现有主营业务开展。高端智能装备制造建设项目可扩大公司现有产能，提升产品质量，以满足光通信、半导体和汽车产业等下游市场对智能生产装备持续增长的需求；研发中心建设项目进一步提升公司的研发能力，有利于促进公司产品的持续优化、升级，拓展产品应用领域，提升公司在市场中的竞争力。

本次募集资金投资项目紧紧围绕公司的主营业务，用于现有主营业务基础上的产能扩张、研发升级，是公司根据未来发展规划做出的战略性安排。本次募集资金投资项目建成后，能够提高产品生产经营规模与生产效率，提升公司研发实力，优化生产工艺，降低生产成本，提升产品品质与性能，扩充公司产品矩阵和应用领域，进一步提升公司现有产品的创新创造创意性，适应公司业务的快速发展需求和下游行业的技术迭代，从而增强公司的持续盈利能力和整体竞争力。

四、募集资金投资项目具体情况

本次募集资金投资项目的具体运用情况详见本招股意向书“第十二节 附件”之“附件三：募集资金投资项目具体情况介绍”。

五、未来发展规划

（一）发行人的发展战略和目标

公司是国内领先的高端智能装备制造商。自设立以来，公司始终致力于推动高端光模块封装测试设备的国产替代，实现对国际厂商的技术追赶甚至赶超。经过多年的发展和积累，公司产品已覆盖光模块封装测试流程的主要核心环节，包括贴片、耦合、老化测试。公司凭借过硬的产品质量、技术创新能力和高效优质的配套服务能力，成为国内光模块智能制造装备的主要供应商之一，产品得到了国内主流市场的高度认可。

未来，公司将在巩固高精度贴片机、耦合设备等核心产品技术优势的基础上，围绕 800G/1.6T 超高速光模块量产需求与 3.2T 技术演进趋势，构建 "技术研发-产品迭代-产业链延伸" 的一体化发展体系。一方面，公司将聚焦光通信领域，基于硅光、CPO 光电共封装等前沿工艺的技术需求，重点突破激光辅助键合（LAB）、倒装热压、纳米级耦合精度控制、多通道并行贴装等关键技术，研发适配 3.2T 光模块的全制程封装设备。

另一方面，公司将持续扩展产品线和应用领域，加大对集成电路、功率半导体等领域智能装备的研发，加大对 IC 高速固晶贴片设备、高精度倒装贴片设备、TCB 热压键合封装设备、PLP 封装工艺贴片设备等新设备的研发，完善公司的产品布局，增强持续盈利能力。

同时，公司将加强产品质量管控建设以及营销网络建设，努力提升公司产品质量和性能，塑造产品的核心竞争力，通过完善的营销渠道建设进一步提升公司产品市场份额。此外，公司还将加强人才团队建设，构建一批实力强劲、人员稳定以及凝聚力强的人才队伍。

（二）为实现战略目标报告期内已采取的措施及未来规划措施

1、坚持自主研发，持续人才梯队建设

报告期内，公司始终将自主研发与创新作为核心发展引擎，依托在运动控制、机器视觉、软件算法、机械设计等领域积累技术优势，构建了“需求洞察-技术研发-产品落地-服务反馈”的闭环创新体系。公司最近三年累计研发投入为 12,788.88 万元，形成多项发明专利，并以技术诀窍（Know-How）和商业机密的形式保有众多工艺及专有技术。通过持续的研发投入，不断迭代现有产品，延伸产品应用领域至集成电路、功率半导体等其他细分领域，以保持公司的核心竞争力。

为强化人才支撑，公司建立了完善的人才激励机制以吸引优秀技术人才加入公司研发工作，增强公司对研发人员的凝聚力。通过常态化的学习培训，加快研发人员的知识更新和研发人才梯队培养。公司建立了结果导向制的考核机制，对成绩优异的员工给予加薪、绩效奖金、股权激励等激励，调动研发人员的创新积极性。同时，公司积极拓宽人才引进渠道，加强外部人才引进机制的建设。经过多年建设，公司已打造了一支经验丰富的高水平研发团队，并持续吸纳创新人才强化技术力量，为公司在技术创新驱动下实现长期、稳定且高速的发展，构筑了坚实的人才支撑。

2、坚持以客户需求为导向

公司根据自身行业及研发模式的特点，建立了以事业部为基础的研发体系，将各研发部门下沉至各个事业部，以更好的理解和应对下游客户需求变化和行业发展趋势。同时，公司的市场开拓以客户需求为导向，通过收集客户需求以及定期参与市场会议、行业展会，了解市场最新动态，形成销售研发相互配合的高效销售、研发体系。公司注重客户的售后技术服务，客户问题响应及时，最新技术实时反馈从而快速响应市场变化，缩短新产品、新技术的研发及产业化应用周期，为公司的业务拓展打下坚实基础。

3、加强业务拓展，完善产品线布局

报告期内，公司持续推进下游市场开拓和战略客户落地。凭借公司在光通信领域的长期深耕，依托公司卓越的产品品质、持续的技术创新能力及高效优

质的配套服务，公司已成为国内光模块智能制造装备的主要供应商之一，产品获得主流市场高度认可，公司设备已广泛应用于中际旭创、索尔思、光迅科技、源杰科技、剑桥科技、客户三、客户四等行业龙头客户和知名企业，并与 2025 年全球前十光模块厂商（前十厂商排名来源于 LightCounting）中的九家保持良好合作。

在新产品拓展方面，公司依托于现有高精密运动平台技术、高精度高动态压力控制技术、脉冲加热技术、高精度视觉对准技术等核心技术，逐步向半导体行业其他领域拓展。目前公司推出的固晶和共晶设备，可适用于半导体微波射频领域，并实现向客户五等射频行业知名客户批量供货。针对 IC 行业单芯片、多芯片、倒装、倒装热压超声等贴装形式，公司正在开展 IC 高速固晶机、TCB 设备等新设备的研发，部分产品如 TCB 设备已形成样机在客户处验证，公司 SiC 预烧结设备已通过士兰微验证。

（三）未来规划采取的措施

1、多元化融资及资本市场运作规划

若本次公开发行股票顺利落地，公司将严格遵循上市公司规范，充分运用多元融资工具，为业务发展注入持久动能。一方面，高效推进募投项目实施，加速战略规划落地，全面提升研发、服务及核心竞争力；另一方面，依托资本市场平台，适时开展产业链并购整合，通过技术协同、市场协同与规模协同效应，强化技术储备，扩大市场份额，拓展产品应用边界，持续巩固行业领先地位。

2、持续加强技术研发实力，丰富产品矩阵并积极布局前沿领域

研发创新是公司核心竞争力的关键。未来，公司将坚定实施创新驱动战略，持续加大研发投入与技术创新力度。一方面，紧扣行业技术趋势，聚焦光模块封装测试设备核心技术迭代，巩固既有优势；另一方面，深化研发中心建设，优化研发管理机制，加速新技术、新产品、新工艺及软件算法自主研发进程，积极拓展集成电路、功率半导体等领域，通过创新与产业化布局延伸，构建多元化协同发展生态，为可持续增长提供强劲动力。

3、人员培养及招募措施

公司将坚持内部培养与外部引进并重，持续加强人才梯队建设。通过构建科学完善的人才培养、考核及激励体系，提升人才队伍稳定性与可持续性，增强团队凝聚力，为公司发展提供坚实的智力支撑。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内公司治理情况

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东会、董事会和高级管理人员组成的治理结构，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度规则，并建立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个董事会专门委员会。

此外，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于取消公司监事会并制定、修改相关内部治理制度的议案》，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

报告期内，公司治理不存在重大缺陷。

二、内部控制评估意见及审计意见

（一）公司管理层对内部控制的自我评价

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）注册会计师对公司内部控制制度的审计意见

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]215Z0870 号《内部控制审计报告》：“苏州猎奇智能设备股份有限公司于 2026 年 6 月 30 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

三、发行人报告期内违法违规行为的情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规规范运作、依法经营，不存在重大违法违规行为，未受到行政处罚，不存在受到中国证监会、中国境内证券交易所、证券业协会所作出的监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况。

四、报告期资金占用和对外担保情况

（一）资金占用情况

1、基本情况

报告期期初，实际控制人罗超存在未清偿向公司拆借款项情形，具体详见本节之“八、关联交易”之“（二）重大关联交易”之“2、重大偶发性关联交易”部分。

2、整改措施及合规情况

截至报告期末，公司与关联方之间的资金拆借均已得到清偿，不存在任何因资金拆借行为导致的现实或潜在的纠纷。上述资金拆借行为已经公司股东会审议确认并经发行人独立董事认可。同时为规范公司资金拆借行为，公司制定了《关联交易管理制度》及《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》等制度，规定了关联交易决策权限、流程、关联方回避等内容，从制度上规范关联交易，有效保障公司对于资金使用的行为规范。

就规范资金往来和避免资金占用事项，公司控股股东、实际控制人、董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员已出具承诺，详见本招股意向书“第十二节 附件”之“附件一：重要承诺”之“（十二）关于避免资金占用和违规担保的承诺”。

截至报告期末，公司不存在其他资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的财务内控不规范情形。

（二）对外担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

五、独立性

公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了健全的法人治理结构，在资产、人员、机构、财务、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。本公司在资产、人员、机构、财务、业务等方面的独立运行情况如下：

（一）资产完整情况

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

公司目前拥有所有权的资产均在公司的控制和支配之下，与股东之间的资产产权关系清晰，不存在被控股股东或其他关联方控制和占用的情况。

（二）人员独立情况

公司设有独立的人事管理部门，负责人力资源、技能培训、薪酬管理，建立了独立的人事管理制度和规范的薪酬考核体系。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均系公司专职工作人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪的情况。

截至本招股意向书签署日，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立情况

公司按照《公司法》《企业会计准则》等法律法规和规范性文件的要求，设立了独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，制定了符合企业会计准则的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，建立了独立的财务会计核算体系，能够独立作出财务决策。公司独立在银行开户，独立支配自有资金和资产，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立情况

公司设立了股东会、董事会、审计委员会等决策及监督机构，建立了规范的法人治理结构。公司设有独立完整的职能部门，主要包括运营中心、营销中心、支持中心和发展中心等部门，上述部门独立行使经管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同、合署办公的情形。

（五）业务独立情况

公司拥有独立、完整的采购、生产、销售和研发系统。公司直接面向市场独立经营，独立对外签署合同，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行原材料采购或产品销售等情形。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（六）关于发行人主营业务、控制权和管理团队的变动情况

公司主营业务、控制权和管理团队稳定，最近两年内主营业务、董事和高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受实际控制人控制的股东所持公司的股份权属清晰，最近两年实际控制人未发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）影响持续经营的重大事项

公司不存在其他主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险、重大担保、重大诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

（一）与控股股东、实际控制人及其控制企业的同业竞争情况

截至本招股意向书签署日，公司控股股东不存在控制的除本公司及下属子公司以外的其他企业。公司实际控制人控制的法人或其他组织情况如下：

企业	关联关系	主营业务	业务定位及差异分析
昆山市玉山镇弘诚	实际控制人罗超设	模具零件制造；精密	模具销售，与公司不

企业	关联关系	主营业务	业务定位及差异分析
翔模具厂	立，并担任经营者的个体工商户	治工具设计制造；模具标准件销售	属于相同或相似业务
昆山奔博	实际控制人罗超持有49.45%份额，并担任执行事务合伙人	投资	作为员工持股平台，专项持有公司股份，无其他经营业务，与公司不属于相同或相似业务
昆山合鸣	实际控制人罗超持有0.10%份额，并担任执行事务合伙人	投资	专项持有公司股份，无其他经营业务，与公司不属于相同或相似业务

截至本招股意向书签署日，公司实际控制人控制的除本公司及下属子公司以外的其他企业不存在以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似业务的情况，不存在与本公司同业竞争的情况。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东昆山奔博、实际控制人罗超及其一致行动人出具《关于避免同业竞争的承诺》，详见本招股意向书“第十二节 附件”之“附件一：重要承诺”之“（十）关于避免同业竞争的承诺”。

七、关联方与关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》的相关规定，报告期内，公司的关联方及关联关系如下：

（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人

公司控股股东为昆山奔博，实际控制人为罗超。此外，罗超还担任公司股东昆山合鸣的执行事务合伙人，因此昆山合鸣系罗超一致行动人。

序号	关联方	关联方关系
1	昆山奔博	公司控股股东，直接持有公司 36.77%股权并由罗超担任执行事务合伙人的企业
2	罗超	公司实际控制人，直接持有公司 20.63%的股权，并通过担任昆山奔博、昆山合鸣执行事务合伙人分别控制公司 36.77%、0.75%表决权
3	昆山合鸣	直接持有公司 0.75%的股权并由罗超担任执行事务合伙人的企业

（二）其他持股 5%以上股东及其一致行动人

截至报告期末，除控股股东及实际控制人外，发行人其他直接或间接持有公司 5%以上股份的股东为毕延文和徐凯。

序号	关联方	关联方关系
1	毕延文	直接持有公司 8.25%的股权
2	徐凯	通过昆山奔博间接持有公司 6.56%的股权

（三）控股股东及实际控制人控制的其他企业

截至报告期末，控股股东及实际控制人控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织基本情况，详见本节“六、同业竞争”之“（一）与控股股东、实际控制人及其控制企业的同业竞争情况”。

（四）发行人控股子公司

公司控股子公司、参股子公司情况详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人控股子公司、参股公司及分公司”。

（五）发行人董事及高级管理人员

公司现任董事及高级管理人员的具体情况详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“十、董事、高级管理人员及其他核心人员情况”。

（六）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人股东及发行人董事、高级管理人员关系密切的家庭成员

直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人及发行人董事、高级管理人员关系密切的家庭成员也属于发行人的关联方，关系密切的家庭成员包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

（七）直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人、发行人董事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除发行人及其下属公司以外的法人或者其他组织

截至报告期末，除前述主体外，其他直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人、发行人董事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制

的或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除发行人及其下属公司以外的法人或者其他组织情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	昆山市玉山镇弘诚翔模具厂	罗超担任经营者的个体工商户
2	武汉普辉塑料制品有限公司	罗超配偶高贤直接持有 70.00%股权并担任执行董事、总经理的企业
3	昆山市周市镇思博润自动化设备厂	罗超配偶高贤担任经营者的个体工商户
4	苏州正合鼎力企业管理合伙企业（有限合伙）	毕延文持有 21.94%合伙份额并担任执行事务合伙人的企业
5	苏州正合鼎欣企业管理合伙企业（有限合伙）	毕延文持有 13.00%合伙份额并担任执行事务合伙人的企业
6	苏州正合致远投资管理合伙企业（有限合伙）	毕延文持有 80.00%合伙份额并担任执行事务合伙人的企业
7	苏州正合鼎越企业管理合伙企业（有限合伙）	毕延文持有 1.95%合伙份额并担任执行事务合伙人的企业
8	苏州榕创企业管理合伙企业（有限合伙）	毕延文持有 3.33%合伙份额并担任执行事务合伙人的企业
9	迈时光电	毕延文直接持有 25.49%股权且拥有控制权，并担任董事长、总经理的企业
10	苏州泰斯凯光电科技有限责任公司	迈时光电的全资子公司
11	GOOLIGHT PTE. LTD.	苏州泰斯凯光电科技有限责任公司的全资子公司
12	Goo-light Optoelectronics Co.,Ltd.	迈时光电持有 0.01%股权，GOOLIGHT PTE.LTD.持有 99.99%股权的企业
13	众恒光电	迈时光电的全资子公司
14	陕西正合	迈时光电的全资子公司
15	成都晶砺微纳科技有限公司（已更名为成都迈时光电有限公司）	迈时光电的全资子公司
16	苏州古莱光学科技有限公司	迈时光电的全资子公司
17	珠海迈时	迈时光电的全资子公司
18	苏州迈时	珠海迈时的全资子公司
19	西安正奇	毕延文持有 80.00%合伙份额并担任执行事务合伙人、毕延文配偶李侠持有 20.00%合伙份额的合伙企业
20	珠海智博驿科技合伙企业（有限合伙）	毕延文持有 16.62%的合伙份额并担任执行事务合伙人的企业
21	苏州众为光电有限公司	迈时光电的全资子公司
22	成都飞锐特科技有限公司	迈时光电的全资子公司
23	成都威晶科技有限责任公司	成都飞锐特科技有限公司的全资子公司

序号	关联方名称	关联关系
24	苏州识光芯科技术有限公司	毕延文配偶李侠持有 10.51%股权并担任董事的企业
25	苏州岚创科技有限公司	毕延文配偶李侠持有 25.00%股权并担任执行董事的企业
26	苏州枫桥光电科技有限公司	毕延文配偶李侠持有 48.50%股权并拥有控制权的企业
27	苏州光子封装测试技术有限公司	毕延文配偶李侠担任董事长的企业，且为苏州枫桥光电科技有限公司的控股子公司
28	苏州众成光电科技有限公司	苏州枫桥光电科技有限公司的控股子公司
29	苏州市智诚拍卖有限公司	张莉持有 20.00%股权，张莉父亲张晓东持有 80%股权并担任执行董事的企业
30	吴江市东亚大理石建筑装璜厂	张莉父亲张晓东持有 100.00%股权的企业
31	苏州市恒大建筑装饰广告有限公司	张莉父亲张晓东持有 70.00%股权并担任执行董事的企业
32	吴江市松陵镇聚福楼酒店	张莉父亲张晓东担任经营者的个体工商户
33	苏州市浩义为财税咨询有限公司	张莉配偶陈东陈持有 50.00%股权并担任执行董事、总经理，张莉母亲徐明芬持有 50.00%股权的企业
34	吴江市松陵镇鲈乡南路东亚宾馆	张莉母亲徐明芬担任经营者的个体工商户

（八）其他关联方

除上述已披露的关联方之外，发行人的其他关联方还包括根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的，或者在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，视同发行人的关联方。上述关联方的具体情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	昆山博阅诚	实际控制人罗超持有 22.50%合伙份额并担任执行事务合伙人、徐凯持有 20.00%合伙份额、毕延文持有 12.50%合伙份额、陈文杰持有 5.00%合伙份额的企业，已于 2024 年 11 月注销
2	昆山美满	实际控制人罗超曾担任其执行事务合伙人，已于 2024 年 3 月卸任
3	苏州海笔斯技术合伙企业（有限合伙）	毕延文配偶李侠持有 99.00%合伙份额的企业
4	苏州正奇永信企业管理合伙企业（有限合伙）	毕延文持有 80.00%合伙份额并担任执行事务合伙人，毕延文配偶李侠持有 20.00%合伙份额的企业，已于 2023 年 12 月注销
5	苏州融享赋信创业投资合伙企业（有限合伙）	毕延文通过苏州正奇永信企业管理合伙企业（有限合伙）持有 66.60%合伙份额的企业，已于 2023 年 6 月注销
6	苏州青木光电有限公司	毕延文通过伽蓝致远持有 60.00%股权的企业，已于 2023 年 7 月注销

序号	关联方名称	关联关系
7	上海洛骞企业管理咨询中心	毕延文配偶李侠的个人独资企业，已于 2022 年 7 月注销
8	苏州众得光电科技有限公司	毕延文配偶李侠控制的苏州枫桥光电科技有限公司持股 100%的公司，已于 2025 年 7 月退出持股
9	识光芯科（上海）技术有限公司	苏州识光芯科技术有限公司全资子公司
10	识光芯科（无锡）技术有限公司	苏州识光芯科技术有限公司全资子公司
11	陈庆东	曾任公司监事，已于 2026 年 5 月离任
12	胡雪萍	曾任公司监事，已于 2026 年 5 月离任

注：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于取消公司监事会并制定、修改相关内部治理制度的议案》，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。陈庆东、胡雪萍因此离任。

（九）报告期内发行人关联方变化情况

报告期内，公司的关联方变化主要系部分关联方法人注销，具体情况详见本节“七、关联方与关联关系”之“（八）其他关联方”。

八、关联交易

（一）关联交易总体情况

报告期内，公司关联交易汇总情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易时间
经常性关联交易	向关联方销售商品	2023 年-2026 年 1-6 月
	关键管理人员薪酬	2023 年-2026 年 1-6 月
偶发性关联交易	向关联方购买商品	2023 年-2024 年
	向关联方租赁	2023 年-2024 年
	关联担保	2023 年-2026 年 1-6 月
	向关联方收购股权	2023 年-2024 年
	关联方资金拆借	2023 年-2024 年

报告期内，公司关联交易主要为关键管理人员薪酬、关联方销售、关联方租赁、关联方资金拆借等交易。参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》应当披露的关联交易标准并结合实际经营情况，公司重大关联交易的判断标准如下：

1、年度与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万元以上的交易（公司提供担保除外）；

2、年度与关联法人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易（公司提供担保除外）。

此外，关键管理人员薪酬为公司正常经营活动的必要支出，归类为一般关联交易。

（二）重大关联交易

1、重大经常性关联交易

报告期内，公司未发生重大经常性关联交易。

2、重大偶发性关联交易

报告期内，公司重大偶发性关联交易包括关联方资金拆借、关联方担保。具体情况如下：

（1）关联方借款

①资金拆出

2022 年以前，罗超、宋玉华基于自身需要，从公司拆出资金。公司于报告期内对上述资金拆借款进行了清理，具体如下：

单位：万元

往来方	年度	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
罗超	2023	948.70	44.11	992.81	-
宋玉华	2023	15.98	0.53	4.00	12.51
	2024	12.51	0.16	12.67	-

②资金拆入

单位：万元

往来方	年度	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
昆山博阅诚	2023	162.00	200.00	362.00	-

凯欧光电原先系实控人罗超控制的公司，2022 年开始从事机加工业务，因有资金需求，因此向原股东昆山博阅诚拆入资金用于公司日常经营。后续为消

除同业竞争和减少关联交易，发行人于 2023 年 12 月将凯欧光电全资收购，凯欧光电偿还了所欠原股东的拆借款。

（2）关联担保

报告期内，公司关联方为公司授信提供的担保情况如下表所示：

单位：万元

担保方	担保金额	合同约定担保期限	主债务是否清偿
罗超	1,980.00	债权人在 2025 年 4 月 29 日至 2027 年 4 月 29 日的期间向债务人连续提供一类或几类授信，前述授信的累计未清偿余额在债权发生期间内最高不能超过 1,980 万元人民币	否
罗超	2,400.00	担保期限为主合同下债务履行期限届满之日起三年，主合同下债务履行期限届满之日为 2022 年 4 月 21 日、2023 年 4 月 11 日	是
高贤	2,400.00	担保期限为主合同下债务履行期限届满之日起三年，主合同下债务履行期限届满之日为 2022 年 4 月 21 日、2023 年 4 月 11 日	是
罗超	3,000.00	担保书生效之日（2022 年 5 月 24 日）起至《授信协议》项下每笔货款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止	是
高贤	3,000.00	担保书生效之日（2022 年 5 月 26 日）起至《授信协议》项下每笔货款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止	是
罗超	500.00	担保期限为债务履行期限届满之日起三年，债务履行期限届满之日为 2023 年 11 月 24 日	是
罗超	100.00	担保期限为债务履行期限届满之日起三年，债务履行期限届满之日为 2024 年 12 月 18 日	是
罗超	500.00	担保期限为债务履行期限届满之日起三年，债务履行期限届满之日为 2024 年 12 月 18 日	是
罗超	3,000.00	对在 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同而产生的一系列债务进行担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算	是

关联方为公司相关授信提供的均为无偿担保，且关联方未实际承担担保责任，因此相关交易对公司经营情况不存在实际影响。

（三）一般关联交易

1、一般经常性关联交易

报告期内，公司一般经常性关联交易包括向关联方销售商品及提供劳务、向关联方采购商品及接受劳务、支付关键管理人员薪酬，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	交易性质	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员	支付薪酬	经常性	352.31	643.24	475.87	319.70
珠海迈时	出售商品	经常性	0.42	42.00	-	-
迈时光电	出售商品	经常性	172.82	240.19	36.99	11.99
陕西正合	出售商品	经常性	0.53	5.45	2.15	1.97
众恒光电	出售商品	经常性	144.57	1.82	8.66	11.83
Goo-light Optoelectronics Co.,Ltd.	出售商品	经常性	0.53	-	-	-

注：迈时光电、陕西正合、众恒光电、珠海迈时、Goo-light Optoelectronics Co.,Ltd.系毕延文同一控制下的企业。

迈时光电及其下属子公司陕西正合、众恒光电、珠海迈时主营光学元器件、元组件的生产、研发及销售。报告期内，除各年有零星治具、机加工件销售外，公司主要向迈时光电销售设备。报告期内，公司向陕西正合主要销售治具、机加工件，金额较小。2026 年 1-6 月，公司向众恒光电销售一台贴片设备，用于元器件贴片，除此之外，报告期内，公司向众恒光电主要销售治具、机加工件，金额较小。报告期内，公司向珠海迈时销售耦合设备一台，用于元器件的耦合。报告期内，公司向 Goo-light Optoelectronics Co.,Ltd.零星销售配件，金额较小。

2、一般偶发性关联交易

报告期内公司一般偶发性关联交易包括向关联方收购、租赁设备，向关联方收购股权，采购关联方设备等，具体情况如下：

（1）关联方借款

①资金拆出

单位：万元

往来方	年度	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
GOOLIGHT	2024	-	143.25	143.25	-

往来方	年度	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
PTE. LTD.					

2024 年，关联方 GOOLIGHT PTE. LTD.因自身资金周转需求，向新加坡芯泰借款 20.00 万美金（对应 142.54 万元人民币），后续 GOOLIGHT PTE. LTD.将该笔款项还款给新加坡芯泰并支付对应利息。

②资金拆入

单位：万元

往来方	年度	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
高贤	2023	6.58	-	6.58	-
宋玉华	2023	-	0.10	-	0.10
	2024	0.10	-	0.10	-

报告期期初，凯欧光电欠高贤拆借款 6.58 万元，2023 年凯欧光电将所欠高贤款项予以归还。

（2）关联方收购

关联方	关联交易内容	2026 年 1-6 月发生额	2025 年度发生额	2024 年度发生额	2023 年度发生额
罗超	向关联方购买凯欧光电 60%的股权	-	-	-	66.67
昆山博阅诚	向关联方购买凯欧光电 40%股权	-	-	-	53.33
罗超	向关联方购买泰国飞泰 49.9950%及 0.0050%股权	-	-	0.00	0.00
宋玉华	向关联方购买泰国飞泰 50.00%股权	-	-	-	0.00

为消除同业竞争和减少关联交易，公司于 2023 年底将凯欧光电全资收购。凯欧光电主要从事机加工业务。根据江苏普信资产评估房地产土地有限公司出具的苏普评报字（2023）第 104 号《评估报告》，凯欧光电评估值 120.00 万元。收购价格参照评估值，并由公司分别向罗超、昆山博阅诚支付了款项。

泰国飞泰于 2023 年 8 月 29 日设立，设立时罗超、宋玉华各持有其 50%股份。2023 年 8 月 30 日，罗超、宋玉华分别将其持有的泰国飞泰 49.9950%、50%股份转让给公司的全资子公司新加坡芯泰。因罗超、宋玉华均未对泰国飞泰实际出资，故本次股份转让的价格均为 0 元。泰国当地法律规定公司至少存在两

名股东，故本次股权转让完成后，罗超仍持有泰国飞泰 0.0050%股份。2024 年 4 月 30 日，罗超将其持有的 0.0050%股权转让给公司。因罗超未对泰国飞泰实际出资，故本次股份转让的价格为 0 元。本次转让完成后，公司全资控股泰国飞泰。

（3）关联租赁及采购

单位：万元

关联方	关联交易内容	交易性质	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
众恒光电	租赁设备	偶发性	-	-	24.00	36.00
众恒光电	购买设备	偶发性	-	-	176.99	0.88

凯欧光电于 2022 年开始从事机加工业务，因众恒光电有部分闲置机加工设备，因此向众恒光电租赁了部分设备。公司于 2023 年底将凯欧光电进行了全资收购，为保障凯欧光电的持续经营能力，并减少关联交易，凯欧光电于 2024 年购买了原先向众恒光电租赁的设备。

（四）报告期内公司主要关联方往来余额情况

单位：万元

关联方名称	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	应收账款			
迈时光电	124.10	72.71	1.40	22.26
陕西正合	0.60	6.16	1.66	2.22
众恒光电	5.00	2.06	0.67	17.25
珠海迈时	4.75	-	-	-
Goo-light Optoelectronics Co.,Ltd.	0.56	-	-	-
关联方名称	合同负债			
迈时光电	92.92	51.23	36.59	9.08
众恒光电	-	42.48	-	-
关联方名称	应付账款			
众恒光电	-	-	-	54.60
关联方名称	其他应收款			
宋玉华	-	-	-	12.51
关联方名称	其他应付款			

宋玉华	-	-	-	0.10

（五）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司具有独立、完整的研发、采购和销售体系，生产经营不依赖关联方。公司不存在重大经常性关联交易。公司重大偶发性关联交易主要为关联方资金拆借及关联方担保。公司一般关联交易主要为向关键管理人员支付薪酬及少量购销交易，金额较小。上述关联交易遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司及其他非关联股东利益的情况，亦不存在利用关联交易转移利润的情形，对公司经营成果和主营业务不构成重大影响。

（六）报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见

股份公司设立以前，公司的关联交易根据执行相关决议或相关合同进行，关联交易的发生符合公司当时的业务需求，关联交易定价参考了相关市场价格。

股份公司设立以后，公司关联交易严格履行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》等规定的权限和程序，不存在损害中小股东利益的情形。2025 年 10 月 25 日，公司召开第一届董事会第五次会议、第一届监事会第五次会议，2025 年 11 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，对公司在 2022 年至 2025 年 1-6 月的关联交易进行了确认，关联董事、关联股东已回避表决。2026 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》，对 2025 年度的关联交易进行了确认，关联董事已回避表决。

报告期内，公司独立董事根据《独立董事工作制度》对公司相关关联交易进行审议并发表独立意见，确认了公司关联交易没有损害公司及其全体股东的权益。独立董事已就此召开独立董事专门会议，全体独立董事认为：公司在 2022 年至 2025 年的关联交易履行了相关决策程序或已经其他非关联股东认可，符合《公司章程》等有关制度的规定，关联交易的发生有其必要性，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，未偏离市场独立第三方的价格，不存在显失公平以及损害发行人和其他非关联股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。

（七）规范和减少关联交易的措施

公司已制定了相关的关联交易决策制度，对关联交易的决策程序、审批权限进行了约定。公司及各关联方将严格遵守相关规范，进一步规范和减少关联交易。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，详见本招股意向书“第十二节 附件”之“附件一：重要承诺”之“（十一）关于减少和规范关联交易的承诺”。

九、其他参照关联交易披露的交易

根据相关规定，中际旭创不属于发行人的关联方。但考虑到中际旭创员工曾经间接持有发行人股份，持股比例较低且已于 2024 年内退出，基于谨慎性原则，发行人对报告期内与中际旭创的交易情况比照关联交易披露，具体如下：

（一）交易情况

报告期内，发行人主要向中际旭创销售光模块封装测试设备，具体如下：

单位：万元

客户名称	交易内容	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
中际旭创	销售商品	37,682.31	64.81%	37,277.97	53.42%	31,949.52	58.85%	17,985.30	62.19%

公司获取中际旭创的业务时，均采用公开、公平的市场化手段或方式。中际旭创发起采购需求，要求各家供应商报价，中际旭创结合供应商资质针对产品价格进行对比，通过审批后发起采购。公司与中际旭创的交易定价系综合考虑产品技术规格、采购规模、交付要求、市场竞争情况等因素，经双方公平谈判后确定。公司与中际旭创的业务合作均通过规范的商业合同进行约定。综上所述，公司与中际旭创之间的交易具有公允性，不存在利益输送行为。

（二）应收应付款项余额

单位：万元

科目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	15,331.46	6,827.40	2,174.26	9,411.40
合同负债	69,692.20	30,332.93	25,254.11	19,300.95

（三）对公司业务的影响

公司自设立以来专注于光通信行业的封装设备，与中际旭创已有近 10 年的合作历史，与中际旭创保持了长期稳定的合作关系。依托公司在运动控制、光学视觉、自动化控制软件及设备机械结构等领域的深耕积累和自主创新，2016 年公司向中际旭创交付首台耦合设备，2017 年公司向中际旭创交付首台老化测试设备，2019 年公司向中际旭创交付首台共晶贴片设备，2020 年公司向中际旭创交付首台固晶贴片设备，助推客户降本增效、提升工艺技术，实现自动化、智能化和高效化生产，成为中际旭创封装设备的主要供货商。中际旭创作为光模块行业的全球龙头企业（根据 LightCounting 的数据，2025 年全球前十光模块供应商中中际旭创排名第一），采购发行人的设备主要系对发行人设备的认可，且随着数据中心、AI 算力对光模块需求爆发性增长，中际旭创为了满足全球光模块不断增加的需求持续加大资本开支力度，对上游封测设备的需求不断增加，从而对发行人设备的需求不断提升。因此，发行人与中际旭创的合作具有合理的商业背景和稳定的商业预期。

第九节 投资者保护

一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司首次公开发行股票前的滚存利润，由发行后的新、老股东按持股比例共享。

二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及本次发行后的股利分配政策

（一）本次发行前后股利分配政策的差异情况

本次发行前后股利分配政策的差异主要在于进一步完善了发行上市后的利润分配政策。发行后的股利分配政策明确了现金分红的条件和比例、利润分配方案的决策程序和机制、制定股东回报规划的相关要求以及利润分配的信息披露要求等。

（二）本次发行后的股利分配政策和决策程序

经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司于《公司章程（草案）》中约定了公司本次发行后的股利分配政策：

1、利润分配的原则

公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提，在相关法律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

2、利润分配的形式

公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的方式。

在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。

用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因

素。

公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或者经营性现金流量净额为负，可以不进行利润分配。

3、现金分红的条件

公司现金分红须同时满足下列条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计未分配利润期末余额为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指下列情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、现金分红的比例

在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

在制定现金分红政策时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

5、发放股票股利的条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。

6、利润分配的期间间隔

在满足利润分配条件的前提下，公司原则上每年进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

7、利润分配的决策机制、决策程序和监督机制

（1）公司的利润分配方案由高级管理人员根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来经营计划等因素草拟后提交董事会审议。利润分配方案经董事会审议通过后提交股东会审议。

（2）利润分配方案的制定或修改须经董事会审议通过后提交股东会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发

表明确意见，并督促其及时改正。

（3）股东会应当根据法律、法规和本章程的规定对经董事会审议通过的利润分配方案进行审议表决。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过电话、信息网络等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（4）公司因发生本章程规定的特殊事项而不进行年度现金分红的，董事会应当就不进行现金分红的具体原因、为增强投资者回报水平拟采取的举措等事项进行专项说明，并在公司指定媒体上予以披露。

（5）公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

（6）出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

8、利润分配政策的调整机制

公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，导致公司当年利润较上年下降超过 20%或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，确需调整或变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，分红政策调整或变更方案经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。审议利润分配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

9、公司未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资，以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

（三）董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况及安排理由

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司拟订了《苏州猎奇智能设备股份有限公司上市后三年分红回报规划》。

本规划制定的基本原则如下：公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识。公司保持持续、稳定的利润分配政策，股利分配方案应从公司盈利情况、战略发展等实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。

本规划制定的考虑因素如下：分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点、资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

（四）发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排

根据公司制定的《苏州猎奇智能设备股份有限公司上市后三年分红回报规划》，在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。现金分红的具体条件、比例和期间间隔等内容与《公司章程（草案）》规定一致，具体内容详见本节之“二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及本次发行后的股利分配政策”之“（二）本次发行后的股利分配政策和决策程序”。

（五）公司长期回报规划内容及制定考虑因素

公司将着眼于长远和可行性发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的稳定性和连续性。

根据《苏州猎奇智能设备股份有限公司上市后三年分红回报规划》，公司

应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应当在总结三年以来公司股东回报规划的执行情况的基础上，充分考虑分红规划制定考虑的各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。

公司长期回报规划的内容详见本节“二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及本次发行后的股利分配政策”之“（二）本次发行后的股利分配政策和决策程序”及“（四）发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排”。

三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排、累计未弥补亏损的情况

截至本招股意向书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情形。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

本部分所列示的重大合同，是指对公司报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的已履行、正在履行和将要履行的合同。

（一）销售合同

报告期内，公司与主要客户签订的已履行完毕或正在履行的合同金额达到5,000 万元的重大销售订单/合同的或者各期与前五大客户签订的最大一笔订单/合同的具体情况如下：

单位：万元

序 号	合同对方	合同标的	合同金额（含税）	合同签订时间	合同执行情况
1	中际旭创	光模块封装测试设备	36,459.22	2026年6月	正在履行
2	中际旭创	光模块封装测试设备	36,386.00	2026年3月	正在履行
3	中际旭创	光模块封装测试设备	22,898.32	2026年4月	正在履行
4	中际旭创	光模块封装测试设备	21,436.10	2026年6月	正在履行
5	中际旭创	光模块封装测试设备	17,807.67	2026年3月	正在履行
6	中际旭创	光模块封装测试设备	15,694.12	2026年3月	正在履行
7	中际旭创	光模块封装测试设备	10,876.71	2026年3月	正在履行
8	中际旭创	光模块封装测试设备	9,944.00	2026年6月	正在履行
9	中际旭创	光模块封装测试设备	8,651.28	2026年6月	正在履行
10	中际旭创	光模块封装测试设备	7,607.16	2026年3月	正在履行
11	剑桥科技	光模块封装测试设备	7,271.55	2026年6月	正在履行
12	中际旭创	光模块封装测试设备	6,864.75	2026年3月	正在履行
13	中际旭创	光模块封装测试设备	6,051.15	2026年3月	正在履行
14	中际旭创	光模块封装测试设备	5,779.95	2026年1月	正在履行
15	中际旭创	光模块封装测试设备	5,324.56	2026年6月	正在履行
16	光迅科技	光模块封装测试设备	5,316.00	2026年3月	正在履行
17	剑桥科技	光模块封装测试设备	5,288.40	2026年2月	正在履行
18	中际旭创	光模块封装测试设备	5,274.66	2026年3月	正在履行
19	东山精密	光模块封装测试设备	3,522.55	2026年4月	正在履行
20	钧恒科技	光模块封装测试设备	3,307.00	2026年5月	正在履行
21	牧野汽车	配件	265.81	2026年4月	正在履行

序 号	合同对方	合同标的	合同金额（含税）	合同签订时间	合同执行情况
22	中际旭创	光模块封装测试设备	17,667.55	2025 年 12 月	正在履行
23	中际旭创	光模块封装测试设备	16,140.92	2025 年 11 月	正在履行
24	中际旭创	光模块封装测试设备	15,112.62	2025 年 12 月	正在履行
25	中际旭创	光模块封装测试设备	12,265.02	2025 年 9 月	正在履行
26	中际旭创	光模块封装测试设备	8,384.60	2025 年 11 月	正在履行
27	索恩格	自动化设备及整线解决方案	2,922.18	2025 年 1 月	履行完毕
28	索尔思	光模块封装测试设备	5,954.52	2025 年 10 月	正在履行
29	苏世博	自动化设备及整线解决方案	775.18	2025 年 7 月	履行完毕
30	客户五	光模块封装测试设备	640.03	2025 年 2 月	履行完毕
31	苏世博	自动化设备及整线解决方案	791.00	2024 年 12 月	履行完毕
32	客户五	半导体封装测试设备	300.58	2024 年 10 月	履行完毕
33	中际旭创	光模块封装测试设备	6,441.00	2024 年 7 月	正在履行
34	光迅科技	光模块封测设备	1,600.00	2024 年 6 月	履行完毕
35	索恩格	自动化设备及整线解决方案	1,184.24	2024 年 5 月	履行完毕
36	中际旭创	光模块封装测试设备	8,271.60	2024 年 4 月	履行完毕
37	索恩格	自动化设备及整线解决方案	2,324.86	2023 年 11 月	履行完毕
38	中际旭创	光模块封装测试设备	7,300.03	2023 年 11 月	正在履行
39	中际旭创	光模块封装测试设备	5,369.76	2023 年 8 月	履行完毕
40	牧野汽车	配件	347.01	2023 年 3 月	履行完毕
41	源杰科技	光模块封装测试设备	630.00	2023 年 1 月	履行完毕
42	客户五	半导体封装测试设备	792.00	2023 年 1 月	履行完毕

（二）采购合同

报告期内，公司与主要供应商签订的已履行完毕或正在履行的合同金额达到 300 万元的重大采购合同具体情况如下：

单位：万元

序号	合同对方	合同标的	合同金额	合同签订时间	合同执行情况
1	星微科技	运动控制平台、驱动系统	440.00	2023 年 11 月	履行完毕
2	南央国际	电动滑台	340.43	2023 年 11 月	履行完毕
3	星微科技	运动控制平台、驱动系统	440.00	2023 年 11 月	履行完毕

序号	合同对方	合同标的	合同金额	合同签订时间	合同执行情况
4	星微科技	运动控制平台、驱动系统	418.00	2023 年 11 月	履行完毕
5	星微科技	运动控制平台、驱动系统	352.00	2023 年 10 月	履行完毕
6	上海骏煦	滑台	540.00	2023 年 9 月	履行完毕
7	星微科技	运动控制平台、驱动系统	880.00	2023 年 8 月	履行完毕
8	星微科技	模组、驱动器、工控机模块	320.00	2025 年 7 月	履行完毕
9	上海坤刻国际贸易有限公司	滑台	440.00	2025 年 8 月	履行完毕
10	津微光电	滑台	338.00	2025 年 9 月	履行完毕
11	南央国际	滑台	418.00	2025 年 9 月	履行完毕
12	上海坤刻国际贸易有限公司	滑台	326.00	2025 年 10 月	履行完毕
13	上海坤刻国际贸易有限公司	滑台	392.40	2025 年 11 月	履行完毕
14	上海坤刻国际贸易有限公司	滑台	760.00	2025 年 11 月	履行完毕
15	上海坤刻国际贸易有限公司	滑台	354.28	2025 年 12 月	履行完毕
16	南京派格测控科技有限公司	光芯片性能测试系统	2,293.56	2025 年 12 月	履行完毕
17	北京拓普光研科技发展有限公司	光谱分析仪	1,300.00	2025 年 12 月	正在履行
18	北京艾宇光电科技有限公司	驱动板	336.68	2026 年 3 月	履行完毕
19	北京艾宇光电科技有限公司	驱动板	336.68	2026 年 3 月	履行完毕
20	北京艾宇光电科技有限公司	驱动板	336.68	2026 年 3 月	履行完毕
21	北京艾宇光电科技有限公司	驱动板	505.02	2026 年 3 月	履行完毕
22	北京艾宇光电科技有限公司	驱动板等	380.41	2026 年 3 月	正在履行
23	北京艾宇光电科技有限公司	驱动板等	599.47	2026 年 3 月	履行完毕
24	北京艾宇光电科技有限公司	驱动板等	380.41	2026 年 3 月	履行完毕
25	奥普瑞	加工件	405.00	2026 年 3 月	履行完毕
26	奥普瑞	加工件	396.73	2026 年 3 月	履行完毕
27	奥普瑞	加工件	384.97	2026 年 3 月	履行完毕
28	大途电子（上海）有限公司	元件	594.00	2026 年 3 月	履行完毕
29	大途电子（上	元件	660.00	2026 年 3 月	履行完毕

序号	合同对方	合同标的	合同金额	合同签订时间	合同执行情况
	海）有限公司				
30	德瑞精工（深圳）有限公司	滑台	1,170.00	2026 年 2 月	履行完毕
31	东莞鼎企智能自动化科技有限公司	滑台	375.75	2026 年 2 月	履行完毕
32	湖南锐创智能装备有限公司	非标组件/套件	510.76	2026 年 3 月	正在履行
33	湖南智宇科教设备有限公司	驱动控制类	701.48	2026 年 4 月	履行完毕
34	武汉环试测设备有限公司	加工件	347.00	2026 年 2 月	正在履行
35	武汉环试测设备有限公司	加工件等	490.60	2026 年 5 月	正在履行
36	昆山胜和鑫精密机电有限公司	滑台	780.00	2026 年 3 月	履行完毕
37	上海四达全轴承有限公司	线轨	404.08	2026 年 1 月	正在履行
38	上海四达全轴承有限公司	线轨	450.44	2026 年 6 月	正在履行
39	苏州天瀚精密机械有限公司	滑台	469.50	2026 年 6 月	正在履行
40	苏州沃克莱智能科技有限公司	非标组件/套件	780.00	2026 年 6 月	正在履行
41	星微科技	运动控制平台、驱动系统	310.00	2026 年 4 月	履行完毕
42	星微科技	运动控制平台、驱动系统	310.00	2026 年 4 月	履行完毕
43	星微科技	运动控制平台、驱动系统	310.00	2026 年 4 月	履行完毕
44	星微科技	运动控制平台、驱动系统	310.00	2026 年 4 月	履行完毕
45	星微科技	运动控制平台、驱动系统	310.00	2026 年 4 月	履行完毕
46	星微科技	运动控制平台、驱动系统	310.00	2026 年 4 月	履行完毕
47	星微科技	运动控制平台、驱动系统	310.00	2026 年 4 月	履行完毕
48	东莞中探探针有限公司昆山分公司	探针	855.04	2026 年 3 月	履行完毕
49	苏州钧信自动控制有限公司	传感器类	484.10	2026 年 6 月	正在履行
50	苏州钧信自动控制有限公司	驱动控制类	359.63	2026 年 6 月	正在履行
51	苏州康巨富自动化设备有限公司	线轨等	1,176.00	2026 年 3 月	正在履行

序号	合同对方	合同标的	合同金额	合同签订时间	合同执行情况
52	苏州康巨富自动化设备有限公司	线轨等	306.00	2026 年 4 月	正在履行
53	昆山市科波达智能科技有限公司	线轨	332.90	2026 年 6 月	正在履行
54	昆山市科波达智能科技有限公司	线轨	421.00	2026 年 6 月	正在履行
55	上海坤刻国际贸易有限公司	滑台	395.00	2026 年 4 月	正在履行
56	上海坤刻国际贸易有限公司	滑台	474.00	2026 年 4 月	正在履行
57	上海坤刻国际贸易有限公司	滑台	395.00	2026 年 4 月	正在履行
58	无锡市莫尼耳自动化工程有限公司	电源	379.60	2026 年 4 月	履行完毕
59	昆山纳博旺精工科技有限公司	滑台	390.00	2026 年 3 月	正在履行
60	上海诺银机电科技有限公司	电机、线缆	306.38	2026 年 3 月	履行完毕
61	南京派格测控科技有限公司	测量仪器	764.52	2026 年 4 月	履行完毕
62	苏州秋奥光电科技有限公司	滑台	312.80	2026 年 1 月	正在履行

（三）借款合同和授信合同

报告期内，公司不存在已履行完毕的，或截至 2026 年 6 月 30 日正在履行的达到 3,000 万元的重大借款合同。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司正在履行的达到 3,000 万元的重大授信合同如下：

序号	额度授予人	合同类型	合同金额（万元）	贷款/授信期限	履行情况
1	招商银行股份有限公司苏州分行	授信	10,000.00	2026/5/22-2029/5/21	正在履行
2	武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行	授信	8,000.00	2026/6/18-2028/6/16	正在履行

报告期内，公司已履行完毕的达到 3,000 万元的重大授信合同如下：

序号	额度授予人	合同类型	合同金额（万元）	贷款/授信期限	履行情况
1	招商银行股份有限公司苏州分行	授信	3,000.00	2022/3/18-2023/3/17	履行完毕

二、对外担保情况

截至本招股意向书签署日，发行人不存在对外担保情况。

三、重大诉讼与仲裁事项

（一）公司重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署日，公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

发行人存在 2 项其他专利诉讼，具体情况如下：

1、MRSI 诉讼

（1）案件基本情况

2025 年 5 月，MRSI 以公司销售的产品侵犯了 MRSI 的 ZL201680048482.5 号发明专利为由，将公司诉至深圳市中级人民法院，诉请法院：（1）判令公司立即停止侵犯原告第 ZL201680048482.5 号发明专利权的行为，包括并不限于停止制造、使用、销售、许诺销售侵害第 ZL201680048482.5 号发明专利权的产品的行为；（2）判令公司赔偿因其侵权行为给 MRSI 造成的经济损失及 MRSI 为制止侵权行为所支付的合理支出人民币共计 2,000 万元；（3）判令公司承担本案的全部诉讼费用。深圳市中级人民法院于 2025 年 6 月立案，案由为侵犯发明专利权纠纷，案号为（2025）粤 03 民初 7154 号。

2026 年 6 月 30 日，深圳市中级人民法院出具民事判决书（（2025）粤 03 民初 7154 号），法院认定原告 MRSI 主张的侵权事实不能成立，对原告 MRSI 的诉讼请求不予支持。本案一审判决驳回原告 MRSI 的全部诉讼请求，案件受理费 141,800 元全部由原告 MRSI 负担。

2026 年 10 月 15 日，发行人收到《中华人民共和国最高人民法院上诉案件应诉通知书》（（2026）最高法知民终 692 号），中华人民共和国最高人民法院已受理 MRSI 的上诉申请。其中 MRSI 的上诉请求主要包括：（1）判令依法撤销一审判决,并改判被上诉人构成对上诉人涉案专利的侵权，判令被上诉人立即停止所有侵犯上诉人第 ZL201680048482.5 号发明专利权的行为;（2）判令被

上诉人赔偿因其侵权行为给上诉人造成的经济损失及上诉人为制止侵权行为所支付的合理支出人民币共计 2,000 万元，并承担本案一审、二审诉讼费用。

截至本招股意向书签署日，该案件尚在审理中。

（2）该案件对发行人的影响

2026 年 6 月 30 日，深圳市中级人民法院出具民事判决书（（2025）粤 03 民初 7154 号），法院认定原告 MRSI 主张的侵权事实不能成立，对原告 MRSI 的诉讼请求不予支持。该案件一审判决驳回原告 MRSI 的全部诉讼请求。

鉴于一审判决情况，本案预计不会对公司本次发行上市构成实质性障碍。

2、先进香港诉讼

（1）案件基本情况

2025 年 9 月，ASMPT 全资子公司先进香港以公司制造、销售和许诺销售的产品侵犯了其的 ZL200610161194.9 号发明专利为由，将公司诉至苏州市中级人民法院，诉请法院：（1）判令被告苏州猎奇智能设备股份有限公司立即停止制造、销售和许诺销售侵权产品的侵权行为；（2）判令被告赔偿原告经济损失以及原告因调查和制止被告侵权行为而支出的合理费用共计人民币 500 万元；（3）判令被告承担本案的诉讼费。

2025 年 11 月，公司向国家知识产权局提交《专利权无效宣告请求》，请求国家知识产权局宣告涉案专利权利要求 1-3 无效，该《专利权无效宣告请求》已被国家知识产权局签收。2026 年 2 月，公司以不同的证据组合形式，再次向国家知识产权局提交《专利权无效宣告请求书》并获受理，请求国家知识产权局宣告涉案专利权利要求 1-3 无效。

诉讼过程中，先进香港向苏州市中级人民法院提交变更诉讼请求申请书，申请将上述第二项诉讼请求变更为判令苏州猎奇智能设备股份有限公司赔偿先进香港经济损失及维权合理开支共计 50 万元，其他诉讼请求不变。

2026 年 6 月 22 日，国家知识产权局作出《无效宣告请求审查决定》，宣告先进香港涉案专利（ZL200610161194.9）权利要求 1 无效。

2026 年 6 月 23 日，先进香港向苏州市中级人民法院提出撤诉申请，苏州

市中级人民法院依法裁定准许原告先进香港撤诉。

（2）该案件对发行人的影响

2026 年 6 月 22 日，国家知识产权局作出《无效宣告请求审查决定》，宣告先进香港涉案专利（ZL200610161194.9）权利要求 1 无效。2026 年 6 月 23 日，先进香港就前述专利纠纷案件向苏州市中级人民法院提交撤诉申请，该院依法裁定准予其撤诉。综上，先进香港指控公司侵权的诉讼权利基础已不存在，且其已主动撤回起诉，对应诉讼程序已终结，该案件不会对公司本次发行上市构成实质性影响。

除上述已披露诉讼外，发行人及其子公司不存在其他尚未了结的或可预见的对发行人经营及本次发行上市产生重大影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

（二）公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和核心人员不存在尚未了结的、对发行人正常生产经营或本次发行上市产生重大不利影响的诉讼或仲裁事项。

第十一节 声明

发行人及其全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

罗 超　　徐 凯　　毕延文

程 显　　张荣君　　张 莉

上官胜

苏州猎奇智能设备股份有限公司

2026 年 1 月 18 日

发行人及其全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会委员：

上官胜　　张　莉　　程　显

苏州猎奇智能设备股份有限公司

2026 年 11 月 18 日

发行人及其全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

除董事以外的其他高级管理人员：

宋玉华　　陈文杰　　刘　正

苏州猎奇智能设备股份有限公司

2026 年 1 月 18 日

发行人控股股东声明

本企业承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

昆山奔博投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：

罗 超

2026 年 11 月 18 日

发行人实际控制人声明

本人承诺本招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人：

罗 超

苏州猎奇智能设备股份有限公司

2026 年 11 月 18 日

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股意向书进行核查，确认招股意向书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

陈家兴

保荐代表人：

贺南涛 任 飞

法定代表人（董事长）：

朱 健

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 11 月 18 日

保荐人（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读苏州猎奇智能设备股份有限公司招股意向书的全部内容，确认招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股意向书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理（总裁）：

朱 健（代）

法定代表人（董事长）：

朱 健

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 11 月 18 日

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股意向书，确认招股意向书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股意向书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人（签名）：

许　成　宝

经办律师（签名）：

杨　学　良　　张　凤　婷

江苏世纪同仁律师事务所

2026 年 11 月 18 日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读苏州猎奇智能设备股份有限公司的招股意向书，确认招股意向书与本所出具的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对苏州猎奇智能设备股份有限公司在招股意向书中引用的上述审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本声明仅供苏州猎奇智能设备股份有限公司申请首次公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。

会计师事务所负责人签名：_____
刘维

签字注册会计师签名：_____ _____
潘汝彬 陆遥

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 1 月 18 日

六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股意向书，确认招股意向书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股意向书中引用的资产评估报告的专业结论无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办评估师：

正式执业会员 资产评估师 刘国帅 39200040

刘国帅

正式执业会员 资产评估师 刘磊 32200056

刘 磊

评估机构负责人：

王健青

厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司

2020 年 11 月 18 日

验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读苏州猎奇智能设备股份有限公司的招股意向书，确认招股意向书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对苏州猎奇智能设备股份有限公司在招股意向书中引用的上述验资报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：_____
刘维

签字注册会计师签名：_____ _____
潘汝彬 陆遥

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年1月18日

验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读苏州猎奇智能设备股份有限公司的招股意向书，确认招股意向书与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对苏州猎奇智能设备股份有限公司在招股意向书中引用的上述验资复核报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名：

刘维

签字注册会计师签名：

潘汝彬 陆遥

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 1 月 18 日

第十二节 附件

一、备查文件

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报告及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；

（七）与投资者保护相关的承诺；

（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；

（九）内部控制审计报告；

（十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十一）股东会、董事会、监事会（审计委员会）、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；

（十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；

（十三）募集资金具体运用情况；

（十四）子公司、参股公司简要情况；

（十五）其他与本次发行有关的重要文件。

二、文件查阅地址和时间

（一）查阅时间

本次发行承销期间内工作日上午 9:00 至 11:00、下午 2:00 至 5:00。

（二）查阅地点

在本次发行承销期间，上述备查文件将存放于发行人和保荐人（主承销商）的办公地点，投资者可在公司股票发行承销期间内查阅。

附件一：重要承诺

（一）关于股份限售、减持安排及股份自愿锁定的承诺

1、控股股东承诺

（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。

（3）股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；上述减持股份数额不包含本企业在此期间增持的股份。

（4）如《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司的股份之锁定、减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

（5）在本企业持有发行人 5%以上股份时，本企业保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前 3 个交易日公告，通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前 15 个交易日予以公告，且将依法及时、准确的履行信息披露义务。

（6）在本企业持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文

件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（7）如未履行上述承诺出售股票的，本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；若因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，并在获得收益的 5 日内将前述收益付至公司指定账户；若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。

2、实际控制人承诺

（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。

（3）股份锁定期满后，本人如担任公司董事、高级管理人员的，任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

（4）股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；上述减持股份数额不包含本人在此期间增持的股份。

（5）如《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本人持有的猎奇智能的股份之锁定、减持另有要求的，本人将按此等要求执行。

（6）在本人持有发行人 5%以上股份时，本人保证减持发行人股份的行为

将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前 3 个交易日公告，通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前 15 个交易日予以公告，且将依法及时、准确的履行信息披露义务。

（7）在本人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（8）在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本人继续履行上述承诺。

（9）如未履行上述承诺出售股票的，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；若因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，并在获得收益的 5 日内将前述收益付至公司指定账户；若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。

3、实际控制人控制的平台昆山合鸣承诺

（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。

（3）股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；上述减持股份数额不包含本企业在此期间增持的股份。

（4）如《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定或中国证

监会和证券交易所对本企业持有的公司的股份之锁定、减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

（5）本企业保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前 3 个交易日公告，通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前 15 个交易日予以公告，且将依法及时、准确的履行信息披露义务。

（6）在本企业持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（7）如未履行上述承诺出售股票的，本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；若因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，并在获得收益的 5 日内将前述收益付至公司指定账户；若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。

4、除罗超外，直接持股的董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员承诺

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。

（3）股份锁定期满后，本人如担任公司董事、高级管理人员的，任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

（4）股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价

以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；上述减持股份数额不包含本人在此期间增持的股份。

（5）如《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本人持有的猎奇智能的股份之锁定、减持另有要求的，本人将按此等要求执行。

（6）在本人持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（7）在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因（如有）不影响承诺的效力，在此期间本人继续履行上述承诺。

（8）如未履行上述承诺出售股票的，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；若因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，并在获得收益的 5 日内将前述收益付至公司指定账户；若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。

5、间接持股的董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员承诺

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。

（3）股份锁定期满后，本人如担任公司董事、监事、高级管理人员的，任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

（4）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，股份锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。

（5）如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《监管规则适用指引——发行类第 4 号》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本人持有的苏州猎奇智能设备股份有限公司的股份之锁定、减持另有要求的，本人将按此等要求执行。

（6）如未履行上述承诺出售股票的，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；若因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，并在获得收益的 5 日内将前述收益付至公司指定账户；若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。

6、发行人直接股东金浦慕和承诺

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；就本企业在发行人首次公开发行股票并在创业板上市申请受理之日前 12 个月内新取得的相应股份，自发行人股票上市之日起 12 个月内或自本企业取得该股份之日（指完成工商变更登记手续之日，即 2024 年 12 月 31 日）起 36 个月内（以孰晚者为准），不转让或者委托他人管理本企业持有该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）如《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本企业持有的猎奇智能的股份之锁定、减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

（3）本企业保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，依法及时、准确的履行信息披露义务。

（4）如未履行上述承诺出售股票的，本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；若因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，并在获得收益的 5 日内将前述收益付至公司指定账户；若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。

7、发行人直接股东士兰控股、盛宇华天、全德学镂科芯、鸿溢盛朗、鸿溢盛越、玉澄德菉、鹏城愿景、士兰微、成都励石、上海励聚承诺

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内或自本企业取得发行人股份之日起 36 个月内（以孰晚者为准），本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）如《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本企业持有的猎奇智能的股份之锁定、减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

（3）本企业保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，依法及时、准确的履行信息披露义务。

（4）如未履行上述承诺出售股票的，本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；若因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，并在获得收益的 5 日内将前述收益付至公司指定账户；若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。

8、除上述已提及直接股东外，发行人其他直接股东承诺

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）如《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本企业持有的猎奇智能的股份之锁定、减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

（3）本企业保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，依法及时、准确的履行信息披露义务。

（4）如未履行上述承诺出售股票的，本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；若因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，并在获得收益的 5 日内将前述收益付至公司指定账户；若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。

（二）关于业绩下滑延长锁定期的承诺

1、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

如公司上市后发生业绩大幅下滑，本人/本企业自愿延长股份锁定期，并承诺如下（“届时所持股份”是指本人/本企业上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份）：

（1）发行人上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；

（2）发行人上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；

（3）发行人上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月。

本人/本企业将严格履行上述承诺。如本人/本企业因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如本人/本企业因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将依法承担相应责任。

（三）关于持股意向及减持意向的承诺

1、控股股东、实际控制人及其一致行动人、其他持股 5%以上的股东承诺

（1）本人/本企业拟长期持有发行人股票。如果在锁定期满后，本人/本企业拟减持首发前股份的，本人/本企业将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，明确并披露发行人的控制权安排，保证公司持续稳定经营。

（2）本人/本企业在持有发行人首发前股份锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格将不低于发行人股票的发行价（若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价相应调整为除权除息后的价格），减持比例不超过有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人/本企业持有的首发前股份的限售规定。

（3）本人/本企业在锁定期届满后减持发行人股份的，将严格按照相关法律、法规和规范性文件的有关规定执行。实施减持时，如本人/本企业仍为公司持股 5%以上的股东，本人/本企业将在减持前 3 个交易日予以公告，通过证券交易所集中竞价交易首次减持的，在减持前 15 个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作。

（4）本人/本企业减持发行人首发前股份的方式应符合相关法律法规的规定，包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（5）如本人/本企业违反上述承诺，将依法承担相应责任。如因本人/本企业未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人/本企业将向发行人或其投资者依法予以赔偿，并承担有关法律、法规、规范性文件及监管部门规定的其他责任。

（6）公司上市后依法增持的股份不受上述承诺约束。

（四）稳定股价的措施和承诺

1、发行人关于稳定公司股价的预案

为维护公众投资者的利益，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体

制改革的意见》《监管规则适用指引——发行类第 4 号》的要求，就猎奇智能上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的相关事宜，公司特制定预案如下：

（1）启动、中止和终止股价稳定措施的具体条件

①启动股价稳定措施的具体条件

自本公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（本预案中涉及的每股净资产值需剔除派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息情形的影响，下同），非因不可抗力因素所致，则本公司及控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员将按下述规则启动稳定公司股价的相关措施。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。

②中止股价稳定措施的具体条件

在稳定股价具体方案的实施期间内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于上一年度末经审计的每股净资产，则相关责任主体可中止实施股价稳定措施；中止实施方案后，如再次出现公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产的，则相关责任主体应继续实施稳定股价措施。

在稳定股价具体方案的实施期间内，各相关主体增持或回购公司股份的资金金额已达到本预案规定的前述单一期间上限，则该单一期间内稳定股价措施中止实施；中止实施方案后，如下一个单一期间内再次出现公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产的，则相关责任主体应继续实施稳定股价措施。

③终止股价稳定措施的具体条件

A.继续回购或增持股份将导致公司股权分布不符合上市条件，或者不符合监管机构对于股份回购、增持等相关规定。

B.各相关主体增持公司股份将触发要约收购义务。

C.稳定股价具体方案的实施期间已届满。

D.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

（2）稳定股价的具体措施

①控股股东、实际控制人增持公司股票

A.控股股东、实际控制人应在符合交易所关于增持公司股票的相关规定、获得监管机构的批准（如需）且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。

B.公司应在触发稳定股价的启动条件当日通知公司控股股东、实际控制人；公司控股股东、实际控制人应在接到通知之日起 3 个交易日内，提出增持公司股票的方案（包括拟增持公司股票的数量、价格区间、时间等）通知公司并由公司进行公告，公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持公司股票的计划。公司控股股东、实际控制人应在公司披露其增持公司股票计划并履行相关法定手续后下一个交易日起开始实施增持公司股票。

C.公司控股股东、实际控制人用于增持股份的资金金额等相关事项，应遵循以下原则：在公司公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市第一个月起至第十二个月止、第十三个月起至第二十四个月止、第二十五个月起至第三十六个月止三个期间内，任意一个单一期间内，控股股东、实际控制人用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司取得的税后现金分红金额的 20%或从公司领取的税后薪酬的 30%（以二者孰高值为准），增持计划开始实施后，若未触发股价稳定措施的中止条件或终止条件，则控股股东、实际控制人需继续进行增持，其用于增持股份的资金金额不超过其上一会计年度从公司取得的税后现金分红金额的 50%或从公司领取的税后薪酬的 70%（以二者孰高值为准）。

D.增持价格原则上不超过公司上一年度末经审计的每股净资产。

②董事、高级管理人员增持公司股票

A.当控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完毕后，仍符合启动条件时，为稳定公司股价，公司董事、高级管理人员应在符合交易所关于增持公司股票的相关规定、获得监管部门的批准（如需）且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。

B.公司应在触发稳定股价的启动条件当日通知有增持义务的公司董事、高

级管理人员，上述人员应在接到通知之日起 3 个交易日内，提出增持公司股票的方案（包括拟增持公司股票的数量、价格区间、时间等）通知公司并由公司进行公告，公司应按照相关规定披露有增持义务的公司董事、高级管理人员增持公司股票的计划。有增持义务的公司董事、高级管理人员应在公司披露其增持公司股票计划并履行相关法定手续后下一个交易日起开始实施增持公司股票。

C.有增持义务的董事、高级管理人员用于增持股份的资金金额等相关事项，应遵循以下原则：在公司公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市第一个月起至第十二个月止、第十三个月起至第二十四个月止、第二十五个月起至第三十六个月止三个期间内，任意一个单一期间内，有增持义务的公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的资金金额不低于该董事、高级管理人员在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬的 10%，增持计划开始实施后，若未触发股价稳定措施的中止条件或终止条件，则有增持义务的公司董事、高级管理人员需继续进行增持，其用于增持股份的资金金额不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 30%。

D.增持价格原则上不超过公司上一年度末经审计的每股净资产。

为避免疑问，在控股股东及实际控制人同时担任公司董事或高级管理人员的情况下，控股股东及实际控制人按照上述“控股股东、实际控制人增持公司股票”的要求履行稳定股价义务，无需基于其董事或者高级管理人员身份，履行上述“董事、高级管理人员增持公司股票”项下的义务。

③公司回购股票

A.当控股股东、实际控制人、有增持义务的公司董事、高级管理人员增持公司股票方案实施完毕后，仍符合启动条件时，为稳定公司股价，公司应在符合交易所关于公司回购公司股票的相关规定、获得监管机构的批准（如需）、且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。

B.满足启动股价稳定措施条件后，公司应在 5 个交易日内召开董事会，讨论公司回购股票的方案，并提交股东会审议。独立董事应对公司回购股票预案发表独立意见。公司董事会应当在做出是否回购股票决议后的 2 个交易日内公

告董事会决议，如不回购需公告理由，如回购还需公告回购股票预案，并发布召开股东会的通知。

C.公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。公司股东会对回购股票做出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东会上投赞成票。

D.公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、法规及规范性文件的规定之外，还应符合下列各项：

a.公司用于回购股份的资金总额累计不超过本次发行所募集资金的总额；

b.在公司公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市第一个月起至第十二个月止、第十三个月起至第二十四个月止、第二十五个月起至第三十六个月止三个期间内，公司每期用于回购股份的资金金额不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，回购开始实施后，若未触发股价稳定措施的中止条件或终止条件，则公司需继续进行回购，其每期用于回购股份的资金金额不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。

E.增持价格原则上不超过公司上一年度末经审计的每股净资产。

④其他稳定股价的措施

根据届时有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，在履行相关法定程序后，公司及相关方可以采用法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会、深圳证券交易所认可的其他稳定股价的措施。

（3）约束措施

①公司未履行稳定股价承诺的约束措施

如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东会审议，尽可

能地保护公司投资者利益。

②控股股东未履行稳定股价承诺的约束措施

如控股股东未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，应同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中归属于控股股东的部分，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

③董事、高级管理人员未履行稳定股价承诺的约束措施

如上述负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行或未按期履行稳定股价承诺，应在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，应调减或停发薪酬或津贴，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

2、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

（1）本企业/本人将根据公司股东会批准的《苏州猎奇智能设备股份有限公司关于稳定公司股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会、股东会上，对回购股份的相关决议投赞成票。

（2）本企业/本人将根据公司股东会批准的《苏州猎奇智能设备股份有限公司关于稳定公司股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

（3）若本企业/本人未履行稳定股价措施的，将在公司股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将与本企业/本人拟根据上述预案中增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，同时本企业/本人持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

3、董事承诺

（1）本人将根据公司股东会批准的《苏州猎奇智能设备股份有限公司关于稳定公司股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票。

（2）本人将根据公司股东会批准的《苏州猎奇智能设备股份有限公司关于稳定公司股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

（3）如本人属于公司股东会批准的《苏州猎奇智能设备股份有限公司关于稳定公司股价的预案》中有增持义务的董事，且本人未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，如非因不可抗力导致，公司有权将与本人拟根据《苏州猎奇智能设备股份有限公司关于稳定公司股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。如因不可抗力导致，将尽快研究使投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

4、高级管理人员承诺

（1）本人将根据公司股东会批准的《苏州猎奇智能设备股份有限公司关于稳定公司股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

（2）如本人属于公司股东会批准的《苏州猎奇智能设备股份有限公司关于稳定公司股价的预案》中有增持义务的高级管理人员，且本人未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，如非因不可抗力导致，公司有权将与本人拟根据《苏州猎奇智能设备股份有限公司关于稳定公司股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。如因不可抗力导致，将尽快研究使投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

（五）股份回购和股份买回的措施和承诺

1、发行人承诺

如证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将按照《依法承担赔偿或赔偿责任的承诺》依法回购本次公开发行的全部新股。

如中国证监会认定本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册，则本公司承诺将依法按照《关于欺诈发行上市的股份回购承诺》从投资者手中购回本次公开发行的全部新股。

当《苏州猎奇智能设备股份有限公司关于稳定公司股价的预案》中约定的预案触发条件成就时，公司将按照《苏州猎奇智能设备股份有限公司关于稳定公司股价的预案》履行回购公司股份的义务。

以上为本公司关于股份回购和股份买回的措施和承诺，如本公司未能依照上述承诺履行义务的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

2、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

如证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本企业/本人承诺将按照《依法承担赔偿或赔偿责任的承诺》极力促使发行人依法回购或由本企业/本人依法回购其本次公开发行的全部新股。

如中国证监会认定发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册，则本企业/本人承诺将按照《关于欺诈发行上市的股份回购承诺》依法从投资者手中购回本次公开发行的全部新股。

当《苏州猎奇智能设备股份有限公司关于稳定公司股价的预案》中约定的预案触发条件成就时，本企业/本人将按照《苏州猎奇智能设备股份有限公司关于稳定公司股价的预案》履行回购公司股份的义务。

以上为本企业/本人关于股份回购和股份买回的措施和承诺，如本企业/本人

未能依照上述承诺履行义务的，本企业/本人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

（六）对欺诈发行上市的股份回购承诺

1、发行人承诺

（1）本公司不存在任何欺诈发行上市的行为，包括招股说明书在内的本次发行及上市申请文件所载之内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，亦不存在本公司不符合本次发行及上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。

（2）如本公司存在任何欺诈发行上市行为，本公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内依法回购欺诈发行上市的股份，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若本公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

（3）本公司因欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

2、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

（1）发行人不存在任何欺诈发行上市的行为，包括招股说明书在内的本次发行及上市申请文件所载之内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，亦不存在发行人不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。

（2）如发行人存在任何欺诈发行上市行为，本企业/本人将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内，自行和/或督促发行人依法启动购回欺诈发行上市的股份及本企业/本人已转让的原限售股份（如有）程序，回购价格根据届时二级

市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

（3）因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业/本人将依法赔偿。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

（七）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、发行人承诺

（1）加强产品技术研发能力，提高公司竞争能力和持续盈利能力

在不断变化的市场环境下，公司将研发新产品、新技术及项目产业化作为重要的发展战略，未来公司将继续在现有基础上积极大力开展产品研发工作。公司将依托自身优秀的研发能力，凭借管理层丰富的行业经验，准确把握行业发展趋势和创新方向，持续加大研发投入；同时，通过公司产业化的优势，迅速将科技成果转化为生产能力，从而提升公司的盈利能力及抗风险能力。

（2）加快募集资金投资项目建设进度，防范募集资金使用风险

本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，有利于丰富和优化公司的产品结构，提升盈利能力。公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建设，及时、高效完成募集资金投资项目建设，通过全方位推动措施，争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益，降低因本次发行导致的股东即期回报被摊薄的风险。

为规范募集资金的管理和使用，公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专项存储、使用、管理和监督进行了明确的规定。本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（3）进一步完善利润分配政策，强化投资者回报机制

公司已经按照相关法律法规要求，以及《公司章程（草案）》的规定制定了《苏州猎奇智能设备股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

本次公开发行实施完成后，将按照法律法规的规定和《公司章程（草案）》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，从而切实保障公众投资者的合法权益。

（4）注重内部控制制度的建设和执行，严格控制成本费用

在加强公司研发能力、推进公司业务发展的同时，公司将更加注重内部控制制度的建设和有效执行，进一步保障公司的生产经营，提高运营效率，降低财务风险。公司将不断提高管理水平，通过建立有效的成本和费用考核体系，对预算、采购、生产、销售等各方面进行管控，加大成本、费用控制力度，提升经营效率和盈利能力。

2、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

本企业/本人作为苏州猎奇智能设备股份有限公司的控股股东/实际控制人或其一致行动人期间，本企业/本人不越权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费行为。本企业/本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本企业/本人对此作出的承诺，若公司违反该等承诺或拒不履行承诺，本企业/本人将在公司股东（大）会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若给发行人或者股东造成损失的，本企业/本人将依法承担对公司或者股东的补偿责任。

3、董事、高级管理人员承诺

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（4）承诺支持董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）承诺公司的股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。

若本人违反该等承诺，本人将在股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会、证券交易所，中国上市公司协会采取相应的监管措施；如给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。

（八）关于利润分配政策的承诺

1、发行人承诺

本公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求对《公司章程（草案）》中的利润分配政策进行了完善，并制定了关于上市后三年股东分红回报规划。

公司高度重视对股东的分红回报，公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》及关于上市后三年股东分红回报规划规定的利润分配政策。

如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，公司将及时调整利润分配政策并严格执行。如公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

2、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

（1）本人/本企业将督促公司遵守并执行《苏州猎奇智能设备股份有限公司章程（草案）》《关于公司上市后三年股东分红回报规划》及相关法律法规规定的利润分配政策。

（2）为维护中小投资者的利益，本人/本企业将根据《苏州猎奇智能设备股份有限公司章程（草案）》《关于公司上市后三年股东分红回报规划》规定

的利润分配政策在相关董事会/股东会上进行投票表决。

（3）本人/本企业将督促公司根据股东会决议实施利润分配。

（4）若本人/本企业未能依照本承诺严格执行利润分配政策，本人/本企业将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

（九）关于未履行承诺的约束措施的承诺

1、发行人承诺

（1）公司违反关于首次公开发行股票并在创业板上市申请文件真实、准确、完整的承诺，关于稳定股价的承诺，关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏应回购股票及赔偿投资者损失的承诺等公开承诺事项的，除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，公司将：

①在公司股东会或中国证监会指定的信息披露平台披露未履行公开承诺事项的详细情况，包括但不限于未履行承诺的内容、原因及后续处理等，并向公司股东和社会公众公开道歉；

②自愿接受社会监督，中国证监会等监督管理部门可以督促公司及时改正并继续履行公开承诺事项，同时接受中国证监会等监督管理部门依法进行的处理；

③因未履行公开承诺事项给公司股东和社会公众投资者造成损失的，承担相应的赔偿责任；

④承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司股东和社会公众投资者权益的，将变更承诺或提出新承诺或者提出豁免履行承诺义务，并经公司股东会审议通过，股东会应向股东提供网络投票方式。

（2）如因不可抗力原因导致公司未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因；

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司

投资者利益。

2、控股股东、实际控制人承诺

（1）如本人/本企业所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本企业无法控制的客观原因导致的除外）或履行相关承诺将不利于维护公司及投资者权益的，本人/本企业将采取以下措施：

①通过公司及时披露本人/本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向公司及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东会审议以保护公司及其投资者的权益。本人/本企业在股东会审议该事项时回避表决；

③将本人/本企业违反本人/本企业承诺所得收益归属于公司（已经公司股东会审议变更或豁免的除外）。

（2）如因本人/本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的，本人/本企业将依法对公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

①将本人/本企业应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；

②若本人/本企业在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人/本企业承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失。

（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人/本企业无法控制的客观原因导致本人/本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人/本企业将通过公司及时、充分披露本人/本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。

3、实际控制人控制的平台昆山合鸣承诺

（1）如本企业所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期

履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外）或履行相关承诺将不利于维护公司及投资者权益的，本企业将采取以下措施：

①通过公司及时披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向公司及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东会审议以保护公司及其投资者的权益。本企业在股东会审议该事项时回避表决；

③将本企业违反本企业承诺所得收益归属于公司（已经公司股东会审议变更或豁免的除外）。

（2）如因本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的，本企业将依法对公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

①将本企业应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；

②若本企业在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本企业承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失。

（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将通过公司及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。

4、其他持股 5%以上股东的承诺

（1）如本人所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外）或履行相关承诺将不利于维护公司及投资者权益的，本人将采取以下措施：

①通过公司及时披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体

原因；

②向公司及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东会审议以保护公司及其投资者的权益。本人在股东会审议该事项时回避表决；

③将本人违反本企业承诺所得收益归属于公司（已经公司股东会审议变更或豁免的除外）。

（2）如因本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的，本企业将依法对公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

①将本人应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；

②若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失。

（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将通过公司及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。

5、董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员的承诺

如本人所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外）或履行相关承诺将不利于维护公司及投资者权益的，本人将采取以下措施：

（1）通过公司及时披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向公司及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东会审议以保护公司及其投资者的权益。本人如持有公司股份的，将在股东会审议该事项时回避表决；

（3）将本人违反本人承诺所得收益归属于公司（已经公司股东会审议变更

或豁免的除外）。

如因本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的，本人将依法对公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

（1）同意公司停止向本人发放工资、奖金或津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给上市公司及投资者带来的损失；

（2）若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公司、投资者的损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。

（十）关于避免同业竞争的承诺

1、实际控制人及其一致行动人承诺

（1）截至本承诺函出具日，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与猎奇智能及其控制的企业相同、相似业务的情形。

（2）在本人/本企业作为猎奇智能的实际控制人或其一致行动人期间，本人及本人控制的企业将不会在中国境内或境外采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与猎奇智能相同、相似或构成竞争的业务，也不会协助（包括但不限于提供技术支持、资金资助）、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与猎奇智能及其子公司相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本人/本企业将对本人/本企业控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务，并对其不履行义务产生后果承担连带责任。

（3）如猎奇智能认定本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业、正在或将要从事的业务与猎奇智能存在同业竞争，则本人/本企业将在猎奇智能提出异

议后立即（在 30 日以内）终止上述业务，或促使本人/本企业控制的其他企业立即（在 30 日以内）终止上述业务，并向猎奇智能承担违约金，违约金标准为：①本人/本企业因从事上述业务的所获得的营业收入全部归猎奇智能；②猎奇智能因本人/本企业从事上述业务所实际发生损失及预计可得的经济利益的 2 倍；③前述①、②金额较高的作为违约金。如猎奇智能有意受让上述业务，则按照猎奇智能选聘的审计/评估机构审计/评估值转让给猎奇智能。

（4）本人/本企业承诺也不会直接或间接地为自身或本人/本企业之关联方或任何第三方，劝诱或鼓励猎奇智能的任何核心人员接受其聘请，或用其他方式招聘猎奇智能任何核心人员。

（5）若本人/本企业违反上述承诺，本人/本企业应对猎奇智能因此而遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。

（6）本承诺函一经签署，即构成本人/本企业不可撤销的法律义务。本承诺函自本人/本企业签署之日起生效，其效力至本人/本企业不再是公司的实际控制人或其一致行动人之日终止。

2、控股股东承诺

（1）截至本承诺函出具日，本企业及本企业控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与猎奇智能及其控制的企业相同、相似业务的情形。

（2）在本企业作为猎奇智能的控股股东期间，本企业及本企业控制的企业将不会在中国境内或境外采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与猎奇智能相同、相似或构成竞争的业务，也不会协助（包括但不限于提供技术支持、资金资助）、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与猎奇智能及其子公司相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本企业将对本企业控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务，并对其不履行义务产生后果承担连带责任。

（3）如猎奇智能认定本企业及本企业控制的其他企业、正在或将要从事的业务与猎奇智能存在同业竞争，则本企业将在猎奇智能提出异议后立即（在 30

日以内）终止上述业务，或促使本企业控制的其他企业立即（在 30 日以内）终止上述业务，并向猎奇智能承担违约金，违约金标准为：①本企业因从事上述业务的所获得的营业收入全部归猎奇智能；②猎奇智能因本企业从事上述业务所实际发生损失及预计可得的经济利益的 2 倍；③前述①、②金额较高的作为违约金。如猎奇智能有意受让上述业务，则按照猎奇智能选聘的审计/评估机构审计/评估值转让给猎奇智能。

（4）本企业承诺也不会直接或间接地为自身或本企业之关联方或任何第三方，劝诱或鼓励猎奇智能的任何核心人员接受其聘请，或用其他方式招聘猎奇智能任何核心人员。

（5）若本企业违反上述承诺，本企业应对猎奇智能因此而遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。

（6）本承诺函一经签署，即构成本企业不可撤销的法律义务。本承诺函自本企业签署之日起生效，其效力至本企业不再是公司的控股股东之日终止。

3、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员承诺

（1）截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与猎奇智能及其控制的企业相同、相似业务的情形。

（2）在本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的企业将不会在中国境内或境外采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与猎奇智能相同、相似或构成竞争的业务，也不会协助（包括但不限于提供技术支持、资金资助）、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与猎奇智能及其子公司相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本人将对本人控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务，并对其不履行义务产生后果承担连带责任。

（3）如猎奇智能认定本人及本人控制的其他企业、正在或将要从事的业务与猎奇智能存在同业竞争，则本人将在猎奇智能提出异议后立即（在 30 日以内）终止上述业务，或促使本人控制的其他企业立即（在 30 日以内）终止上述业务，并向猎奇智能承担违约金，违约金标准为：①本人因从事上述业务的所获得的

营业收入全部归猎奇智能；②猎奇智能因本人从事上述业务所实际发生损失及预计可得的经济利益的 2 倍；③前述①、②金额较高的作为违约金。如猎奇智能有意受让上述业务，则按照猎奇智能选聘的审计/评估机构审计/评估值转让给猎奇智能。

（4）本人承诺也不会直接或间接地为自身或本人之关联方或任何第三方，劝诱或鼓励猎奇智能的任何核心人员接受其聘请，或用其他方式招聘猎奇智能任何核心人员。

（5）若本人违反上述承诺，本人应对猎奇智能因此而遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。

（6）本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是公司的董事、监事、高级管理人员之日终止。

（十一）关于减少和规范关联交易的承诺

1、实际控制人及其一致行动人承诺

（1）本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）及其控制的其他企业与猎奇智能及其控制的其他企业之间不存在未披露的关联交易；

（2）本人/本企业承诺并促使本人/本企业控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员及其控制的其他企业不利用本人地位及控制性影响谋求猎奇智能及其控制的其他企业在业务合作等方面优于市场第三方的权利；

（3）本人/本企业承诺并促使本人/本企业控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员及其控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与猎奇智能及其控制的企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害猎奇智能及其控制的企业利益的行为；

（4）本人/本企业承诺并促使本人/本企业控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员及其控制的其他企业将尽量避免或减少与猎奇智能及其控制的企

业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益；

（5）本人/本企业承诺本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员及其控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用猎奇智能及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与猎奇智能及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。

（6）本人/本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，本人/本企业若违反本承诺约定的义务与责任，而给猎奇智能及其控制的企业或其他股东造成损失，本人/本企业将承担连带赔偿责任；

（7）本承诺函一经签署，即构成本人/本企业不可撤销的法律义务。本承诺函自本人/本企业签署之日起生效，其效力至本人/本企业不再是公司的实际控制人或其一致行动人之日终止。

2、控股股东承诺

（1）本企业承诺，本企业及本企业控制的其他企业与猎奇智能及其控制的其他企业之间不存在未披露的关联交易；

（2）本企业承诺，本企业及本企业控制的其他企业不利用本企业地位及影响谋求猎奇智能及其控制的其他企业在业务合作等方面优于市场第三方的权利；

（3）本企业承诺，本企业及本企业控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与猎奇智能及其控制的企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害猎奇智能及其控制的企业利益的行为；

（4）本企业承诺，本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免或减少与猎奇智能及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益；

（5）本企业承诺，本企业及本企业所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用猎奇智能及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与猎奇智能及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来；

（6）本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，本企业若违反本承诺约定的义务与责任，而给猎奇智能及其控制的企业或其他股东造成损失，本企业将承担连带赔偿责任；

（7）本承诺函一经签署，即构成本企业不可撤销的法律义务。本承诺函自本企业签署之日起生效，其效力至本企业不再是公司的控股股东之日终止。

3、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员承诺

（1）本人及本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）及其控制的其他企业与猎奇智能及其控制的其他企业之间不存在未披露的关联交易；

（2）本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员及其控制的其他企业不利用本人地位及控制性影响谋求猎奇智能及其控制的其他企业在业务合作等方面优于市场第三方的权利；

（3）本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员及其控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与猎奇智能及其控制的企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害猎奇智能及其控制的企业利益的行为；

（4）本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员及其控制的其他企业将尽量避免或减少与猎奇智能及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益；

（5）本人承诺本人及本人所控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员

及其控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用猎奇智能及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与猎奇智能及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来；

（6）本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，本人若违反本承诺约定的义务与责任，而给猎奇智能及其控制的企业或其他股东造成损失，本人将承担连带赔偿责任；

（7）本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是公司董事、监事、高级管理人员之日终止。

4、持股 5%以上股东承诺

（1）本人承诺，本人及本人控制的其他企业与猎奇智能及其控制的其他企业之间不存在未披露的关联交易；

（2）本人承诺本人及本人控制的其他企业不利用本人地位及影响谋求猎奇智能及其控制的其他企业在业务合作等方面优于市场第三方的权利；

（3）本人承诺本人及本人控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与猎奇智能及其控制的企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害猎奇智能及其控制的企业利益的行为；

（4）本人承诺本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与猎奇智能及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益；

（5）本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用猎奇智能及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与猎奇智能及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来；

（6）本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，本人若违反本承诺约定的义务与责任，而给猎奇智能及其控制的企业或其他股东造成损失，本人将承担连带赔偿责任；

（7）本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再单独或合计持有猎奇智能 5%以上股份之日终止。

（十二）关于避免资金占用和违规担保的承诺

1、实际控制人及其一致行动人承诺

（1）本人及/或本人直接或间接控制企业（不包括公司及其直接或者间接控制企业）不存在以任何方式违法占用或使用公司的资金、资产和资源的情形，也不存在违规要求公司为本人及/或本人直接或间接控制企业的借款或其他债务提供担保的情形；

（2）本人及/或本人直接或间接控制企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用公司的资金、资产和资源，也不会违规要求公司为本人及/或本人直接或间接控制企业的借款或其他债务提供担保；

（3）本人及/或本人直接或间接控制企业将按照公司章程及内部治理制度的规定，在审议涉及要求公司为本人及/或本人直接或间接控制企业提供担保的任何董事会、股东会上回避表决；在审议涉及本人及/或本人直接或间接控制企业违规占用公司的资金、资产和资源的任何董事会、股东会上投反对票，依法维护公司利益。自公司本次发行上市后，本人将严格遵守中国证监会和证券交易所关于上市公司法人治理的有关规定，采取任何必要的措施保证不占用公司的资金、资产和资源，维护公司的独立性，不损害公司及公司其他股东的利益。

（4）本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：①本人不再是公司的实际控制人；②公司的股票终止在任何证券交易所上市（但公司的股票因任何原因暂停买卖除外）；③法律法规和规范性文件规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

2、控股股东承诺

（1）本企业及/或本企业直接或间接控制企业（为本承诺函之目的，不包括公司及其直接或者间接控制企业）不存在以任何方式违法占用或使用公司的资金、资产和资源的情形，也不存在违规要求公司为本人及/或本人直接或间接控制企业的借款或其他债务提供担保的情形；

（2）本企业及/或本企业直接或间接控制企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用公司的资金、资产和资源，也不会违规要求公司为本人及/或本人直接或间接控制企业的借款或其他债务提供担保；

（3）本企业及/或本企业直接或间接控制企业将按照公司章程及内部治理制度的规定，在审议涉及要求公司为本人及/或本人直接或间接控制企业提供担保的任何董事会、股东会上回避表决；在审议涉及本人及/或本人直接或间接控制企业违规占用公司的资金、资产和资源的任何董事会、股东会上投反对票，依法维护公司利益。自公司本次发行上市后，本人将严格遵守中国证监会和证券交易所关于上市公司法人治理的有关规定，采取任何必要的措施保证不占用公司的资金、资产和资源，维护公司的独立性，不损害公司及公司其他股东的利益；

（4）本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：①本人不再是公司的控股股东；②公司的股票终止在任何证券交易所上市（但公司的股票因任何原因暂停买卖除外）；③法律法规和规范性文件规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

（十三）关于缴纳社会保险、住房公积金的承诺

1、实际控制人承诺

（1）公司及其子公司未曾就社会保险金及住房公积金缴纳事宜受到社会保障部门、住房公积金部门的行政处罚；

（2）本人将敦促公司及其子公司按照法律、法规及其所在地政策规定，为全体符合要求的员工开设社会保险金账户及住房公积金账户，缴存社会保险金及住房公积金；

（3）若公司及其子公司被有关政府部门司法机关依法认定或被公司及其子公司的员工本人合法要求补缴或者被追缴本次发行及上市前应缴而未缴、未足额为其全体员工缴纳和代扣代缴各项社会保险金及住房公积金，或因此被有关部门处以罚款、滞纳金或被追究其他法律责任，本人将承担所有补缴款项、罚款、滞纳金及其他支出，并承诺此后不向公司及其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受损失，确保公司及其子公司免受任何损失和损害。

（十四）关于股东相关信息披露的承诺

1、发行人承诺

（1）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整的披露了股东信息。

（2）本公司历次股本演变过程中，直接股东层面不存在股权代持关系，间接股东层面曾存在股权代持关系。截至本承诺出具之日，上述股权代持情况已解除，相关方不存在任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷，不存在委托持股、利益输送或者其他利益安排等情形。

（3）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。

（4）除已披露的持股情况外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形。

（5）本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

（6）本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

（十五）依法承担赔偿责任的承诺

1、发行人承诺

（1）本公司的招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且公司对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

（2）如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将采取如下措施依法回购首次公开发行的全部新股：

①若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后至股票尚未上市交易前的时间段内发生上述情况，对于首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳的股票申购款加计该期间内银行同期活期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

②在本公司首次公开发行的股票上市交易后发生上述情况，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加算同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。

（3）如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解和设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

（4）本公司承诺在按照上述安排实施退款、回购及赔偿的同时，将积极促使本公司相关责任主体按照其相关承诺履行退款、购回及赔偿等相关义务。

2、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺

（1）公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本企业/本人对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（2）如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业/本人将采取下列措施依法回购首次公开发行的全部新股：

①若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后至股票尚未上市交易前的时间

段内发生上述情况，本企业/本人及发行人将按照投资者所缴纳的股票申购款加计该期间内银行同期活期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

②若在本公司首次公开发行的股票上市交易后发生上述情况，本企业/本人及发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加算同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。

（3）如因公司招股说明书被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业/本人将采取如下措施依法赔偿投资者的直接经济损失：

①在相关监管机构认定公司招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之日起 10 个交易日内，启动赔偿投资者损失的相关工作；

②投资者损失将依据相关监管机构或司法机关认定的金额、公司与投资者协商确定的金额或者通过符合相关法律法规要求的其他方法合理确定。

3、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员承诺

（1）发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本人对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

（2）如证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

（3）若违反上述承诺，发行人董事、监事、高级管理人员在发行人股东会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时其持有的发行人股份（如有）将不得转让（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外），直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完

毕时为止。

4、保荐人（主承销商）承诺

保荐人（主承销商）国泰海通承诺如下：

“因本保荐人在发行人首次公开发行股票并在创业板上市工作期间未勤勉尽责，导致本保荐人为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照中国证券监督管理委员会、人民法院等有权机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。”

5、发行人律师承诺

发行人律师江苏世纪同仁律师事务所承诺如下：

“因本所律师在发行人首次公开发行股票并在创业板上市工作期间未勤勉尽责，导致本所律师为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照中国证券监督管理委员会、人民法院等有权机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。”

6、发行人会计师、验资机构、验资复核机构承诺

发行人会计师、验资机构、验资复核机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承诺如下：

“本所承诺：如因本所为苏州猎奇智能设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实被认定后，将依法赔偿投资者损失。”

7、发行人资产评估机构承诺

发行人资产评估机构厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司承诺如下：

“因厦门嘉学在发行人首次公开发行股票并在创业板上市工作期间未勤勉尽责，导致厦门嘉学为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照中国证券监督管理委员会、人民法院等有权机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除

外。”

附件二：发行人主要无形资产详细情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人主要无形资产详细情况如下：

（一） 商标

序号	商标内容	注册号	注册类别	权利人	有效期限（截至）	取得方式
1	SZLQ	32104427	7	猎奇智能	2029.4.6	原始取得
2	云琦 YUNQI	81251891	40	云琦精密	2035.4.13	原始取得
3	云琦	81272477	9	云琦精密	2035.7.6	原始取得

（二） 专利

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人	申请日	取得方式
1	一种光纤阵列自动耦合贴装装置和耦合贴装方法	2025100641329	发明专利	猎奇智能	2025.1.15	原始取得
2	一种贴片机自动上下料机及其上下料方法	2024116602207	发明专利	猎奇智能	2024.11.20	原始取得
3	一种隧道式高速原位共晶焊台、贴片设备及贴片方法	2024117684670	发明专利	猎奇智能	2024.12.4	原始取得
4	一种基于气缸力控的双力控贴装头及控制方法	202411636299X	发明专利	猎奇智能	2024.11.15	原始取得
5	一种加热吸嘴组件	2024114983007	发明专利	猎奇智能	2024.10.25	原始取得
6	一种气弹簧两端接头全自动组装设备及组装方法	2024111266356	发明专利	猎奇智能	2024.8.16	原始取得
7	一种气弹簧两端部件组装检测生产线	2024111262321	发明专利	猎奇智能	2024.8.16	原始取得
8	一种气弹簧缸筒两端防尘密封件自动组装设备及组装方法	2024111265993	发明专利	猎奇智能	2024.8.16	原始取得
9	一种兼容性高的气弹簧自动充气检测一体设备及充气方法	2024105900560	发明专利	猎奇智能	2024.5.13	原始取得
10	一种同轴封装透镜焊接设备及其同轴封装焊接方法	2024102886701	发明专利	猎奇智能	2024.3.14	原始取得
11	一种气弹簧端部支架高效自动组装设备	2024101062121	发明专利	猎奇智能	2024.1.25	原始取得
12	一种温控阀高效自动组装检测生产线	2023116639349	发明专利	猎奇智能	2023.12.6	原始取得
13	一种温控阀自动组装设备	202311663932X	发明专利	猎奇智能	2023.12.6	原始取得
14	一种旋转夹持机构及滚槽设备	2023115133096	发明专利	猎奇智能	2023.11.14	原始取得

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人	申请日	取得方式
15	一种气弹簧活塞杆接头自动组装设备	2023115133113	发明专利	猎奇智能	2023.11.14	原始取得
16	一种双压力控制的贴装头	2023112330355	发明专利	猎奇智能	2023.9.22	原始取得
17	硅光芯片测试装置及其测试方法	2023112213991	发明专利	猎奇智能	2023.9.21	原始取得
18	一种汽车尾翼多功能自动测试设备及测试方法	2023112009400	发明专利	猎奇智能	2023.9.18	原始取得
19	一种高压继电器组装设备及组装方法	2023111242287	发明专利	猎奇智能	2023.9.1	原始取得
20	一种电机转子平衡板与止动环自动组装设备及组装方法	2023110318170	发明专利	猎奇智能	2023.8.16	原始取得
21	一种带壳电子产品开帽返修方法	2023106975697	发明专利	猎奇智能	2023.6.13	原始取得
22	一种光模块自动测试设备及其检测方法	2023104107986	发明专利	猎奇智能	2023.4.18	原始取得
23	一种 360°旋转微压力感测模组及贴装吸附装置	2023102426883	发明专利	猎奇智能	2023.3.14	原始取得
24	一种贴装模组及其标定方法	2023101405485	发明专利	猎奇智能	2023.2.21	原始取得
25	基于视觉的运动系统热变形二维测量方法及使用方法	2022116921044	发明专利	猎奇智能	2022.12.28	原始取得
26	一种气浮旋转吸附结构及其使用方法	2022116836111	发明专利	猎奇智能	2022.12.27	原始取得
27	一种芯片光电测试机构及其测试方法	2020107567386	发明专利	猎奇智能	2020.7.31	原始取得
28	一种压力控制闭环系统及其压力控制方法	2020107580037	发明专利	猎奇智能	2020.7.31	原始取得
29	一种点胶针自动校准系统及其校准方法	2020107498668	发明专利	猎奇智能	2020.7.30	原始取得
30	一种光斑测试机构及其测试方法	2020106030218	发明专利	猎奇智能	2020.6.29	原始取得
31	一种能保持压紧力恒定的高精度共晶焊接设备	2019108024172	发明专利	猎奇智能	2019.8.28	原始取得
32	浸粉自动线	2018110607606	发明专利	猎奇智能	2018.9.12	原始取得
33	自动耦合设备	2018110593393	发明专利	猎奇智能	2018.9.12	原始取得
34	太阳能电池片 EL 缺陷测试机	2018110593209	发明专利	猎奇智能	2018.9.12	原始取得
35	玻璃镜片贴合机及玻璃镜片自动贴合方法	2017111562152	发明专利	猎奇智能	2017.11.20	原始取得
36	自动耦合机及自动耦合方法	2017111562148	发明专利	猎奇智能	2017.11.20	原始取得
37	一种自动贴片机	2017107356260	发明专利	猎奇智能	2017.8.24	原始取得
38	一种自动耦合机	2016112404575	发明专利	猎奇智能	2016.12.29	原始取得
39	镜片贴装设备	201611202629X	发明专利	猎奇智能	2016.12.23	原始取得
40	动力锂电池电芯处理装置	2016111598959	发明专利	猎奇智能	2016.12.15	原始取得
41	动力锂电池电芯打包装置	2016111510543	发明专利	猎奇智能	2016.12.14	原始取得
42	一种芯片产品测试用定位夹具	2022235502982	实用新型	猎奇智能	2022.12.29	原始取得

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人	申请日	取得方式
43	一种芯片产品高效测试装置	2022235213944	实用新型	猎奇智能	2022.12.28	原始取得
44	一种带有多维碰撞感应的光学透镜对准夹持机构	2022235213959	实用新型	猎奇智能	2022.12.28	原始取得
45	一种弹性预压的柔性龙门系统	2022234747056	实用新型	猎奇智能	2022.12.26	原始取得
46	一种基于视觉的实时对准贴装机	2021232327205	实用新型	猎奇智能	2021.12.21	原始取得
47	一种激光器软板供电耦合夹具	2021232327192	实用新型	猎奇智能	2021.12.21	原始取得
48	一种半导体透镜耦合设备	2021208220857	实用新型	猎奇智能	2021.4.21	原始取得
49	一种用于组装 LENS 与 HOLDER 的自动组装设备	2020232852311	实用新型	猎奇智能	2020.12.31	原始取得
50	一种可灵活调节推力的高精密夹持机构	2020219634512	实用新型	猎奇智能	2020.9.10	原始取得
51	一种高精度透镜耦合贴装用点胶装置	2020219554734	实用新型	猎奇智能	2020.9.9	原始取得
52	一种基于视觉自动定位的高精度 Lens 耦合贴装设备	2020219555031	实用新型	猎奇智能	2020.9.9	原始取得
53	一种多位置角度可调的高精度光纤插头自动插拔机构	2020219554753	实用新型	猎奇智能	2020.9.9	原始取得
54	一种气浮式自适应耦合支撑平台	202021954567X	实用新型	猎奇智能	2020.9.9	原始取得
55	一种焊接效率高且焊接质量好的共晶焊台	2019214122197	实用新型	猎奇智能	2019.8.28	原始取得
56	一种能保持压紧力恒定的高精度共晶焊接设备	2019214122464	实用新型	猎奇智能	2019.8.28	原始取得
57	一种定点式多角度多功能视觉拍照装置	201921412220X	实用新型	猎奇智能	2019.8.28	原始取得
58	一种 Bar 条测试装置	2019210064309	实用新型	猎奇智能	2019.7.1	原始取得
59	产品角度无级定位送料装置	2019209917921	实用新型	猎奇智能	2019.6.28	原始取得
60	激光器分拣机	2018214878034	实用新型	猎奇智能	2018.9.12	原始取得
61	双工位芯片自动上下料装置	201821487464X	实用新型	猎奇智能	2018.9.12	原始取得
62	自动点胶机	2018214867716	实用新型	猎奇智能	2018.9.12	原始取得
63	用于 LENS 自动贴装机的 LENS 夹具	2018214868691	实用新型	猎奇智能	2018.9.12	原始取得
64	自动耦合焊接机	201821485026X	实用新型	猎奇智能	2018.9.12	原始取得
65	老化测试箱	2017215517804	实用新型	猎奇智能	2017.11.20	原始取得
66	一种自动贴片机	2017210659847	实用新型	猎奇智能	2017.8.24	原始取得
67	一种自动耦合机	2016214592729	实用新型	猎奇智能	2016.12.29	原始取得
68	动力电池自动点焊机	2016214435268	实用新型	猎奇智能	2016.12.27	原始取得
69	镜片贴装设备	2016214211939	实用新型	猎奇智能	2016.12.23	原始取得
70	动力锂电池电芯处理装置	2016213781507	实用新型	猎奇智能	2016.12.15	原始取得

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人	申请日	取得方式
71	动力锂电池电芯打包装置	2016213691888	实用新型	猎奇智能	2016.12.14	原始取得
72	三枪焊接耦合机	2016209084280	实用新型	猎奇智能	2016.8.22	原始取得
73	一种用于三枪焊接耦合机的耦合装置	2016209084187	实用新型	猎奇智能	2016.8.22	原始取得
74	收光元器件的装配机	2016209084399	实用新型	猎奇智能	2016.8.22	原始取得
75	一种用于耦合机的负载平衡贴面装置	2016208112705	实用新型	猎奇智能	2016.7.29	原始取得
76	玻璃片透光率与光损的检测机	2016208107317	实用新型	猎奇智能	2016.7.29	原始取得
77	一种镜头耦合机	201620811948X	实用新型	猎奇智能	2016.7.29	原始取得
78	自动焊接机	2016208107711	实用新型	猎奇智能	2016.7.29	原始取得
79	阴极板自动焊接线	2016208107533	实用新型	猎奇智能	2016.7.29	原始取得
80	一种用于自动焊接机的专用治具	2016208102154	实用新型	猎奇智能	2016.7.29	原始取得
81	玻璃组件检测机	2016208102050	实用新型	猎奇智能	2016.7.29	原始取得
82	一种磁环压装机构	2022111803592	发明专利	飞泰智能	2022.9.27	原始取得
83	一种光模块自动焊接耦合机	2018108256226	发明专利	飞泰智能	2018.7.25	原始取得
84	一种冷却定位工装	2024216490921	实用新型	飞泰智能	2024.7.12	原始取得
85	一种批量零部件的风冷设备	2024216389201	实用新型	飞泰智能	2024.7.11	原始取得
86	一种激光自动清洗设备	2023222596755	实用新型	飞泰智能	2023.08.22	原始取得
87	一种自动切料翻转机构	2023219197815	实用新型	飞泰智能	2023.7.20	原始取得
88	一种自动冷却装置	2023217964028	实用新型	飞泰智能	2023.7.10	原始取得
89	一种机器人夹爪	2022225582247	实用新型	飞泰智能	2022.9.27	原始取得
90	一种旋转顶升组件	2022225589725	实用新型	飞泰智能	2022.9.27	原始取得
91	一种调节器的定位治具	2021218721039	实用新型	飞泰智能	2021.8.11	原始取得
92	一种调节器碳刷弹簧力检测装置	2021218704546	实用新型	飞泰智能	2021.8.11	原始取得
93	一种转子铁芯点胶设备	2020233242407	实用新型	飞泰智能	2020.12.31	原始取得
94	一种齿轮刀具加工精密辅助工装	2020232273361	实用新型	飞泰智能	2020.12.28	原始取得
95	一种螺钉批嘴快速换型工装	2020232235158	实用新型	飞泰智能	2020.12.28	原始取得
96	一种自动装配弹簧机构	2020233201040	实用新型	飞泰智能	2020.12.31	原始取得
97	一种夹紧翻转上下料机构	2020231713792	实用新型	飞泰智能	2020.12.24	原始取得
98	一种定子与转子表面自动清洁装置	2020232273376	实用新型	飞泰智能	2020.12.28	原始取得

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人	申请日	取得方式
99	一种动平衡钻孔深度补偿优化工装	2020232235124	实用新型	飞泰智能	2020.12.28	原始取得
100	一种光器件的清洁避位装置	2020213900907	实用新型	飞泰智能	2020.7.15	原始取得
101	一种转盘式铆钉定位装置	2020214141877	实用新型	飞泰智能	2020.7.17	原始取得
102	一种转盘式铆钉供料装置	2020214148594	实用新型	飞泰智能	2020.7.17	原始取得
103	一种光器件端面清洁装置	2020213900875	实用新型	飞泰智能	2020.7.15	原始取得
104	一种光器件的定位供料夹具	2020213912228	实用新型	飞泰智能	2020.7.15	原始取得
105	一种手机马达的边框送料装置	2019213629024	实用新型	飞泰智能	2019.8.21	原始取得
106	一种手机马达翻转装置	201921362073X	实用新型	飞泰智能	2019.8.21	原始取得
107	一种光纤头六维定位平台	2018211832630	实用新型	飞泰智能	2018.7.25	原始取得
108	光纤锁紧装置	2018211916212	实用新型	飞泰智能	2018.7.25	原始取得
109	一种光模块自动焊接耦合机	2018211916231	实用新型	飞泰智能	2018.7.25	原始取得
110	一种光模块夹具	201821184117X	实用新型	飞泰智能	2018.7.25	原始取得
111	光纤上料装置	2018211841038	实用新型	飞泰智能	2018.7.25	原始取得
112	光模块耦合定位装置	201821184043X	实用新型	飞泰智能	2018.7.25	原始取得
113	保偏光纤定轴机	2018211846050	实用新型	飞泰智能	2018.7.25	原始取得
114	一种光模块焊枪找正装置	2018211847744	实用新型	飞泰智能	2018.7.25	原始取得
115	一种双龙门芯片贴装设备及其方法	2025113775707	发明专利	猎奇智能	2025.9.25	原始取得
116	镜片自动叠合设备及叠合方法	2025113158350	发明专利	猎奇智能	2025.9.15	原始取得
117	非对称芯片拾放操作轨迹分段速度规划方法、设备、存储介质	2025111444714	发明专利	猎奇智能	2025.8.15	原始取得
118	一种泵体中反射镜耦合设备及其耦合方法	2025109291180	发明专利	猎奇智能	2025.7.7	原始取得
119	PLC 光芯片的 FA 耦合设备及其耦合方法	2025107889503	发明专利	猎奇智能	2025.6.13	原始取得
120	一种光通信芯片测试设备及方法	2025108981121	发明专利	猎奇智能	2025.7.1	原始取得
121	一种基于直驱技术回转中心对准的贴装头组件	202510891777X	发明专利	猎奇智能	2025.6.30	原始取得
122	一种芯片拾取操作轨迹规划方法、设备	2025104956046	发明专利	猎奇智能	2025.4.21	原始取得
123	一种自动插磁钢设备	2024113081015	发明专利	飞泰智能	2024.9.19	原始取得
124	吸嘴库机构及贴装装置	2025214078522	实用新型	猎奇智能	2025.7.7	原始取得
125	一种抓取部、自动上料装置和自动上料工位	2024224794952	实用新型	飞泰智能	2024.10.14	原始取得
126	一种平衡装置机构	2024223307386	实用新型	飞泰智能	2024.9.24	原始取得

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人	申请日	取得方式
127	一种多类型芯片全自动混合贴装设备及贴装方法	2023102115973	发明专利	猎奇智能	2023.3.7	原始取得
128	一种 FA 耦合设备及其耦合方法	2025115964718	发明专利	飞泰智能	2025.11.4	原始取得
129	一种多芯片同步贴装系统及方法	2025117890545	发明专利	猎奇智能	2025.12.1	原始取得

注：根据飞泰智能与武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行于 2025 年 4 月 29 日签订的《最高额质押合同》，飞泰智能将上表中九项专利质押给武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行，为飞泰智能自 2025 年 4 月 29 日至 2027 年 4 月 29 日期间办理约定的各类业务所形成的债权提供担保，担保债权的最高余额为人民币 1,000 万元。

（三） 软件著作权

序号	软件著作权名称	登记号	登记日	权属人	取得方式
1	猎奇基于欧姆龙 CP 系列 PLC 控制系统	2024SR2235162	2024.12.30	猎奇智能	原始取得
2	猎奇基于三菱 L 系列 CPU 控制软件系统	2024SR2236246	2024.12.30	猎奇智能	原始取得
3	猎奇基西门子 1500 系列 CPU 控制软件系统	2024SR2235026	2024.12.30	猎奇智能	原始取得
4	猎奇芯片测试软件	2020SR0982293	2020.8.25	猎奇智能	原始取得
5	猎奇芯片测试软件	2020SR0982436	2020.8.25	猎奇智能	原始取得
6	猎奇开放式通用耦合设备控制软件	2020SR0981352	2020.8.25	猎奇智能	原始取得
7	猎奇光电耦合设备控制软件	2020SR0227009	2020.3.9	猎奇智能	原始取得
8	猎奇组装生产线控制软件	2020SR0188290	2020.2.27	猎奇智能	原始取得
9	猎奇自动耦合设备控制软件	2020SR0188293	2020.2.27	猎奇智能	原始取得
10	猎奇自动点胶贴片软件	2020SR0068870	2020.1.14	猎奇智能	原始取得
11	猎奇自动上下料软件	2020SR0069015	2020.1.14	猎奇智能	原始取得
12	猎奇全自动亚微米耦合贴片机软件	2020SR0019924	2020.1.6	猎奇智能	原始取得
13	猎奇组装生产线控制软件	2019SR0679826	2019.7.2	猎奇智能	原始取得
14	猎奇 COC 老化测试软件	2019SR0127553	2019.2.2	猎奇智能	原始取得
15	猎奇 COC 老化测试软件	2018SR687487	2018.8.28	猎奇智能	原始取得
16	猎奇自动耦合设备控制软件	2018SR652323	2018.8.15	猎奇智能	原始取得
17	猎奇自动耦合设备控制软件	2018SR640660	2018.8.10	猎奇智能	原始取得
18	猎奇光电耦合设备控制软件	2018SR632211	2018.8.9	猎奇智能	原始取得
19	猎奇自动耦合设备控制软件	2018SR634665	2018.8.9	猎奇智能	原始取得
20	飞泰自动点胶贴片机软件	2025SR0499262	2025.3.21	飞泰智能	原始取得
21	飞泰全自动亚微米共晶贴片机软件	2025SR0499249	2025.3.21	飞泰智能	原始取得
22	猎奇基于三菱 FX3U 控制软件系统	2025SR0352985	2025.2.28	猎奇智能	原始取得
23	猎奇基于基恩士 PLC 控制系统	2025SR0343728	2025.2.27	猎奇智能	原始取得

序号	软件著作权名称	登记号	登记日	权属人	取得方式
24	猎奇 H3 系列点胶贴片机 Pro 版软件	2025SR0341352	2025.2.27	猎奇智能	原始取得
25	猎奇 EML 老化测试 Pro 版软件	2025SR0341360	2025.2.27	猎奇智能	原始取得
26	猎奇 EB3300 亚微米共晶贴片机 Pro 版软件	2025SR0341379	2025.2.27	猎奇智能	原始取得
27	猎奇 H3 系列点胶贴片机标准版软件	2025SR0285287	2025.2.19	猎奇智能	原始取得
28	猎奇 800G 光模块产品耦合设备控制软件	2025SR0290346	2025.2.19	猎奇智能	原始取得
29	猎奇 EB3300 亚微米共晶贴片机标准版软件	2025SR0272252	2025.2.17	猎奇智能	原始取得
30	猎奇 EML 老化测试标准版软件	2025SR0242412	2025.2.12	猎奇智能	原始取得
31	猎奇非标产线控制系统	2025SR0247189	2025.2.12	猎奇智能	原始取得
32	猎奇硅光产品耦合设备控制软件	2025SR0237161	2025.2.11	猎奇智能	原始取得
33	猎奇基于欧姆龙 CJ 系列 PLC 控制系统	2025SR0165933	2025.1.24	猎奇智能	原始取得
34	焊接在线检测及监测系统	2024SR2000018	2024.12.6	飞泰智能	原始取得
35	飞泰基于基恩士 PLC 控制系统	2024SR1538042	2024.10.16	飞泰智能	原始取得
36	飞泰基于西门子 PLC 控制系统	2024SR1529821	2024.10.15	飞泰智能	原始取得
37	飞泰基于三菱 PLC 控制系统	2024SR1530313	2024.10.15	飞泰智能	原始取得
38	飞泰组装生产线控制系统	2024SR1530351	2024.10.15	飞泰智能	原始取得
39	飞泰自动耦光设备控制软件	2019SR0556589	2019.6.3	飞泰智能	原始取得
40	飞泰自动耦光设备控制软件	2018SR1033400	2018.12.18	飞泰智能	原始取得
41	水导激光控制系统	2025SR2507693	2025.12.26	瑞森联	原始取得
42	玻璃激光焊接系统	2025SR2507697	2025.12.26	瑞森联	原始取得
43	激光焊接在线监测软件	2025SR2507696	2025.12.26	瑞森联	原始取得
44	贴片机软件平台	2026SR0673953	2026.6.22	飞泰智能	原始取得
45	贴片机软件平台	2026SR0670919	2026.6.18	飞泰智能	原始取得
46	飞泰基于西门子 PLC 控制系统	2026SR0653574	2026.6.10	飞泰智能	原始取得
47	飞泰通用型耦合软件	2026SR0593618	2026.5.8	飞泰智能	原始取得

（四） 域名

序号	域名	域名所有者	取得方式	备案号
1	suzhoulieqi.com	猎奇智能	原始取得	苏 ICP 备 16042332 号-1

附件三：募集资金投资项目具体情况介绍

（一）高端智能装备制造建设项目

1、项目概况

本项目实施主体为猎奇智能，项目总投资 58,240.78 万元，建设期为 3 年。公司计划新建智能化生产线，项目建筑面积 56,000.00 平方米，并引入先进的生产设备，扩大公司现有产能，以满足光通信、半导体和汽车产业等下游市场对智能生产装备持续增长的需求。

2、项目投资概算

本项目总投资为 58,240.78 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占总投资的比例
1	**建设投资**	**48,846.70**	**83.87%**
1.1	建筑工程费	23,303.33	40.01%
1.2	设备购置费	19,224.90	33.01%
1.3	安装工程费	523.50	0.90%
1.4	工程建设其他费用	3,510.60	6.03%
1.5	预备费	2,284.37	3.92%
2	**铺底流动资金**	**9,394.08**	**16.13%**
合计		**58,240.78**	**100.00%**

注：工程建设其他费用中包含土地购置费 875 万元

3、项目实施进度

本项目建设期拟定为 3 年，进度计划内容包括前期准备、勘察设计、土建施工、设备采购与安装调试、人员招聘与培训、试生产。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	前期准备	■											
2	勘察设计	■	■										
3	土建施工		■	■	■	■	■						
4	设备采购与安装调试					■	■	■	■				
5	人员招聘与培训								■	■	■		

序号	建设内容	月份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
6	试生产												

4、项目选址及用地情况

本项目建设地点位于江苏省苏州市昆山市高新技术开发区北门路东侧、龙生路南侧，用地面积约 35 亩，周边配套设施齐全。截至本招股意向书出具日，公司已取得苏（2026）昆山市不动产权第 3010906 号不动产权证书。

5、环保影响及措施

本项目建成后主要进行光模块封装测试设备的装配、生产，不属于重污染行业。本项目将在建设过程中严格遵守国家和地方的法律法规，严格执行建设项目环境评价和环境管理制度。项目生产过程中产生的少量废水、废气、固体废弃物、噪声和危险废物均经过相应的环保设施处理，对周围环境不会造成污染，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。

6、项目经济效应分析

项目建成投产后，项目达产年营业收入 151,070.80 万元，投资回收期为 6.60 年（含建设期），税后内部收益率为 28.21%。

（二）研发中心建设项目

1、项目概况

本项目实施主体为猎奇智能，项目总投资 25,100.61 万元，建设期为 3 年。公司计划新建研发中心，建立功能完善的研究实验室，购置先进的研发、试验设备和软件，并通过引进机械、光学、软件等领域的高端研发人才以扩充公司技术研发团队。同时，公司还将根据光模块行业发展趋势，开展前瞻性技术研发，向半导体领域封装设备进行技术延伸，以持续提升公司的技术研发实力和综合竞争力。

2、项目投资概算

本项目总投资为 25,100.61 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占总投资的比例
1	**建设投资**	**11,160.45**	**44.46%**
1.1	建筑工程费	5,225.00	20.82%
1.2	设备购置费	4,122.73	16.42%
1.3	安装工程费	72.51	0.29%
1.4	工程建设其他费用	544.94	2.17%
1.5	预备费	1,195.27	4.76%
2	**研究开发费用**	**13,940.16**	**55.54%**
2.1	研发人员工资	9,845.66	39.22%
2.2	研发耗材费用	3,824.50	15.24%
2.3	检测费等其他研发费用	270.00	1.08%
合计		**25,100.61**	**100.00%**

3、项目研发方向

本项目研发方向具体如下表所示：

序号	研发方向	研发课题
1	产品迭代升级	芯片级老化测试设备的研发、高精度多芯片混合贴片设备的研发、高精度倒装贴片设备的研发
2	前瞻性技术储备	TCB 热压键合封装设备的研发、Chip to Wafer 封装工艺贴片设备的研发、PLP 封装工艺贴片设备的研发、晶圆级耦合工艺开发
3	应用领域拓展	IC 高速固晶贴片设备的研发、微组装工艺的研发

4、项目实施进度

本项目建设期拟定为 3 年，进度计划内容包括前期准备、勘察设计、土建施工、设备采购、安装与调试、人员招聘与培训、课题研发等。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		3	**6**	**9**	**12**	**15**	**18**	**21**	**24**	**27**	**30**	**33**	**36**
1	项目前期准备												
2	勘察设计												
3	土建施工												
4	设备采购、安装与调试												

序号	建设内容	月份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
5	人员招聘与培训												
6	课题研发												

5、项目选址及用地情况

本项目建设地点位于江苏省苏州市昆山市高新技术开发区北门路东侧、龙生路南侧，用地面积约 35 亩，周边配套设施齐全。截至本招股意向书出具日，公司已取得苏（2026）昆山市不动产权第 3010906 号不动产权证书。

6、环保影响及措施

本项目建成后主要进行光模块、半导体封装测试设备的研发，不属于生产性项目，不属于重污染行业。本项目将在建设过程中严格遵守国家和地方的法律法规，严格执行建设项目环境评价和环境管理制度。

7、项目经济效应分析

本项目投资于研发中心建设及课题研发，不直接为公司带来营业收入，不进行单独的财务评价，但项目投入使用后，将对公司长远发展产生重要支撑作用，进一步夯实并提升公司的技术研发实力，拓展公司业务的覆盖范围与深度，强化公司的核心竞争力，从而有力推动公司的可持续发展进程。

（三）补充流动资金

公司本次公开发行拟使用募集资金 8,000.00 万元用于补充流动资金，本项目不涉及备案及环境影响评价等事项。报告期内，公司营收规模扩张较快，对营运资金的需求持续增加。随着公司经营规模的不断扩大，公司正常运营和持续发展所需的资本性支出和营运资金迅速增加，公司除了要进行生产厂房建设、生产设备的购置等固定资产投资外，还需要大量流动资金以保证原材料采购、人工费用支付、技术研发等重要的日常生产经营活动。公司所处光通信、半导体行业，需要持续进行研发投入以保证技术领先性和产品的市场竞争优势。同时，公司所处行业为知识密集型和人才密集型行业，保留和吸引高端人才对公司的发展经营具有重要意义。

本次补充流动资金将成为公司在研发团队建设、业务拓展和日常营运方面

的重要资金来源，对公司研发投入和人才队伍建设给予有力的支持。公司将进一步巩固在光通信封装测试设备行业的市场地位，增加市场竞争力和影响力，提升核心竞争力。

附件四：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

（一）投资者关系的主要安排

1、信息披露制度和流程

为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程（草案）》等有关规定，公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。相关制度明确了信息披露的内容、程序、管理、责任追究机制，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。

2、投资者沟通渠道的建立情况

发行人设置了董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作，主管负责人为董事会秘书。为确保与投资者沟通渠道畅通，为投资者依法参与公司决策管理提供便利条件，董事会秘书将负责接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料等，联系方式如下：

董事会秘书	刘正
电话	0512-57022580-622
电子邮箱	ir@suzhoulieqi.com
地址	昆山市玉山镇新塘路 826 号 12 栋、13 栋

3、未来开展投资者关系管理的规划

公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理工作的基本原则、与投资者沟通的内容以及公司的主要职责等有明确规定。

（二）股利分配决策程序

公司股利分配政策及决策程序请详见本招股意向书“第九节 投资者保护”之“二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及本次发行后的股利分配政策”的相关内容。

（三）股东投票机制的建立情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定了《公司章程（草案）》、《股东会议事规则》，并经公司股东会审议通过。

公司通过制定上述章程、规则对股东投票机制作出了规定，建立了累积投票、中小投资者单独计票、股东会网络投票、征集投票权等股东投票机制，保障公司股东会规范运作；保障所有股东，特别是中小股东的投票权，使公司股东能够依法行使投票权，充分表达意志。

附件五：股东会、董事会、监事会（审计委员会）、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

（一）股东会制度的建立健全及运行情况

自股份公司设立以来，公司股东会严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等文件的规定规范运作，历次会议的召集方式、议事程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司董事会由 7 名董事组成，包括独立董事 3 名，非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事由股东会选举或更换，任期 3 年，任期届满，可连选连任。自股份公司设立以来，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》等文件的规定规范运作，历次会议的召集方式、议事程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定。

（三）监事会（审计委员会）制度的建立健全及运行情况

公司取消监事会前，公司监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。自股份公司设立以来，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等文件的规定规范运作，历次会议的召集方式、议事程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于取消公司监事会并制定、修改相关内部治理制度的议案》，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

董事会审计委员会由 3 名成员组成，设召集人 1 名。自审计委员会承接原监事会职能以来，按照《公司章程》、《苏州猎奇智能设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等文件的规定规范运作。

（四）独立董事制度的建立健全及履行职责情况

公司董事会设 3 名独立董事，达到董事会总人数的三分之一，其中 1 名为会计专业人士。独立董事自聘任以来，依据有关法律、法规及有关上市规则、《公司法》和《独立董事工作制度》谨慎、认真、勤勉地履行权利和义务，为公司完善治理结构和规范运作发挥了重要作用。

（五）董事会秘书制度的建立健全及履行职责情况

公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘，主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司第一届董事会第一次会议决议聘任刘正先生为公司董事会秘书。董事会秘书自受聘以来，严格按照《公司章程》《董事会秘书工作制度》的相关规定筹备董事会和股东会，勤勉地履行了其职责。

附件六：申报前十二个月新增股东的基本情况

（一）金浦慕和

企业名称	上海金浦慕和私募投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MAC1WLFM7M
成立时间	2022 年 11 月 10 日
出资额	19,698.00 万元人民币
执行事务合伙人	上海金浦新朋私募基金管理有限公司
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2026 年 6 月 30 日，金浦慕和的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙份额（万元）	出资比例	合伙人性质
1	上海金浦新朋私募基金管理有限公司	18.00	0.09%	普通合伙人
2	上海瀚娱动投资有限公司	5,400.00	27.41%	有限合伙人
3	和元生物技术（上海）股份有限公司	5,400.00	27.41%	有限合伙人
4	江苏新潮创新投资集团有限公司	3,600.00	18.28%	有限合伙人
5	郑玉英	1,800.00	9.14%	有限合伙人
6	苏州市聚萤产业投资有限公司	1,800.00	9.14%	有限合伙人
7	上海尤聚安企业管理合伙企业（有限合伙）	1,500.00	7.61%	有限合伙人
8	上海烁焜企业管理中心（有限合伙）	180.00	0.91%	有限合伙人
合计		**19,698.00**	**100.00%**	

（二）士兰控股

企业名称	士兰控股（浙江）有限公司
统一社会信用代码	91331127MA2E4YKPXJ
成立时间	2021 年 1 月 12 日
注册资本	10,000.00 万元
法定代表人	陈向东
注册地址	浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道惠明路 82 号 510—35 号
经营范围	一般项目：控股公司服务；企业总部管理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；工程和技术研究和试验发

	展；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2026 年 6 月 30 日，士兰控股的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	杭州士兰控股有限公司	10,000.00	100.00%

（三）盛宇华天

企业名称	江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320105MA27EWM43A
成立时间	2021 年 11 月 17 日
出资额	63,600.00 万元
执行事务合伙人	南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	江苏省南京市江宁区天元东路 228 号财富广场二期 8 幢 1013 室（江宁高新园）
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2026 年 6 月 30 日，盛宇华天的出资结构如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙份额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	南京华宇管理咨询合伙企业（有限合伙）	600.00	0.94%	普通合伙人
2	丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	9,000.00	14.15%	有限合伙人
3	上海铖晟投资中心（有限合伙）	7,500.00	11.79%	有限合伙人
4	西安天利投资合伙企业（有限合伙）	7,500.00	11.79%	有限合伙人
5	江苏鱼跃科技发展有限公司	6,000.00	9.43%	有限合伙人
6	朱江声	5,460.00	8.58%	有限合伙人
7	南京融泓嘉毅投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	4.72%	有限合伙人
8	姜冬仙	1,800.00	2.83%	有限合伙人
9	陈厚	1,800.00	2.83%	有限合伙人
10	李健	1,800.00	2.83%	有限合伙人
11	李萌	1,800.00	2.83%	有限合伙人
12	丹阳市高新技术创业投资有限公司	1,500.00	2.36%	有限合伙人
13	陈建平	1,500.00	2.36%	有限合伙人
14	江苏绿叶锅炉有限公司	1,200.00	1.89%	有限合伙人
15	刘代华	1,200.00	1.89%	有限合伙人
16	陈首益	1,200.00	1.89%	有限合伙人

序号	合伙人姓名/名称	合伙份额（万元）	出资比例	合伙人类型
17	施明泰	1,200.00	1.89%	有限合伙人
18	沈胜昔	1,200.00	1.89%	有限合伙人
19	南京霍顿石化科技有限公司	1,200.00	1.89%	有限合伙人
20	上海良辰投资管理有限公司	1,140.00	1.79%	有限合伙人
21	西安汇锦天诚科技合伙企业（有限合伙）	1,080.00	1.70%	有限合伙人
22	安赫集团有限公司	1,020.00	1.60%	有限合伙人
23	刘明凌	780.00	1.23%	有限合伙人
24	单峰	720.00	1.13%	有限合伙人
25	卞开勤	600.00	0.94%	有限合伙人
26	路晶鹏	600.00	0.94%	有限合伙人
27	钱伟	600.00	0.94%	有限合伙人
28	梁峰	600.00	0.94%	有限合伙人
合计		**63,600.00**	**100.00%**	

（四）全德学镂科芯

企业名称	南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320691MAC7RQNL1U
成立时间	2023 年 2 月 21 日
出资额	93,751.00 万元
执行事务合伙人	金芯通达企业咨询服务（上海）合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	江苏省南通市开发区崇州大道 60 号紫琅科技城 6 号楼 12 层
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2026 年 6 月 30 日，全德学镂科芯的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙份额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	金芯通达企业咨询服务（上海）合伙企业（有限合伙）	1,951.00	2.08%	普通合伙人
2	通富微电子股份有限公司	20,000.00	21.33%	有限合伙人
3	南通新兴产业基金（有限合伙）	20,000.00	21.33%	有限合伙人
4	南通华泓投资有限公司	17,000.00	18.13%	有限合伙人
5	南通宝月湖科创投资集团有限公司	9,500.00	10.13%	有限合伙人

序号	合伙人名称/姓名	合伙份额（万元）	出资比例	合伙人类型
6	国泰君安母基金	8,000.00	8.53%	有限合伙人
7	苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000.00	5.33%	有限合伙人
8	沈志刚	2,000.00	2.13%	有限合伙人
9	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	2,000.00	2.13%	有限合伙人
10	张振宇	1,300.00	1.39%	有限合伙人
11	谢力书	1,000.00	1.07%	有限合伙人
12	盛美半导体设备（上海）股份有限公司	1,000.00	1.07%	有限合伙人
13	朱小红	1,000.00	1.07%	有限合伙人
14	徐康宁	1,000.00	1.07%	有限合伙人
15	常州中英科技股份有限公司	1,000.00	1.07%	有限合伙人
16	吴美琴	1,000.00	1.07%	有限合伙人
17	佛山市联动科技股份有限公司	1,000.00	1.07%	有限合伙人
合计		**93,751.00**	**100.00%**	

（五）鸿溢盛朗

企业名称	宁波鸿溢盛朗创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330205MACKBY3N7G
成立时间	2023 年 6 月 8 日
出资额	3,496.00 万元
执行事务合伙人	上海襄聚私募基金管理有限公司
主要经营场所	浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 360 号 1153 室
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2026 年 6 月 30 日，鸿溢盛朗的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙份额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	上海襄聚私募基金管理有限公司	1.00	0.03%	普通合伙人
2	潘志龙	1,150.00	32.89%	有限合伙人
3	宁波香溢融升股权投资合伙企业（有限合伙）	600.00	17.16%	有限合伙人
4	郑晓燕	450.00	12.87%	有限合伙人

序号	合伙人名称/姓名	合伙份额（万元）	出资比例	合伙人类型
5	朱伟元	355.00	10.15%	有限合伙人
6	盖淑琴	220.00	6.29%	有限合伙人
7	蒋国星	200.00	5.72%	有限合伙人
8	姚岳阳	200.00	5.72%	有限合伙人
9	张莉莉	120.00	3.43%	有限合伙人
10	王辉	100.00	2.86%	有限合伙人
11	严旭燕	100.00	2.86%	有限合伙人
合计		**3,496.00**	**100.00%**	

（六）鸿溢盛越

企业名称	宁波鸿溢盛越创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330205MACJLB6Y7K
成立时间	2023 年 5 月 15 日
出资额	3,852.00 万元
执行事务合伙人	上海襄聚私募基金管理有限公司
主要经营场所	浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 360 号 1154 室
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2026 年 6 月 30 日，鸿溢盛越的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙份额（万元）	持股比例	合伙人类型
1	上海襄聚私募基金管理有限公司	1.00	0.03%	普通合伙人
2	汪乐平	800.00	20.77%	有限合伙人
3	陆帅帅	500.00	12.98%	有限合伙人
4	朱伟元	478.00	12.41%	有限合伙人
5	陈妙飞	400.00	10.38%	有限合伙人
6	潘志龙	400.00	10.38%	有限合伙人
7	陈裕忠	300.00	7.79%	有限合伙人
8	黄达	200.00	5.19%	有限合伙人
9	绍兴市大舜农业发展有限公司	200.00	5.19%	有限合伙人
10	唐智君	200.00	5.19%	有限合伙人
11	卢珉	200.00	5.19%	有限合伙人

序号	合伙人名称/姓名	合伙份额（万元）	持股比例	合伙人类型
12	周红萍	173.00	4.49%	有限合伙人
合计		**3,852.00**	**100.00%**	

（七）玉澄德菉

企业名称	昆山市玉澄德菉股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320583MADCF9MWXN
成立时间	2024 年 3 月 13 日
出资额	20,000.00 万元
执行事务合伙人	昆山市国科创业投资有限公司
主要经营场所	江苏省苏州市昆山市玉山镇登云路 258 号汇金财富广场 1 号楼 703 室
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2026 年 6 月 30 日，玉澄德菉的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	昆山市国科创业投资有限公司	200.00	1.00%	普通合伙人
2	昆山创业控股集团有限公司	7,800.00	39.00%	有限合伙人
3	昆山沪苏新城科创发展有限公司	6,000.00	30.00%	有限合伙人
4	昆山汇创投资有限公司	6,000.00	30.00%	有限合伙人
合计		**20,000.00**	**100.00%**	

（八）鹏城愿景

企业名称	深圳鹏城愿景创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MAD0HK6B6Y
成立时间	2023 年 9 月 25 日
出资额	111,111 万元
执行事务合伙人	深圳银杏谷创业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城 B805
经营范围	一般经营项目是：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

截至 2026 年 6 月 30 日，鹏城愿景的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	深圳银杏谷创业投资合伙企业（有限合伙）	1,111.00	1.00%	普通合伙人
2	深圳市汇通金控基金投资有限公司	30,000.00	27.00%	有限合伙人
3	景宁银杏谷壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000.00	18.00%	有限合伙人
4	广东省粤科创业投资有限公司	10,000.00	9.00%	有限合伙人
5	陈向明	5,000.00	4.50%	有限合伙人
6	浙江兆丰机电股份有限公司	5,000.00	4.50%	有限合伙人
7	杭州上城领航创业投资有限公司	5,000.00	4.50%	有限合伙人
8	张煜	5,000.00	4.50%	有限合伙人
9	张永胜	5,000.00	4.50%	有限合伙人
10	张拥军	5,000.00	4.50%	有限合伙人
11	俞培斌	5,000.00	4.50%	有限合伙人
12	浙江吉华集团股份有限公司	3,200.00	2.88%	有限合伙人
13	马紫君	2,000.00	1.80%	有限合伙人
14	王惠方	2,000.00	1.80%	有限合伙人
15	北京海天瑞声科技股份有限公司	2,000.00	1.80%	有限合伙人
16	倪弘晔	2,000.00	1.80%	有限合伙人
17	任建林	2,000.00	1.80%	有限合伙人
18	庞友谊	1,800.00	1.62%	有限合伙人
合计		**111,111.00**	**100.00%**	

（九）士兰微

企业名称	杭州士兰微电子股份有限公司
统一社会信用代码	91330000253933976Q
成立时间	1997 年 9 月 25 日
注册资本	166,407.1845 万元
法定代表人	陈向东
注册地址	浙江省杭州市黄姑山路 4 号
经营范围	电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）。

士兰微为上海证券交易所主板上市公司，截至 2026 年 6 月 30 日，士兰微的前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	杭州士兰控股有限公司	51,391.70	30.88%
2	华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	6,197.50	3.72%
3	香港中央结算有限公司	5,400.87	3.25%
4	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	2,502.25	1.50%
5	陈向东	1,234.99	0.74%
6	范伟宏	1,061.39	0.64%
7	中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	932.25	0.56%
8	江忠永	825.00	0.50%
9	郑少波	737.93	0.44%
10	高盛国际-自有资金	686.73	0.41%
合计		**70,970.61**	**42.64%**

（十）成都励石

企业名称	成都励石创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91510100MA7K08UB0C
成立时间	2022 年 3 月 8 日
出资额	30,000.00 万元
执行事务合伙人	成都励赞企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区兴业大道 1688 号 3 栋 6 楼 607 号
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2026 年 6 月 30 日，成都励石的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	成都励赞企业管理合伙企业（有限合伙）	300.00	1.00%	普通合伙人
2	青岛励新投资管理中心（有限合伙）	9,100.00	30.33%	有限合伙人
3	成都市菁蓉创富投资有限公司	8,600.00	28.67%	有限合伙人
4	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	6,000.00	20.00%	有限合伙人
5	成都新经济产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000.00	10.00%	有限合伙人
6	成都中金现代产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000.00	10.00%	有限合伙人
合计		**30,000.00**	**100.00%**	

（十一）上海励聚

企业名称	上海励聚创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310113332568321U
成立时间	2015 年 4 月 10 日
出资额	10,000.00 万元
执行事务合伙人	上海励烁企业管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	上海市嘉定区曹安公路 1615 号 601 室-5
经营范围	一般项目：创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2026 年 6 月 30 日，上海励聚的出资结构如下：

序号	合伙人名称/姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类型
1	上海励烁企业管理合伙企业（有限合伙）	100.00	1.00%	普通合伙人
2	上海励新投资管理中心（有限合伙）	4,900.00	49.00%	有限合伙人
3	上海天使引导创业投资有限公司	3,000.00	30.00%	有限合伙人
4	林进展	2,000.00	20.00%	有限合伙人
合计		**10,000.00**	**100.00%**	

附件七：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，选举产生了各专门委员会委员，建立了董事会专门委员会工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会对董事会负责。审计委员会中担任主任委员的独立董事是会计专业人士。

截至本招股意向书签署日，董事会专门委员会组成人员具体如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
战略委员会	罗超	徐凯、张荣君
薪酬与考核委员会	上官胜	张莉、罗超
审计委员会	上官胜	张莉、程显
提名委员会	张荣君	张莉、罗超

各专门委员会的主要职权如下：

（一）战略委员会

公司董事会下设战略委员会，根据《苏州猎奇智能设备股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

（二）薪酬与考核委员会

公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据《苏州猎奇智能设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案。

（三）审计委员会

公司董事会下设审计委员会，根据《苏州猎奇智能设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，审计委员会的主要职责如下：

1、根据审计委员会工作细则，审核公司的财务信息及其披露；

2、监督及评估内外部审计工作和内部控制；

3、审查公司的内控制度；

4、对重大关联交易、募集资金使用、大额资金往来等事项实施监督并提出报告；

5、履行《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规规定的审计委员会职权；

6、公司董事会授权的其他事宜及相关法律、法规中涉及的其他事项。

（四）提名委员会

公司董事会下设提名委员会，根据《苏州猎奇智能设备股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，提名委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出建议。

附件八：子公司、参股公司简要情况

截至本招股意向书签署日，公司拥有 4 家境内全资子公司、1 家境内控股

子公司、2 家境外全资子公司，1 家分公司，无参股公司。具体情况如下：

（一）飞泰智能

飞泰智能的基本情况及简要财务数据，详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人控股子公司、参股公司及分公司”之“（一）重要子公司”。

（二）凯欧光电

截至本招股意向书签署日，凯欧光电基本情况如下：

企业名称	昆山凯欧光电科技有限公司
统一社会信用代码	913205835939183423
注册地/主要生产经营地	昆山市玉山镇亿升路 398 号 4 号房一层
法定代表人	罗超
成立日期	2012 年 4 月 10 日
注册资本	1,000.00 万元
股权结构	猎奇智能持股 100%
主营业务/业务定位	机加工业务

凯欧光电最近一年一期的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月/2026 年 6 月 30 日	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产	3,547.18	2,576.23
净资产	1,571.02	1,108.64
营业收入	1,411.93	1,672.32
净利润	462.38	405.91

注：上述财务数据经容诚会计师审计。

（三）峻博软件

截至本招股意向书签署日，峻博软件基本情况如下：

企业名称	苏州峻博软件有限公司
统一社会信用代码	91320583MA22NKK93P
注册地/主要生产经营地	苏州市昆山市玉山镇亿升路 398 号 3 号房
法定代表人	罗超
成立日期	2020 年 10 月 14 日

注册资本	500.00 万元
股权结构	猎奇智能持股 100%
主营业务/业务定位	设备软件开发

峻博软件最近一年一期的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月/2026 年 6 月 30 日	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产	67.29	67.21
净资产	66.56	66.55
营业收入	-	-
净利润	0.02	0.04

注：上述财务数据经容诚会计师审计。

（四）瑞森联

截至本招股意向书签署日，瑞森联基本情况如下：

企业名称	武汉瑞森联科技有限公司
统一社会信用代码	91420100MADCW50MXT
注册地/主要生产经营地	武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A1 栋 103-501 室
法定代表人	罗超
成立日期	2024 年 3 月 11 日
注册资本	1,000.00 万元
股权结构	猎奇智能持股 100%
主营业务/业务定位	激光设备的研发、生产和销售

瑞森联最近一年一期的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月/2026 年 6 月 30 日	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产	2,552.30	2,290.66
净资产	-855.30	-462.86
营业收入	-	-
净利润	-453.10	-920.36

注：上述财务数据经容诚会计师审计。

（五）云琦精密

截至本招股意向书签署日，云琦精密基本情况如下：

企业名称	武汉云琦精密制造有限公司
统一社会信用代码	91320583MA278CFT6R
注册地/主要生产经营地	湖北省武汉市蔡甸区玉贤街前进村蔡家岭 112 号-18
法定代表人	罗超
成立日期	2021 年 10 月 18 日
注册资本	1,000.00 万元
股权结构	猎奇智能持股 70%，李慧持股 15%，边小社持股 10%，马雪毅持股 5%
主营业务/业务定位	陶瓷劈刀技术的研发、生产及销售

云琦精密最近一年一期的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月/2026 年 6 月 30 日	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产	1,480.09	1,198.21
净资产	293.83	417.43
营业收入	153.87	118.24
净利润	-123.60	-266.14

注：上述财务数据经容诚会计师审计。

（六）新加坡芯泰

截至本招股意向书签署日，新加坡芯泰基本情况如下：

企业名称	XINTAI SEMICONDUCTOR EQUIPMENT PTE.LTD.
注册地/主要生产经营地	120 Robinson Road #13-01, Singapore 068913
成立日期	2023 年 8 月 4 日
注册资本	2.00 万新加坡元
股权结构	猎奇智能持股 100%
主营业务/业务定位	海外研发和销售中心

新加坡芯泰最近一年一期的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月/2026 年 6 月 30 日	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产	664.89	674.75
净资产	-73.71	-124.73
营业收入	-	-
净利润	27.70	-52.85

注：上述财务数据经容诚会计师审计。

（七）泰国飞泰

截至本招股意向书签署日，泰国飞泰基本情况如下：

企业名称	FEITAI SEMICONDUCTOR EQUIPMENT CO.,LTD.
注册地/主要生产经营地	No.71/5 Unit 3A-02Village No.6, Nong Pla Mo Subdistrict, Nong Khae District, Saraburi Province
成立日期	2023 年 8 月 29 日
注册资本	3,150.00 万泰铢
股权结构	新加坡芯泰持股 99.9950%，猎奇智能持股 0.0050%
主营业务/业务定位	海外生产加工、售后服务基地

泰国飞泰最近一年一期的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月/2026 年 6 月 30 日	2025 年度/2025 年 12 月 31 日
总资产	296.24	436.84
净资产	236.12	374.21
营业收入	14.43	14.11
净利润	-111.99	-139.01

注：上述财务数据经容诚会计师审计。